

Infineon Technologies Geschäftsbericht 2004

Logische Schritte



Never stop thinking.

Infineon auf einen Blick

Infineon-Konzern ::: Infineon Technologies ist der ausgegliederte Halbleiterbereich der Muttergesellschaft Siemens und wurde im April 1999 mit Hauptsitz in München als Aktiengesellschaft gegründet. Seit dem 13. März 2000 ist das Unternehmen an

Geschäftsbereiche

Drahtgebundene Kommunikation (COM)

Historisch gewachsen in der traditionellen **Sprachkommunikation**; jetzt verstärkte Ausrichtung auf die **Datenkommunikation** in Nahverkehrsnetzen und im Heimbereich.



VINETIC für Sprachübertragung ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Drahtgebundene Kommunikation

Anwendungen

- ::: Traditionelle **Sprachkommunikation**
- ::: Kupferbasierte **Breitband-Datenkommunikation**
- ::: Integrierte **Sprach- und Datenkommunikation**
- ::: **Netzwerke** im Heimbereich
- ::: Infrastruktur für **Glasfasernetzwerke**
- ::: Infrastruktur für **innerstädtische Datennetzwerke und Weitverkehrsnetzwerke**

Sichere Mobile Lösungen (SMS)

Drahtlose Kommunikation und **Sicherheitskarten**. Fokus auf Mobiltelefone, Infrastruktur für Mobilfunknetze und schnurlose Telefone. Chips für Plastikkarten, allen voran die SIM-Karte.

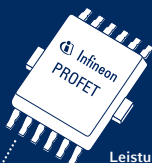


Chipkartenmodul ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Sichere Mobile Lösungen

- ::: **Mobilfunk**
- ::: **Schnurlose Telefone**
- ::: **Funktechnologie** über kurze, mittlere und große Entfernungen
- ::: Vielfältige Anwendungen für **chipbasierte Karten** in den Bereichen Kommunikation (Bankenkarten, SIM-Karten, Telefonkarten), Zahlungsverkehr (Kredit- und Debitkarten), Identifikation (Ausweise, Versicherungskarten), Unterhaltung (Pay-TV), Objektidentifikation (Logistik) und Plattformsicherheit (Rechner, Netzwerke)

Automobil- und Industrieelektronik (AI)

Chips für Fahrzeugsteuerung und Industrie- und Haushaltsgeräte. **Im Auto**: Chips für Antriebssteuerung, Sicherheit, Klimaanlage und Navigation. **In der Industrie**: Chips für Steuerung elektrischer Motoren, Spannungsversorgung, Energieübertragung und Züge. **Im Haushalt**: Chips für Netzgeräte für Fernseher, DVD-Rekorder und Computer, Lampensteuerung und Waschmaschinen.

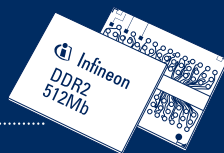


Leistungshalbleiter ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Automobil- und Industrieelektronik

- ::: **Automobilelektronik**:
Antriebsstrang
Karosserie- und Komfortelektronik
Sicherheit
Infotainment
- ::: **Industrie**:
Netzteile
Antriebe

Speicherprodukte (MP)

Speicher für Computer. **Standardspeicher** für die traditionellen Märkte PC, Notebook, Workstation und Server. **Spezialspeicher** für Grafikkarten sowie für tragbare Geräte wie PDAs und Mobiltelefone.



512 Mbit DDR2 SDRAM, Speicherbaustein ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Speicherprodukte

- ::: **Datenverarbeitung**:
PCs, Notebooks
Grafikkarten
Workstations, Server
- ::: **Infrastruktur**:
Lokale Netzwerke, Speichernetzwerke
- ::: **Mobile Anwendungen**:
PDAs, Smartphones
- ::: **Consumer-Elektronik**:
Speicherkarten für MP3-Player,
Digitalkameras, USB-Sticks

1 In alphabetischer Reihenfolge.

den Börsen von Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San José, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio.

Mit weltweit fast 35.600 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2004 einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro im Vergleich zu 6,15 Milliarden Euro in 2003.

Produkte	Marktposition	Schlüsselkunden ¹	Wettbewerber ¹
<ul style="list-style-type: none"> ::: Schnittstellenbausteine für Sprachkommunikation in Vermittlungsstellen und Endgeräten (CODECs, SLICs, ISDN, T/E, etc.) ::: Lösungen für integrierte Sprach- und Datenkommunikation und VoIP (VINETIC, INCA IP, etc.) ::: Systemlösungen für drahtgebundene Breitbandtechnologien (xDSL, CO/CPPE) ::: Systemlösungen für DSL-Modems, Router, Home-Gateways, WLAN Access Points, NICs, etc. ::: ICs und Module (Transceiver) für optische Netzwerke ::: Ethernet over Sonet/SDH multi service Framer 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Nr. 1 bei ISDN ::: Nr. 1 bei T/E Carrier ::: Nr. 1 bei analogen Linecards (CODECs, SLICs) ::: Nr. 5 für drahtgebundene Kommunikation insgesamt 	<ul style="list-style-type: none"> ::: AFC ::: Alcatel ::: Avnet ::: Cisco ::: ECI ::: Ericsson ::: Flextronics ::: Fujitsu ::: Huawei ::: Lucent ::: Marconi ::: NEC ::: Nokia ::: Nortel ::: Siemens ::: Tyco ::: ZTE 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Agere ::: Broadcom ::: Centillum ::: Conexant ::: Ikanos ::: Intel ::: Legerity ::: Marvell ::: Metalink ::: Mindspeed ::: PMC-Sierra ::: STMicroelectronics ::: Texas Instruments ::: Vitesse Semiconductor
<ul style="list-style-type: none"> ::: Basisband- und Applikationsprozessoren für die gängigen drahtlosen Kommunikationsstandards (GSM, GPRS, E-GPRS, EDGE, W-CDMA, DECT, WDCT, Bluetooth) ::: Hochfrequenz-Transceiver für die gängigen drahtlosen Kommunikationsstandards (GSM, GPRS, E-GPRS, EDGE, W-CDMA, DECT, WDCT, Bluetooth) ::: Ein-Chip-Lösungen oder Module, in denen Basisband-Prozessor und Hochfrequenz-Transceiver in einem Bauteil zusammengefasst werden ::: Systemlösungen für Mobilfunktelefone, einschließlich Plattformdesign, Betriebssoftware, Applikationen ::: Serviceleistungen für Systemintegration und kundenspezifische Anpassungen ::: Leistungstransistoren für Verstärker in Mobilfunk-Basisstationen (bis zu 180 Watt) für alle 2G- und 3G-Mobilfunkstandards ::: Sicherheitskontroller (8 Bit, 16 Bit, 32 Bit) ::: Sicherheitspeicher ::: Trusted Platform Module (TPM) ::: Module für kontaktbasierte und kontaktlose Sicherheitskontroller und Sicherheitspeicher ::: RFID-Speicher 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Nr. 1 bei Mobilfunk Hochfrequenz-Transceiver ::: Nr. 1 bei Chipkarten-ICs ::: Einer der zwei führenden Anbieter bei DECT/WDCT ::: Nr. 2 bei Bluetooth ::: Nr. 2 bei Leistungstransistoren für Mobilfunk-Basisstationen ::: Nr. 3 bei Basisband- und Applikationsprozessoren für Mobilfunk ::: Nr. 4 bei Hochfrequenz-Transceivern für Mobilfunk-Basisstationen 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Axalto ::: DBTel ::: Ericsson ::: Gemplus ::: Giesecke & Devrient ::: Konka ::: Nokia ::: Oberthur Card Systems ::: Panasonic ::: Siemens ::: Sony ::: Sony-Ericsson 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Agere ::: Atmel ::: Broadcom ::: Cambridge Silicon Radio ::: Freescale ::: Philips ::: Qualcomm ::: Renesas ::: RF Microdevices ::: Samsung ::: Skyworks ::: STMicroelectronics ::: Texas Instruments
<ul style="list-style-type: none"> ::: Mikrokontroller ::: Leistungshalbleiter-ICs ::: Diskrete Leistungshalbleiter ::: Diskrete Kleinsignalhalbleiter ::: IGBT- und bipolare Module ::: Thyristoren und Dioden ::: Sensoren ::: Hochfrequenz-Halbleiter 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Nr. 2 bei Halbleitern im Automobilbereich (Nr. 1 in Europa) ::: Nr. 2 bei Halbleitern in industriellen Antrieben und Traktion ::: Nr. 1 bei Leistungshalbleitern ::: Führend bei Reifendrucküberwachungssystemen 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Autoliv ::: Avnet ::: Bosch ::: Continental Automotive Systems ::: Delphi ::: Denso ::: Hella ::: Lear ::: Motorola ACES ::: SAC ::: Siemens ::: TRW ::: Visteon 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Fairchild ::: Freescale ::: International Rectifier ::: Mitsubishi ::: National Semiconductor ::: ON Semiconductor ::: Philips ::: Renesas ::: STMicroelectronics ::: Toshiba
<ul style="list-style-type: none"> ::: Standard DRAM-Speicher mit Speicherdichten von 64 Mbit bis 1 Gbit ::: Speichermodule für PCs, Notebooks, Workstations und Server mit Speicherdichten von 64 MByte bis 4 GByte ::: Spezialspeicher für Grafikanwendungen (SGRAM) ::: Spezialspeicher für mobile Geräte (Mobile-RAM, CellularRAM) ::: Spezialspeicher für Netzwerkinfrastruktur (RLDRAM) ::: Nichtflüchtige Speicher (NAND-Flash) ::: Flash-Speicherkarten mit Speicherdichten von 64 MByte bis 256 MByte in den gängigen Formaten SD-Card und MMC 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Nr. 3 bei DRAM-Speichern ::: Technologieführer in der 300mm-Waferproduktion ::: Spitzenstellung bei hochkomplexen DRAM-Produkten wie Spezialspeichern und Speichermodulen 	<ul style="list-style-type: none"> ::: Acer ::: Cisco ::: Dell ::: Fujitsu-Siemens ::: HP ::: IBM ::: Kingston ::: Legend ::: Sony ::: Sun Microsystems 	<ul style="list-style-type: none"> ::: ELPIDA ::: Hynix ::: Micron Technologies ::: Powerchip ::: Samsung

Infineon-Kennzahlen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre¹

	2003		2004	2004	2004:2003
	Mio. €	in % vom Umsatz	Mio. €	in % vom Umsatz	Veränderung in %
Umsatzerlöse	6.152		7.195		17 %
nach Regionen					
Deutschland	1.535	25 %	1.675	23 %	9 %
Übriges Europa	1.112	18 %	1.263	18 %	14 %
Nordamerika	1.393	23 %	1.524	21 %	9 %
Asien-Pazifik	1.821	29 %	2.263	32 %	24 %
Japan	256	4 %	364	5 %	42 %
Andere	35	1 %	106	1 %	203 %
nach Geschäftsbereichen					
Drahtgebundene Kommunikation	459	7 %	434	6 %	-5 %
Sichere Mobile Lösungen	1.403	23 %	1.790	25 %	28 %
Automobil- und Industrieelektronik	1.634	27 %	1.820	25 %	11 %
Speicherprodukte	2.485	40 %	2.926	41 %	18 %
Sonstige Geschäftsbereiche	139	2 %	196	3 %	41 %
Konzernfunktionen	32	1 %	29	0 %	-9 %
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.538	25 %	2.525	35 %	64 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.089	18 %	1.219	17 %	12 %
Betriebsergebnis	-344		314		-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-435		61		-
Ebit Ebit-Marge	-299	-5 %	256	4 %	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert in €	-0,60		0,08		-
Dividende pro Aktie in €	-		-		-
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	731		1.857		154 %
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522		-1.809		-19 %
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	566		-402		-
Free-Cash-Flow ²	-53		206		-
Planmäßige Abschreibungen	1.437		1.320		-8 %
Außerplanmäßige Abschreibungen	98		136		39 %
Auszahlung für Sachanlagen	872		1.163		33 %
Brutto-Cash-Position zum 30. September ³	2.753		2.546		-8 %
Netto-Cash-Position zum 30. September ⁴	261		548		110 %
Sachanlagen zum 30. September	3.817		3.587		-6 %
Bilanzsumme zum 30. September	10.875		10.864		0 %
Summe Eigenkapital zum 30. September	5.666		5.978		6 %
Eigenkapitalquote	52 %		55 %		6 %
Eigenkapitalrendite ⁵	-7 %		1 %		-
Gesamtkapitalrendite ⁶	-4 %		1 %		-
Anlagendeckung ⁷	148 %		167 %		13 %
Verschuldungsgrad ⁸	44 %		33 %		-25 %
Gesamtverschuldungsgrad	23 %		18 %		-22 %
Mitarbeiter zum 30. September	32.308		35.570		10 %

¹ Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

² Free-Cash-Flow = Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.

³ Brutto-Cash-Position = Zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.

⁴ Netto-Cash-Position = Brutto-Cash-Position, verringert um kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

⁵ Eigenkapitalrendite = Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital.

⁶ Gesamtkapitalrendite = Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

⁷ Anlagendeckung = Eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.

⁸ Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

Inhalt

3	Informationen für Aktionäre
4	Brief an die Aktionäre
7	Mitglieder des Vorstands
8	Das Geschäftsjahr 2004 im Überblick
11	Die Infineon-Aktie
15	Unser Geschäftskonzept
16	Drahtgebundene Kommunikation
18	Sichere Mobile Lösungen
20	Automobil- und Industrieelektronik
22	Speicherprodukte
24	Innovationen
27	Kunde im Fokus
30	Globale Präsenz
34	Fertigung
37	Unser soziales Engagement
38	Menschen bei Infineon
42	Unser Beitrag zur Ökologie
45	Finanzbericht
47	Inhalt
48	Bericht des Aufsichtsrats
52	Corporate Governance
54	Konzernlagebericht
86	Konzernabschluss
92	Anhang zum Konzernabschluss
143	Weitere Informationen
144	Mehrjahresübersicht 2000–2004
146	Finanz- und Technologieglossar
150	Stichwortverzeichnis
152	Finanzkalender

Zukunftsorientierte Aussagen:

Der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der Infineon Technologies AG. Diese beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen auf Grund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

2004 war für Infineon ein Jahr der **Veränderung.**

Die strategische Ausrichtung wurde optimiert, der Markterfolg wurde ausgebaut, die Zukunftsinvestitionen wurden verstärkt.

Jede dieser Veränderungen ist Beleg für gewachsene Tatkraft und ein **logischer Schritt** in Richtung auf unser zentrales Ziel:

Profitables Wachstum.

Logische Schritte

Anpacken ...

Profitables Wachstum

Voraussetzung dafür, Ideen zu entwickeln und umsetzen zu können. Nicht als Selbstzweck, sondern als Vorbedingung für nachhaltiges Wirtschaften. Deshalb setzt Infineon Profitabilität vor Wachstum. ... Brief an die Aktionäre, Seite 4

Operative Spitzenleistung

Intelligente Abläufe, perfekt aufeinander abgestimmt. Für gesteigerte Innovationskraft, Effizienz und Qualität. In weltweiten Entwicklungs- und Produktionszentren arbeitet Infineon unter diesen Prämissen an den Technologien von morgen. ... Unser Geschäftskonzept, ab Seite 15

... umsetzen!

Kundenorientierung

Dem Kunden das geben, was er braucht. Wünsche erkennen und erfüllen. Für den Erfolg am Markt entwickelt Infineon gemeinsam mit der Industrie kundenorientierte Lösungen, die überzeugen. ... Kunde im Fokus, Seite 27

Kooperative Unternehmenskultur

Vernetzung braucht Dialog und fordert Kooperation. In der Wirtschaft. Im Privatleben. Im technologischen Sinne. Und im menschlichen. So setzt auch Infineon mit einer kooperativen Unternehmenskultur Potenziale frei. ... Menschen bei Infineon, Seite 38

Brief an die Aktionäre



Dr. Wolfgang Ziebart
Vorsitzender des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals seit dem Geschäftsjahr 2000 schreibt Infineon wieder schwarze Zahlen. Nach drei harten Jahren, die nicht nur Infineon, sondern auch die gesamte Halbleiterindustrie vor große Herausforderungen gestellt haben, schließen wir das Geschäftsjahr 2004 mit einem Konzerngewinn von 61 Millionen Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem wir einen Konzernverlust von 435 Millionen Euro verzeichnet haben, ist dies eine Verbesserung um 496 Millionen Euro.

Das Ergebnis wurde durch unsere Einigung mit der US-Justizbehörde in einem Wettbewerbsverfahren bezüglich Speicherprodukten belastet, bei dem wir im September 2004 ein Bußgeld in Höhe von 160 Millionen US-Dollar akzeptiert haben. Um größeren Schaden vom Unternehmen fernzuhalten, war es meinen Kollegen und mir aber wichtig, ein eventuell langjähriges und aufreibendes, industrieweites Ermittlungsverfahren für uns zu beenden und unbelastet in das neue Geschäftsjahr starten zu können.

Ohne Zweifel war 2004 insgesamt ein gutes Jahr für die Halbleiterindustrie und für Infineon. Unser Umsatz ist um 17 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro gestiegen. Wir haben es schon im ersten Kalenderhalbjahr geschafft, unter die Top 5 der weltweiten Halbleiterunternehmen zu kommen. Besonders hervorzuheben ist unser verbessertes Ranking in den USA, wo wir im selben Zeitraum von Platz sieben auf Rang drei vorgerückt sind. Darüber hinaus nehmen wir in unseren wichtigsten Produktgruppen weiterhin eine Spitzenposition ein. Bei Halbleitern für Chipkarten sind wir Weltmarktführer, bei Chips für die Automobilindustrie sowie bei Chips für die drahtgebundene Kommunikation liegen wir auf Platz zwei, bei Speicherchips sind wir derzeit die Nummer vier unter den Herstellern weltweit.

Deutlich verbessert hat sich auch die Finanzkraft von Infineon. Der Free-Cash-Flow ist von minus 53 Millionen Euro auf einen positiven Wert von 206 Millionen Euro gestiegen. Unsere Finanzverbindlichkeiten haben wir verringert; sie belaufen sich nun auf zwei Milliarden Euro, im Vergleich zu 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der Aktienkurs blieb jedoch hinter diesen positiven Entwicklungen zurück. Die Infineon-Aktie hat über das Geschäftsjahr 2004 27 Prozent an Wert verloren. Wir alle wissen, dass gerade Halbleiterwerte im Kurs erheblich schwanken und von internationalen Anlegern besonders genau beobachtet werden. Gerade deswegen ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, Analysten

2/3

und Investoren zu beweisen, dass Infineon mehr leisten kann, als die derzeitige Marktkapitalisierung widerspiegelt.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Produktion müssen dicht am Markt und an unseren Kunden sein, wenn wir unseren Marktanteil in den Schlüsselländern und -regionen erhöhen wollen. Dies ist für unser zukünftiges Geschäft von grundlegender Bedeutung. Deshalb haben wir unsere Präsenz vor allem in Nordamerika und Asien verstärkt.

China ist der am schnellsten wachsende Markt für Halbleiterprodukte. Deshalb hat Infineon in Xi'an im Januar 2004 ein weiteres Entwicklungszentrum eröffnet, das neue Produkte für die Kommunikationsbranche, die Automobil- und Industrieelektronik sowie Speicheranwendungen entwickelt. Im September 2004 haben wir ein neues Montage- und Testwerk in Suzhou in Betrieb genommen, das bereits Anfang 2005 mit der Volumenproduktion startet.

Inotera Memories, ein Gemeinschaftsunternehmen von Infineon und unserem taiwanischen Partner Nanya, hat im Oktober 2004 in einer neuen Halbleiterfabrik in Taiwan die Volumenproduktion von Speicherchips auf 300-Millimeter-Wafern aufgenommen.

In den USA werden wir in unserem Halbleiterwerk in Richmond neben der laufenden 200-Millimeter-Produktion Speicherchips mit der 300-Millimeter-Technologie fertigen. Die Produktion wird in der zweiten Hälfte 2005 starten und die dortigen Kapazitäten steigern.

In Europa haben wir zwei Projekte auf den Weg gebracht. An unserem Referenzstandort Dresden werden wir das Entwicklungszentrum für Speicherkonzepte und Fertigungsprozesse der 300-Millimeter-Technologie weiter ausbauen. Die Erweiterung wird im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Für die Montage und den Test von Speicherchips wurde unser Werk in Portugal um ein zweites Modul ergänzt, das bereits in Betrieb gegangen ist.

Was Infineon im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht hat, ist das Verdienst meiner Vorstandskollegen und der weltweit fast 35.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Infineon. Ich habe in den letzten Monaten viele meiner neuen Kollegen in den Regionen kennen gelernt und schätze den Einsatz, den sie tagtäglich für unser Unternehmen zeigen. Dafür möchte ich ihnen danken.

Meine wichtigste Aufgabe wird es sein, das Vertrauen in Infineon zu stärken. Ich bitte Sie als unsere Aktionäre, uns darin mit allen Kräften zu unterstützen. Wenn wir weiter erfolgreich sein wollen, sind wir auf das Vertrauen unserer Kunden und Lieferanten, unserer Aktionäre, der Analysten und der breiten Öffentlichkeit angewiesen. Genauso wichtig erscheint es mir, dass wir selbst an unsere Fähigkeiten und Stärken glauben.

Ich kenne Infineon bereits von meinen früheren Tätigkeiten bei BMW und Continental. Beide Unternehmen sind langjährige Kunden von Infineon. Schon damals war ich beeindruckt, über welches Know-how und welche Innovationskraft Infineon verfügt. Meine Reisen an die Infineon-Standorte, die ich in den ersten Wochen seit Übernahme meines Amtes unternommen habe, haben diesen Eindruck ohne Einschränkungen bestätigt. Infineon – das bedeutet Kompetenz, motivierte Mitarbeiter und ein großes Potenzial für Innovationen.

Das Bild, das ich mir für Infineon in der Öffentlichkeit wünsche: stärker als bisher als Unternehmen wahrgenommen zu werden, das mit einer erstklassigen Mannschaft aus Entwicklern,

3/3

Ingenieuren, Produktionsfachleuten und Vertriebsspezialisten hervorragende Produkte entwickelt und herstellt sowie den Kunden beratend zur Seite steht.

Von der bisher verfolgten Strategie wird Infineon nicht grundsätzlich abweichen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie in ihren wichtigsten Punkten richtig ist. Meine Kollegen und ich werden im Hinblick auf die künftige Marktentwicklung allerdings andere Schwerpunkte setzen.

Marktforschungsunternehmen gehen davon aus, dass sich das Wachstum in der Halbleiterindustrie 2005 abschwächen wird. Wir rechnen wie die meisten Experten damit, dass die Nachfrage im Vergleich zu 2004 nur leicht zunehmen und sich der Preisdruck verschärfen wird. Natürlich wollen wir weiter wachsen, aber nicht um jeden Preis. Im Vordergrund wird vielmehr nachhaltige Sicherung der Profitabilität stehen.

Dazu gehört auch, das Kostenbewusstsein im Unternehmen zu schärfen. Was heißt das? Wir müssen im schwächer werdenden Markt konservativ planen. Wir müssen uns noch genauer überlegen, wie viel und wofür wir Geld ausgeben. Und jeder Mitarbeiter muss darüber nachdenken, wie er für Infineon Wert schaffen kann. Wenn wir in guten Tagen vorausschauend handeln, haben wir in schlechten Zeiten mehr Spielraum.


Verbesserungspotenzial sehe ich auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wie können wir ihnen noch bessere Lösungen bieten und diese noch schneller realisieren? Hören, was der Kunde braucht, Probleme auf kreative und zuverlässige Weise lösen – das stärkt das Vertrauen in unser Unternehmen. Ich werde sehr genau prüfen, wie wir unsere Organisation, Strukturen und Prozesse effizienter und flexibler gestalten können, damit wir dem Anspruch unserer Kunden besser gerecht werden.

Ganz weit oben auf meiner Agenda steht das Thema Effizienz unserer Prozesse. Wir müssen unsere Abläufe ständig weiter verbessern, uns schnell an veränderte Bedingungen anpassen und die Qualität unserer Produkte gleich bleibend sicherstellen.

Im Kern halten wir an unserer Strategie fest. Im Detail wird sich bei Infineon aber einiges ändern. Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen.

Ich freue mich auf meine Aufgabe.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr


Dr. Wolfgang Ziebart
Vorsitzender des Vorstands

Die Mitglieder des Vorstands der Infineon Technologies AG



Von links:

Peter Bauer: Chief Sales & Marketing Officer (CMO)
Studium der Elektrotechnik, Diplomingenieur; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Peter J. Fischl: Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor
Industriekaufmann; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Dr. Wolfgang Ziebart: Vorsitzender des Vorstands
Studium des Maschinenbaus, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit September 2004

Dr. Andreas von Zitzewitz: Chief Operating Officer (COO)
Studium der Elektrotechnik, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Das Geschäftsjahr 2004 im Überblick

2003

Oktober

- ::: Höhere Sicherheit für Business-Notebooks von Hewlett-Packard:** Infineon liefert Sicherheitschips, die die Zugangskontrolle zu vernetzten Computern verbessern und die abgelegten Daten besser schützen – sowohl im Büro als auch unterwegs.
- ::: Bis zu 25 Prozent Stromersparnis bei Leuchtstoffröhren:** Der neue LightMOS-Chip wird in das so genannte Vorschaltgerät im Lampengehäuse eingebaut und sorgt zusätzlich für mehr Komfort – Leuchtstoffröhren zünden künftig ohne Flackern und lassen sich sogar dimmen.



LightMOS-Chip

2003

November

- ::: Hochgeschwindigkeitsdaten über bereits installierte Infrastruktur:** Das XPAK-Transceiver-Modul überträgt Daten mit einer Transferrate von zehn Gigabit pro Sekunde bis zu 300 Meter weit fehlerfrei. Heute basieren mehr als 80 Prozent aller Infrastrukturen in Unternehmen auf solchen Multimode-Glasfasernetzen.
- ::: Internet, Video und Multimedia-Anwendungen per Satellit:** Constellation, das Infineon gemeinsam mit ViaSat aus den USA und ZyXEL aus Taiwan entwickelt hat, erlaubt via VDSL eine bis zu 200-mal schnellere Übertragungsrate als herkömmliche Anbindungen mit 56K-Modems.

Constellation

Via VDSL bis zu

200-mal schneller

als herkömmliche 56K-Modems

2003

Dezember

- ::: Breitbandanwendungen mit konventioneller Telefoninfrastruktur:** Der Netzwerkchip MetroMapper 622 versetzt Hersteller von Daten- und traditionellen Telekommunikationsgeräten in die Lage, flexible Systeme für Ethernet in vorhandenen Glasfasernetzen zu entwickeln.
- ::: Überlegene RFID-Chips in der Logistik:** Mit der australischen Magellan Technology hat Infineon RFID-Chips entwickelt, die 25-mal schneller als bisherige Bausteine erkannt, gelesen und beschrieben werden. Die Funketiketten setzen sich immer mehr durch.



RFID-Tag mit Chip und Antenne

2004

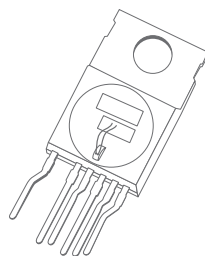
April

- ::: Flacher Speicher mit mehr Kapazität:** Für das 2-Gigabyte-DDR2-Speichermodul werden 36 einzelne 512-Megabit-Chips nicht wie bisher gestapelt, sondern planar angeordnet. Es ist nur 4,1 Millimeter dick.
- ::: Finisar übernimmt Geschäft mit Glasfaserkomponenten:** Die Finisar Corporation und Infineon haben vereinbart, dass Finisar das Geschäft mit Glasfaserkomponenten von Infineon übernehmen wird. Nach Genehmigung entsteht mit Infineons Entwicklung, Produktion und verschiedenen Marketingaktivitäten für Glasfaserkomponenten eines der größten ausschließlich auf optische Komponenten spezialisierte Unternehmen der Welt.

2004

Mai

- ::: Chipsatz reduziert Stromverbrauch:** Bei Netzteilen erhöht der CoolSET F3 den Wirkungsgrad und senkt die Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb auf 75 Milliwatt – halb so viel wie die besten bisherigen Netzteile und weit unter den gesetzlichen Vorgaben.
... Unser Beitrag zur Ökologie, S. 42



CoolSET F3

2004

Juni

- ::: Mehr Sensoren für automobiler Sicherheit:** Infineon stellt drei neue Sensoren für Sicherheitsanwendungen wie Seiten-Airbags, Reifendrucküberwachung und Antilockiersysteme vor.
- ::: Durchbruch bei nichtflüchtigen MRAMs:** Infineon und IBM haben den weltweiten magneto-resistiven Speicherchip mit einer Speicherkapazität von 16 Megabit und damit der höchsten Speicherdichte entwickelt.
- ::: Leistungsfähigere Sprach- und Datenkommunikation:** Die GOLDMOS-Hochfrequenz-Leistungstransistoren, nutzbar für Mobilfunk-Basisstationen, digitales Radio und Fernsehen, vereinen hohe Bandbreite und bessere Betriebseffizienz.

... Sichere Mobile Lösungen, S.18

2004

Januar

- ::: Forschen und Entwickeln in China:** Im chinesischen Xi'an eröffnet Infineon ein neues Designzentrum, das Chips für Kommunikationsanwendungen, die Automobil- und Industrieelektronik sowie Speicheranwendungen entwickelt. Das Entwicklungszentrum wird zu einem der größten in Asien zählen. ... Innovationen, S. 24
- ::: Infineon vereinbart Übernahme von ADMtek Inc.:** Die Akquisition des taiwanischen Halbleiterunternehmens, das auf Netzwerk- und Kommunikationssysteme spezialisiert ist, stärkt den Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation. Der Bereich wird sich auf die Entwicklung von Chips für Breitband-Teilnehmeranschlüsseinrichtungen (Customer Premise Equipment, CPE) konzentrieren und Infineon damit den Einstieg in den Markt für Home-Gateway-Systeme ermöglichen. ... Drahtgebundene Kommunikation, S. 16

2004

Februar

- ::: Leistung nun auch für Linux:** Der 32-Bit-Mikrokontroller TC1130 für Industrie- und Kommunikationsanwendungen ist erstmals für alle gängigen Betriebssysteme geeignet und übertrifft die bisherige Leistungsfähigkeit um das Dreifache.
- ::: Neue Plattformen vorgestellt:** Die Multimedia-Mobiltelefon-Plattform ist für UMTS, EDGE und GPRS geeignet; die Plattform P2002+ ermöglicht beispielsweise Kamerafunktionalität und Farbdisplays.
- ::: Erweiterung des Dresdner Entwicklungszentrums:** 120 neue Arbeitsplätze schafft Infineon mit der Erweiterung seines Designzentrums für Speicherprodukte in Dresden und baut damit die Bedeutung des Standorts für die Entwicklung von Prozesstechnik, insbesondere für DRAM-Produkte, weiter aus.

2004

März

- ::: Samsung tritt Entwicklungskooperation bei:** Damit entwickeln mit Infineon, Chartered Semiconductors und IBM nunmehr vier Halbleiterunternehmen Logikprozesse der kommenden Generationen – zuerst der 65-, später der 45-Nanometer-Technologie. ... Innovationen, S. 24
- ::: Kommunikationsprozessor verknüpft Zugangsnetzwerke:** Der ConverGate-C verbindet vormals inkompatible Netzwerkprotokolle und ermöglicht anspruchsvolle Kommunikationsdienste wie Voice-over-IP oder Video-on-Demand. ... Drahtgebundene Kommunikation, S. 16



ConverGate-C-Prozessor

2004

Juli

- ::: Fingerabdruck im Reisepass:** Ein neuer Chipkartenkontroller bietet genügend Platz für biometrische Daten, indem er die doppelte Datenmenge speichert und über 50 Sicherheitsmerkmale verfügt.
- ::: Alles auf einem Chip:** Der SMARTi SD, der weltweit erste Single-Chip-Hochfrequenz-Transceiver, vereint alle Funktionen für den GSM/GPRS-Mobilfunkstandard – das Bauteil braucht so nur noch halb so viel Platz.



SMARTi SD

2004

August

- ::: Kooperation mit Winbond gestärkt:** Der taiwanische Auftragsfertiger erhält Infineons 90-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie, entwickelt auf 300-Millimeter-Wafern. Dafür erhält Infineon eine Abnahmeoption für die Speicherchips, die mit dieser Technologie entstehen.
- ::: Speichermodule für die nächste Server-Generation:** Infineon testet erfolgreich einen neu entwickelten Advanced-Memory-Buffer-Chip, der in der Geschwindigkeit der Speichermodule den künftigen Anforderungen des Workstation- und Server-Markts gewachsen ist. ... Speicherprodukte, S. 22

2004

September

- ::: Ausgezeichneter Zulieferer:** Sun Microsystems würdigt Infineon mit dem Meritorious Award für Supply-Chain-Excellence für seine hervorragenden Leistungen als Lieferant während des Geschäftsjahrs 2004.
- ::: Drahtlose Kommunikation fürs Auto:** Infineon hat mit Volkswagen eine Plattform entwickelt, die drahtlose Telekommunikation und die Nutzung ortsbezogener Informationsdienste schon bald zum Standard jeder Fahrzeugklasse machen soll.
- ::: Meilenstein in China:** Infineon eröffnet in Suzhou eine neue Back-End-Produktionsstätte, die Anfang 2005 mit der Volumenproduktion startet, und ein neues IT Development Center.

Wussten Sie, dass ...

- ... von den insgesamt fast 35.600 Mitarbeitern bei Infineon jeder fünfte im Bereich Forschung und Entwicklung tätig ist?
- ... der weltweite Jahresumsatz der Halbleiterbranche zwischen 1958 und 2003 um mehr als das 40.000fache auf 166 Milliarden US-Dollar angewachsen ist?
- ... sich vor 20 Jahren noch etwa 30.000 Schaltelemente auf einem regulären Chip befanden, wo heute mehr als 125 Millionen solcher Miniatur-Bauteile untergebracht sind?
- ... sich inzwischen in allen Computern weltweit 110 Millionen Transistoren pro Erdenbürger befinden?
- ... in den Halbleiterchips aktueller Pkw mehr Rechenleistung als in den Raumschiffen aller Apollo-Missionen steckt?

Die Infineon-Aktie

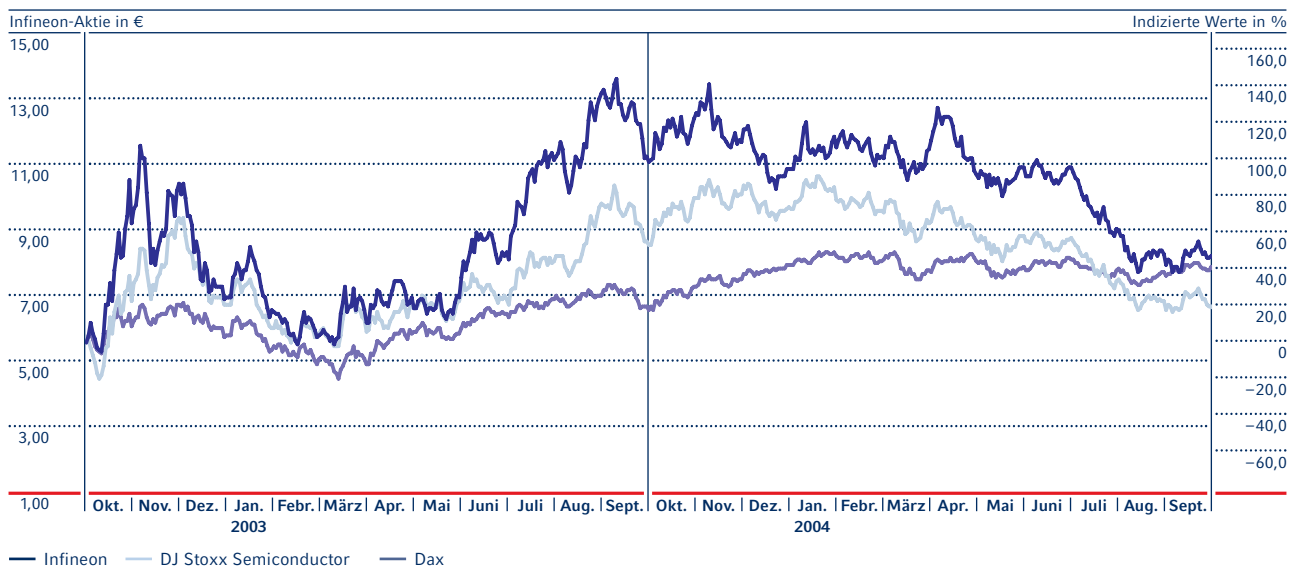
Infineon-Aktie kann Aufwärtstrend des Vorjahrs nicht fortsetzen

Infineon-Aktie fällt im Berichtsjahr um 27 Prozent, DJ-Stoxx-Halbleiterindex um 22 Prozent
 Handelsvolumen in Deutschland und den USA erhöht sich erneut
 Rückkauf eines Anteils eigener Wandelschuldverschreibungen verringert künftige Zinsaufwendungen

Die Aktien der Chiphersteller entwickelten sich im vergangenen Jahr schlechter als der Aktienmarkt insgesamt. Obwohl der Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2004 deutlich gewachsen ist, hat sich dies nicht in der Kursentwicklung niedergeschlagen. Die Investoren gehen vielmehr davon aus, dass sich das Wachstum des Halbleitermarkts im Jahr 2005 stärker abschwächen wird als zunächst erwartet. Diese Annahme spiegelt sich bereits in den Kursen der Halbleiteraktien wider. Gestützt wird das durch Marktanalysen: Das Marktforschungsinstitut World Semiconductor Trade Statistics etwa hatte seine Wachstumsprognose für den Halbleitermarkt für 2004 zwar von 19,4 auf 28,5 Prozent erhöht, für das Jahr 2005 wurde der voraussichtliche Anstieg hingegen von 12,6 Prozent auf 1,2 Prozent nach unten korrigiert (Stand: November 2004). Mit einem Rückgang von 22 Prozent lag der Halbleiter-Aktienindex DJ Stoxx Semiconductor damit im Jahresverlauf deutlich unter den Indizes DJ-Stoxx-50 und Dax, die um zwölf beziehungsweise 20 Prozent zulegen.

Dieser Entwicklung konnte sich auch die Infineon-Aktie nicht entziehen: Nachdem sich ihr Kurs im Vorjahr verdoppelt hatte, verlor sie im Berichtsjahr 27 Prozent ihres Wertes. Dabei gab es im Jahresverlauf erhebliche Schwankungen: Zu Beginn des Geschäftsjahrs konnte sich die Aktie sogar besser entwickeln als der Markt und erreichte am 7. November 2003 ein Jahreshoch von 13,65 Euro. Danach sanken die Preise für Speicherchips, und der Kurs ging bis Ende Dezember 2003 deutlich zurück. Bis Anfang April 2004 zogen die Preise für Speicherchips wieder an, die Aktie konnte sich daraufhin wieder erholen. Im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahrs geriet die Infineon-Aktie in einen Abwärtssog, der alle Halbleiteraktien erfasste. Das Jahrestief lag am 12. August bei 7,80 Euro. Zum Ende des Berichtsjahrs konnte sich die Aktie mit einem Kurs von 8,22 Euro wieder etwas erholen.

Relative Entwicklung von Infineon Technologies, DJ-Stoxx-Halbleiterindex und Dax seit Beginn des Geschäftsjahrs 2003 (Schlusskurse)



Weiter zugenommen hat das Handelsvolumen der Infineon-Aktie und der American Depositary Shares (ADS): Im Durchschnitt 11,7 Millionen Infineon-Aktien wurden im Geschäftsjahr täglich auf Xetra, auf dem Frankfurter Parkett und an den Regionalbörsen gehandelt; das entspricht 17 Prozent mehr als im Vorjahr. An der New Yorker Börse NYSE wurden im Tagesdurchschnitt etwa 0,9 Millionen ADS-Anteile gehandelt; der Anstieg liegt bei ebenfalls 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die langfristige Kursentwicklung der Infineon-Aktie entspricht weiterhin nicht den Erwartungen. Gegenüber dem Ausgabepreis zum Börsengang am 13. März 2000 ist die Infineon-Aktie um 77 Prozent im Wert gesunken. Im Vergleich mit Technologieindizes hat die Infineon-Aktie im gleichen Zeitraum im Durchschnitt jedoch weniger an Wert verloren.

Kursdaten der Infineon-Aktie

Geschäftsjahr zum 30.9.	2003	2004
Europa Xetra-Schlusskurse in Euro		
Höchstkurs	13,79	13,65
Tiefstkurs	5,34	7,80
Jahresendkurs Ende September	11,22	8,22
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	10.041.871	11.743.938
davon auf Xetra in %	94	96
USA NYSE-Schlusskurse in US-Dollar		
Höchstkurs	15,35	15,87
Tiefstkurs	5,25	9,39
Jahresendkurs Ende September	12,89	10,22
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	766.588	896.317

Langfristige Entwicklung Infineon-Aktie und Indizes in %

Zeitraum zum 30.9.2004	Seit IPO am 13.3.2000	Seit Oktober 2002	Seit Oktober 2003
Europa			
Infineon (Xetra)	-77 ¹	+47	-27
DJ Stoxx Semiconductor	-85	+19	-22
DJ Stoxx Technology	-80	+54	+6
DJ-Stoxx-50	-47	+15	+12
Dax	-49	+41	+20
USA			
Infineon (NYSE)	-70 ¹	+79	-21
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	-71	+61	-8

¹ Basiert auf dem Ausgabepreis von 35 Euro bzw. 33,92 US-Dollar.

Börsenkapitalisierung bei 6,1 Milliarden Euro

Die Börsenkapitalisierung lag zum Ende des Geschäftsjahrs bei 6,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Stichtag im Vorjahr hat sie sich damit um 24 Prozent verringert. Ursache ist hauptsächlich der Rückgang des Aktienkurses. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dagegen um vier Prozent erhöht, da Infineon im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausstehende Minderheitsanteile an dem eigenen 300-Millimeter-Fertigungsunternehmen in Dresden übernommen hat.

Grundkapital, Anzahl Aktien und Marktkapitalisierung Infineon Technologies AG

Stichtag	30.9.2003	30.9.2004	Entwicklung
Grundkapital in Mio. €	1.442	1.495	+4 %
Ausstehende Aktien in Mio. ¹	721	748	+4 %
im Jahresdurchschnitt in Mio. ¹	721	735	+2 %
Marktkapitalisierung in Mio. €	8.090	6.149	-24 %
Marktkapitalisierung in Mio. US-\$	9.294	7.645	-18 %

¹ Unverwässert.

Infineon zahlt keine Dividende

Obwohl Infineon im Geschäftsjahr 2004 einen Konzernüberschuss von 61 Millionen Euro (Vorjahr: minus 435 Millionen Euro) erwirtschaftet hat, können Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen. Die Muttergesellschaft des Konzerns, die Infineon Technologies AG, weist nämlich auf Grund von kumulierten Verlustvorträgen aus den Vorjahren für das abgelaufene Geschäftsjahr keinen Bilanzgewinn aus.

Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen

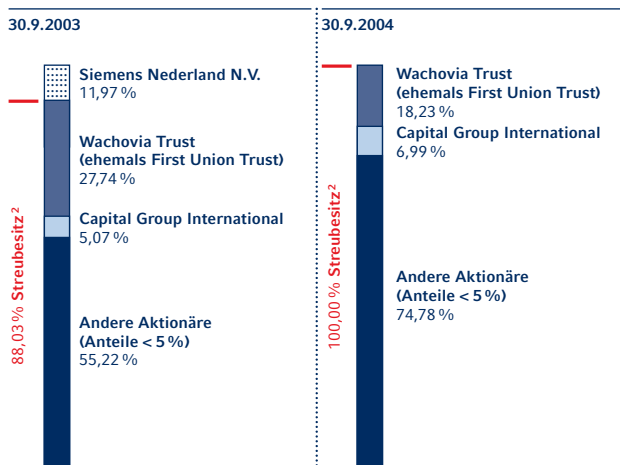
Infineon hat in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 nachrangige Wandelschuldverschreibungen zurückgekauft, um zukünftige Zinsaufwendungen zu verringern. Sie hatten einen Nennwert von 360 Millionen Euro und wären im Jahr 2007 fällig gewesen. Das gesamte Emissionsvolumen der betroffenen Anleihe betrug eine Milliarde Euro und wurde durch den Rückkauf auf nominal 640 Millionen Euro reduziert.

Streubesitz von hundert Prozent

Nach der Definition des britischen Indexanbieters FTSE hat sich der Anteil der Infineon-Aktien, die sich in Streubesitz befinden, im Berichtsjahr von 88 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Im Berichtsjahr gab es folgende mitteilungspflichtige Veränderungen in der Aktionärsstruktur, die Infineon bekannt sind:

- ::: Siemens Nederland N.V. hat am 14. Januar 2004 durch den Verkauf aller Aktien die Schwellen von zehn und fünf Prozent der Stimmrechte unterschritten.
- ::: Die Wachovia Trust Company National Association hat am 14. Januar 2004 63,7 Millionen Aktien verkauft und damit die Schwelle von 25 Prozent der Stimmrechte unterschritten. In ihrem Besitz befinden sich damit noch 136,3 Millionen Aktien, zuvor waren es 200,0 Millionen.
- ::: Die Fonds der Capital Group International haben ihren Anteil bis zum 26. Februar 2004 um 15,7 Millionen Aktien auf insgesamt 6,99 Prozent aufgestockt.

Aktionärsstruktur¹



1 Gemäß der Infineon bekannten Pflichtmeldungen.
 2 Streubesitz gemäß Definition von FTSE. Deutsche Börse und Stoxx berechnen den Infineon-Streubesitz ohne die Anteile des Wachovia Trust.

Kontinuierlicher Dialog mit Investoren und Analysten

Das Interesse der Analysten und Investoren an Infineon ist unverändert hoch. Auch im Jahr 2004 haben das Infineon-Management und das Investor-Relations-Team zahlreiche

Einzelgespräche mit Investoren geführt und den Konzern auf einer Vielzahl von Konferenzen präsentiert. Diese Aktivitäten werden auch im kommenden Jahr in gewohntem Umfang fortgeführt.

Interessierte Anleger können sich im Internet unter www.infineon.com ausführlich über das Unternehmen informieren. Dort finden Sie auf den „Investor Information“-Seiten aktuelle Nachrichten, Finanzberichte, ausführliche Informationen über die Infineon-Aktie, zu Wandelanleihen und zur Corporate Governance sowie Unternehmenspräsentationen und den Investor-Relations-Kalender.

Basisinformationen zur Aktie

Art der Aktien	Namensaktien (Stammaktien) in Form von Aktien oder American Depositary Shares (ADS) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 2,00 € (Verhältnis ADS: Aktien = 1:1)
Grundkapital	€1.495 Mio. (am 30. 9. 2004)
Ausstehende Aktien	748 Mio. (am 30. 9. 2004)
Börsennotierungen	Aktien: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ADS: New York Stock Exchange (NYSE)
Optionshandel	Optionen auf die Aktien: Eurex Optionen auf die ADS: CBOE
Börsengang	13. März 2000 an der FWB und NYSE
Emissionspreis	€35,00 pro Aktie US-\$33,92 pro ADS
Börsenkürzel	IFX
ISIN-Code	DE0006231004
CUSIP	45662N103
Bloomberg	IFX.GY (Xetra-Handelssystem) IFX.US
Reuters	IFXGn.DE
Indexmitglied (Auswahl)	Dax 30 Dow Jones German Titans 30 Dow Jones Stoxx Semiconductor FTSE Euro 100 MSCI Germany SOX S&P Europe 350

Das Investor-Relations-Team von Infineon ist in **München** unter **Tel. +49 (0)89 234-26 655** bzw. **Fax +49 (0)89 234-26 155** und in **San José/Kalifornien, USA** unter **Tel. +1 408 501 6800** bzw. **Fax +1 408 392 8023** sowie per **E-Mail** an investor.relations@infineon.com zu erreichen.

Wussten Sie, dass ...

... in vier von fünf ISDN-Telefonen Chips von Infineon eingebaut sind?

... bei 30 Prozent aller Telefonleitungen in China über Infineon-CODECs gesprochen wird, die Sprachsignale von analog in digital und umgekehrt umwandeln?

Drahtgebundene Kommunikation

Schnelles Internet und VoIP treiben Breitband-Datentransfer

Triple-Play-Dienste sind die treibende Kraft für den Markt der Teilnehmeranschlüsseinrichtungen
 Entwicklung hin zur Konvergenz von Sprache und Daten in einem einzigen IP-Netzwerk
 Fokussierung des Geschäftsbereichs als Anbieter für Zugangslösungen

Heute werden Telefonleitungen nicht mehr nur für die reine Sprachübertragung verwendet. Zahlreiche Dienste, wie die Übertragung von großen Datenmengen, Multimedia-Anwendungen und IP-Telefonie, laufen nun über dieselbe Telefonleitung. Derzeit ist der Breitband-Dienstleistungssektor einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Sprach- und Datenkommunikation, für die auch der Infineon-Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation Produkte entwickelt. Zusätzlich zu den Produkten für die traditionelle Telefonie bietet Infineon eine breite Palette an Systemlösungen für die effiziente Übertragung von schnellen Triple-Play-Diensten, die Sprache, Daten und Video umfassen. Zu den Produkten des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation zählen Core-to-Door-Halbleiterlösungen, von Metro-Ring-Netzwerken über Vermittlungssysteme (Central Offices) bis zum Teilnehmeranschluss.

Charakter des Geschäfts

Infineon zählt zu den führenden Anbietern von Halbleitern für den Telekommunikationssektor. Daher hängt unser Umsatz in großem Maße von den Investitionsentscheidungen der Telekommunikationsunternehmen in ihre Infrastruktur ab. Während herkömmliche Sprachübertragungstechnologien wie analoge Telefonie und ISDN kein Wachstumspotenzial mehr bieten, werden Breitband-Zugangstechnologien, insbesondere ADSL, immer populärer. Zudem werden Netzwerk-Applikationen zunehmend auch in privaten Haushalten eingesetzt. Infineon bedient diesen Markt mit drahtgebundenen und drahtlosen Home-Gateway-Lösungen. Diese Systeme übernehmen die Funktion von integrierten Zugangspunkten für Sprach-, Video- und Datendienste im Haus sowie die Funktion von Routern zur Einrichtung und Steuerung von Heimnetzwerken. In Verbindung mit einem schnellen Internet-Zugang bilden Heimanwendungen einen schnell wachsenden und wettbewerbsintensiven Markt.

Strategische Ausrichtung

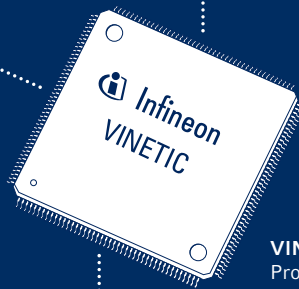
Infineon ist der weltweit führende Anbieter von Halbleitern für herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur und bietet eine umfassende Auswahl an traditionellen Produkten, für analoge Telefonanschlüsse, ISDN-Anschlüsse und T/E Carrier. Auf Basis seiner führenden Position auf diesem Sektor reagiert Infineon auf die wachsende Nachfrage nach Voice-over-IP(VoIP)-Lösungen, indem es IP-Telefone und analoge Telefonadapter (ATA) zur Nutzung von VoIP-Technologie auf jeder analogen Telefonleitung anbietet. Um sein Portfolio zu vervollständigen, plant Infineon die Herstellung von durchgehenden xDSL-Zugangstechnologien für Anwendungen wie Broadband-in-the-Home (BBITH) und digitales Home-Networking.

Durch die Übernahme des taiwanischen Unternehmens ADMtek, eines Lieferanten von Halbleitern für Teilnehmeranschlüsseinrichtungen (Customer Premises Equipment, CPE), kann Infineon heute komplette Breitband-Kommunikationslösungen für beide Seiten der Kommunikationsleitung anbieten, vom Vermittlungssystem bis hin zum einzelnen Nutzer. Durch die Aufnahme von CPE-Lösungen in unser Produktportfolio haben wir Zugang zu dem vielversprechenden Markt des digitalen Home-Networking, in dem Triple-Play-Dienste in privaten Haushalten und in Unternehmen über Breitband laufen. Digitales Home-Networking ermöglicht die Verbindung von Fernseher, Telefon, Computer, HiFi-Anlage und anderen Geräten über Wireless LAN oder ein drahtgebundenes Home-Gateway. Unsere Präsenz in Taiwan – gleich neben den weltweit führenden CPE-Herstellern – ist der optimale Ausgangspunkt für die Entwicklung dieses Marktes.

Drahtgebundene Kommunikation

Prof. Dr. Hermann Eul

Leiter Geschäftsbereich
Drahtgebundene
Kommunikation,
Studium der Elektrotechnik,
Promotion zum Dr.-Ing.



VINETIC für Sprachübertragung ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Drahtgebundene Kommunikation

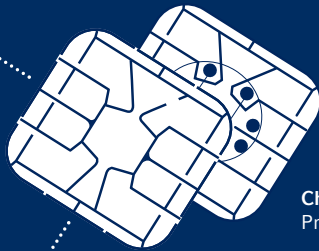
Produktinnovationen

- ::: Komplettlösungen für Home-Gateways in Breitbandanwendungen (Broadband-in-the-Home, BBITH) integrieren ADSL 2+, VoIP, Ethernet-Switching und WLAN-Produkte.
- ::: Mit Ethernet-over-SONET(EoS)-Lösungen können Telekommunikationsbetreiber Daten mittels bestehender Sprachnetzwerke (SONET/SDH) auf kosteneffiziente Weise übertragen.
- ::: Voice-over-IP(VoIP)-Lösungen ermöglichen kostengünstige Sprachdienste über herkömmliche Telefone sowie über speziell entwickelte IP-Telefone.

Sichere Mobile Lösungen

Dr. Erk Thorsten Heyen

Leiter Geschäftsbereich
Sichere Mobile Lösungen,
Studium der Physik,
Promotion zum Dr. rer. nat.



Chipkartenmodul ::: Ein Beispiel aus dem
Produktportfolio Sichere Mobile Lösungen

Produktinnovationen

- ::: **Multimediaplattform ermöglicht Einzug der UMTS-Mobilfunkgeneration:** Die Plattform kann sowohl im UMTS- als auch im herkömmlichen GSM-Netz genutzt werden – das System schaltet je nach Verfügbarkeit automatisch um.
- ::: **Familie der Basisband-Chips erweitert:** Der S-GOLD-Multimedia-Basisband-Chip unterstützt den EDGE-Standard, mit dem die Datenraten in GSM-Mobilfunknetzen erhöht werden. Daneben steht der E-GOLDlite für den GSM-/GPRS-Standard zur Verfügung.
- ::: **Hochfrequenz-Transceiver in CMOS:** Statt in der bisher verwendeten BiCMOS-Technologie entsteht der SMARTi SD als Ein-Chip-Lösung in der kostengünstigeren CMOS-Fertigungstechnologie. Für den Nutzer bringt das zudem den Vorteil längerer Stand-by- und Gesprächszeiten.
- ::: **GOLDMOS-Hochfrequenz-Leistungstransistoren für Mobilfunk-Basisstationen:** Diese zeichnen sich durch eine große Linearität und durch ein hervorragendes thermisches Verhalten aus. Die GOLDMOS-Transistoren werden in Verstärkern für Basisstationen aller Standards eingesetzt.
- ::: **Kunden können schneller mit 32-Bit-Kontrollern aus der 88-Familie beliefert werden:** Infineon kann nun bereits innerhalb von zwei Wochen seine Kunden mit der gewünschten Applikation beliefern – dreimal schneller als zuvor. Ermöglicht wird dies durch eine Speichertechnologie, die vor Ort vom Kunden programmiert werden kann.

Sichere Mobile Lösungen

Drahtlose Lösungen auf dem Vormarsch

Komplettlösungen ergänzen Produktportfolio bei Mobilfunkplattformen : : : :
 UMTS treibt Infrastrukturinvestitionen bei Basisstationen voran : : : :
 Neue Produktplattformen bieten höchste Sicherheit bei Chipkarten : : : :

Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen umfasst ein großes Portfolio drahtloser Applikationen und bedient den gesamten Markt der Sicherheitschipkarten. Dazu gehören zahlreiche Halbleiterkomponenten für schnurlose und Mobiltelefone, aber auch Betriebssoftware und Applikationen für Handy-Hersteller, die Systemlösungen beziehen. Hinzu kommen Bluetooth-Chips, die Daten drahtlos über kurze Entfernungen übertragen, und Chips für Mobilfunk-Basisstationen. Die dritte Mobilfunkgeneration (UMTS) bietet dem Handy-Nutzer neben dem Telefonieren weitere multimediale Dienste. Mit ihrer Einführung gewinnt auch der Markt für UMTS-Mobilfunk-Basisstationen an Fahrt. Zudem werden die Kapazitäten der herkömmlichen GSM- und GPRS-Netzwerke erweitert oder – wie in Teilen Osteuropas, Südamerikas und in Indien – neu aufgebaut. Unsere Sicherheitschips werden vielfach eingesetzt, zum Beispiel in SIM-Karten, die zur Identifikation von Mobilfunknutzern im Netz dienen, in Pay-TV-, Bank- und Kreditkarten bis hin zu Ausweisen und Reisepässen.

Charakter des Geschäfts

Im Mobilfunkmarkt zeichnen sich deutlich zwei Trends ab: Einerseits benötigen Multimedia-Telefone immer leistungsfähigere Prozessoren sowie komplexere Software- und Systemlösungen, andererseits entsteht vor allem im wichtigen asiatischen Markt, aber auch in Osteuropa und Südamerika ein Massenmarkt für kostensensitive Einsteigermodelle. Immer stärker werden komplette Referenz-Designs einschließlich der Software-Lösungen nachgefragt, die wir bei Bedarf kundenspezifisch anpassen.

Die Wachstumstreiber bei den Sicherheitschips sind die Applikationen Personenidentifikation (Pässe, Personalausweise, Gesundheitskarten) und Zahlungsmittel (Geldkarten und Kreditkarten). In diesen sensiblen Bereichen werden sowohl an kontaktbasierte als auch an kontaktlose Chipkarten höchste Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Leistung gestellt. Nach wie vor wird der größte Umsatz mit SIM-Karten erzielt.

Diese Märkte stellen uns vor eine Vielfalt von Herausforderungen: Das Mobiltelefonsegment ist von kurzen Innovationszyklen geprägt, die Anbieterstrukturen und die Wertschöpfungskette verschieben sich. Mobiltelefonanbieter lagern verstärkt Entwicklungs- und Produktionsprozesse aus; Mobilfunkanbieter geben zunehmend eigene Spezifikationen für Mobiltelefone vor und lassen diese im eigenen Auftrag fertigen. Im Fall der Sicherheitschips erweitern sich beständig die Anwendungsfelder, zusätzlich werden für bestehende Applikationen immer neue Sicherheitsfunktionen nachgefragt.

Strategische Ausrichtung

Im Bereich Mobiltelefone betrachtet Infineon das Plattform-Geschäft als ein entscheidendes Wachstumssegment. Entsprechend konsequent wurden Software- und Systementwicklung vorangetrieben. Heute sieht sich Infineon als Anbieter einer großen Bandbreite von Leistungen. Sie beinhaltet neben der Bereitstellung funktionsfähiger Telefonplattformen mit der gewünschten Funktionalität auch die Unterstützung beim Testen und beim Produktionshochlauf. Darüber hinaus baut Infineon seine Marktführerschaft bei Hochfrequenz-Komponenten aus.

Die Einführung hochmoderner Technologien, Innovation und hohe Wettbewerbsfähigkeit des Produktspektrums stärken das Wireless-Infrastrukturgeschäft genauso wie der konsequente Ausbau der Kundenbasis.

Den Erhalt und den Ausbau der Marktführerschaft bei Sicherheitschips und -lösungen können wir durch die Einführung leistungsstarker 16-/32-Bit-Produktplattformen mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen sowie einer neuen kontaktlosen Controller-Familie gewährleisten. Mit RFID-Chips für Identifikationsaufgaben und so genannten TPMs (Trusted Platform Modules) für PC- und Netzwerksicherheit vergrößern wir unser Angebot an Applikationen und unsere Kundenbasis.

Automobil- und Industrieelektronik

Systemkompetenz und Energie sparende Lösungen

Geringere Systemkosten bei höherer Performance für Automobilhersteller durch Infineon-Produkte
 Marktführerschaft mit hochintegrierten und Energie sparenden Leistungshalbleitern
 Mikrokontroller für Echtzeitanwendungen, Reifendrucksensoren und kombinierte Funktionen in einem System

Halbleiter gehören zum Auto: Die Chips des Bereichs Automobilelektronik steuern zahlreiche Funktionen von der Klimaanlage und Sitzeinstellung über ABS und Airbag bis hin zu Motor und Getriebe. Der Wert der Halbleiter im Auto liegt heute im Durchschnitt bei 250 Euro, Tendenz steigend.

Der Teilbereich Industrieelektronik ist für Stromversorgung und elektrische Antriebe zuständig – im Kleinen wie im Großen. Hochleistungselektronik sorgt beispielsweise in Umspannwerken, ICE-Zügen, Windkraftanlagen und Industrieantrieben dafür, dass hohe Leistungen zuverlässig gesteuert werden. Halbleiter regeln aber auch die Energiezufuhr für Motherboards in PCs und Notebooks sowie Ladestationen mobiler Geräte.

Charakter des Geschäfts

Der Markt für Automobilhalbleiter ist der stabilste der gesamten Halbleiterbranche. Das liegt zum einen an den – vergleichsweise – geringen Kapazitätsschwankungen bei der Automobilproduktion, zum anderen an der sich ständig verbessernden Elektronikausstattung der Autos. Daraus ergibt sich für den Teilbereich Automobilelektronik eine relativ hohe Planungssicherheit – mit langen Produktlebenszyklen und dauerhaften Kundenbeziehungen. Dabei müssen die Produkte höchsten Qualitätsstandards genügen. Unsere Kunden erwarten absolute Fehlerfreiheit („null Fehler“).

Die zwei wichtigsten Segmente im Industriebereich – Antriebssteuerung von Elektromotoren und Spannungsversorgung für PCs und Notebooks sowie für Ladestationen mobiler Geräte – werden geprägt von dem Streben nach geringerer Verlustleistung und reduzierter Baugröße. Von der Architektur der Halbleiter-Bauelemente hängt das Erreichen dieser Anforderungen ab.

Strategische Ausrichtung

Infineon verfügt im Teilbereich Automobil über ein umfassendes Produktportfolio und eine Systemexpertise, die über mehrere Jahrzehnte gewachsen ist. Infineon ist in den drei Bereichen des klassischen Regelkreises vertreten: Messen mittels Sensoren, Berechnen mittels Mikrocontrollern und Steuern mittels Leistungselektronik. So können die drei wichtigsten Anwendungsfelder – Antriebsstrang, Sicherheit sowie Karosserie- und Komfortelektronik – in besonderem Maße abgedeckt werden. Hier gilt als oberstes Gebot: absolute Fehlerfreiheit – und das bei Milliarden von ausgelieferten Bauelementen. Bei einem Großteil unserer Produkte haben wir dieses Ziel bereits erreicht.

Bei den Leistungshalbleitern im Teilbereich Industrieelektronik haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Verlustleistung zu minimieren. Eine höhere Leistungsdichte und damit kleinere Baugruppen bei gleichzeitig geringerer Wärmeentwicklung sind das Ergebnis. Schaltnetzteile, wie sie etwa in PCs, Notebooks und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik vorkommen, stehen daher bei uns im Vordergrund.

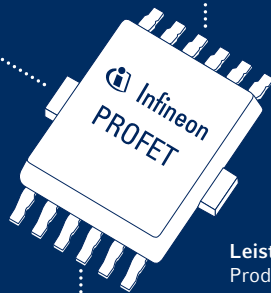
Daneben spielt die Spannungsversorgung der Mikroprozessoren in PCs eine herausragende Rolle. Je nach Betriebszustand braucht der Mikroprozessor mehr oder weniger Strom. Trotzdem muss die Spannung präzise eingehalten werden, und das mit minimaler Verlustleistung.

Die Steuerung elektrischer Antriebe lässt sich in zwei Segmente unterteilen: einerseits in die industriellen Anwendungen wie zum Beispiel bei Zügen, U-Bahnen und Automatisierung, andererseits in Konsumanwendungen wie Waschmaschinen, Spülmaschinen und Klimaanlagen.

Automobil- und Industrieelektronik

Dr. Reinhard Ploss

Leiter Geschäftsbereich
Automobil- und Industrie-
elektronik, Studium der
Verfahrenstechnik,
Promotion zum Dr.-Ing.



Leistungshalbleiter ::: Ein Beispiel aus dem
Produktportfolio Automobil- und Industrieelektronik

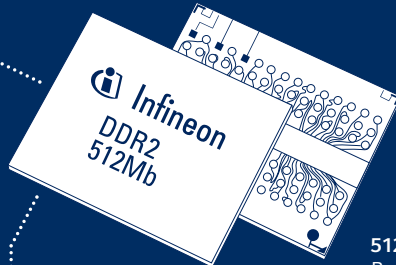
Produktinnovationen

- ::: TriCore-AUDO-NG-Familie technologisch führend: Ihre Architektur ermöglicht besonders leistungsfähige Mikrokontroller, die mit dem besten Echtzeitverhalten am Markt aufwarten. Damit eignen sich die Chips für Motorsteuerung und Safety-Management im Auto, die keine Zeitverzögerung erlauben.
- ::: TriCore-2-Architektur für Industriefanwendungen optimiert: Das Marktforschungsinstitut In-Stat/MDR kürte die besonders energiesparende Halbleiterlösung zum „Best Low-Power Embedded Processor of 2003“.
- ::: SPT6-Technologie vereint Vorteile von CMOS- und Bipolartechnologie: Die Mischtechnologie wird in Leistungshalbleitern eingesetzt. Durch sie werden weniger Bauteile gebraucht und es können bei geringerer Verlustleistung höhere Ströme gesteuert werden.
- ::: Reifendrucksensoren beugen Unfall vor: Drucksensoren im Reifen melden dem Fahrer rechtzeitig einen Druckabfall und können damit helfen, einen Unfall durch Reifenschaden zu vermeiden. Sie sind auf besonders geringen Stromverbrauch ausgelegt und werden mit einer Batterie fest in das Rad integriert.

Speicherprodukte

Thomas Seifert

Leiter Geschäftsbereich
Speicherprodukte,
Studium der Betriebswirtschaftslehre, MA in Volkswirtschaftslehre



512-Megabit DDR2 SDRAM, Speicherbaustein ::: Ein Beispiel aus dem Produktportfolio Speicherprodukte

Produktinnovationen

- ::: Nächste Technologiegeneration vorgestellt: Erste funktionsfähige Muster in 90-Nanometer-Technologie sind verfügbar. Die 90-Nanometer-Volumenproduktion beginnt im nächsten Jahr, und zwar mit 512-Megabit-DDR-Speicherchips.
- ::: Standard-DRAM-Speicher mit DDR2-Interface im Kommen: Die Markteinführung begann bereits im Juli 2004 bei PCs und Servern. Im nächsten Jahr wird DDR2 die aktuelle DDR-Generation als Hauptvolumenprodukt verdrängen.
- ::: Neue Speichermodule entwickelt: Mit dem Micro-DIMM wurde ein noch kleineres Speichermodul für Sub-Notebooks präsentiert. Zusammen mit dem Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation wurde ein Pufferspeicher für Hochgeschwindigkeitsdatentransport entwickelt, der in der nächsten Generation Server-Module, den so genannten Fully Buffered DIMMs, eingesetzt werden soll.
- ::: Speicherspeicher für 3-D-Grafikkarten verfügbar: Die mit 500 Megahertz getakteten GDDR3-Grafikspeicher unterstützen die anspruchsvollsten Grafikanwendungen.
- ::: DRAMs auf geringen Stromverbrauch optimiert: Der 256-Megabit-Mobile-RAM liegt nun für 1,8 Volt Versorgungsspannung vor und zielt auf Smart Phones ab. Der 32-Megabit-CellularRAM ersetzt teure SRAMs in Mobiltelefonen.
- ::: Erste eigene Flash-Komponenten am Markt platziert: Anfang 2004 ist Infineon Technologies Flash, ein Joint Venture mit dem israelischen Unternehmen Saifun, mit einem 512-Megabit-Chip in den Markt für Flash-Speicher eingestiegen. Die Flash-Komponenten lassen sich in USB-Sticks und in Flash-Karten der Formate Secure-Digital-Card (SD) und MultiMediaCard (MMC) einsetzen.

Speicherprodukte

Technologieführer durch überlegene Prozesstechnik

Hochintegrierte Speicher in 110-Nanometer-Technologie : : : :
 Erweitertes Produktportfolio mit anwendungsspezifischen und höherwertigen Speichern : : : :
 Mit Partnerschaften Risiken teilen und Ressourcenbasis vergrößern : : : :

Schätzungen zufolge entstehen täglich rund 52 Milliarden Megabyte an Daten weltweit – Tendenz steigend. Diese Datenflut verlangt nach stets höherer Speicherkapazität sowohl der Netzwerkinfrastruktur als auch der die Daten verarbeitenden Endgeräte; die Anwendungs- und Betriebssystem-Software wird nicht zuletzt durch Nutzung immer größerer Speicherkapazitäten zunehmend leistungsfähiger. Infineon entwickelt Halbleiter-Speicherkomponenten für die unterschiedlichsten Geräte zur Datenverarbeitung und -verteilung.

Vom PDA über das Notebook und den PC bis zum Großrechner kommt dabei in allen Rechnern der DRAM-Speicherchip (Dynamic Random Access Memory) zum Einsatz. Aber auch bei batteriegetriebenen Kleingeräten wie dem Handy ist immer mehr Speichervolumen gefragt, da diese nicht mehr nur zum Telefonieren benutzt werden, sondern zunehmend zum Empfang und zur lokalen Verarbeitung von Daten.

Charakter des Geschäfts

Hauptumsatzträger im Geschäftsbereich Speicherprodukte sind DRAMs, die größtenteils industrieweit genormt sind und damit einem harten Wettbewerb unterliegen. Mit 60 bis 70 Prozent absorbiert der Markt für Computer den Löwenanteil der weltweiten DRAM-Produktion – dazu zählen Workstations, Desktop- und Notebook-PCs. Der Rest entfällt auf weniger preissensitive Märkte wie Server und Router, die als Vermittlungsstellen in Netzwerken dienen, aber auch Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und PC-Peripheriegeräte.

Über die letzten Jahre ist die Anzahl der Lieferanten von DRAMs nicht zuletzt auf Grund des harten Wettbewerbs gesunken und die Marktanteile haben sich auf einige wenige Firmen konzentriert. Im Kalenderjahr 2003 hatten die Top-5-DRAM-Lieferanten einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es nur rund 50 Prozent.

Strategische Ausrichtung

Im Markt der Speicherprodukte sind Innovation und Flexibilität die im Wettbewerb entscheidenden Voraussetzungen für profitables Wachstum. Infineon ist in der Lage, durch seine modernsten Fertigungstechnologien die Kosten der Speicherproduktion Jahr für Jahr erheblich zu senken. So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr der Großteil der Fertigungskapazitäten auf Strukturgrößen von 110 Nanometern umgestellt. Zudem haben wir neue Kapazitäten in der 300-Millimeter-Technologie geschaffen, bei der Infineon eine Vorreiterrolle einnimmt und mit der sich Speicher noch wirtschaftlicher produzieren lassen. Dadurch stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft die Produktivität bei der Herstellung von Speicherbausteinen jährlich um etwa 30 Prozent steigern können. ... Fertigung, S. 34

Der Geschäftsbereich setzt auch in Zukunft auf Kooperationen, um seine Kapazitäten erweitern zu können und neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. Risiken und Kosten lassen sich auf diese Weise teilen und minimieren und Projekte auf eine breitere Ressourcen- und Finanzbasis stellen.

Im Übrigen arbeitet der Geschäftsbereich Speicherprodukte kontinuierlich daran, das Produktportfolio auf Marktsegmente mit höheren Margen auszurichten. Denn im Unterschied zu Standardspeichern erzielen sie höhere Preise und unterliegen geringeren Marktschwankungen. Es handelt sich in diesem Zusammenhang um anwendungs- und kundenspezifische DRAM-Produkte, etwa Server-Module oder Energie sparende Speicherspeicher für mobile Geräte. Damit soll einerseits die Volatilität des Gesamtgeschäfts verringert, andererseits die Produktpalette auf Systemebene vervollständigt werden. So punktet Infineon etwa bei Mobiltelefonen: Wir entwickeln nicht nur einen Großteil der Plattform eines Mobiltelefons selbst, sondern bieten auch eine dazu passende Palette von Speichern an.

Innovationen

Technologieführer mit Innovationskraft

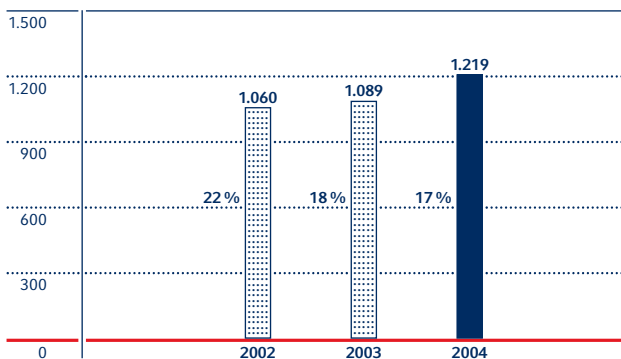
Der effiziente Einsatz von Entwicklungsressourcen verbessert Profitabilität
 Infineon investiert weltweit in Forschungszentren und Partnerschaften
 Von der Mikro- zur Nanoelektronik

Infineon bewegt sich in einer sehr dynamischen Branche und nimmt in der Halbleiterindustrie als einer der Technologieführer eine exponierte Stellung ein. Forschung und Entwicklung spielen bei Infineon eine Schlüsselrolle bei der Erschließung von Wachstumspotenzialen und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

Welchen Stellenwert wir der Arbeit an Innovationen über alle Geschäftsbereiche hinweg beimessen, drückt sich auch in unseren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus: Infineon hat im Geschäftsjahr 2004 1,2 Milliarden Euro in die Technologien der Zukunft investiert – das entspricht einer Steigerung um zwölf Prozent oder 130 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. ... Die Geschäftsbereiche, ab S. 16

Das Unternehmen kann zum Bilanzstichtag auf weltweit rund 7.200 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung zählen – das sind rund 1.200 mehr als zum Ende des vergangenen Geschäftsjahrs.

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
 in Mio. €, % vom Umsatz



Effizienter Einsatz von Entwicklungsressourcen

Die hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sichern die Zukunft des Unternehmens. Nur die kontinuierliche Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte in den

neuesten Technologien ermöglicht es uns, die Kostenposition zu verbessern und dadurch die Profitabilität zu steigern. Besonderen Wert legen wir dabei auf den effizienten Einsatz von Entwicklungsressourcen: Denn nur wenn unsere Aufwendungen für die Produktentwicklung und der Umsatz, den wir mit unseren Produkten generieren, in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, können wir angemessen profitabel sein. Die Voraussetzungen dafür werden mittels eines sorgfältigen Projektmanagements geschaffen. Vor allem in der Anfangsphase der Produktentwicklung stellen eine enge Abstimmung mit dem Kunden und gründliche Analysen sowie Bewertungen möglicher Chancen und Risiken einen reibungslosen Ablauf des Entwicklungsprozesses sicher. Neben der reinen Kostenbetrachtung ist insbesondere auch der richtige Zeitpunkt für die Einführung neuer Produkte am Markt entscheidend (Time-to-Market), um im Vergleich zum Wettbewerb Kostenvorteile zu realisieren und Absatzpotenziale zu nutzen. ... Kunde im Fokus, S. 27

Ein weiterer wichtiger Baustein zur Steigerung der Entwicklungsproduktivität ist die Wiederverwendung von einmal entwickelten Halbleiterelementen und Blöcken in neuen Produkten. Auf Grund der Ähnlichkeit einer Vielzahl von Produkten und Produktfamilien lässt sich hier durch ein Baukastenverfahren einmal entwickelter Komponenten der Einsatz unserer Ressourcen optimieren. Wegen des großen Produktivitätspotenzials wird dieses Konzept bei Infineon systematisch verfolgt. Die Einbeziehung unserer Kunden in den Entwicklungsprozess, die systematische Planung und die kosteneffiziente Entwicklung sind entscheidende Erfolgsfaktoren, die Infineon zu einem starken und verlässlichen Partner machen.

In einer hochinnovativen Branche wie der Halbleiterindustrie ist es unabdingbar, die aus Forschung und Entwicklung entstehende Wertschöpfung nachhaltig durch Patentschutz abzusichern. Rund 1.700 seiner Erfindungen hat Infineon im vergangenen Jahr zum Patent angemeldet – dies entspricht durchschnittlich sieben Patenten pro Arbeitstag.

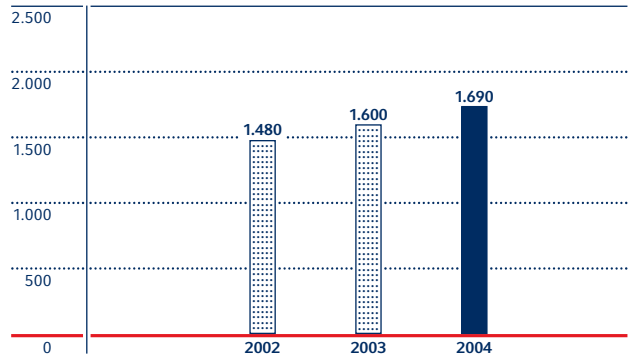
Weltweite Entwicklung unserer Produkte

Infineon bündelt seine weltweiten Entwicklungsaktivitäten für die Produktentwicklung in rund 40 Entwicklungszentren. Wichtige Voraussetzungen für die Auswahl der Standorte sind die Nähe zu unseren Kunden, die qualifizierten Mitarbeiter vor Ort und eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur. Infineon hat im Oktober 2003 rund 145 Software-Entwickler von Siemens ICM übernommen, um seine Entwicklungskompetenz in der Mobilfunksparte auszubauen. Damit verfügen wir über hervorragendes Software-Know-how, das wir mit unseren Basisband- und Hochfrequenzhalbleitern zu kompletten Plattformlösungen für Handy-Hersteller bündeln. ... Sichere Mobile Lösungen, S. 18

Zudem haben wir unser Software-Zentrum im indischen Bangalore um 200 weitere Mitarbeiter verstärkt – ein Großteil der rund 400 Entwickler arbeitet an Software für drahtlose Anwendungen, für Signalprozessoren und Sicherheitsanwendungen, aber auch für Breitbandtechnologien und die Industrieautomatisierung. Im chinesischen Xi'an entsteht zurzeit eines der größten Entwicklungszentren in Asien – hier soll künftig an innovativen Produkten für die Kommunikationsbranche, die Automobil- und Industrieelektronik sowie Massenspeichern gearbeitet werden. Mit dem Standort in Xi'an stärken wir unsere Position in einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Elektronikprodukte und profitieren gleichzeitig von den vergleichsweise niedrigen Kosten. Unser Kompetenzzentrum für Leistungselektronik im österreichischen Villach wird momentan um ein neues Gebäude mit 270 Arbeitsplätzen für Produktentwickler erweitert. In Villach zeigen sich die Vorteile einer engen Verzahnung von Entwicklung und Produktion besonders deutlich: Eine schnelle Überführung der entwickelten Produkte in die Fertigung ist an ein und demselben Standort möglich und schafft eine der wesentlichen Voraussetzungen für profitables Wachstum. ... Globale Präsenz, S. 30

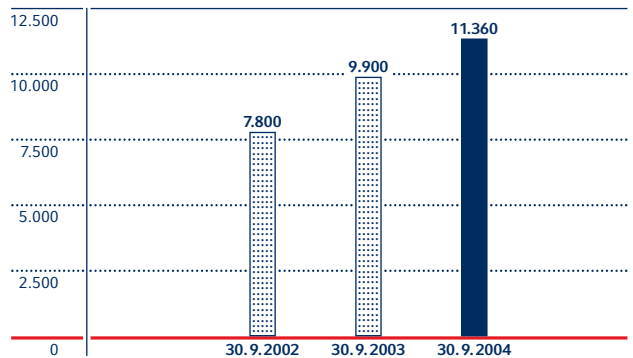
Die Entwicklung von Basistechnologien für Speicher hat Infineon in Dresden konzentriert. Unser dortiges Memory Development Center (MDC) wird bis Anfang 2005 für 120 neue Mitarbeiter erweitert. Die Entwicklung innovativer Konzepte und Fertigungsprozesse sowie die Untersuchung neuer Materialien für Speichertechnologien stehen hier im Mittelpunkt. An den idealen Arbeitsbedingungen,

Erstanmeldungen Patente¹



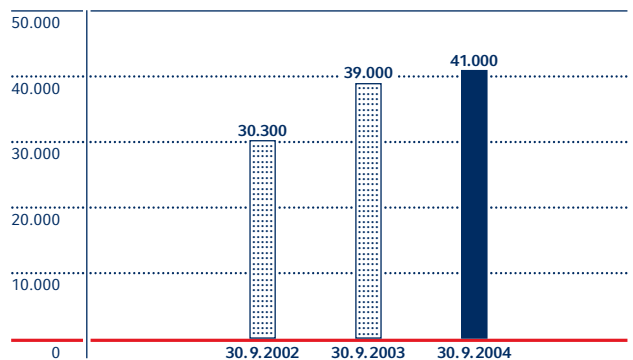
¹ Erfindungen werden zunächst bei einem Patentamt in einem Land angemeldet.

Lebende Patentfamilien¹



¹ Patente haben eine maximale Lebensdauer von 20 Jahren und zählen kumuliert. Alle Patente und Patentanmeldungen, die eine Erfindung betreffen, bilden zusammen „Patentfamilien“.

Lebende Patente und Patentanmeldungen¹ weltweit kumuliert



¹ Infineon meldet wichtige Erfindungen innerhalb eines Jahres auch im Ausland an. Darum ergeben sich im Durchschnitt aus einer Erfindung vier Patentanmeldungen.

die dieses Entwicklungszentrum bieten wird, lassen wir künftig auch externe Partner teilhaben: Das neue Zentrum für Nanoelektronische Technologien (Center for Nanoelectronic Technologies, CNT), an dem sich die Fraunhofer-Gesellschaft und die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) beteiligen, wird sich auf dem Infineon-Gelände in Dresden befinden und auf unsere Infrastruktur zugreifen können.

Durch Kooperationen Kosten optimieren

Logik- und Speicherbausteine unterliegen einem harten Wettbewerb. Diesen erfolgreich zu meistern erfordert immer höhere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Mit Hilfe strategischer Kooperationen können wir die Kosten und Risiken mit anderen teilen. Indem wir Kooperationspartner auswählen, die Infineons Know-how bestmöglich ergänzen, profitieren wir von ihren Stärken: Neueste DRAM-Speichertechnologien mit Strukturweiten von 90 und 70 Nanometern entwickeln wir gemeinsam mit unserem taiwanischen Partner Nanya Technologies im MDC in Dresden. Mit der dort entwickelten 90-Nanometer-DRAM-Technologie werden bereits beachtliche Ausbeuten erreicht. Für die 70-Nanometer-Technologie liegen erste Prototypen vor. Mit Chartered Semiconductors, IBM und Samsung Electronics entwickeln wir in einer strategischen Partnerschaft eine gemeinsame Technologieplattform für die Fertigung von Logikbausteinen im IBM-Entwicklungszentrum im amerikanischen East Fishkill. Unsere Anstrengungen konzentrieren sich dabei zunächst auf Fertigungstechnologien für Chipstrukturen von 65 und später 45 Nanometern. Jedes der beteiligten Unternehmen wird die entwickelten Prozesse und Technologien in seine eigenen Fertigungen transferieren. Ebenfalls in Dresden hat das Advanced Mask Technology Center (AMTC) seinen Betrieb aufgenommen – hier entwickeln und produzieren AMD, DuPont Photomasks und Infineon modernste lithographische Masken für die Halbleiterfertigung. Diese sind die Vorlagen für die integrierten Schaltungen im Belichtungsprozess, der für immer kleinere Chipstrukturen immer anspruchsvollere Fotomasken erfordert.

Darüber hinaus beteiligt sich Infineon an staatlichen Forschungsprogrammen, etwa am Projekt NANOCMOS, mit dem die EU-Kommission die führende Stellung der euro-

päischen Halbleitertechnologien sichern will. Die drei größten Halbleiterhersteller in Europa – Infineon, Philips und STMicroelectronics – arbeiten dabei mit den bedeutendsten europäischen Technologie-Forschungslabors wie zum Beispiel CEA Leti in Frankreich und IMEC in Belgien zusammen. Im Rahmen der Forschungsk Kooperation werden die Möglichkeiten zu Strukturverkleinerungen von CMOS-Technologien untersucht, die kleiner als 45 Nanometer sind.

Von der Mikro- zur Nanoelektronik: Leistungshalbleiter aus Carbon-Nanotubes

Die Chipstrukturen immer weiter zu verkleinern und dabei die Grenzen der Halbleitertechnologie immer weiter zu verschieben – darin liegt nach wie vor eine der größten Herausforderungen der Halbleiterindustrie. Deshalb messen wir unseren eigenen Forschungsanstrengungen eine große Bedeutung bei. In der molekularen Elektronik ist Infineon-Forschern eine bahnbrechende Entwicklung gelungen. Sie haben als weltweit Erste einen Leistungshalbleiter mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen, so genannten Carbon-Nanotubes, hergestellt: Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind aus heutiger Sicht die kleinsten aller denkbaren Leiter – sie bestehen aus einem einzigen Molekül, das ein perfektes, nahtloses Röhrchen mit idealen physikalischen Eigenschaften formt. Sie leiten Wärme hervorragend, halten hohe Stromdichten aus, und ihr elektrischer Widerstand ist quasi unabhängig von der Länge. Bereits vor zwei Jahren hat es Infineon als weltweit erstes Unternehmen geschafft, leitende Carbon-Nanotubes als Vias, also Verbindungsleitungen zwischen zwei Chipebenen, einzusetzen. Der neue Leistungshalbleiter aus Carbon-Nanotubes steuert bei einer Spannung von 2,5 Volt Leuchtdioden und kleine Elektromotoren an und eröffnet neue Möglichkeiten für die verlustarme und damit kostengünstige Ansteuerung von Elektronikkomponenten.

Innovationskraft bestimmt maßgeblich den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. Infineon setzt im Bereich von Forschung und Entwicklung seine Ressourcen gezielt für die Entwicklung zukunftsweisender Produkte und Technologien ein, damit wir als Technologieführer das profitable Wachstum unseres Unternehmens auch in der Zukunft sichern.

Kunde im Fokus

Innovative Lösungen für anspruchsvolle Kunden

Infineons Vertriebsteam garantieren Zuverlässigkeit und Kompetenz : : : :
Auftragsfertiger als neue Akteure am Markt : : : :
Nah am Verbraucher mit Service aus einer Hand : : : :

Umfassende Kundenorientierung und ihre konsequente Umsetzung sind die Grundvoraussetzung, profitabel zu wachsen. Nachhaltiges Wachstum und positive Geschäftsergebnisse lassen sich nur erreichen, wenn unsere Kunden zufrieden mit uns sind. Diese tendieren dazu, nicht nur einzelne Produkte, sondern komplette Lösungen zu kaufen, die einen entsprechenden Mehrwert bieten. Darum beginnt Infineons Kundenorientierung bei der Vertriebsorganisation und zieht sich geschäftsbereichsübergreifend durch alle anderen Funktionen des Unternehmens, wie Marketing, Forschung & Entwicklung, Logistik und Produktion. Über unseren Erfolg entscheidet am Ende das Vertrauen der Kunden in uns, dass wir unsere Zusagen in vollem Umfang und zuverlässig erfüllen.

Etwa 70 Prozent des Umsatzes mit unseren rund 380 direkten Kunden erzielen wir mit Unternehmen, die auf mehr als einem Kontinent aktiv sind. Zirka 52 Prozent des Umsatzes generieren wir dabei mit den 20 größten Kunden. Zugleich hat der allgemeine Preisdruck in der Halbleiterbranche dazu geführt, dass viele Marktteilnehmer ihre Organisation in den vergangenen Jahren angepasst haben: So wurden zunehmend Produktions- und Entwicklungsleistungen an Dritte ausgegliedert oder Partnerschaften eingegangen, die es den Kunden ermöglichen, mit geringeren Kosten zu wachsen. Dies führt zu immer komplexer werdenden Netzwerken, die weltweit agieren. Wir wissen, dass wir in einem solchen globalen Geflecht die individuellen Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden nicht aus den Augen verlieren dürfen. Denn nur so können wir das Systemwissen unserer Kunden bei Neuentwicklungen berücksichtigen und optimale Lösungen bereitstellen, um auf diesem Wege gemeinsam mit ihnen zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen. Die ständige Weiterentwicklung und Integration führt zu immer komplexeren Systemen, wobei das Einbeziehen des Systemwissens der Kunden in Neuentwicklungen zum erfolgsentscheidenden Faktor wird.

Die Veränderungen in unseren Märkten und bei unseren Kunden haben wir frühzeitig erkannt und aufgegriffen. Wir konzentrieren uns auf Wachstumssegmente und die daraus resultierenden Anwendungen. Dabei wenden wir uns vor allem an Kunden, deren strategische Ausrichtung sich mit unserem Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt und signifikant zum beiderseitigen langfristigen Geschäftserfolg beiträgt. Eine klare Kundensegmentierung erlaubt es uns, einen maßgeschneiderten Service anzubieten. : : : :
 : : : :
 : : : :
 : : : :
 : : : :
 : : : :
 : : : :

Vertriebspartner im Einsatz

Unsere weltweit präsente Vertriebsorganisation hält engen Kontakt zu allen Kunden. Deren optimale Betreuung ist Infineon ein großes Anliegen; darin spiegelt sich unser Interesse an ihren Bedürfnissen und Vorstellungen. Fest zugeteilte Vertriebsteams können überregional und geschäftsbereichsübergreifend beraten. Ein Team besteht aus Vertriebs- und Anwendungsingenieuren, die vor Ort Produkte, Lösungen und Dienstleistungen aller Geschäftsbereiche anbieten. Die Qualifikation und das Fachwissen unserer Vertriebsmitarbeiter sind dabei von großer Bedeutung. Aus diesem Grund nimmt die systematische, praxisorientierte und projektbezogene Aus- und Weiterbildung der Vertriebsmitarbeiter einen besonderen Stellenwert ein.

Lokale Betreuung schafft Vertrauen

Ein wichtiges Bindeglied zu unseren Kunden sind die so genannten Distributoren. Diese externen Vertriebspartner betreuen mehrere tausend Kunden von Infineon umfassend und intensiv. Auf diese Weise können wir unserem Anspruch auf größtmögliche Kundennähe am besten gerecht werden. Die Kernkompetenz unserer Distributoren ist dabei das Anbieten maßgeschneiderter Lösungen, um eine verbrauchsgesteuerte und produktionsgerechte Lieferung

zu gewährleisten. Des Weiteren leisten sie vielfältige technische Unterstützung, von der einfachen Produktberatung bis hin zur konkreten Mithilfe bei der Entwicklung von Applikationen. Diese Art von lokaler kompetenter Betreuung kommt unseren indirekten Kunden unmittelbar zugute.

Unsere Partner in der Kundenbetreuung bieten ein breites und anspruchsvolles Leistungsspektrum. Die vertrauensvolle und sorgfältig abgestimmte Zusammenarbeit dieser Distributoren mit Infineon ist eine Voraussetzung dafür, dass wir das Marktpotenzial erfolgreich ausschöpfen.

Die fortwährende Verbesserung von Prozessen, die Wahl der richtigen Vertriebspartner und unser wettbewerbsfähiges Produktportfolio haben im abgelaufenen Geschäftsjahr entscheidend zur Steigerung unseres Anteils am Distributionsmarkt beigetragen. Der Umsatzanteil mit diesen Partnern konnte im vergangenen Jahr auf knapp 20 Prozent des Infineon-Umsatzes im Logikbereich gesteigert werden.

Auftragsfertiger als neue Kunden

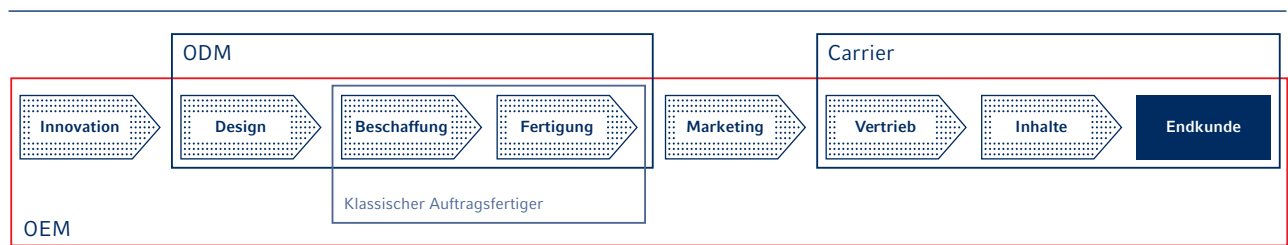
In den vergangenen Jahren zeichnete sich eine Veränderung in der Wertschöpfungskette ab, die unsere Kundenbeziehungen stark beeinflusst hat. Traditionelle Hauptabnehmer unserer Produkte waren bisher in erster Linie große Markenhersteller (Original Equipment Manufacturers, OEM). Um Kosten zu senken und sich auf ihr Ge-

schäft mit dem Endkunden zu konzentrieren, lagern OEMs jedoch immer mehr Aufgaben an Auftragsfertiger aus. In der Folge übernehmen spezialisierte Auftragsfertiger inzwischen auch Design-Aufgaben für die Markenhersteller und entwickeln sich so zu neuen Akteuren im Markt, den Original Design Manufacturers (ODM). Sie übernehmen nicht mehr allein die effiziente Fertigung, sondern setzen die technologischen Vorgaben der Markenhersteller um, indem sie eigenes Entwicklungs-Know-how einbringen.

Daher beziehen wir seit geraumer Zeit ODMs systematisch in die Kundenbasis mit ein und bieten ihnen unsere Erfahrung bei der Integration und Entwicklung von ganzen Systemen an.

Um die wichtigen Computer-ODMs in Asien zu adressieren, haben wir vor Ort ein technisches Kompetenzteam für Power Management & Supply aufgebaut. Durch die Weitergabe unseres technologischen Know-hows über Leistungshalbleiter und die enge Zusammenarbeit in der Konzept- und Systemerstellung konnte Infineon gemeinsam mit den größten ODMs die kostengünstigste Lösung entwickeln, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Ein erfolgreiches Beispiel hierfür sind Infineons Power-Management-Lösung für Motherboards, die in Zusammenarbeit mit großen taiwanischen ODMs entstand, sowie der effizienteste Server-Power-Supply, der aus der Kooperation mit marktführenden ODMs der Switch-Mode-Power-Supply (SMPS)-Branche in Asien resultierte.

Spezialisierung der Marktakteure entlang der Wertschöpfungskette am Beispiel Mobilfunkgerät



Traditionell haben die großen Markenhersteller (**Original Equipment Manufacturers, OEM**) alle Aufgaben in der Wertschöpfungskette ausgeführt: von der Produktinnovation über die Entwicklung (Design), Beschaffung und Fertigung bis hin zum Marketing und Vertrieb zum Endkunden. Um Kosten zu senken, lagern sie nun mehr Aufgaben an Auftragsfertiger aus. Der **klassische Auftragsfertiger** fokussiert sich dabei auf die Beschaffung und Fertigung; die neuen Akteure, so genannte **Original Design Manufacturers (ODM)**, hingegen übernehmen zudem noch Design- und Entwicklungsaufgaben. Der Netzwerkbetreiber oder **Carrier** hingegen konzentriert sich auf den Vertrieb zum Endkunden und bietet seinen Service an, wie zum Beispiel die Bereitstellung eines Mobilfunknetzes mit allen Serviceaspekten sowie den Vertrieb von Handys.

Direkter Draht zum Endverbraucher

Um ein umfassendes Bild vom Markt zu erhalten, richten wir unseren Blick auf alle Stufen der Wertschöpfungskette und bauen auch den Informationsaustausch mit den Kunden unserer Kunden aus. In unserem Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen suchen wir beispielsweise nicht nur den Dialog mit den Herstellern von Mobiltelefonen und Netzwerken, sondern auch mit öffentlichen Institutionen, Banken und Telefongesellschaften. Dieser Kundenkreis hat genaue Vorstellungen von zukünftigen Sicherheitsprozessen, System- und Kundenanforderungen. Dieses Wissen hilft uns wiederum, unsere Chipkartentechnologie in die richtige Richtung voranzutreiben und gleichzeitig die bereits heute marktführende Position weiter auszubauen und zu festigen. Indem wir Unternehmen mit eben diesem direkten Zugang zum Endkunden einbinden, erhalten wir ein zuverlässiges Bild vom Markt und erfahren frühzeitig, in welche Richtung sich Trends bewegen, welche Standards sich durchsetzen und wie sich die Nachfrage entwickelt. Dieses Wissen erlaubt es uns, mit den richtigen Produkten zum richtigen Zeitpunkt am Markt zu sein.

... Sichere Mobile Lösungen, S. 18

Ein wichtiger Bestandteil unserer Vertriebsorganisation sind erfahrene Vertriebs- und Anwendungsingenieure, die Ansprechpartner des Kunden für alle technischen Fragen und Belange sind. Diese technische Vertriebsorganisation ist auf bestimmte Kundenanwendungen

beziehungsweise Kunden spezialisiert und arbeitet in allen technischen Aspekten sehr eng mit unseren Kunden zusammen.

Die genaue Kenntnis unserer Kunden und der Märkte sowie ein optimales Kundenmanagement sind entscheidende Erfolgsfaktoren, um sich im hart umkämpften Halbleitermarkt durchzusetzen. Aber sie allein genügen nicht. Kundenorientierung bezieht sich bei Infineon sowohl auf externe als auch interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen. Alle Mitarbeiter haben diesen Gedanken verinnerlicht – nicht nur diejenigen Abteilungen, die in direktem Kontakt zum Kunden stehen.

Wir sind bemüht, kontinuierlich die Abläufe im Unternehmen, vom Auftragseingang bis zur Auslieferung der Ware, zu optimieren. Jeweils ein verantwortlicher Mitarbeiter betreut den Kunden „aus einer Hand“ auf einem konstant hohen Serviceniveau. Zusagen einzuhalten und schnell aussagefähig zu sein, das sind die Schlüssel zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit. Dies bestätigen auch die Ergebnisse einer Kundenbefragung im Geschäftsjahr 2004, bei der 60 Prozent unserer Kunden mit unserer Logistikleistung zufrieden waren – im Vergleich zu 48 Prozent im Vorjahr. 80 Prozent der Kunden würden Infineon weiterempfehlen, ein zufrieden stellendes Ergebnis, das wir auch in Zukunft ausbauen wollen.



Globale Präsenz

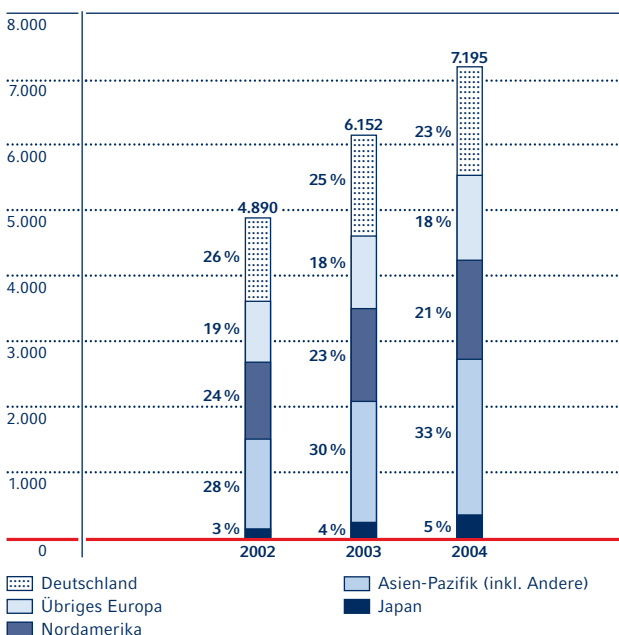
Globale Reichweite, lokale Flexibilität

- Wachstum in allen Regionen
- Starke Präsenz in Nordamerika
- Investition in asiatische Wachstumsmärkte, um Potenzial voll auszuschöpfen

Die Leistungsfähigkeit der Regionen und Werke ist eine der wichtigsten Stärken von Infineon. Bei unseren Entscheidungen orientieren wir uns an den Absatzchancen, der Innovationskraft und den Kostenvorteilen in den jeweiligen Regionen. Infineon ist ein globaler Konzern, getragen von der Flexibilität seiner lokal verankerten Unternehmen. Deshalb siedelt Infineon viele Aufgaben und Kompetenzen vor Ort in den Regionen an. So können wir Änderungen im Marktumfeld rasch erkennen und umgehend auf sie reagieren – ein großer Vorteil im temporeichen Halbleitermarkt.

Der Ausbau von Infineons internationaler Präsenz ist unser erklärtes Ziel. Deshalb weiten wir unsere Aktivitäten in Fokusbörsen wie Nordamerika, China und Japan auch in den kommenden Jahren weiter aus, um Erträge und Umsätze überdurchschnittlich zu steigern.

Umsatz nach Regionen in Mio. €



Europa: starke Stellung verteidigt

Trotz der noch anhaltenden konjunkturellen Schwäche im Vergleich zu Asien und Nordamerika ist Europa weiterhin ein wichtiger Absatzmarkt für Halbleiterprodukte. Infineon ist in Europa und insbesondere in Deutschland stark vertreten. Unsere weit reichende Präsenz konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut nutzen, um unsere Marktposition zu festigen. So stieg der Umsatz in Gesamteuropa um elf Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Damit haben wir im ersten Kalenderhalbjahr 2004 einen Marktanteil von über zehn Prozent erreicht und sind fest als Nummer zwei im europäischen Halbleitermarkt etabliert.

Im portugiesischen Porto haben wir unser Back-End-Werk um ein zweites Modul erweitert, wobei unter anderem das sehr hohe Qualitäts- und Leistungsniveau der bereits bestehenden Produktionsstätte für die Standortentscheidung ausschlaggebend war. Die Bedeutung des Standorts Dresden innerhalb des Konzerns wird auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Hier hat sich, nicht zuletzt auf Grund des Engagements von Infineon, ein international viel beachtetes Kompetenzzentrum für die Halbleitertechnik herausgebildet. Infineon baut zurzeit wegen dieser guten Rahmenbedingungen das dortige Entwicklungszentrum aus. ... Innovationen, S. 24

Nordamerika: Absatzpotenzial realisieren

Nordamerika ist mit seinem im internationalen Vergleich robusten Konsumklima und als Sitz bedeutender Unternehmen der IT-, Automobil- und Telekommunikationsbranche ein Schlüsselmarkt für alle Halbleiterhersteller. Für Infineon bietet Nordamerika darüber hinaus besondere Chancen, da wir unser Absatzpotenzial dort noch nicht voll ausgeschöpft haben. Infineon wird das Engagement in den USA weiter ausbauen, denn hier treffen viele unserer international aufgestellten Kunden ihre Entscheidungen,

ob sie ein Produkt von Infineon für ihre Waren verwenden werden. Diese Entscheidungen haben einen starken Einfluss auf unsere globale Umsatzentwicklung.

Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt: Wir wollen unsere Position im Bereich Automobil- und Industrieelektronik in den nächsten drei Jahren deutlich ausbauen. Zudem erweitern wir unser 200-mm-Modul in Richmond um eine 300-mm-Fertigungslinie. Dadurch werden wir unsere Präsenz in einem der größten und vielversprechendsten Absatzmärkte für Speicherchips ausweiten, um in Zukunft schneller und flexibler auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen zu können. ... *Fertigung, S. 34*

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg unser Umsatz in Nordamerika auf über 1,5 Milliarden Euro, was vor allem auf das Geschäft mit Speicherbausteinen zurückzuführen ist. Damit belegen wir im ersten Kalenderhalbjahr 2004 mit knapp fünf Prozent Marktanteil die Top-3-Position der Halbleiterunternehmen auf dem amerikanischen Markt.

Asien: Standortvorteile für Infineon nutzen

In Asien konnte Infineon seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro steigern und belegt damit im ersten Kalenderhalbjahr 2004 Platz sechs der Halbleiterhersteller mit einem Marktanteil von über drei Prozent. Die Region spielt aus mehreren Gründen eine zunehmend wichtige Rolle für Infineon: Das Wirtschaftswachstum liegt weit über dem Weltdurchschnitt, wodurch Asien zu einem immer interessanteren Absatzmarkt für uns wird. Darüber hinaus stellt Asien verstärkt den Leitmarkt für innovative Trends dar und ist damit richtungweisend für neue Produkte und Funktionalitäten. Zudem hat die Ausbildung in vielen Fällen Weltklasseniveau. Und schließlich liegen hier die Lohn- und Produktionskosten oft deutlich unter europäischem und nordamerikanischem Standard.

Im Wachstumsmarkt China wollen wir das enorme Potenzial ausschöpfen. Langfristige Hochschulkooperationen mit verschiedenen Universitäten wie der Tongji-Universität in Shanghai sollen es uns ermöglichen, die Bedürfnisse des Marktes noch besser zu verstehen und am außerordentlichen Innovationspotenzial Chinas partizipie-

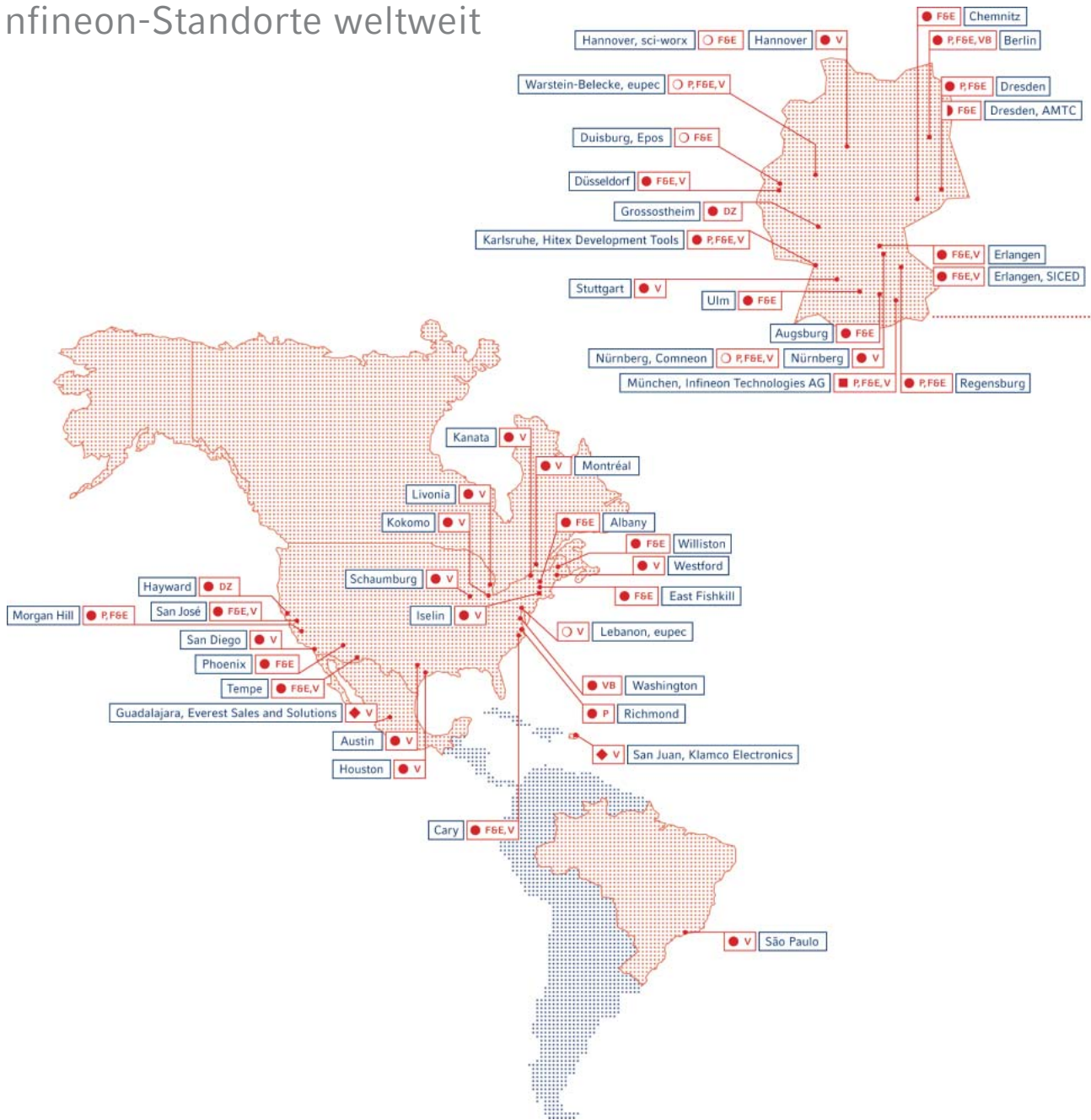
ren zu können. Im Januar 2004 haben wir in Xi'an ein Entwicklungszentrum eröffnet, da die Stadt auf Grund ihrer Lage und ihrer hervorragenden Universitäten Kostenvorteile mit hoher Innovationskraft verbindet. ... *Innovationen, S. 24*

Des Weiteren bauen wir derzeit im indischen Bangalore unser weltweites Kompetenzzentrum für Software-Entwicklung aus. An diesem Standort sind rund 400 Entwickler beschäftigt.

Japan hat sich von seiner lang anhaltenden Wirtschaftskrise erholt. Grundlage für diese positive Entwicklung waren teils drastische Umstrukturierungsmaßnahmen in Wirtschaft und Politik. Weil sich die geschlossenen Strukturen der japanischen Wirtschaft mehr und mehr aufzulösen beginnen, eröffnen sich für ausländische Anbieter lukrative Absatzchancen. Daran wollen wir teilhaben, unter anderem indem wir das Produktangebot von Infineon stärker an die japanischen Anforderungen anpassen und das Vertriebsnetz ausbauen. Ein langfristiges Engagement und der Schwerpunkt auf Qualität sind zentrale Erfolgsfaktoren im japanischen Markt und damit Kernpunkte unseres Handelns. Darüber hinaus treiben wir gezielt Innovationspartnerschaften mit unseren Kunden voran, um so unsere Position im japanischen Markt langfristig zu stärken und gemeinsam mit unseren Kunden von den sich eröffnenden Möglichkeiten zu profitieren. Ziel ist, unseren Marktanteil deutlich zu erhöhen. Mit einer Umsatzsteigerung von 42 Prozent auf 364 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir dabei auf dem richtigen Weg.

Ein globales Netzwerk aus flexiblen und lokal verankerten Unternehmen – an diesem Bild orientieren wir uns auch in Zukunft. Wir werden die Dynamik in den Regionen aufmerksam beobachten und rasch auf Veränderungen reagieren, um Risiken zu vermeiden und frühzeitig neue Chancen einzelner Standorte für Infineon zu nutzen.

Infineon-Standorte weltweit



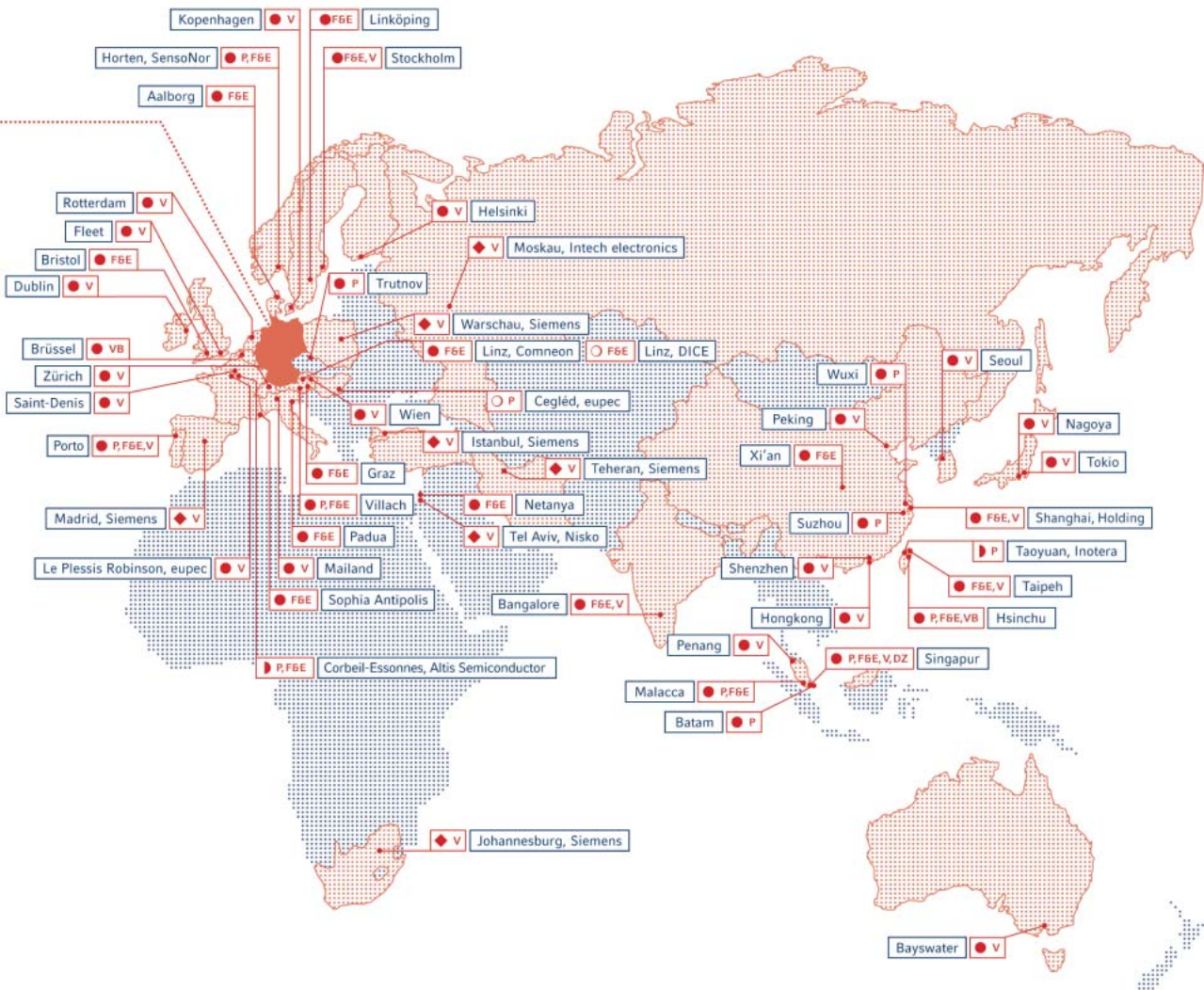
Infineon: Standorte und Vertretungen

Region Nordamerika

Robert LeFort

Leiter Infineon Technologies Nordamerika, Studium der Elektrotechnik, MBA





Region Asien-Pazifik

Loh Kin Wah

Leiter Infineon Technologies Asien-Pazifik, Studium der Verfahrenstechnik



Region Japan

Yasuaki Mori

Leiter Infineon Technologies Japan, Studium der Elektrotechnik, MBA in International Affairs und International Business



Fertigung

Modernste Fertigung mit zukunftsweisenden Technologien

Flexible Kapazitäten in der Fertigung

Überzeugender technologischer Vorsprung

Zügiger Ausbau der Fertigung

In der Phase der Erholung auf dem Halbleitermarkt hat sich Infineons Modell der flexiblen Produktionskapazitäten bewährt. So konnten wir die stark steigende Nachfrage nach Logikprodukten durch kurzfristiges Umstellen von DRAM-Fertigungskapazität zur Zufriedenheit unserer Kunden bewältigen. Diese Flexibilität zeichnet uns gegenüber dem Wettbewerb aus. Infineon kann nicht nur auf seine eigenen Produktionsanlagen zurückgreifen, sondern auch auf ein ganzes Netzwerk von Partnern und Auftragsproduzenten. Deshalb sind wir in der Lage, durch eine geeignete Kombination von Eigen- und Auftragsfertigung auf die Marktverhältnisse zu reagieren. Dies nutzen wir für die Produktion sowohl von Speicher- als auch von Logikprodukten.

Kleinere Strukturen – höhere Produktivität

Unterdessen baut Infineon seine starke Position bei den Fertigungstechnologien weiter aus: Auf dem Weg zu immer kleineren und zugleich höher integrierten Speicherchips haben wir die Hürde zu Strukturbreiten von nur noch 110 Nanometern genommen. Mehr als 80 Prozent unserer Speicherchips wurden Ende des Geschäftsjahrs 2004 in der neuen Technologie hergestellt. Inzwischen liegt die Ausbeute ebenso hoch wie zuvor bei der 140-Nanometer-Technologie – was bei 40 Prozent mehr Chips pro Scheibe einer erheblichen Produktivitätssteigerung gleichkommt.

Ausbau der Fertigungskapazitäten für Speicherprodukte

Angesichts der verstärkten Nachfrage und der fortschreitenden Umstellung von Speicher- auf Logikkapazitäten treibt Infineon nun auch diejenigen Projekte wieder voran, die in den vergangenen Jahren wegen des stagnierenden Marktes zurückgestellt wurden. So wird das Halbleiter-

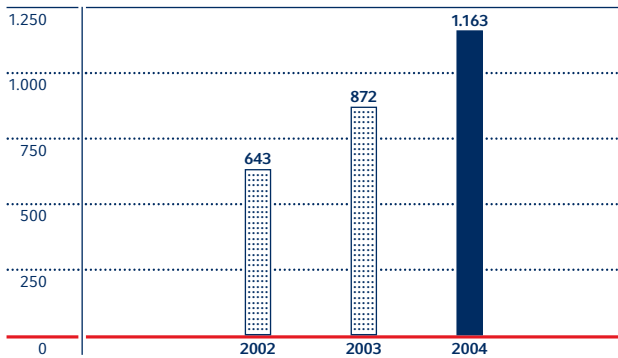
werk in Richmond, USA, ausgebaut und seine Kapazität erhöht. Hier entsteht ein modernes Produktionsmodul für die Fertigung auf 300-Millimeter-Scheiben, das in der zweiten Hälfte 2005 mit der Produktion beginnt. Der Standort soll zukünftig mehr als doppelt so viele Speicherchips wie bisher produzieren können.

Im gemeinsam mit unserem Partner Nanya gegründeten Joint Venture Inotera in Taiwan werden bereits Speicherchips in 110-Nanometer-Technologie produziert. Inotera ist eine der derzeit größten und modernsten 300-Millimeter-Fabriken weltweit und wird Infineons Wettbewerbsposition weiter verbessern.

Um die zusätzlichen Kapazitäten in der Scheibenfertigung weiterverarbeiten zu können, investieren wir in unsere Fabrik im portugiesischen Porto 230 Millionen Euro für den Ausbau unserer Montage- und Testkapazitäten: Hier werden die Siliziumscheiben, die in den Werken Dresden und Richmond produziert werden, in der so genannten Back-End-Fertigung zu Bausteinen und Modulen weiterverarbeitet und geprüft. In Porto können ab Mitte 2006 bis zu 600 Millionen Chips pro Jahr zusätzlich montiert und getestet werden – doppelt so viele wie bisher. China mit seinen wachsenden Märkten und seinen vergleichsweise niedrigen Lohnkosten bietet viele Chancen für Infineon. Aus diesem Grund haben wir im chinesischen Suzhou ein Joint Venture für die Back-End-Produktion von Speicherbausteinen gegründet. Das verbessert unsere Wettbewerbssituation auf dem chinesischen Markt erheblich. ... Globale Präsenz, S. 30

Insgesamt hat Infineon im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 1,2 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Das ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2003 ein Anstieg um 33 Prozent.

Investitionen in Sachanlagen in Mio. €



Starker Partner für die Entwicklung und Produktion im Logikbereich

Mit geeigneten Kooperationen und Partnerschaften festigen wir unsere Position auch auf dem Gebiet der Advanced-Logik-Technologien. So produziert Infineon Produkte in der gemeinsam mit IBM und UMC entwickelten 130-Nanometer-Technologie in unseren Werken in Dresden, bei Altis, unserem Joint Venture mit IBM in Essonnes bei Paris, und bei unserem Partner UMC in Taiwan und Singapur. Außerdem werden bereits erste Muster in unserer fortschrittlichen 90-Nanometer-Logiktechnologie hergestellt.

Der Weg zu noch kleineren Dimensionen und damit sich stetig verbessernder Kostenposition pro integrierter Funktion ist vorgezeichnet: Gemeinsam mit Chartered, Samsung und IBM entwickeln wir in den USA die nächsten Logiktechnologien mit 65- und 45-Nanometer-Strukturbreiten. Um das volle Potenzial dieser Technologien ausschöpfen zu können, planen wir auch hier die Fertigung auf 300-Millimeter-Scheiben. ... Innovationen, S. 24

Im Vergleich zum Wettbewerb ist Infineon besonders gut im Bereich der Leistungshalbleiter positioniert: Im Power-Logic-Cluster, das aus den drei Werken Villach, Regensburg

und Perlach besteht, werden vornehmlich Produkte für die Automobil- und Industrieelektronik gefertigt. Auf diesem Gebiet besitzt Infineon ein hervorragendes Fertigungs-Know-how und äußerst innovative Produkte. Wir nehmen darum in diesem Marktsegment eine Spitzenposition ein.

... Automobil- und Industrieelektronik, S. 20

Kostenvorteil durch Flexibilität

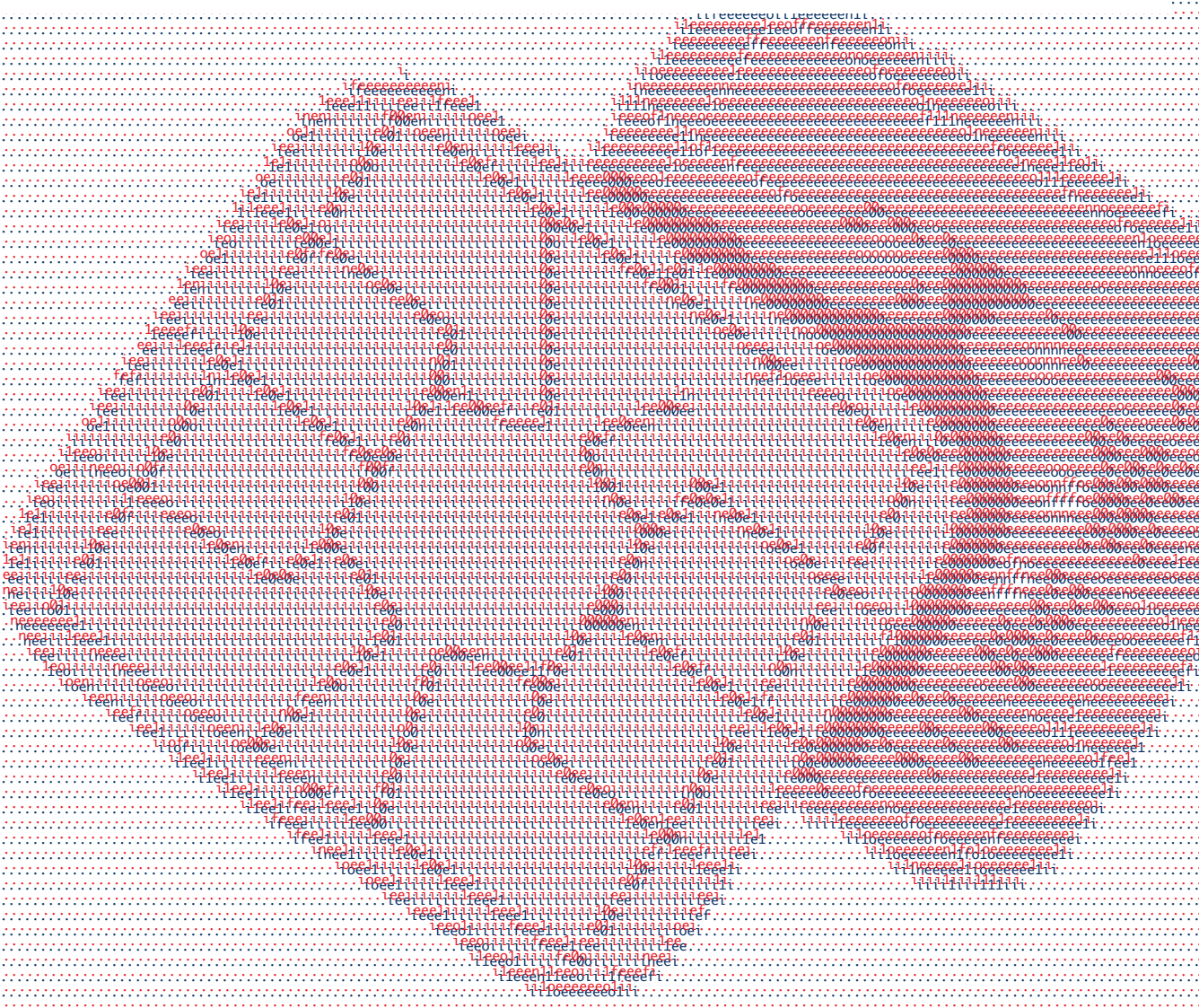
Infineon schöpft große Kostenvorteile aus seiner Strategie der Nachnutzung, dem so genannten Cascading, bei der in derselben Produktionsstätte in zeitlicher Abfolge Speicher-, Logik- und schließlich Power-Logic-Technologien gefertigt werden. Die für die Produktion neuester Speicher- und Logikgenerationen benötigten Maschinen können für die Fertigung von Power-Technologien weiter verwendet werden. Diese Mehrfachnutzung erhöht Infineons Profitabilität, da im Bereich der Power-Logic weniger Investitionen nötig sind. Darüber hinaus hat die gleichzeitige Fertigung von modernsten Speicher- und Logiktechnologien einen entscheidenden Vorteil. Kann im Falle steigender Nachfrage Kapazität schnell von Speicher auf Logik umgestellt werden, so gilt dies natürlich auch im umgekehrten Fall: Um Leerstandskosten zu vermeiden, kann Infineon bei abnehmendem Bedarf an Logikprodukten die Fertigungskapazitäten für die Speicherproduktion verwenden. Dieses Konzept der flexiblen Nutzung ist eine entscheidende Stärke von Infineon und wird durch unsere Entwicklungs- und Produktionsallianzen zusätzlich gestärkt.

Infineon ist im Vergleich zum Markt auch im Geschäftsjahr 2004 überdurchschnittlich gewachsen. Die führende Position in der Fertigungstechnologie ist dabei ein Schlüssel für unseren Erfolg: Sie macht Infineon für Partner attraktiv und ermöglicht eine kostengünstige Entwicklung und Produktion unserer Produkte. Infineon wird diesen Weg auch in Zukunft weitergehen – und seinen Kunden in attraktiven Wachstumsmärkten ein starker Partner sein.

Wussten Sie, dass ...

- ... jedes dritte verkaufte GSM-Mobiltelefon im Jahr 2004 mit Hochfrequenz-Chips von Infineon arbeitet?
- ... Infineon maßgeblich am größten Gesundheitskartenprojekt Asiens beteiligt ist und über die Hälfte der 22 Millionen Chipkarten aller taiwanischen Krankenkassen mit Sicherheitskontrollern ausgerüstet hat?
- ... neue elektronische Personalausweise auf Chipkartenbasis – beispielsweise in Hongkong (6,4 Millionen), Macao (640.000) und dem Sultanat von Oman (1,2 Millionen) – mit Sicherheitscontrollern von Infineon bestückt sind?
- ... jede zweite Chipkarte einen Chip von Infineon beinhaltet?
- ... Infineon im Jahr 2003 die Nummer 3 im Verkauf von Plattformlösungen für chinesische Handy-Hersteller war?

Unser soziales Engagement



Menschen bei Infineon

Wir fördern Teamgeist, Vielfalt und Ergebnisorientierung

Starke Unternehmenskultur und Identifikation mit dem Unternehmen
 Führungsstil geprägt von Zusammenarbeit und Offenheit
 Kontinuierliche Weiterbildung als Motor unserer Unternehmensentwicklung

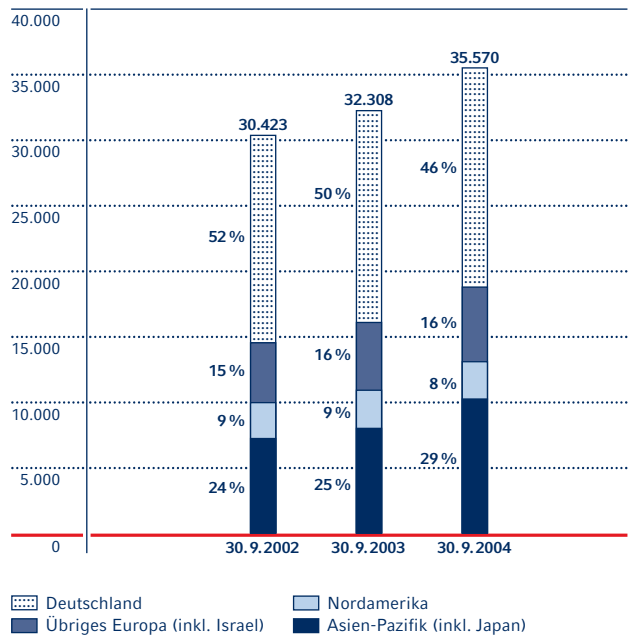
Seit der Unternehmensgründung vor fünf Jahren haben sich bei Infineon eine starke Unternehmenskultur und eine klare Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen herausgebildet, die zum Großteil von unseren gemeinsamen Werten sowie Unternehmensmission und -vision geprägt sind. Die vier Qualitätsmerkmale von Infineon – Innovationskraft (We never stop thinking), Teamgeist (We win together), Exzellenz (We strive for excellence in people and leadership) und Engagement (We act entrepreneurially for the sake of our customers) – sind für jeden Infineon-Mitarbeiter maßgeblich. Unsere Führungskräfte tragen in diesem Zusammenhang eine große Verantwortung: Es ist ihre Aufgabe, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die diese Werte widerspiegelt.

Mitarbeiter der Spitzenklasse einstellen und binden

Wir wollen Infineons Position als Top-Arbeitgeber in der Halbleiter- und Technologiebranche halten und haben uns zum Ziel gesetzt, die besten Mitarbeiter einzustellen und ihre Entwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig fördern wir die Entwicklung einer Unternehmenskultur, die die Vielfalt, das Wissen sowie die Erfahrung und Kreativität unserer Mitarbeiter zur Geltung bringt. Wir stellen Menschen ein, die in ihrem Fachgebiet herausragen, und ermutigen sie, bei uns ihr Potenzial weiter auszuschöpfen. Weil wir auf internationalen Märkten agieren, unsere Kunden welt-

weit angesiedelt sind und wir auf Expertise großen Wert legen, beschäftigen wir zunehmend Mitarbeiter aus unterschiedlichen Nationen. In der Summe stieg im Geschäftsjahr 2004 die Zahl der Infineon-Mitarbeiter von 32.000 auf fast 35.600. ... Globale Präsenz, S. 30

Mitarbeiter in den Regionen



PEOPLE

- Potenzial und Talent des Einzelnen werden in dem richtigen Umfeld gefördert.
- Ein gutes Team lebt von der Vielfalt seiner Mitarbeiter.
- Oberstes Gebot ist, herausragende Mitarbeiter einzustellen und zu binden.
- Programme der Spitzenklasse machen unser Unternehmen kreativ.
- Lebenslanges Lernen fördern und eine effektive Organisation sicherstellen.
- Erfolg basiert auf Flexibilität und Optimierung der Prozesse.

Weltweite Vielfalt fördern

Bei Infineon arbeiten Menschen aus mehr als 80 Nationen, die ihr Wissen untereinander austauschen und so das Unternehmen als Ganzes voranbringen. Häufig finden Universitätsabsolventen durch spezielle Programme für Berufseinsteiger den Weg zu Infineon – dazu gehören unser Doktorandenprogramm und das International Graduate Program, unser Programm für junge Talente, das auch einen Arbeitsaufenthalt an einem der ausländischen Infineon-Standorte einschließt.

Unseren partnerschaftlichen Führungsstil erachten wir als einen wichtigen Beitrag für den Erfolg eines weltweit aktiven Unternehmens. Er ist auf Zusammenarbeit, Offenheit und Vertrauen ausgerichtet und mit effizienten Steuerinstrumenten verbunden. Bei Infineon werden Führungskräfte und Teams zu eigenen Entscheidungen in ihren Arbeitsbereichen ermutigt und befugt, während die oberen Führungskräfte dafür Sorge tragen, dass auch die globalen Unternehmensziele und -prioritäten verfolgt werden.

Umfassende Ausbildungskonzepte helfen neuen Führungskräften, die Fähigkeiten zu erwerben, die sie als Rüstzeug für bevorstehende Aufgaben benötigen. Einsätze im Ausland fördern den Wissensaustausch und erweitern den Horizont der Mitarbeiter, die sich erstmals mit einer fremden Kultur auseinander setzen.

Flexibilität und Optimierung der Prozesse

Als wir 2004 vor der Herausforderung eines starken Nachfrageanstiegs nach Halbleiterprodukten standen, haben wir unsere Einstellungsmaßnahmen schnell und flexibel der benötigten Mitarbeiterstruktur angepasst. Um der Auftragslage gerecht zu werden, haben wir verstärkt auf die Unterstützung von Angestellten mit befristeten Arbeitsverträgen sowie von externen Dienstleistern gesetzt. Dadurch erhalten wir die Flexibilität, unsere Ressourcen gegebenenfalls einer nachlassenden Nachfrage anzupassen – und sichern uns dadurch einen strategischen Wettbewerbsvorteil.

Mit der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden im Geschäftsjahr 2004 gewann das Thema Mitarbeiterführung bei Infineon noch größere Bedeutung. Partnerschaftlicher Führungsstil, Dialogfähigkeit und Zuverlässigkeit

waren nicht nur Tagesordnungspunkte bei den vierteljährlichen Strategietreffen oder auf der Top-Management-Konferenz im Oktober 2004, sie sind im Unternehmen verankert.

Transparente Bewertungsprogramme machen es uns möglich, den Mitarbeitern auf allen Ebenen das entsprechende Feedback für ihre Leistungen zu geben. Darüber hinaus versuchen wir in Umfragen ein Stimmungsbild unserer Mitarbeiter zu einzelnen Programmen oder Entwicklungen einzufangen. Auf diese Weise können wir flexibel handeln und beteiligen unsere Mitarbeiter an den erwünschten Veränderungen.

Lebenslanges Lernen und eine effektive Organisation

Ein dynamisches Geschäftsumfeld verlangt nach ständiger Weiterbildung. Wir bieten eine Vielzahl von Trainings, die unsere Mitarbeiter in den Anforderungen unseres Unternehmens schulen: profitables Wachstum, Kundenorientierung, partnerschaftliche Führung und operative Bestleistung.

Diese Programme sind auf die Fähigkeiten und Leistungen des Einzelnen zugeschnitten; sie reichen von der Weiterbildung im Bereich der technischen Kernkompetenzen und -prozesse bis zur Förderung der Führungs- und Managementqualitäten. Neuen Mitarbeitern zum Beispiel bieten wir eine betriebswirtschaftliche Fortbildung, eine auf ihre zukünftige Tätigkeit zugeschnittene Ausbildung (on the job) und Lehrlingsausbildungen an.

Der Ideenreichtum unserer Mitarbeiter zeigt sich in den Ergebnissen des Ideenmanagement-Programms YIP (Your Idea Pays), und unser jeweiliges Team des Monats

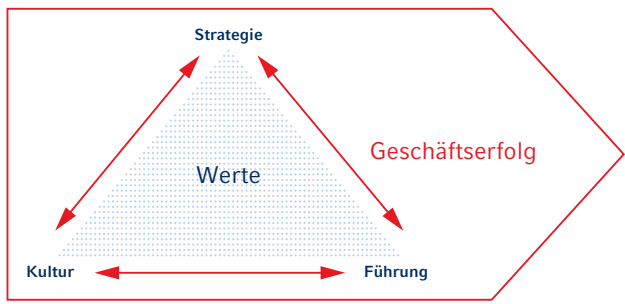
Dr. Thomas Marquardt

Leiter Personalbereich,
Studium der Rechtswissenschaften und
Volkswirtschaftslehre,
Promotion zum Dr.-Jur.



lehrt uns, was guter Gruppenzusammenhalt ist. Mit diesen unternehmensinternen Programmen prämiieren wir herausragende Einzel- oder Teamleistungen. Das große Interesse am YIP-Programm, das vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde, überraschte sogar seine Organisatoren: Die Vielfalt und Qualität der von den Mitarbeitern eingereichten Vorschläge erbrachten im abgelaufenen Geschäftsjahr Einsparungen in Höhe von 146 Millionen Euro. Die realisierten Projekte reichen von Kosten sparenden Prozessverbesserungen in den Fertigungen bis zu Ideen, die gezielt die Kundenzufriedenheit steigern werden. All das beweist uns, dass unsere Mitarbeiter aktiv zum Erfolg „ihres Unternehmens“ beitragen wollen.

Führung und Geschäftserfolg ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Auf Grundlage seiner Werte stimmt Infineon Führung, Kultur und Strategie eng aufeinander ab und schafft damit die Basis für seine Geschäftserfolge. Den Führungskräften kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Eine attraktive Umgebung für individuelles Potenzial

Wir bei Infineon sind davon überzeugt, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter von mehr als nur wettbewerbs- und leistungsorientierten Entlohnungssystemen abhängt. Mindestens genauso wichtig ist es, dem Einzelnen eine für ihn passende Arbeitsumgebung und berufliche Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Diesen Gedanken verfolgen wir auch mit unserem Umzug an den neuen Infineon-Hauptsitz Campeon. Die Bauarbeiten in Neubiberg südlich von München haben im Frühjahr 2004 begonnen und werden voraussichtlich im Herbst 2005 beendet sein. 6.000 Angestellte aus den Geschäftsbereichen und Zentralfunktionen, die zurzeit auf verschiedene Standorte in und um München verteilt sind, werden hier ein gemeinsames Arbeitsumfeld finden. Die Architektur des Gebäudekomplexes erlaubt optimierte Kommunikationswege auf allen Ebenen und zwischen allen Geschäftsfunktionen, ob in den modernen Forschungslabors oder nach der Arbeit bei den diversen Freizeitmöglichkeiten.

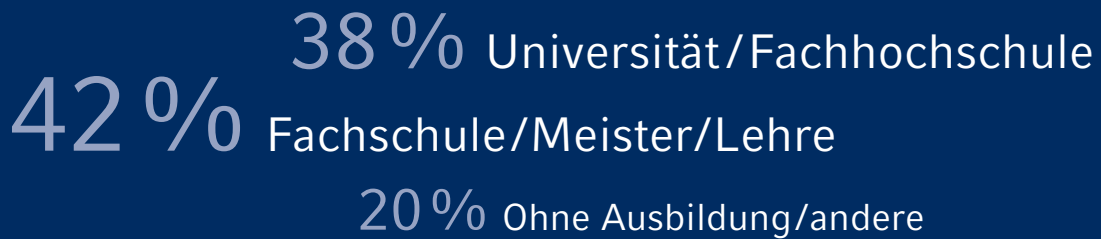
Die Bereitstellung einer attraktiven Arbeitsumgebung kombiniert mit einer starken Unternehmenskultur birgt Vorteile für alle: Unsere Mitarbeiter sind motiviert und engagieren sich für „ihr Unternehmen“, „ihr Team“ und „ihre Kunden“.

Menschen bei Infineon

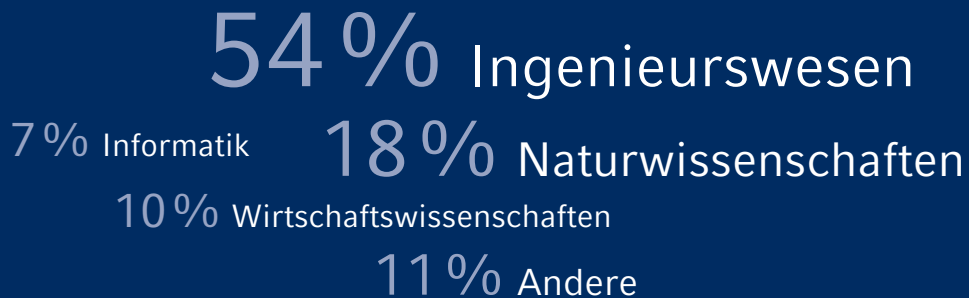
Funktionen:



Qualifikation:



Akademische Berufsrichtung:



Unser Beitrag zur Ökologie

Nachhaltiges Handeln – ein Vorteil für alle

Innovative Produkte sparen Energie
 Reduzierung von PFC-Emission durch Recycling
 Soziale Verantwortung durch persönliches Engagement der Infineon-Mitarbeiter

Unternehmen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen. Infineon orientiert sich dabei an dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit. Die Bandbreite unserer Maßnahmen reicht vom sparsamen Umgang mit den Ressourcen weltweit zum Schutz der Umwelt bis hin zur Unterstützung von lokalen Einzelprojekten.

Einsparpotenziale realisieren

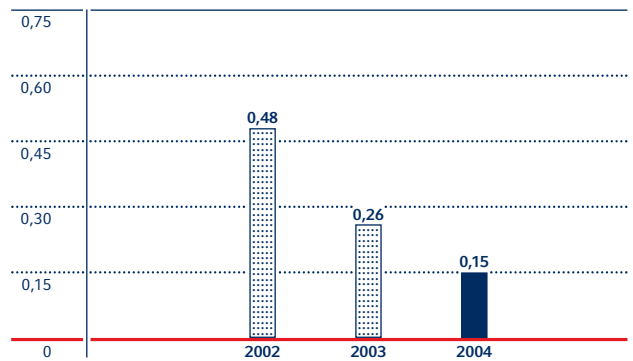
Bei der Herstellung von Halbleitern können Umweltauswirkungen nicht gänzlich vermieden werden. In den vergangenen Jahren haben wir daran gearbeitet, die Emissionen perfluorierter Verbindungen (PFC, perfluorinated compounds), die zum Treibhauseffekt beitragen, zu begrenzen. Unser Ziel ist es, die PFC-Emissionen bis 2010 um zehn Prozent zu senken, bezogen auf das Jahr 1995 und gerechnet in Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten, die als Maßeinheit für den Beitrag einer Substanz zum Treibhauseffekt dienen. Bei den in der Halbleiterindustrie typischen jährlichen Wachstumssteigerungen des weltweiten Produktionsvolumens von 15 Prozent bedeutet dies, dass die PFC-Emissionen im Jahr 2010 um etwa 90 Prozent gegenüber 1995 reduziert werden – wiederum gerechnet in Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten.

Im Geschäftsjahr 2004 ist es uns insbesondere gelungen, an unserem Fertigungsstandort in Villach die chemische Verbindung Schwefelhexafluorid (SF₆) intern zu recyceln. Sie zählt zu den PFCs und wird hauptsächlich als Schutzgas bei Funktionstests von Leistungshalbleiter-Schaltungen verwendet. Ihre Klimawirksamkeit ist um das 23.900fache höher als die von Kohlenstoffdioxid. Durch das Recyceln von SF₆ haben wir uns unserem Ziel, die PFC-Emissionen zu reduzieren, weiter angenähert.

An unserem Dresdner Fertigungsstandort haben wir den Stickstofftrifluorid(NF₃)-Verbrauch beim so genannten Kammerreinigen um mehr als 30 Prozent gesenkt. Wie

SF₆ zählt NF₃ zu den PFCs. Diese Beispiele zeigen, dass Ökonomie und Ökologie eine sinnvolle Einheit bilden können, denn eine Reduzierung von Ressourcen und Emissionen kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern senkt auch die Produktionskosten.

SF₆-Verbrauch in kg pro Arbeitsstunde Test-Equipment



Im Geschäftsjahr 2004 konnte am Standort Villach der SF₆-Verbrauch durch Prozessoptimierung und Recycling weiter gesenkt werden.

Ein weiteres Beispiel ist der Infineon-Standort in Regensburg, der schon zum fünften Mal den Umweltpreis der Stadt erhalten hat. In besonderer Anerkennung der ständigen Bemühungen um den Umweltschutz wurde der Standort im November 2003 außerdem mit der Bayerischen Umweltmedaille ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren konnten in Regensburg durch Maßnahmen zur Ressourcenschonung, wie zum Beispiel Wasserrecycling und Wärmerückgewinnung, beträchtliche Kostenreduzierungen erzielt werden.

Ein gut funktionierendes Umweltmanagementsystem

Infineons Umweltmanagementsystem verankert unser Umweltengagement unternehmensweit. Dieses Managementsystem ist nach EN ISO 14001 zertifiziert und zeigt damit, dass der Schutz der Umwelt einen hohen Stellen-

wert in unserem Unternehmen hat und aktiv gelebt wird. Im Geschäftsjahr 2004 konnte auch unser amerikanischer Standort Richmond erfolgreich in das Infineon-Matrix-zertifikat aufgenommen werden.

Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001 :::::



Wir legen großen Wert darauf, dass auch unsere Kunden die hohen Umweltstandards im Unternehmen wahrnehmen. Gleichzeitig fordern auch unsere Kunden verstärkt die Einhaltung von definierten Umweltstandards bei ihren Lieferanten: So dürfen seit April 2004 nur noch solche Unternehmen den japanischen Konzern Sony beliefern, die von dem Elektronikhersteller als so genannte „Green Partner“ anerkannt sind. Nach einem Umweltaudit hat Sony den Infineon-Standorten in Singapur, Japan, Malaysia und Portugal den Green-Partner-Status verliehen. Von den maximal hundert möglichen Punkten haben wir an unserem Standort in Singapur beispielsweise 98,4 Punkte erreicht.

Produkte mit Spareffekt

Die Einsparung von Energie ist ein wesentlicher Bestandteil von wirksamem Umweltschutz. Infineon entwickelt und liefert auch innovative Lösungen, die weniger Energie verbrauchen oder verbrauchen helfen und damit einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Unsere neuartigen LightMOS-Chips in Leuchtstoffröhren helfen Strom zu sparen. Diese Chips nutzen Strom sehr viel effizienter, so dass der Energiebedarf für die Beleuchtung um bis zu 25 Prozent gesenkt werden kann. Mit der neuen Generation von Mobile-RAMs mit 1,8-V-Stromversorgung kann der Stromverbrauch in tragbaren Geräten wie Handys, digitalen Kameras, MP3-Playern und PDAs um bis zu 80 Prozent reduziert werden.

Einen Rekord im Stromsparen bei Netzteilen stellen die CoolSET-F3-Chips auf. Diese Produkte haben industrieweit die niedrigste Stand-by-Leistungsaufnahme. Sie unterbieten die Spezifikationen des deutschen Blauen Umweltengels und des US-amerikanischen „Energy Star“-Programms. Typische Anwendungsgebiete dieser Chips sind Netzteile für Notebooks und tragbare Elektrogeräte sowie integrierte Stromversorgungen für DVD-Spieler, LCD-Fernseher und digitale Videokameras.

... Automobil- und Industrieelektronik, S. 20

Soziale Verantwortung ernst nehmen

Infineon engagiert sich in einer Vielzahl von Projekten, die über die Sicherheit am Arbeitsplatz und den Umweltschutz hinausgehen. Darüber hinaus machen sich unsere Mitarbeiter für soziale Belange stark oder arbeiten ehrenamtlich in verschiedenen Regionen:

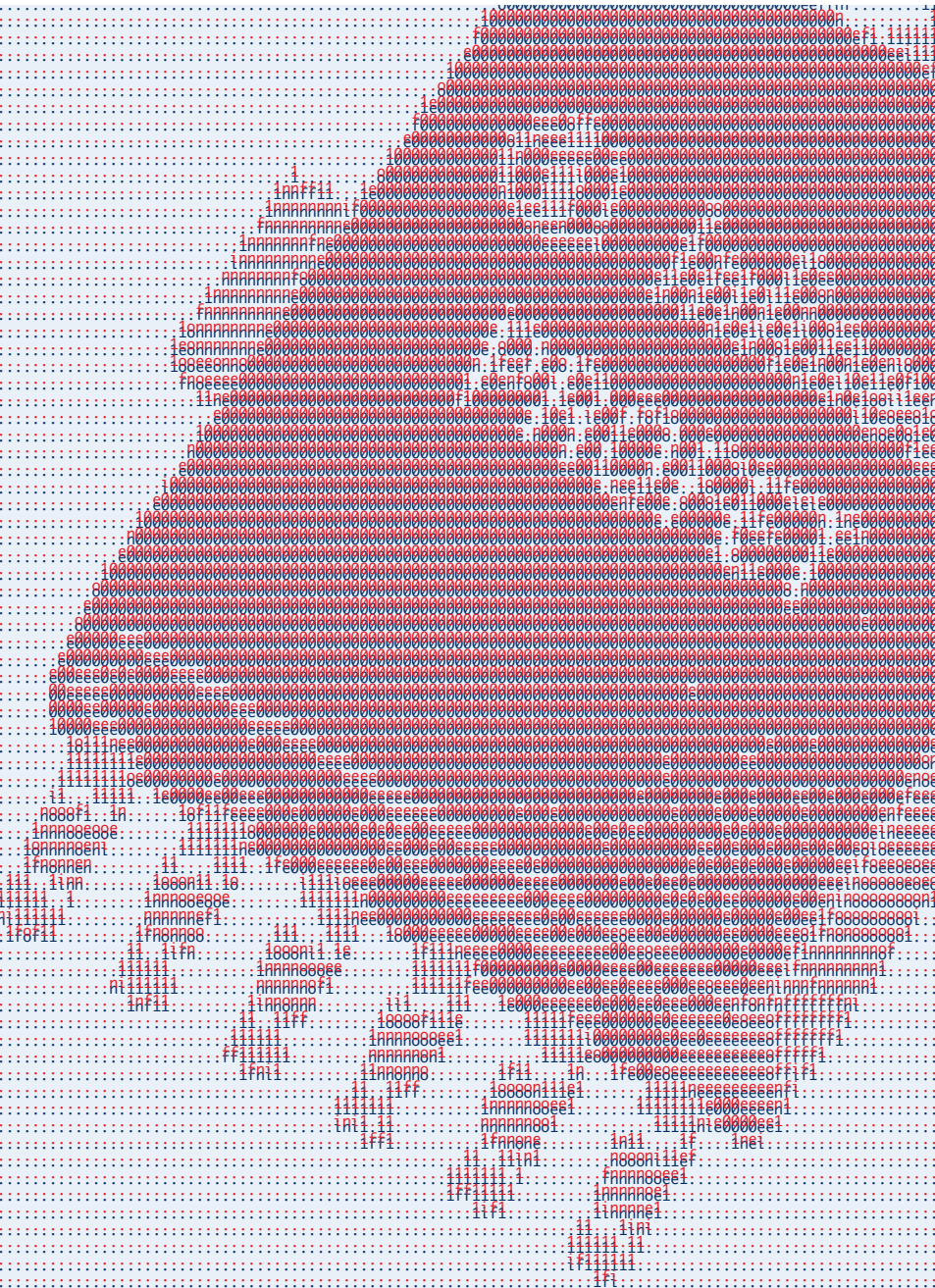
Die Ausbildung von Kindern wird nicht nur ihnen selbst, sondern auch der Gesellschaft langfristig großen Nutzen bringen. Darum organisieren die Mitarbeiter verschiedener Standorte Umwelt- und Gesundheitsprojekte an den Schulen vor Ort. Auch beim Aufbau karitativer Einrichtungen halfen Infineon-Mitarbeiter: Sie unterstützen unter anderem durch ihr Engagement und Spenden die Arbeit von „Educara“, einem Verein, der sich um die Ausbildung von Kindern in einer der ärmsten Regionen Brasiliens kümmert. Educara hat sich Hilfe zur Selbsthilfe zum Ziel gesetzt. Der Verein fördert und fordert frühzeitig begabte Kinder und Jugendliche mit hohem sozialen Verantwortungsbewusstsein, indem er sie motiviert, anderen zu helfen.

Weitere Informationen zu Infineons Umweltengagement sind dem aktuellen Umweltbericht zu entnehmen, der unter anderem konkrete Daten und Fakten zu den einzelnen Produktionsstandorten ausweist. Er kann bei der Infineon Technologies AG angefordert werden.

Wussten Sie, dass ...

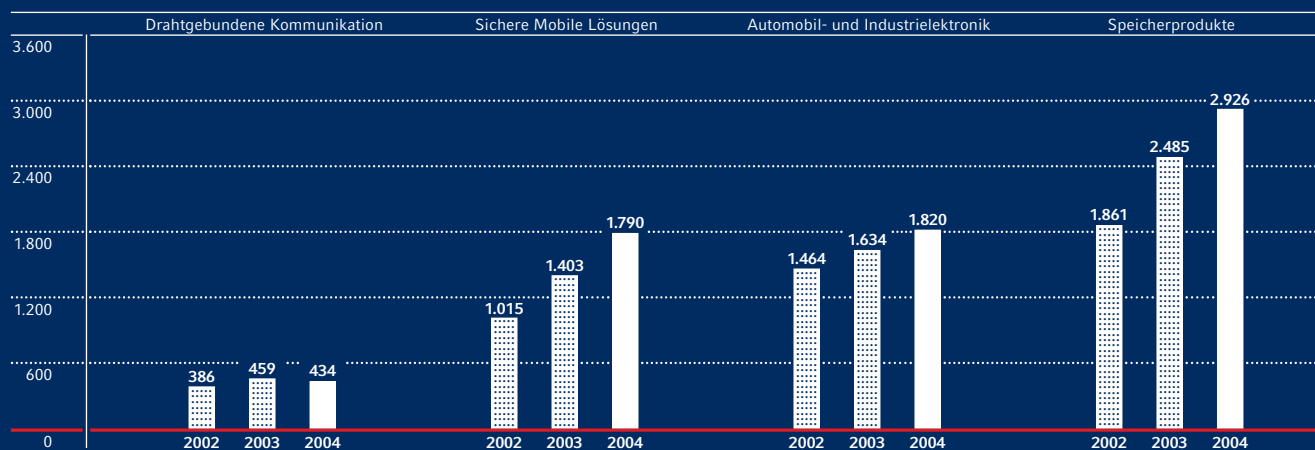
- ... jedes neue Auto, das weltweit vom Band läuft, durchschnittlich rund 20 Chips von Infineon enthält?
- ... in jedem Neuwagen im Durchschnitt zwei Sensoren von Infineon für ABS oder Seiten-Airbag eingebaut sind?
- ... weltweit in jedem dritten Neuwagen die 16-Bit-Mikrokontroller von Infineon mit Echtzeit-Datenverarbeitung für die Motorsteuerung eingesetzt werden?
- ... weltweit in jedem Neuwagen Leistungshalbleiter von Infineon die Stromversorgung steuern – von der Armaturenbrett-Beleuchtung über den Anlasser bis zur Nebelschlussleuchte?
- ... 30 Prozent Energieeinsparungen bei Haushaltsgeräten durch Infineons innovative Leistungshalbleiter möglich werden?

Finanzbericht

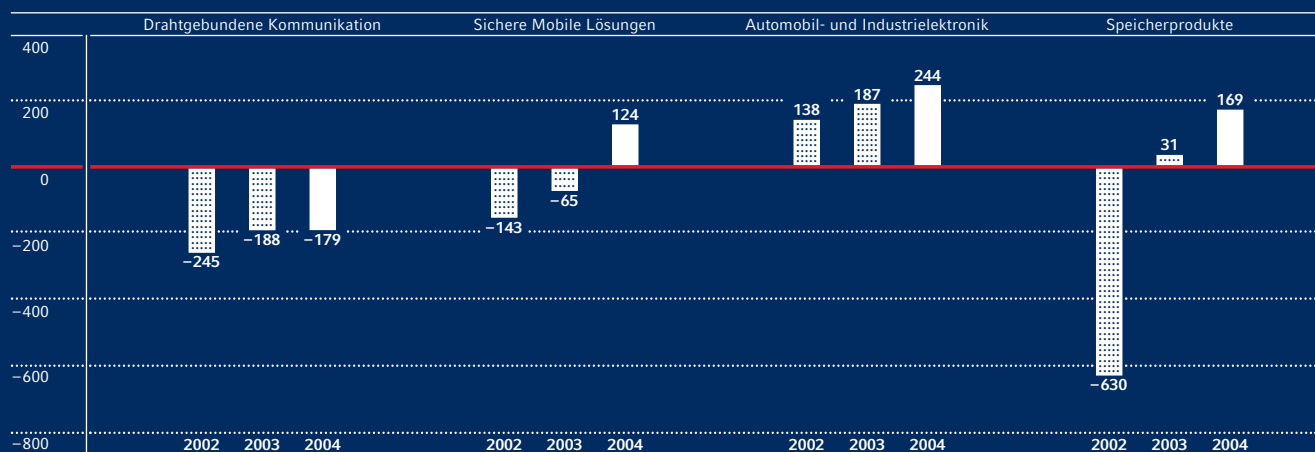


Die Geschäftsbereiche: Umsatzerlöse und Ebit

Umsatzerlöse in Mio. €



Ebit in Mio. €



Inhalt

48 Bericht des Aufsichtsrats	92 Anhang zum Konzernabschluss
52 Corporate Governance	92 Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung
54 Konzernlagebericht	92 Bilanzierung und Bewertung
54 Überblick über das Geschäftsjahr 2004	96 Akquisitionen
56 Unser Geschäft	98 Aufgegebene Geschäfte und Geschäftsanteilsveräußerungen
56 Darstellung der Halbleiterindustrie und der Faktoren mit Einfluss auf unser Geschäft	99 Lizenzerträge
59 Herausforderungen in der Zukunft	99 Zuwendungen der öffentlichen Hand
59 Darstellung des Halbleitermarkts im Geschäftsjahr 2004	99 Zusätzliche Angaben zu betrieblichen Aufwendungen
60 Entwicklung der Ertragslage	100 Umstrukturierungsmaßnahmen
60 Umsatzerlöse	101 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
65 Umsatzkosten – Bruttomarge	103 Ergebnis je Aktie
67 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung	104 Wertpapiere
68 Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	104 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
69 Weitere Bestandteile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung	105 Vorräte
70 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)	105 Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände
71 Zinsergebnis	106 Sachanlagen
72 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	106 Finanzanlagen
72 Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	108 Sonstige Vermögensgegenstände
73 Darstellung der Vermögenslage	109 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
74 Darstellung der Finanzlage	109 Rückstellungen
74 Cash-Flow	109 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
75 Free-Cash-Flow	110 Finanzverbindlichkeiten
75 Netto-Zahlungsmittelbestand	111 Sonstige Verbindlichkeiten
76 Kapitalbedarf	112 Grundkapital
77 Vertragliche Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen	112 Aktienoptionspläne
77 Investitionen	115 Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren
78 Kreditlinien	115 Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung
79 Mitarbeiter und Campeon	116 Verbundene Unternehmen
80 Risiken und Chancen	118 Pensionsverpflichtungen
83 Infineon Technologies AG	121 Derivative Finanzinstrumente
84 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	122 Risiken
84 Ausblick	122 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
85 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	127 Segmentberichterstattung
86 Konzernabschluss	129 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
86 Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen	130 Ergänzende Erläuterungen
87 Konzern-Bilanzen	134 Vorstand und Aufsichtsrat
88 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen	141 Wesentliche Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen
90 Konzern-Kapitalflussrechnungen		

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung



Max Dietrich Kley
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

das vergangene Geschäftsjahr war für Infineon außerordentlich ereignisreich, die Arbeit des Aufsichtsrats und sein Zusammenwirken mit dem Vorstand daher intensiv. In insgesamt sieben Sitzungen im Geschäftsjahr haben wir die Lage des Unternehmens diskutiert und Entscheidungen für die Entwicklung des Unternehmens gefällt.

Nach drei Verlustjahren in Folge konnte Infineon das vergangene Geschäftsjahr positiv abschließen. Obwohl sich die Ertragssituation derzeit verbessert hat, muss sich das Unternehmen weiterhin mit möglichen Überkapazitäten auseinandersetzen. Infineon hat darauf mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, zum Beispiel bei der Vertragsgestaltung mit wichtigen Kunden und durch größere Flexibilität bei der Chipfertigung. Ziel muss sein, auch in Phasen des Abschwungs profitabel zu bleiben. Mit dem Vorstand sind wir uns dabei einig, gerade in den ertragsstärkeren Jahren die entsprechende Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Das vom Vorstand beschlossene „Smart Savings“-Programm ist in diesem Zusammenhang zu sehen.

Aus der Aufsichtsratsarbeit möchte ich besonders erwähnen:

- ::: Wir haben uns umfassend und fortlaufend über das US-Kartellverfahren sowie die damit zusammenhängenden Sammelklagen wegen angeblicher verbotener Preisabsprachen informieren lassen, unter anderem in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung im Januar 2004. Schließlich haben wir die Entscheidung des Unternehmens, mit den Kartellbehörden zu kooperieren und dabei auch eine erhebliche Geldbuße zu akzeptieren, zusammen mit den möglichen Alternativen umfassend mit dem Vorstand erörtert und tragen sie mit. Wir begrüßen, dass es dem Unternehmen gelungen ist, in sehr kurzer Zeit gütliche Vereinbarungen mit seinen wichtigsten Kunden über die Folgen der behaupteten Kartellrechtsverstöße zu schließen.
- ::: Im März 2004 legte Herr Dr. Schumacher sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft nieder. Der Aufsichtsrat hat diesem Schritt nach intensiver Diskussion zugestimmt und seinen Vorsitzenden zur Stärkung der Unternehmensführung für eine Übergangszeit in den Vorstand entsandt. Die Aufgabe für diese Übergangszeit bestand vor allem

2 / 4

darin, die Zuversicht der Mitarbeiter und die Motivation zu stärken durch Teilnahme an Belegschaftsversammlungen, Gespräche mit den Mitarbeitervertretungen, Besuche bei den wesentlichen Fabrikationsstandorten und Besuche und Gespräche bei unseren wichtigen Partnern. Darüber hinaus hat der Vorstand unter meiner Leitung die notwendigen Korrekturen in organisatorischen und finanziellen Fragen rasch und effizient umgesetzt. In erfreulich kurzer Zeit gelang es, mit Herrn Dr. Wolfgang Ziebart einen neuen Vorsitzenden des Vorstands zu finden und im Mai 2004 zu bestellen. Herr Dr. Ziebart hat sein Amt im Unternehmen vereinbarungsgemäß am 1. September 2004 angetreten.

::: Intensiv haben wir uns zusammen mit dem Vorstand mit der Strategie des Unternehmens befasst. Innovation ist für das Unternehmen von ausschlaggebender Bedeutung. Zur Unterstützung und Umsetzung der Strategien haben wir deshalb erstmals einen Strategie- und Technologieausschuss des Aufsichtsrats eingerichtet.

Außerdem hat der Vorstand den Aufsichtsrat im Rahmen der jeweiligen ordentlichen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert und ausführliche Quartalsberichte vorgelegt. Der Vorstand hat auch schriftlich und mündlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet. Davon abgesehen hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten lassen.

Schließlich haben wir uns auch dem Thema Corporate Governance gewidmet. So hat der Aufsichtsrat Herrn Kley als „Financial Expert“ gemäß den Bestimmungen des US-amerikanischen „Sarbanes Oxley Act“ benannt. Die Entsprechenserklärung 2004 gemäß § 161 Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat im November 2004 beschlossen; sie ist auf Seite 53 des Geschäftsberichts abgedruckt. Auf Seite 52 des Geschäftsberichts ist das Infineon-Corporate-Governance-System detailliert beschrieben.

Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse

Im Berichtsjahr fanden sieben Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden im Berichtsjahr sowohl in Sitzungen als auch im Umlaufverfahren gefasst. Ein Mitglied des Aufsichtsrats hat bei mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils entschuldigt gefehlt.

Der Präsidialausschuss hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abgehalten und verschiedene Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr fünfmal getagt und einen Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die Prüfung der Zwischenabschlüsse, die Vorprüfung des Jahresabschlusses, die Erörterung des

3/4

Prüfungsberichts mit dem Wirtschaftsprüfer, die Prüfung der Finanz- und Investitionsplanung, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und die Erörterung von größeren Desinvestitionen und Investitionen. Dies waren der Verkauf unseres Faseroptik-Geschäfts an die Finisar Corporation, Sunnyvale, USA, gegen Gewährung von deren Aktien, die Ausübung einer Option für den Kauf der Minderheitsbeteiligung der bisherigen Mitgesellschafter an unserer 300-Millimeter-Fertigungsgesellschaft in Dresden sowie der weitere Ausbau unserer Front-End-Fabrik in Richmond, USA.

Der im Berichtsjahr neu gebildete Strategie- und Technologieausschuss hat bereits zweimal getagt. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die Erörterung von strategischen Grundsatzfragen mit dem Vorstand, insbesondere der Notwendigkeit von Anpassungen bei der „Agenda 5 zu 1“.

Der gemäß § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss musste nicht tätig werden.

Jahres- und Konzernabschluss

Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, hat den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG zum 30. September 2004, den nach den Vorschriften der US-GAAP unter Anwendung der Befreiungsvorschrift des § 292a HGB aufgestellten Konzernabschluss zum 30. September 2004 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Infineon Technologies AG und des Infineon-Konzerns geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Diese Unterlagen haben wir auch selbst geprüft.

Die Berichte der KPMG über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden zunächst in der Sitzung des Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschusses am 8. November 2004 und dann in unserer Bilanzsitzung am 23. November 2004 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wir hatten keine Einwendungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Besetzung des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr hat es verschiedene Veränderungen im Aufsichtsrat gegeben: Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 20. Januar 2004 haben die neuen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ihre Mandate angetreten. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Herren Eibl, Luschnitz, Ruth und Schmidt. Neu gewählt wurden Frau Kerstin Schulzendorf und Herr Jakob Hauser als Vertreter der nicht-leitenden Angestellten und die Herren Dieter Scheitor und Alexander Trüby als Vertreter der Gewerkschaften.

4/4

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind Frau Beyhan und die Herren Dechant, Hawreliuk und Müller. Am 29. Februar 2004 ist Herr Midunsky aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. An seine Stelle rückte der von der Hauptversammlung als Ersatzmitglied gewählte Herr Günther Fritsch. Der Aufsichtsrat hat allen Ausgeschiedenen für ihre engagierte Mitarbeit gedankt.

In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 20. Januar 2004 wurde Herr Klaus Luschtinetz zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Mit Wirkung zum 25. März 2004 ist Herr Kley vom Aufsichtsrat gemäß § 105 Absatz 2 Aktiengesetz für eine Übergangszeit zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt worden. Herr Kley hat diese Aufgaben vom Ausscheiden Dr. Schumachers bis zum 1. September 2004 wahrgenommen. Während dieser Zeit ruhte das Aufsichtsratsmandat von Herrn Kley; er wurde in dieser Zeit im Vorsitz von Herrn Luschtinetz vertreten.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Infineon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistung im Geschäftsjahr 2004. Auch allen Betriebsräten gilt der Dank des Aufsichtsrats für ihre konstruktive Mitarbeit.

München, im November 2004

Für den Aufsichtsrat



Max Dietrich Kley
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Corporate Governance

Unser ganzheitliches Konzept

Ganzheitliches Konzept zur Umsetzung der unternehmerischen Ziele und Erfassung aller unternehmerischen Prozesse
 Eigener Infineon-Kodex
 Corporate-Governance-Beauftragter berichtet direkt an Vorstand und Aufsichtsrat

Corporate Governance – das sind Standards guter und verantwortlicher Unternehmensführung. Unser Corporate-Governance-System umfasst das gesamte Unternehmen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Infineon verstehen unter Corporate Governance ein ganzheitliches Konzept, das alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele einschließt, die unserem unternehmerischen Auftrag dienen. Es umfasst die Standards des internen Controllings, die „Business Conduct Guidelines“ (Leitlinien für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb), die Regelungen, die die Organisations- und Aufsichtspflichten des Unternehmens betreffen, und einen Corporate-Governance-Beauftragten, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Ein besonders wesentliches Element des Konzepts ist unser Infineon-Corporate-Governance-Kodex.

Auf dieser Grundlage wollen wir die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben – und zu den Unternehmen mit der besten Corporate Governance gehören.

Infineon hält hohe Standards ein

Infineon hat fast alle Regelungen übernommen, die die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ empfiehlt oder anregt, außerdem entsprechen wir den Vorgaben des US-amerikanischen Kapitalmarktrechts. So haben wir zum Beispiel in der Directors- und Officers-Versicherung einen Selbstbehalt der Mitglieder des Vorstands von 25 Prozent und des Aufsichtsrats von 100 Prozent des jeweiligen Jahresfixums vereinbart.

Infineon hat sich über die Regelungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ hinaus zusätzliche Ziele hinsichtlich guter Unternehmensleitung und -kontrolle gesteckt:

::: Wir werden unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit weiterhin umfassend und offen über das Unternehmen informieren.

- ::: Wir wollen die Aktionäre bei der Ausübung ihrer Rechte so weit wie möglich unterstützen. Die Aktionäre können sich zum Beispiel online zur Hauptversammlung anmelden, über das Internet an Abstimmungen teilnehmen oder die Generaldebatte im Internet verfolgen.
- ::: Wir werden die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat noch weiter stärken. Um unsere Ziele zu erreichen, wollen wir das positive Klima offener und respektvoller Gespräche weiter fördern.
- ::: Die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden ist nur mit fähigen und engagierten Mitarbeitern möglich. Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als gemeinsame Aufgabe an, die größten Talente für das Unternehmen zu gewinnen und zu halten.

Ständige Überprüfung des Regelwerks

Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte sorgen dafür, dass unser Corporate-Governance-Regelwerk aktiv im Unternehmen gelebt wird. Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt. So haben wir im Herbst 2004 erneut geprüft, ob wir die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats jeweils individuell angeben wollen. In der Öffentlichkeit wurde dies immer wieder gefordert. Unsere Prüfung hat ergeben:

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats geben wir nunmehr individualisiert an. Diese Vergütung bestimmen kraft Gesetzes die Aktionäre; sie haben die Vergütungsregelung in § 11 unserer Satzung in der Hauptversammlung beschlossen. Unsere Satzung finden Sie im Internet unter www.infineon.com, „Company Information“.

Für den Vorstand gilt: Nach zwingendem deutschem Aktienrecht ist der Vorstand insgesamt für die wertschaffende Führung des Unternehmens verantwortlich. Auch nach der Geschäftsordnung des Infineon-Vorstands leiten alle Mitglieder das Unternehmen gemeinsam. Alle wesentlichen Entscheidungen müssen im Gesamtvorstand getroffen werden. Selbstver-

ständig informieren wir unsere Aktionäre über die Struktur der Vorstandsvergütung und geben die Gesamtvergütung des Vorstands, getrennt nach Fixum, erfolgsabhängigen Komponenten und Aktienoptionen, an, so dass jeder Aktionär erkennen kann, wie sich die Leistung des Vorstands insgesamt auf dessen Gehalt auswirkt. In einer individualisierten Angabe der Vergütung können wir keinen so großen Informationsgewinn erkennen, dass die Verletzung der Privatsphäre der Mitglieder des Vorstands gerechtfertigt wäre. Bisher geht auch der Gesetzgeber davon aus, dass der Ausweis der individuellen Vergütung in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen eingreift und diese Informationen dem Datenschutz unterliegen. Dies gilt besonders für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder, die an einem Beschluss zur Offenlegung nicht beteiligt wären. Allerdings hat Herr Kley, der das Unternehmen von der Niederlegung des Vorstandsamts durch Herrn Dr. Schumacher bis zur Übernahme dieser Aufgabe durch Herrn Dr. Ziebart geleitet hat, im Hinblick auf die außerordentliche Situation die Offenlegung seiner Vergütung beschlossen. ... Vorstand und Aufsichtsrat, S. 134

Das Gesamteinkommen der Vorstandsmitglieder setzt sich zusammen aus dem Jahreseinkommen (Barvergütung), aus Aktienoptionen und aus einkommenswirksamen Nebenleistungen. Das Jahreseinkommen besteht

- ::: aus einem festen Jahresgrundgehalt, das – nach Abzug der gesetzlichen Abgaben – teils monatlich anteilig, teils am Ende des Geschäftsjahrs ausgezahlt wird, und
- ::: aus dem Jahresbonus als variabler erfolgsabhängiger Komponente. Im Geschäftsjahr 2004 war der Jahresbonus an die Gesamtkapitalrendite, die wir als Geschäftsergebnis nach Steuern, bereinigt um Sondereffekte, im Verhältnis zum eingesetzten Kapital definieren, gekoppelt. Dadurch wird sichergestellt, dass ein Bonus nur bei positivem Geschäftsverlauf verdient wird. Der Jahresbonus wird nach Geschäftsjahresende ausgezahlt.

Als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter erhalten die Vorstandsmitglieder Optionen auf Aktien der Infineon Technologies AG aus dem Aktienoptionsplan 2001. Hinzu kommen Nebenleistungen, zum Beispiel für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ein Dienstwagen mit Fahrer auch zur privaten Nutzung.

Eine Komponente der Vergütung unserer Führungskräfte ist unser Aktienoptionsplan 2001, den Sie im Volltext ebenfalls im Internet unter www.infineon.com einsehen können und dessen Grundzüge wir dort erläutern. Dieser erlaubt die Ausgabe von Optionen an Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen. Wir brauchen dieses Instrument, um auch in Zukunft Talente für uns gewinnen und halten zu können. Sie sind eine Garantie für unseren Erfolg in einem wettbewerbsintensiven und technologiegetriebenen Umfeld. In der Hauptversammlung 2001 haben unsere Aktionäre als Ausübungsbedingung und -preis eine Wertsteigerung des Aktienkurses von mindestens fünf Prozent während der Laufzeit der Optionen festgelegt. Da unsere Wettbewerber, die alle ihren Sitz im Ausland haben, oft keine Erfolgshürde vorsehen oder sogar Optionen zu einem Kurs unter dem aktuellen Börsenkurs ihrer Aktien ausgeben, halten wir unseren Aktienoptionsplan im Vergleich dazu für anspruchsvoll, da er an für uns relevante Vergleichsparameter geknüpft ist.

Über das Corporate-Governance-System von Infineon informieren wir Sie auf unseren Internet-Seiten www.infineon.com, „Investor Information“ und in der Hauptversammlung am 25. Januar 2005.

Entsprechenserklärung 2004 gem. § 161 Aktiengesetz

„Die Infineon Technologies AG hat seit Abgabe der letzten Erklärung gem. § 161 Aktiengesetz allen Empfehlungen der Regierungskommission ‚Deutscher Corporate Governance Kodex‘ (Fassung 21. Mai 2003) mit folgenden Ausnahmen entsprochen und entspricht ihnen auch weiterhin:

- ::: Wir verzichten auf die individualisierte Angabe der Vergütung aller Mitglieder des Vorstands (Ziffer 4.2.4).
- ::: Die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands (Ziffer 4.2.2) wird im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats beraten und beschlossen.“

Weitere Informationen zur Corporate Governance in der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse finden Sie im Geschäftsbericht im Bericht des Aufsichtsrats. Unser Risikomanagement stellen wir unter „Risiken und Chancen“ vor. Eine detaillierte Erläuterung der Regeln unserer Konzernrechnung finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss.

... Bericht des Aufsichtsrats, S. 48; ... Risiken und Chancen, S. 80;
... Anhang zum Konzernabschluss, S. 92

Konzernlagebericht

Wichtiger Hinweis

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) sollte im Kontext mit den geprüften Konzernfinanzdaten und den Konzernanhangsangaben, die an anderer Stelle stehen, gelesen werden. Die geprüften Konzernabschlüsse basieren auf einer Reihe von Annahmen, die detaillierter in den Konzernanhangsangaben Nr. 1 (Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung) und Nr. 2 (Bilanzierung und Bewertung) dargestellt sind.

Da die Infineon Technologies AG (Infineon oder die Gesellschaft) Teil des konzernweiten Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Marketingnetzwerks ist, wird der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Dieser Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen; Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Planungen, Annahmen und Schätzungen beruhen. Zukunftsaussagen sind immer nur für den Zeitpunkt gültig, an dem sie gemacht werden. Infineon übernimmt keine Verpflichtung, diese beim Auftreten neuer Informationen zu überarbeiten. Zukunftsaussagen unterliegen immer Risiken und Unsicherheiten. Wir möchten Sie diesbezüglich deutlich darauf hinweisen, dass eine Reihe von Faktoren die tatsächlichen Ergebnisse dahingehend beeinflussen können, dass diese von den prognostizierten wesentlich abweichen. Einige dieser Faktoren sind im Abschnitt Risikofaktoren und in weiteren Teilen dieses Berichts beschrieben.

Grafiken und Schaubilder einschließlich der Kommentierung dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil des Lageberichts.

Überblick über das Geschäftsjahr 2004

Im Geschäftsjahr 2004 entwickelte sich die Weltwirtschaft besser als im Vorjahr, und der Halbleitermarkt erlebte eine Wachstumsphase. Wir erreichten im Geschäftsjahr 2004, vorwiegend auf Grund einer gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten, insbesondere im Bereich DRAM-Speicherprodukte eine zweistellige Zuwachsrate bei den Umsatzerlösen. Wir erhöhten die Bruttomarge durch Senkung der Stückkosten, indem wir sowohl zusätzliche Produktionskapazitäten auf unsere 300-Millimeter-DRAM-Fertigung und 110-Nanometer-Technologie verlagerten als auch die Auslastung unserer Produktionsanlagen gesteigert haben. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr die Gewinnzone erreicht, obwohl wir erhebliche Belastungen im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Ermittlungen und den damit verbundenen Forderungen sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen verkraften mussten. Die wesentlichen Entwicklungen im Geschäftsjahr 2004 waren:

- ::: Die Umsatzerlöse stiegen um 17 Prozent. Unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich von einem Verlust von 299 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2003 auf ein positives Ebit von 256 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004.
- ::: Infineon hat sich im ersten Halbjahr 2004 unter den weltweit größten Halbleiterherstellern mit einem Marktanteil von vier Prozent von Rang sieben im Vorjahr auf Rang fünf verbessert. Das Ranking basiert auf Umsätzen und wurde von IC Insights, einem weltweit führenden Marktforschungsinstitut, durchgeführt.
- ::: Im Geschäftsjahr 2004 konnten wir unseren Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von 731 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2003 auf 1.857 Millionen Euro erheblich verbessern. Dies verdanken wir vor allem dem verbesserten operativen Ergebnis und dem aktiven Cash-Management.

- ::: Wir haben weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Bedeutende Erfolge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind:
 - ::: Einführung der nächsten Generation der GOLDMOS®-Technologie und RF-Leistungstransistoren, optimiert im Leistungsmerkmal Linearität;
 - ::: Vorstellung des weltweit ersten Magneto-resistiv 16-Mbit-RAM(MRAM)-Prototyps zusammen mit IBM;
 - ::: Einführung der neuen CoolSET-Leistungshalbleiterfamilie, die sich durch die branchenweit niedrigste Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb auszeichnet;
 - ::: Vorstellung eines auf Kohlenstoff-Nanoröhrchen basierenden Transistors im Leistungshalbleiterbereich.
- ::: Im April 2004 haben wir den taiwanischen Chipdesigner ADMtek Inc., Hsinchu, Taiwan (ADMtek) übernommen. ADMtek wird ein komplettes IC-Lösungspaket zur Vervollständigung unseres Portfolios der Breitband-Access-Produkte für Zentralstellen mit komplexen Multimedia-Schnittstellen-Lösungen für Teilnehmeranschlusseinrichtungen anbieten.
- ::: Wir haben den Verkauf unseres Glasfaserkomponentengeschäfts (ein Teil unseres Segments Drahtgebundene Kommunikation) an die Finisar Corporation vereinbart. Mit unserem Glasfaserkomponentengeschäft übertragen wir Entwicklungs-, Produktions- und zugehörige Marketingaktivitäten an Finisar sowie ungefähr 1.200 Mitarbeiter. Mit Abschluss der Transaktion erwarten wir einen Anteil von 33 Prozent an Finisar zu halten, das mit diesem strategischen Zusammenschluss zu einem der größten auf optische Komponenten spezialisierten Unternehmen der Welt wird.
- ::: Erfolge im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, Produktionsprozesse zu verbessern und unsere Produktionsleistungsfähigkeit zu erhöhen, sind:
 - ::: erfolgreicher Transfer unserer leistungsfähigen Prozesstechnologie für die Herstellung von Logikchip-Produkten auf der Basis von 130-Nanometer-Strukturen an verschiedene Fertigungsstätten zur Erhöhung unserer Produktionsflexibilität;
 - ::: im Bereich der Speicher-Prozesstechnologien haben wir erfolgreich die 110-Nanometer-Prozesstechnologie für DRAM-Produkte in unseren 200-Millimeter- und 300-Millimeter-Fertigungsstätten hochgefahren;
 - ::: Erweiterung unserer Fertigungsstätte für Montage und Test (Back-End) von Speicherchips in Porto, Portugal;
- ::: Erweiterung der Kooperation mit dem Auftragshersteller Winbond und Transfer der 90-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie und des Know-hows für die 300-Millimeter-Fertigung an Winbond im Austausch einer Erweiterung der Auftragsherstellungskapazität;
- ::: Wiederaufnahme der Erweiterung eigener Fertigungskapazitäten in Richmond/Virginia, USA, durch den Bau einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte;
- ::: Fertigstellung einer Fertigungsstätte zur Montage und zum Test (Back-End) in China, deren Start der Volumenproduktion in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2005 erwartet wird;
- ::: Abschluss des Ausbaus der Fertigungsstätte auf 300-Millimeter-Technologie unseres Gemeinschaftsunternehmens Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan (Inotera); die Volumenproduktion ist angelaufen.
- ::: Im September 2004 erreichten wir eine Einigung mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit laufenden kartellrechtlichen Ermittlungen und damit in Zusammenhang stehenden Forderungen einiger unserer größten OEM(Original Equipment Manufacturer)-Kunden. Ähnliche Untersuchungen laufen in Europa und Kanada. Für diese Einigungen und Untersuchungen sind im Geschäftsjahr 2004 Aufwendungen in Höhe von 209 Millionen Euro angefallen.
- ::: Im Geschäftsjahr 2004 haben wir Wertberichtigungen in Höhe von 136 Millionen Euro auf unsere Beteiligungen vorgenommen, im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Catamaran Communications Inc. (Catamaran) im Geschäftsjahr 2001 und der Entscheidung, die Venture-Aktivitäten der Gesellschaft nicht weiterzuführen.
- ::: Im September 2004 hießen wir Dr. Wolfgang Ziebart als unseren neuen Vorstandsvorsitzenden willkommen.

Unser Geschäft

Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten, eingesetzt. Unser Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Unsere Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Gesellschaft ist schwerpunktmäßig in vier Geschäftsbereichen tätig, die eine Reihe von Märkten der Halbleiterbranche beliefern:

- ::: Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Glasfaserbauteile für Kommunikationsanwendungen, WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und Carrier-Access (Breitband und traditionelle Zugänge), des drahtgebundenen Kommunikationsmarkts. Wir haben eine Vereinbarung zum Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts aus diesem Segment an die Finisar Corporation abgeschlossen.
- ::: Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt ein breites Spektrum von Bausteinen für drahtlose Anwendungen, Sicherheitskontrollbausteine, Sicherheitsspeicherbausteine und andere Halbleiterprodukte sowie komplette Systemlösungen für drahtlose und Sicherheitsanwendungen.
- ::: Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.
- ::: Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Konfigurationen und Gehäusen bzw. Architekturen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in Standard-, speziellen und eingebetteten Speicheranwendungen.

Wir führen aus Berichtsgründen zwei weitere Segmente auf: Sonstige Geschäftsbereiche umfasst verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften wie auch andere Geschäftsaktivitäten. Konzernfunktionen erfasst die Positionen, die nicht den anderen Geschäftsbereichen zugerechnet werden können, wie bestimmte Kosten der Konzernzentrale, strategische Investitionen, nicht verrechnete Leerkosten, Restrukturierungskosten und zentrale IT-Entwicklungskosten.

Darstellung der Halbleiterindustrie und der Faktoren mit Einfluss auf unser Geschäft

Unser Geschäft und die Halbleiterindustrie sind durch eine hohe Zyklizität gekennzeichnet. Charakteristisch sind konstante und rapide technologische Veränderungen, schnelle Produktveralterung und Preiserosion, die kontinuierliche Entstehung neuer Standards, kurze Produktlebenszyklen und starke Schwankungen bezüglich des Produktangebots und der -nachfrage. Obwohl diese Faktoren alle Segmente unseres Geschäfts beeinflussen, treffen sie in besonderem Maße auf das Segment der Speicherprodukte zu und haben den geringsten Einfluss auf den Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik.

Zyklizität

Die Zyklizität in der Halbleiterindustrie entspringt einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren, wie insbesondere der fluktuierenden Nachfrage nach Endprodukten, die Halbleiter nutzen, als auch den Schwankungen in der zur Verfügung stehenden Kapazität zur Herstellung von Halbleitern. Diese Zyklizität ist im Bereich der DRAM-Speicherprodukte besonders ausgeprägt. Weil sich Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Halbleiterfertigungsstätten über mehrere Jahre hinziehen können, neigen Halbleiterhersteller zu Investitionen während Zeiten günstiger Marktbedingungen, um so die Reaktion auf mögliche zukünftige Nachfragesteigerungen zu antizipieren. Neuerrichtungen nehmen tendenziell ihren Betrieb gleichzeitig auf und weiten das Angebot an Chips auf dem Markt beträchtlich aus. Ohne anhaltendes Nachfragewachstum führt dieses Verhalten typischerweise zu Überkapazitäten in der Produktion und einem Überangebot an Produkten, was folglich zu einschneidenden Preis-

einbrüchen für Halbleiterprodukte führt. Fallen die Preise, verzichteten die Hersteller in der Vergangenheit auf Investitionen in neue Fertigungsstätten. Da aber mit der Zeit die Nachfrage nach Chips wieder zunimmt, steigen die Preise ohne Inbetriebnahme zusätzlicher Fertigungsstätten, was zu einem neuen Investitionszyklus führt. Die Halbleiterindustrie reagiert auf einen Nachfragerückgang üblicherweise träge, weil sie kapitalintensiv ist und Entscheidungen über den Zukauf von Produktionsanlagen weit vor einer geplanten Expansion zu treffen sind.

Wir sind bestrebt, den Einfluss der Zyklizität mit Hilfe von kontinuierlichen Investitionen in Fertigungskapazitäten über den gesamten Zyklus, Kooperationsvereinbarungen und Auftragsfertigungsabkommen zu mindern, um so auf Zyklusänderungen flexibler reagieren zu können. Wir sind der Überzeugung, dass wir unsere Bruttomarge und den Gewinn aus dem operativen Geschäft durch die Fokussierung unserer Investitionen in zwei Kerngebieten verbessern können: die Entwicklung einer diversifizierteren Produktpalette und die Verbesserung der Flexibilität unserer Produktionsstätten und Produktionsprozesse. Solche Verbesserungen werden uns größere Flexibilität bei durch Nachfrageschwankungen erforderlichen Produktionsänderungen zur Fertigung von Produkten mit höherer Gewinnspanne gestatten und eine optimale Auslastung unserer Fertigungsstätten gewährleisten.

Substanzielle Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsaufwendungen

Die Halbleiterproduktion ist höchst kapitalintensiv. Die zu einer wettbewerbsfähigen Kostenposition notwendigen Produktionskapazitäten fordern hohe Investitionen in Fertigungsanlagen. Der Anteil der zehn größten Investoren in der Halbleiterindustrie beträgt, gemessen an den durchschnittlichen Investitionsausgaben, mehr als 50 Prozent. Gemäß dieser Studie von IC Insights sind wir auf Rang acht. Fertigungsprozesse und Produktgestaltung basieren auf Spitzentechnologien, denen beträchtliche Forschungs- und Entwicklungskosten vorangehen. Der Großteil der Betriebskosten einer Fertigungsstätte sind Fixkosten; daher können sich Fluktuationen in der Auslastung der Kapazitäten in einem signifikanten Maß auf die Profitabilität auswirken.

Besonders der Markt für DRAM-Speicherprodukte ist durch äußerst marktsensible Preissetzung gekennzeichnet, die sich größtenteils unserem Einfluss entzieht. Einen

Schlüsselfaktor zur Sicherung der Profitabilität stellt für uns daher die kontinuierliche Verringerung unserer Stückkosten durch Verringerung der Herstellungskosten und Erhöhung der Produktionsmenge dar.

Zur Verringerung unserer gesamten Kosten zielen wir darauf ab, die Kosten für Forschung und Entwicklung und für Fertigungsstätten mit Dritten zu teilen. Dazu dienen uns Allianzen oder Vereinbarungen zur Auftragsfertigung. Wir sind der Überzeugung, dass strategische Allianzen bei Forschung und Entwicklung, der Produktion sowie mit Auftragsherstellern uns eine Vielzahl von Vorteilen schaffen. Dazu gehören die Aufteilung der Risiken und Kosten, die Reduktion unseres eigenen Kapitalbedarfs, die Möglichkeit, eine breitere Produktpalette zu entwickeln, der Erwerb technischen Know-hows und der Zugriff auf weitere Produktionskapazitäten. Wir entwickeln zusammen mit Nanya DRAM-Technologien auf Basis von 90-Nanometer- und 70-Nanometer-Strukturen. Zusätzlich sind wir in Asien Verträge zur Auftragsfertigung mit SMIC und Winbond eingegangen, um unsere Produktionskapazität und somit unsere Umsatzbasis zu erhöhen, ohne selbst in Produktionsanlagen zu investieren.

Wir planen eine Erhöhung der Stückzahlen durch Produktivitätssteigerungen in der Herstellung, indem wir Chips von geringerer Strukturgröße, das heißt mehr Bits pro Chip und mehr Chips pro Wafer, durch Verwendung größerer Wafer produzieren. Für die DRAM-Prozesstechnologie haben wir die Umstellung unserer auf 110-Nanometer-Strukturgröße basierenden Produktion nahezu abgeschlossen. Wir produzieren im Werk in Dresden auf 300-Millimeter-Scheiben-Basis unter Vollauslastung. Zu Beginn des Geschäftsjahrs 2003 hat das Werk in Dresden bei der 300-Millimeter-Produktion die Kostenschwelle unterschritten, was bedeutet, dass die Stückkosten unterhalb der Kosten in unseren 200-Millimeter-Fertigungsstätten liegen. Wir planen, diese Leistungsfähigkeit auf unser 300-Millimeter-Werk in Richmond/Virginia, USA, im Geschäftsjahr 2005 auszuweiten.

Technologische Entwicklung und Wettbewerb

Die Verkaufspreise pro Stück sind volatil und sinken wegen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbsdrucks üblicherweise im Zeitverlauf. Speziell DRAM-Speicher sind standardisierte Produkte. Die Standardisierung der meisten Spezifikationen ermöglicht es den Kunden, kurz-

fristig den Anbieter zu wechseln. Dies führt zu einem starken Wettbewerb innerhalb des Markts und zwingt die Hersteller, Kosteneinsparungen an den Kunden weiterzugeben, um Marktanteile auszubauen. Logikchip-Produkte stellen normalerweise kein standardisiertes Produkt dar und beschränken sich in einem gewissen Grad auf bestimmte Anwendungsbereiche. Trotz der im Vergleich zu Speicherprodukten üblicherweise geringeren Stückpreisvolatilität sinken auch im Bereich der Logikchip-Produkte die Verkaufspreise mit der Weiterentwicklung der Technologie.

Der Auswirkung auf unsere Erlöse durch die sinkenden Preise begegnen wir, indem wir das Verkaufsvolumen erhöhen. Weiteren Effekten auf die Bruttomarge begegnen wir, indem wir kontinuierlich unsere Stückkosten reduzieren. Zunahmen im Verkaufsvolumen hängen teilweise von der Verbesserung der Produktivität bei der Herstellung von Halbleitern ab. Indem sich die Strukturgrößen in der Herstellung stets verkleinern, hat sich historisch gesehen die Anzahl funktionaler Elemente etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Dieser auch als „Moore's Gesetz“ bekannte Trend führte zu einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate der Bit-Volumen von 40 Prozent bis 45 Prozent und, unter der Annahme konstanter Preise für einen Quadratzentimeter Silizium, zu einer jährlichen Kostenreduktion von ungefähr 30 Prozent pro Bit.

Saisonabhängigkeit

Das umsatzstärkste Quartal ist erfahrungsgemäß das vierte Quartal des Geschäftsjahrs, das umsatzschwächste das erste. In der Saisonabhängigkeit unserer Verkäufe wird die saisonale Nachfrage nach Produkten, die unsere Halbleiter verwenden, widerspiegelt. Wenn antizipierte Umsätze und Lieferungen nicht wie erwartet stattfinden, treten in einem solchen Quartal überproportional hohe Ausgaben und Lagerbestände auf, was das Ergebnis des Quartals und möglicherweise das Ergebnis folgender Quartale negativ beeinflussen kann.

Produktlebenszyklen

Logikprodukte unterliegen einem Zyklus aus Test, Evaluierung und Kundenakzeptanz bis hin zur Serienfertigung, der sich über mehrere Monate bis über mehr als ein Jahr hinziehen kann. Wegen der Länge dieses Zyklus kann es zu signifikanten zeitlichen Verzögerungen zwischen den Anwendungen für Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten und Vorratsinvestitionen und der Einnahme der entsprechenden Erlöse kommen. Speicherprodukte werden auf Grund der größeren Standardisierung der DRAM-Produkte von Produktlebenszyklen weniger beeinflusst.

Akquisitions- und Desinvestitionsstrategie

Die Akquisition und Desinvestition von Geschäften, Vermögensgegenständen, Produkten oder Technologien ist ein Schlüsselfaktor unserer Geschäftsstrategie, der die Entwicklungszeit neuer Technologien und Produkte und deren Markteinführung verkürzt, der unser existierendes Produktangebot, die Marktabdeckung, den Einsatz von Ingenieuren und unsere technologischen Kompetenzen optimiert. Wir planen die Fortsetzung der Evaluierung sich bietender strategischer Möglichkeiten. Dies umfasst Unternehmensakquisitionen, strategische Partnerschaften, Investitionen und auch den Erwerb oder Verkauf von Vermögensgegenständen.

Geistiges Eigentum

Durch den High-Tech-Charakter der Halbleiterindustrie sind immaterielle Vermögensgegenstände, die sich auf geschützte Technologien wie geistiges Eigentum beziehen, von großer Bedeutung. Unternehmen stellen für gewöhnlich Dritten ihr patentiertes geistiges Eigentum gegen Lizenzgebühren zur Verfügung. Es kann kostspielig und schwierig sein, sich gegen Verletzungen Dritter zur Wehr zu setzen oder sich bei Klagen Dritter, die eine Verletzung ihrer Rechte behaupten, zu verteidigen. Selbst entwickeltes geistiges Eigentum wird nicht aktiviert. Nur erworbenes oder durch Lizenzerwerb genutztes geistiges Eigentum wird in der Bilanz aufgeführt und über die erwartete technische und wirtschaftliche Lebensdauer abgeschrieben. Bewertungsansätze wie auch Schätzungen für erworbenes geistiges Eigentum gestalten sich in der Regel äußerst komplex.

Herausforderungen in der Zukunft

Unser zukünftiger Erfolg wird vor allem von unserer Fähigkeit abhängen, Spitzentechnologien zu entwickeln und unser Produktportfolio zu optimieren. Wir müssen beide Ziele erreichen, um der fluktuierenden Nachfrage nach verschiedenen Halbleiterprodukten zu begegnen. Wir sind der Überzeugung, dass die Fähigkeit, ein breites Portfolio anzubieten und flexibel zu fertigen, in zunehmendem Maße zu unserem langfristigen Erfolg auf vielen Märkten in der Halbleiterindustrie beitragen wird. Die Entwicklung und Erhaltung eines Technologievorsprungs, Entwicklungs- und Fertigungsallianzen, einschließlich der Auftragsfertigung durch Dritte, und beständige Bemühungen zur Portfolio-Diversifikation werden die Reaktion auf veränderte Marktbedingungen erleichtern und unsere finanzielle Ertragskraft stärken.

Darstellung des Halbleitermarkts im Geschäftsjahr 2004

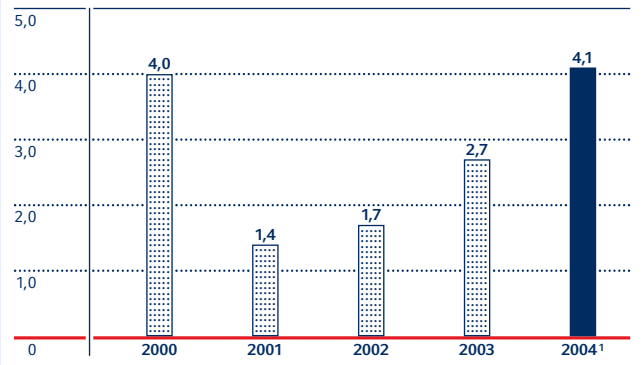
Die positiven Signale auf dem Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2003 haben sich im Kalenderjahr 2004 weiter verstärkt. Nachdem der Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2003 entsprechend World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) um 18 Prozent gewachsen ist, erwartete WSTS im September 2004 für das Kalenderjahr 2004 ein deutlich höheres Wachstum von 28 Prozent. Seinen Umsatz ausweiten wird laut WSTS der asiatisch-pazifische Raum mit einem prognostizierten Wachstum von 42 Prozent im Kalenderjahr 2004, während für die restlichen drei Regionen ein zwar hohes, aber doch geringeres Wachstum vorhergesagt wird (Europa: 21 Prozent, Japan: 18 Prozent, Amerika: 21 Prozent). Der Bereich der Nicht-Speicherprodukte (Logikchips, analoge, diskrete und optische Komponenten), der 78 Prozent des Gesamtmarkts im ersten Halbjahr 2004 ausmachte, soll gegenüber dem Kalenderjahr 2003 um 24 Prozent wachsen. Für den Bereich der Speicherprodukte wird im Vergleich zum Kalenderjahr 2003 eine Wachstumsrate von 46 Prozent prognostiziert.

Für das Kalenderjahr 2004 sieht das Marktforschungsinstitut Gartner ein weltweites Marktwachstum von 37 Prozent

bei Halbleitern im Kommunikationssegment (drahtlose und drahtgebundene Kommunikation). Im Bereich Halbleiter für Datenverarbeitung werden 26 Prozent, für Konsumelektronik 22 Prozent und für die Automobilelektronik 23 Prozent Wachstum vorhergesagt.

Im Geschäftsjahr 2004 konnten wir von den verbesserten Bedingungen auf dem weltweiten Halbleitermarkt profitieren.

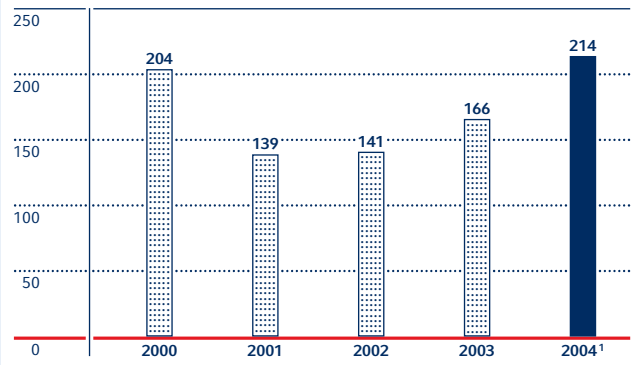
Weltwirtschaftswachstum in %



Das starke Weltwirtschaftswachstum gibt positive Wachstumsimpulse für den Halbleitermarkt.

Quelle: Internationaler Währungsfonds; Stand: September 2004.
1 Geschätzt.

Entwicklung des Halbleitermarkts in Mrd. US-\$



Verstärkung der positiven Signale auf dem Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2004.

Quelle: WSTS; Stand: Oktober 2004.

1 Geschätzt.

Entwicklung der Ertragslage

Positionen der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung in % vom Umsatz

Geschäftsjahr zum 30.9. ¹	2002	2003	2004
Umsatzerlöse	100,0	100,0	100,0
Umsatzkosten	-87,7	-75,0	-64,9
Bruttoergebnis vom Umsatz	12,3	25,0	35,1
Forschungs- und Entwicklungskosten	-21,7	-17,7	-16,9
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-13,1	-11,0	-10,0
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-0,3	-0,5	-0,2
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	0,9	-1,4	-3,6
Betriebsergebnis	-21,9	-5,6	4,4
Zinsergebnis	-0,5	-0,8	-0,6
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	-1,0	0,3	-0,2
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	0,4	-0,0	0,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	-0,8	0,3	-0,9
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	0,1	0,1	0,3
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23,7	-5,7	3,0
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,9	-1,4	-2,1
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-20,9	-7,1	0,9

¹ Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

Umsatzerlöse

Wir generieren Erlöse vorwiegend aus dem Verkauf von Halbleiterprodukten und Systemlösungen. Wir haben zusätzliche Erlöse von weniger als fünf Prozent aus unseren Umsätzen durch Aktivitäten wie die Auftragsfertigung für verkaufte Geschäfte und Lizenzvergaben auf unser geistiges Eigentum. Unsere Halbleiterprodukte gliedern sich in zwei Hauptkategorien:

- ::: Die Palette unserer Speicherprodukte umfasst Dynamic-Random-Access-Memory(DRAM)-Chips für Computer und andere elektronische Geräte. Wir bieten außerdem eine begrenzte Palette nicht-flüchtiger Flash-Speicherprodukte an, die in der Konsumelektronik wie bei Digitalkameras oder bei Mobiltelefonen Anwendung finden.
- ::: Die Palette unserer Logikchip-Produkte wie Chips und Komponenten findet breite Anwendung in elektronischen Geräten zur drahtlosen Kommunikation (Mobilfunk und Bluetooth-Datenübertragung), Chipkarten, Modems und anderen drahtgebundenen Technologien wie DSL, Automobilelektronik und Industrietechnik.

Der Großteil der Verkäufe erfolgt über unseren direkten Vertrieb. Ungefähr zehn Prozent vom Gesamtumsatz wurden in den genannten Perioden über Distributoren getätigt.

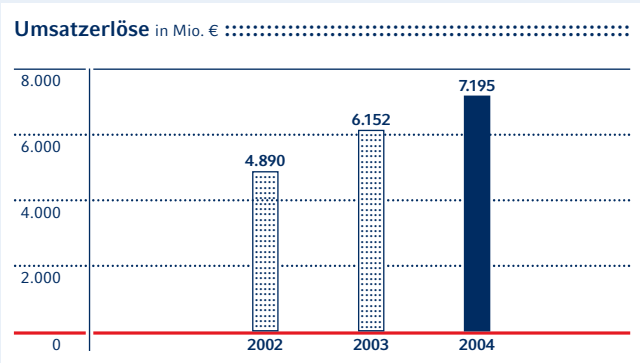
Wir erzielen unsere Einkünfte aus Lizenzen über Stück- und Pauschalgebühren, indem wir an Dritte Lizenzen auf Technologien vergeben, deren Eigentümer wir sind. So können wir einen Teil unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen abdecken und erlangen oft gleichzeitig über Lizenzierungs- und Kapazitätsreservierungs-Vereinbarungen Zugang zu zusätzlichen Fertigungskapazitäten bei Auftragsherstellern. Wir erzielen die Lizenzeinnahmen hauptsächlich im Segment der Speicherprodukte. Diese entstanden durch Technologie-Transfer an unsere Kooperationspartner wie Winbond und Nanya und in früheren Jahren unser Gemeinschaftsunternehmen ProMOS Technologies Inc. (ProMOS). Unsere Umsatzerlöse schwanken in Folge verschiedenster Faktoren:

- ::: Marktpreise für unsere Produkte, insbesondere bei DRAM-Speicherprodukten,
- ::: unser gesamter Produkt-Mix und unser Verkaufsvolumen,
- ::: die Phase im Lebenszyklus unserer Produkte und
- ::: Wettbewerbseffekte und konkurrenzfähige Preisstrategien.

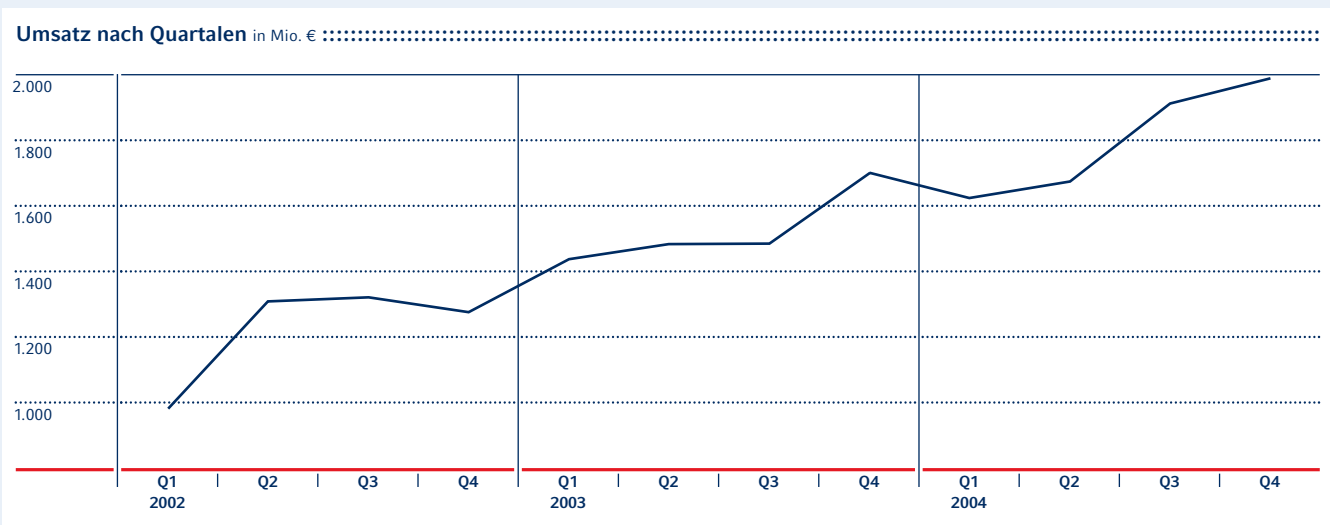
Geschäftsjahr zum 30. 9.	2002	2003	2004
Umsatzerlöse	4.890	6.152	7.195
Prozentuale jährliche Veränderung		26 %	17 %
darin enthalten:			
Einkünfte aus Lizenzvergaben in Mio. €	147	183	76
Prozent des Umsatzes	3 %	3 %	1 %
Fremdwährungseffekte im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	–	–317	–445
Prozent des Umsatzes	–	–5 %	–6 %
Auswirkungen von Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	7	126	29
Prozent des Umsatzes	0 %	2 %	0 %

Die Zunahme der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2003 und im Geschäftsjahr 2004 wurde größtenteils durch eine gesteigerte Nachfrage nach Speicherprodukten und Chips für Mobiltelefone und die weiterhin starke Entwicklung unseres Automobil- und Industrieelektroniksegments getrieben. Lizenzeinnahmen stiegen 2003 und sanken 2004. Dies war hauptsächlich bedingt durch die Beendigung unserer Lizenzvereinbarung mit ProMOS. Zusätzlich wurde der berichtete Umsatz durch die Schwäche der wichtigsten Fremdwährungen in Relation zum Euro (vorwiegend des US-Dollars) während der Geschäftsjahre 2003 und 2004 negativ beeinflusst. Die Fremdwährungseffekte im Vergleich zum Vorjahr errechnen sich aus der geschätzten Veränderung, die sich ergibt, wenn der durchschnittliche Wechselkurs des vergangenen Jahres als konstanter Wechselkurs im aktuellen Jahr angesetzt worden wäre. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus zugekauften Geschäften seit Beginn des vergangenen Jahrs

spiegelt vorwiegend die Ganzjahrs-Konsolidierung der Umsätze im Jahr nach der Akquisition wider.



Erhöhte Nachfrage nach unseren Produkten lässt die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 weiter steigen.



Die Umsatzerlöse konnten über das Geschäftsjahr 2004 deutlich gesteigert werden und erreichten im vierten Quartal den Spitzenwert.

Umsatzerlöse nach Segmenten

Im Geschäftsjahr 2004 gliederte die Gesellschaft bestimmte Aktivitäten ihres Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen zum Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik um. Dementsprechend wurden die Vorjahreszahlen dieser Umgliederung angepasst, um die Analyse gegenwärtiger und zukünftiger Finanzdaten zu unterstützen.

::: Drahtgebundene Kommunikation

Im Geschäftsjahr 2003 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 erlebten wir eine steigende Nachfrage für digitale Zugangsprodukte, da der Bedarf an DSL-internetbasierter Kommunikation stieg und sich die Märkte in den Entwicklungsländern verbesserten. Ein entgegengesetzter Trend hierzu war der Nachfragerückgang für traditionelle analoge Kommunikationsprodukte, der in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 stärker ausgeprägt war als in den vorhergegangenen Perioden. Der Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2004 war sowohl bedingt durch einen Volumenrückgang bei Analog- und Glasfaserkomponenten als auch durch rückläufige durchschnittliche Verkaufspreise. Weiterhin geringe Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur der weltweiten Telefongesellschaften haben sowohl den Markt für Glasfaserprodukte als auch für optische Netzwerkprodukte negativ beeinflusst. Gleichwohl konnten wir im vierten Quartal eine gestiegene Nachfrage verzeichnen. Nach der Entscheidung, unser Glasfaserkomponentengeschäft zu veräußern, verzeichneten wir rückläufige Umsätze von Glasfaserprodukten im dritten Quartal des Berichtsjahrs, im vierten Quartal stiegen diese wieder an.

::: Sichere Mobile Lösungen

Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2003 war besonders stark durch einen gestiegenen Absatz bei Basisband- und Hochfrequenz-Produkten (RF) für Mobiltelefone und die Konsolidierung des ganzen Jahres von Ericsson Microelectronics AB (MIC), was den Preisdruck im Sicherheitsgeschäft ausglich. Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2004 war gemäßigter und trat hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs auf, da sich die Nachfrage nach mobilen Lösungen und Sicherheitsprodukten erhöhte. Im Markt für Chipkarten-ICs erfuhren wir im Geschäftsjahr 2003 anhaltenden Preisdruck. Im Geschäftsjahr 2004 profitierte der Umsatz von einem geringeren Preisrückgang.

::: Automobil- und Industrieelektronik

Das Segment befand sich während der letzten zwei Geschäftsjahre in einer ständigen Wachstumsphase, da vor allem der Absatz von Automobilanwendungen wuchs. Dies resultierte aus einem steigenden Einsatz von Halbleitern in der Automobilelektronik, der stärker als der anhaltende Preisdruck durch technischen Fortschritt und Wettbewerb war. Die Umsatzsteigerung war überwiegend auf einen Volumenanstieg in den Bereichen Automobilanwendungen, Energiemanagement und Energieversorgung zurückzuführen. Der Umsatz profitierte zudem von der ganzjährigen Konsolidierung von SensoNor, das im Juni 2003 erworben wurde, und dem steigenden Absatz von Industrieapplikationen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004.

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002		2003		2004	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Drahtgebundene Kommunikation	386	8	459	7	434	6
Sichere Mobile Lösungen	1.015	21	1.403	23	1.790	25
Automobil- und Industrieelektronik	1.464	30	1.634	27	1.820	25
Speicherprodukte	1.861	38	2.485	40	2.926	41
Sonstige Geschäftsbereiche	117	2	139	2	196	3
Konzernfunktionen	47	1	32	1	29	-
Summe Umsatzerlöse	4.890	100	6.152	100	7.195	100

::: Speicherprodukte

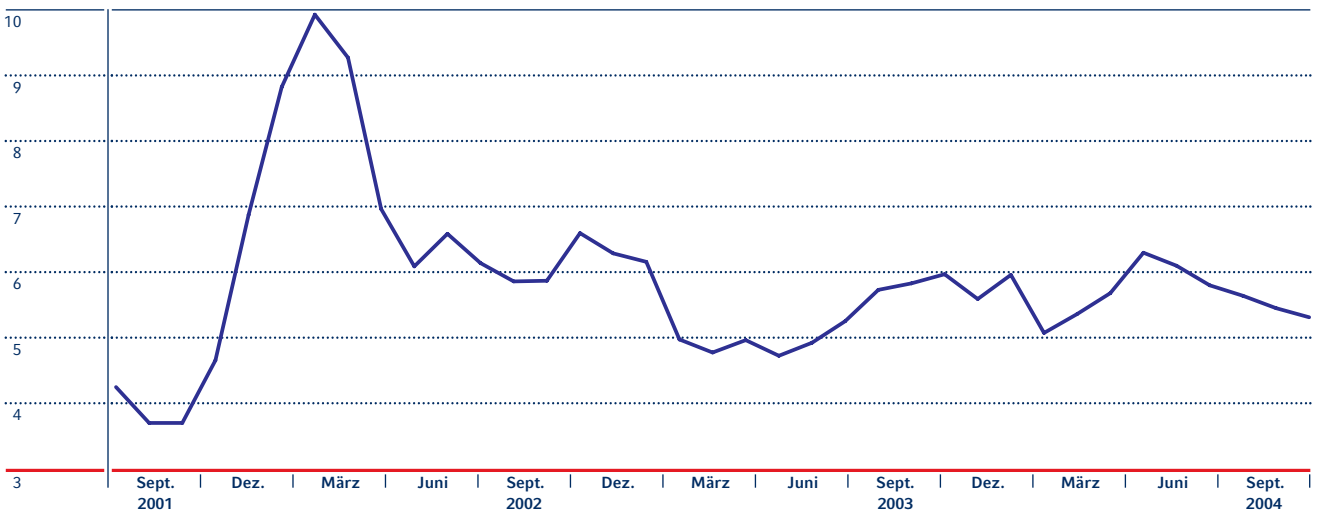
Das Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren war hauptsächlich volumenbedingt, da sich die DRAM-Industrie erholte und die Nachfrage stieg. Das Wachstum in Stückzahlen kompensierte die fallenden Durchschnittspreise des Geschäftsjahrs 2003. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 sanken die Preise in US-Dollar, stiegen im dritten Quartal und waren im Geschäftsjahr 2004 auf einem höheren Durchschnittsniveau als im Geschäftsjahr 2003. Die Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2004 resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen, das den ungünstigen Wechselkurs zwischen Euro und Dollar und geringere Lizenzeinnahmen im Vergleich zum vorhergehenden Jahr mehr als ausgleichen konnte. Der Absatz wurde weiterhin von dem Produktionshochlauf der 300-Millimeter-Fertigung in Dresden, der Umstellung auf 110-Nanometer-Technologie und der zusätzlichen Kapazität aus der Kooperation mit Winbond und SMIC begünstigt, was den Rückgang der von ProMOS gekauften Produkte kompensierte. Das Ab-

satzvolumen in Megabit erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahrs 2004 durch die gestiegene Nachfrage nach Personalcomputern und Datenspeichern.

DRAM-Preisentwicklung

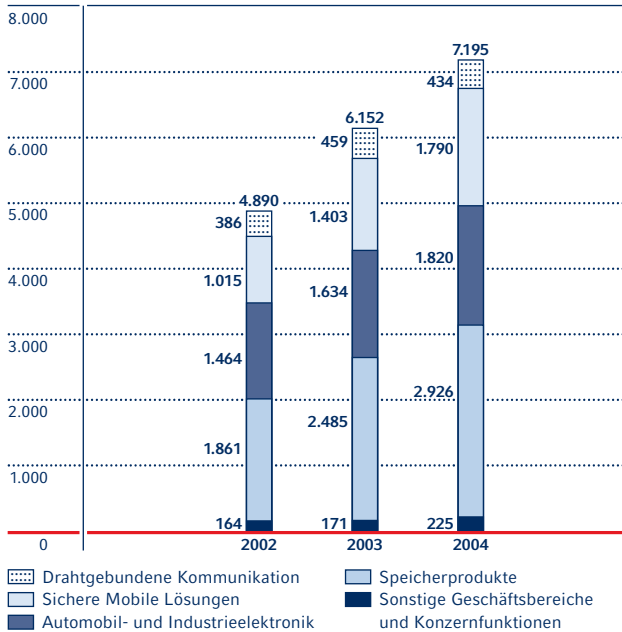
Die Preise in US-Dollar für DDR-Speicherbausteine waren während des Geschäftsjahrs 2004 relativ stabil, mit einem leichten Rückgang im Januar, einer Steigerung im April und einem Rückgang im vierten Geschäftsjahresquartal. Die Vertragspreise für das Hauptvolumenprodukt 256-Mbit-DDR-DRAM waren generell stabil, wobei die Spotmarktpreise stärkeren Schwankungen ausgesetzt waren. Die Preise pro Bit für SDRAM-Produkte kleinerer Speicherdichte waren das ganze Jahr über höher, da die weltweite Fertigungskapazität zu höheren Speicherdichten und DDR-Produkten umgeschichtet wurde. Zur Mitte des Kalenderjahrs 2004 begannen wir die Lieferung von DDR2-Speicherprodukten mit durchschnittlich höheren Verkaufspreisen als die Standard-DDR-Produkte. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Produkt-Mix zu optimieren,

Entwicklung DRAM-Marktpreis je 256-Mbit-Äquivalent in US-\$



Quelle: WSTS.

Umsatzerlöse nach Segmenten in Mio. €



Gestiegene Nachfrage nach Speicherchips und Chips für Mobiltelefone erhöht die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 beträchtlich.

um diese Preisdifferenzen zu nutzen. Des Weiteren versuchen wir, uns verstärkt auf spezielle Produkte zu fokussieren und unser Produktportfolio zu diversifizieren. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megabit (ohne Währungseffekte) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2004 um rund vier Prozent.

::: Sonstige Geschäftsbereiche

Im Geschäftsjahr 2004 stiegen die Umsatzerlöse der Sonstigen Geschäftsbereiche in erster Linie auf Grund unseres Geschäfts mit ASIC & Design Solutions (ADS).

Umsatzerlöse nach Regionen und Kunden

Unser Umsatz wuchs in allen bedeutenden Regionen, wobei Asien-Pazifik unsere größte Umsatzregion war und die stärkste Wachstumsrate aufwies. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da weitere Kunden ihre Betriebe in Produktionsstätten mit niedrigeren Kosten in Asien ausweiten und der chinesische Markt weiter wächst.

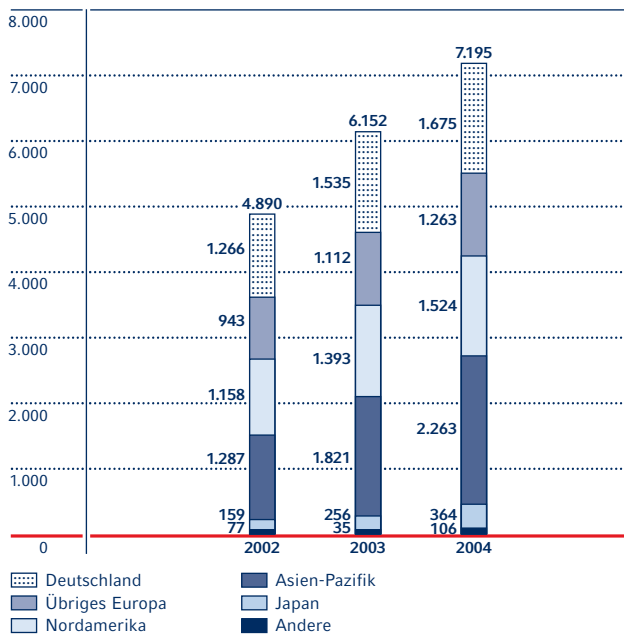
Mit der gestiegenen Nachfrage für digitale Zugangsprodukte veränderte sich unser Kundenstamm bei der Drahtgebundenen Kommunikation hin zu weniger, jedoch größeren Kunden (dies spiegelt die Konzentration auf dem Telekommunikationsmarkt wider). Die Zahl der Kunden des Automobil- und Industrieelektronik-Segments blieb in etwa konstant. Dies reflektiert das Wesen des Automobilmarkts. Im Geschäftsjahr 2004 verlagerten Kunden unseres Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen vermehrt ihre Produktion in Schwellenländer wie Brasilien und China, die geringere Produktionskosten aufweisen. Die Kunden für Speicherprodukte unterlagen einem zunehmenden Konzentrationsprozess. So entfielen im Geschäftsjahr 2004 auf unsere zehn Top-Kunden 65 Prozent des Umsatzes in diesem Segment.

Auf den Siemens-Konzern entfielen in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 14 Prozent, 14 Prozent und 13 Prozent unserer Umsatzerlöse. Der Umsatz mit Siemens beinhaltet sowohl Direktverkäufe an den Siemens-Konzern in Höhe von zwölf Prozent, 13 Prozent und 13 Prozent für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 als auch Verkäufe an die Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Drittkunden in Höhe von zwei Prozent, ein Prozent und null Prozent in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004. Die Umsätze mit dem Siemens-Konzern werden hauptsächlich mit Nicht-Speicherprodukten getätigt. Auf keinen anderen Kunden entfielen mehr als zehn Prozent unserer Umsatzerlöse in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004.

Umsatzerlöse nach Regionen

Geschäftsjahr zum 30. 9.	2002		2003		2004	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Deutschland	1.266	26	1.535	25	1.675	23
Übriges Europa	943	19	1.112	18	1.263	18
Nordamerika	1.158	24	1.393	23	1.524	21
Asien-Pazifik	1.287	26	1.821	29	2.263	32
Japan	159	3	256	4	364	5
Andere	77	2	35	1	106	1
Gesamt	4.890	100	6.152	100	7.195	100

Umsatzerlöse nach Regionen in Mio. €



Die Asien-Pazifik-Region konnte wieder die höchsten Umsatzerlössteigerungen erzielen.

Umsatzkosten – Bruttomarge

Unsere Umsatzkosten enthalten hauptsächlich:

- ::: direktes Material, das hauptsächlich Kosten für Rohwafer beinhaltet,
- ::: Lohnkosten,

- ::: Gemeinkosten einschließlich der Wartung der Produktionsanlagen, indirekter Materialien, der Betriebsmittel und Lizenzgebühren,
- ::: Abschreibungen und Amortisation,
- ::: Kosten für Zulieferer für Montage und Test,
- ::: Fertigungsunterstützung inklusive Betriebsanlagen und -mittel, Qualitätskontrolle, Automatisierung und Leitungsfunktionen,
- ::: Kosten für Auftragsfertigung.

Zusätzlich zu den umsatzbezogenen Faktoren ist die Bruttomarge beeinflusst durch:

- ::: Auslastung der Fertigungsstätten und verbundene Leerkosten,
- ::: Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte,
- ::: Produktgarantieleistungen,
- ::: Wertberichtigungen für überschüssigen oder veralteten Lagerbestand und
- ::: Zuwendungen der öffentlichen Hand, die über die wirtschaftliche und technische Restlebensdauer der Fertigungsanlagen abgesetzt werden.

Infineon weist die Kosten für die Materialbezüge von unseren Gemeinschaftsunternehmen und anderen verbundenen und assoziierten Unternehmen wie ALTIS und Inotera und bis zum 1. Januar 2003 auch ProMOS unter den Umsatzkosten aus. Diese Bezüge von diesen Fertigungen und von assoziierten und verbundenen Unternehmen beliefen sich im Berichtsjahr 2004 auf 357 Millionen Euro, gegenüber 470 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2003 und 686 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2002.

Geschäftsjahr zum 30. 9.

Umsatzkosten in Mio. €

Prozentuale jährliche Veränderung

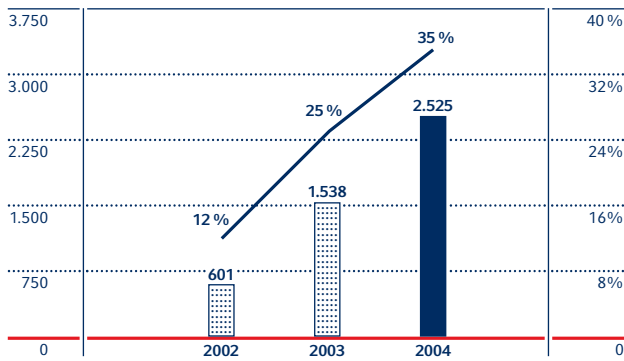
Prozent des Umsatzes

Bruttomarge

	2002	2003	2004
Umsatzkosten in Mio. €	4.289	4.614	4.670
Prozentuale jährliche Veränderung		8 %	1 %
Prozent des Umsatzes	88 %	75 %	65 %
Bruttomarge	12 %	25 %	35 %

Die Bruttomarge stieg in den letzten zwei Jahren, wobei diese prozentuale Verbesserung auf einer Vielzahl von Faktoren gründet: bessere Integration und höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten in den meisten Geschäftsbereichen, beträchtliche Verbesserung der Kostenposition im Segment Speicherprodukte und verbessertes Preisumfeld im Vergleich zu vorangegangenen Geschäftsjahren.

Bruttomarge absolut in Mio. €
und im Verhältnis zum Umsatz in %



Höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten und Verbesserung der Kostenstruktur erhöhten die Bruttomarge deutlich.

Die Bruttomarge unserer Geschäftsbereiche hat sich folgendermaßen entwickelt:

::: Drahtgebundene Kommunikation

Die Bruttomarge stieg im Geschäftsjahr 2003 auf Grund des erhöhten Absatzes für Access-Produkte mit höheren Margen. Höhere Produktivität und Auslastung der Fertigungskapazitäten trugen ebenfalls zu dieser Verbesserung bei. Die Bruttomarge blieb im Durchschnitt in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 konstant, trotz eines Rückgangs im Laufe des Geschäftsjahrs, beginnend mit einem Hoch im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004. Dies wurde hauptsächlich durch einen anhaltenden Preisrückgang bei den Access-Produkten ausgelöst.

::: Sichere Mobile Lösungen

Die Bruttomarge verbesserte sich beginnend in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2003 bis zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 und blieb bis Jahresende konstant. Grund hierfür war eine gestiegene Nachfrage nach Sicherheitsprodukten und drahtlosen Lösungen sowie eine höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten, die den anhaltenden Preisrückgang mehr als kompensierten. Die Bruttomarge wurde im Geschäftsjahr 2004 positiv beeinflusst auf Grund eines geringeren Preisrückgangs und einer verbesserten Kostensituation in unserer MIC-Gesellschaft, die wir im Geschäftsjahr 2003 erworben haben. Im gesamten Geschäftsjahr 2003 wurde die Bruttomarge durch einen anhaltenden Preisdruck negativ beeinflusst.

::: Automobil- und Industrieelektronik

Die Bruttomarge verbesserte sich auf Grund der höheren Produktivität und Kosteneinsparungen wegen der fortgeführten Umstellung von 5-Zoll- auf 6-Zoll- und 8-Zoll-Fertigung. Höhere Verkaufsmengen und eine bessere Kapazitätsauslastung der Fertigungsanlagen trugen zu einer verbesserten Effizienz bei und kompensierten damit negative Einflüsse, denen die Bruttomarge durch den Preisdruck ausgesetzt war.

::: Speicherprodukte

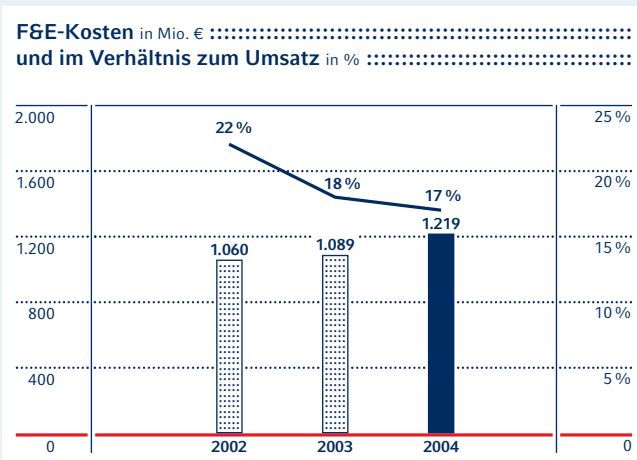
Die Bruttomargen verbesserten sich über die letzten zwei Jahre durchgehend auf Grund einer wesentlich höheren Produktivität und geringerer Herstellungskosten in der 300-Millimeter-Produktion, bedingt durch die 140- und 110-Nanometer-Umstellung, welche den negativen Effekt der niedrigeren Verkaufspreise im Geschäftsjahr 2003 mehr als kompensierten. Dies führte zu einem signifikanten Wachstum der Bruttomarge in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004. Die Bruttomargen im Geschäftsjahr 2004 waren beeinflusst durch geringere Lizenzeinnahmen, die teilweise auf Grund von Kürzungen der Abschreibungen, die staatlichen Zuschüssen zuzuordnen sind, kompensiert worden sind.

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002	2003	2004
Aufwendungen für R&D in Mio. €	1.060	1.089	1.219
Prozentuale jährliche Veränderung		3 %	12 %
Prozent des Umsatzes	22 %	18 %	17 %
Erworbene R&D-Aufwendungen in Mio. €	37	6	9
Prozent des Umsatzes	1 %	0 %	0 %
Zuwendungen der öffentlichen Hand in Mio. €	59	59	74
Prozent des Umsatzes	1 %	1 %	1 %

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (R&D) umfassen vor allem Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen und Instandhaltung der Laboreinrichtungen, die wir für unsere R&D-Projekte benötigen, als auch Kosten aus vertraglich vereinbarter Technologieentwicklung. Materialkosten umfassen Ausgaben für Wafer zu Entwicklungszwecken und Kosten aus Pilotprojekten, die vor dem Start der Serienproduktion anfallen. In den Aufwendungen für R&D sind auch Kosten aus Vereinbarungen über die Entwicklungen von gemeinsamer Technologie mit unseren Partnern wie Nanya und IBM enthalten.

Wir werden weiterhin unsere Investitionen auf die Entwicklung von Spitzen-Fertigungstechnologien mit großem Wachstumspotenzial fokussieren, im Wesentlichen bei Speicherprodukten und Sicheren Mobilien Lösungen.



Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Entwicklung von Spitzen-Fertigungstechnologien mit großem Wachstumspotenzial, insbesondere in den Geschäftsbereichen Sichere Mobile Lösungen und Speicherprodukte.

Erworbene R&D-Aufwendungen beziehen sich auf spezifische Akquisitionen: MIC im Jahr 2002, überwiegend SensoNor im Jahr 2003 und ADMtek im Jahr 2004. Jede Position bezieht sich einzig auf die dazugehörige Akquisition und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie dem Entwicklungsstand der Technologie und der antizipierten zukünftigen Verwendung am Akquisitionstag.

Einige unserer R&D-Projekte erhalten Zuwendungen der öffentlichen Hand von lokalen und regionalen Behörden am Ort unserer Aktivitäten. Werden die Kriterien für solche Zuwendungen erfüllt, reduzieren die Zuschüsse die R&D-Aufwendungen über die Projektdauer, in der die Kosten anfallen.

::: Drahtgebundene Kommunikation

Aufwendungen für R&D verringerten sich in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 sowohl absolut als auch in Relation zu den Umsatzerlösen. Im Geschäftsjahr 2003 waren der Grund hierfür niedrigere Abschreibungen, im Wesentlichen aus dem Erwerb von Catamaran, und geringere Aufwendungen als Ergebnis unseres Kostensenkungsprogramms Impact für R&D im Geschäftsfeld Access. Die Aufwendungen für R&D gingen durch Kürzungen betreffend optische Netzwerke zurück, was aber teilweise durch Aufwendungen für erworbene R&D-Kosten von ADMtek kompensiert wurde.

::: Sichere Mobile Lösungen

Die Aufwendungen für R&D stiegen für das Geschäftsjahr 2004 in absoluten Zahlen auf Grund der erhöhten Anstrengungen bei Software- und Lösungsaktivitäten und der dritten Halbleitergeneration. Dagegen wirkte im Geschäftsjahr 2003 positiv, dass erworbene R&D-Aufwendungen in Höhe von 37 Millionen Euro, die im Geschäftsjahr 2002 gezeigt wurden, nicht wieder auftraten.

::: Automobil- und Industrieelektronik

Die Kosten für R&D stiegen in absoluten Zahlen auf Grund höherer R&D-Aufwendungen im Mikrokontrollerbereich und bei Automobilanwendungen und blieben im Verhältnis zum Umsatz konstant. Im Geschäftsjahr 2003 hatten wir erworbene R&D-Kosten in Verbindung mit der Akquisition von SensoNor in Höhe von vier Millionen Euro.

::: Speicherprodukte

Die Aufwendungen für R&D gingen im Geschäftsjahr 2003 sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu den Umsatzerlösen zurück. Dies zeigt die Vorteile der gemeinsamen Entwicklung von DRAM-Technologien mit Nanya. Diese Vorteile wurden im Geschäftsjahr 2004 zum größten Teil durch die gestiegenen Entwicklungskosten bei Standard-DRAM-Produkten und Flash-Technologien mehr als kompensiert, so dass die R&D-Aufwendungen in absoluten Zahlen anstiegen, aber im Verhältnis zum Umsatz konstant blieben.

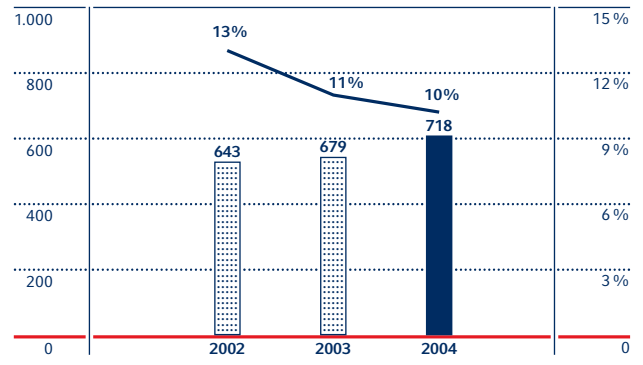
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten

Die Vertriebskosten umfassen Personalkosten für die Mitarbeiter des Vertriebs und des Marketings, Kosten für Musterprodukte für Kunden, Kosten im Zusammenhang mit Prototypen, Marketinganreizen und Marketingaufwendungen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten umfassen im Wesentlichen die Personalkosten der Mitarbeiter in der Verwaltung, nicht produktionsbezogene Gemeinkosten, Beratungsleistungen, Rechtskosten und andere Expertenonorare, Personalbeschaffungs- und Ausbildungskosten.

Der prozentuale Rückgang in den Geschäftsjahren 2003 und 2004, gemessen an den Umsatzerlösen, wurde im Wesentlichen durch die Umsatzsteigerung hervorgerufen.

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten in Mio. € :::
und im Verhältnis zum Umsatz in % :::::::::::::::::::::::::::::::



Die Aufwendungen für die Geschäftsausweitung und Rechtskosten konnten über Kostensenkungsprogramme teilweise kompensiert werden.

Die Vertriebskosten stiegen absolut innerhalb der letzten zwei Jahre wegen des höheren Umsatzvolumens und der Expansion im Raum Asien-Pazifik und konnten teilweise durch Kostensenkungsprogramme in den Bereichen Drahtgebundene Kommunikation und Sichere Mobile Lösungen wieder kompensiert werden.

Der Anstieg innerhalb der letzten zwei Jahre ist hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Informationstechnologien, Kosten externer Dienstleister und Ausgaben in Verbindung mit der Erweiterung unserer Präsenz in den USA und Asien zurückzuführen, welcher aber teilweise durch unsere Kostensenkungsprogramme kompensiert werden konnte. Die ganzjährige Konsolidierung des erworbenen Geschäfts von MIC erhöhte im Geschäftsjahr 2003 die Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen. Die Rückstellungen für Rechtskosten im Zusammenhang mit laufenden Verfahren und erzielten Einigungen stiegen im Geschäftsjahr 2004.

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002	2003	2004
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten in Mio. €	643	679	718
Prozentuale jährliche Veränderung		6 %	6 %
Prozent des Umsatzes	13 %	11 %	10 %

Weitere Bestandteile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002	2003	2004
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Mio. €	16	29	17
Prozent des Umsatzes	0 %	0 %	0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge (-) in Mio. €	-46	85	257
Prozent des Umsatzes	-1 %	1 %	4 %
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag (-) von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften in Mio. €	-47	18	-14
Prozent des Umsatzes	-1 %	0 %	-0 %
Sonstige Erträge/Aufwendungen (-) in Mio. €	-41	21	-64
Prozent des Umsatzes	-1 %	0 %	-1 %

Restrukturierung

Im Geschäftsjahr 2004 führten wir unsere Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen weiter. In Verbindung mit unserer Entscheidung, verschiedene Entwicklungszentren im Geschäftsjahr 2004 zu schließen, fielen Restrukturierungskosten an, hauptsächlich für Abfindungszahlungen. Im Geschäftsjahr 2003 bildeten wir vorwiegend für Abfindungszahlungen Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Abbau von Gemeinkosten. Im Geschäftsjahr 2002 fielen zusätzliche Restrukturierungsaufwendungen für nicht kündbare Verpflichtungen an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge, Saldo

Im Geschäftsjahr 2004 bestanden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (netto) im Wesentlichen aus Aufwendungen aus der Vereinbarung mit dem US-Bundesjustizministerium im kartellrechtlichen Verfahren und verbundenen Vereinbarungen mit OEM-Kunden sowie ähnlichen laufenden Ermittlungen in Europa. Ebenso war eine Wertberichtigung des Geschäfts- und Firmenwerts in Höhe von 71 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran im Geschäftsjahr 2001 enthalten. Im Geschäftsjahr 2003 haben wir im Zusammenhang mit den oben genannten kartellrechtlichen Angelegenheiten in den USA Rückstellungen gebildet und eine Wertberichtigung des Geschäfts- und Firmenwerts in Höhe von 68 Millionen Euro bei Catamaran vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2002 enthielten die sonstigen betrieblichen Erträge den Vorsteuergewinn aus dem Verkauf des restlichen Infrarotkomponenten-Geschäfts in Höhe von 39 Millionen Euro und des Gallium-Arsenid-Geschäfts in Höhe von zwei Millionen Euro.

Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Die wichtigsten Beteiligungen sind ALTIS Semiconductor (ALTIS), Inotera (seit dem Geschäftsjahr 2003) und ProMOS (bis zum Geschäftsjahr 2003). ProMOS und Inotera sind DRAM-Produzenten, und unser anteiliges Ergebnis unterliegt den Fluktuationen der DRAM-Preise und wirkt sich auf das Ergebnis des Geschäftsbereichs Speicherprodukte aus.

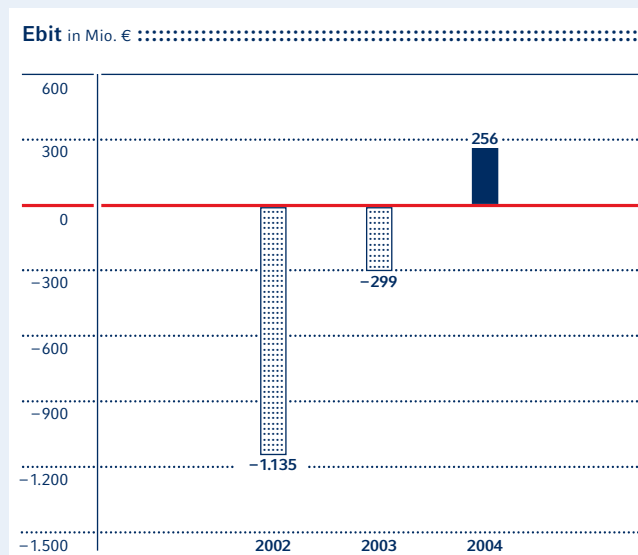
Die Verluste im Geschäftsjahr 2002 verursachte vorwiegend ProMOS als Ergebnis niedriger DRAM-Preise. Im Geschäftsjahr 2003 wirkte sich die Erholung der DRAM-Preise in gesteigerten Erträgen bei ProMOS, vor unserem Ausstieg aus der Gemeinschaftsunternehmung, aus. Verluste während der Hochlaufphase von Inotera trugen zu den Verlusten im Geschäftsjahr 2004 bei.

Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo

Sonstige Erträge, die nicht unseren Kerngeschäften zugeordnet werden, können von Periode zu Periode aus vielfältigen Positionen bestehen, einschließlich der Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens. Im Geschäftsjahr 2004 bestehen die sonstigen Aufwendungen hauptsächlich aus Wertberichtigungen auf Beteiligungen in Höhe von 65 Millionen Euro. Die sonstigen Erträge im Geschäftsjahr 2003 beinhalten einen Ertrag in Höhe von 60 Millionen Euro aus dem Verkauf der ProMOS-Anteile, der teilweise durch Wertberichtigungen auf verschiedene Finanzanlagen in Höhe von 34 Millionen Euro und den Verlust aus dem Verkauf der UMCi-Anteile in Höhe von neun Millionen Euro ausgeglichen wurde. Im Geschäftsjahr 2002 ergaben sich im Wesentlichen Aufwendungen durch Wertberichtigungen auf Finanzanlagen.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)

Wir definieren Ebit als Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management nutzt das Ebit als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Infineon berichtet Ebit-Daten, um Investoren nützliche Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft und im Speziellen über die einzelnen Segmente zur Verfügung zu stellen. Das Ebit wird wie folgt aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung hergeleitet:



Höheres Absatzvolumen und bessere Margen wirkten positiv auf das Ebit.

Geschäftsjahr zum 30.9. in Mio. €	2002	2003	2004
Konzernüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit von fortgeführten Geschäften	-1.017	-435	61
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-143	84	154
Zinsaufwendungen	25	52	41
Ebit	-1.135	-299	256

Das Ebit verteilt sich wie folgt auf die Geschäftsbereiche:

Geschäftsjahr zum 30.9. in Mio. €	2002	2003	2004
Drahtgebundene Kommunikation	-245	-188	-179
Sichere Mobile Lösungen	-143	-65	124
Automobil- und Industrieelektronik	138	187	244
Speicherprodukte	-630	31	169
Sonstige Geschäftsbereiche	9	-49	-58
Konzernfunktionen	-264	-215	-44
Gesamt	-1.135	-299	256

Die Steigerung des Ebit ist das Resultat der unten aufgeführten Effekte innerhalb der Geschäftsbereiche:

::: Drahtgebundene Kommunikation

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2004, hauptsächlich durch geringere Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs, wurde aber durch Verluste aus der Akquisition von ADMtek erhöht. Das Ebit der Geschäftsjahre 2004 und 2003 enthält Wertberichtigungen auf den Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von 71 Millionen Euro und 68 Millionen Euro aus unserer Catamaran-Akquisition. Die Verringerung des Ebit-Verlusts im Geschäftsjahr 2003 resultiert hauptsächlich aus einem größeren Geschäftsvolumen, einem verbesserten Produkt-Mix, erhöhten Gewinnmargen bei Glasfaserprodukten, Kosteneinsparungen mittels Restrukturierung und anderer Kostenreduzierungsanstrengungen.

::: Sichere Mobile Lösungen

Die Rückkehr zur Profitabilität im Geschäftsjahr 2004 resultiert überwiegend aus einem größeren Geschäftsvolumen und einer moderaten Verbesserung der Preisentwicklung. Die Verringerung des Ebit-Verlusts im Geschäftsjahr 2003 wurde auf Grund von gestiegenen Absatzmengen, höheren Margen und Kostenreduzierungen, wodurch die Auswirkung der ganzjährigen Konsolidierung des MIC-Geschäfts ausgeglichen werden konnte, erzielt.

::: Automobil- und Industrieelektronik

Die Verbesserungen des Ebit in den Geschäftsjahren 2004 und 2003 resultierten vor allem aus einem höheren Verkaufsvolumen und einer verbesserten Effizienz in der Produktion, teilweise kompensiert durch den anhaltenden Preisdruck.

::: Speicherprodukte

Gründe für die Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2004 waren vorwiegend höhere Stückzahlen und ansteigende

Produktivität. Kompensiert wurde die Erhöhung durch einen Rückgang der Lizenzeinnahmen, den schwachen US-Dollar/Euro-Wechselkurs und Aufwendungen im Zusammenhang mit laufenden kartellrechtlichen Ermittlungen. Die Rückkehr zur Profitabilität wurde im Geschäftsjahr 2003 hauptsächlich wegen eines höheren Verkaufsvolumens, wesentlich gesunkener Herstellungskosten und gestiegener Lizenzeinkünfte erreicht.

::: Sonstige Geschäftsbereiche

Der Ebit-Verlust in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 spiegelt im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Finanzanlagen wider. Ausgaben zum Aufbau unseres Geschäftsfelds ASIC & Design Solutions im Geschäftsjahr 2003 wurden im Geschäftsjahr 2004 signifikant reduziert, was zu Profitabilität führte.

::: Konzernfunktionen

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2003 und insbesondere im Geschäftsjahr 2004, bedingt durch geringere unverrechnete Leerkosten auf Grund verbesserter Auslastung.

Zinsergebnis

Zinserträge erzielen wir im Wesentlichen aus Zahlungsmitteln und Wertpapieren. Zinsaufwendungen entstehen uns in erster Linie aus Bankdarlehen und Wandelanleihen, abzüglich aktivierter Zinsen für im Bau befindliche Fertigungsgebäude.

Zinsaufwendungen hatten wir hauptsächlich aus unserer im Februar 2002 ausgegebenen Wandelanleihe und der im Juni 2003 ausgegebenen Wandelanleihe. Diese Zinsaufwendungen wurden im Geschäftsjahr 2004 teilweise durch Rückkauf eines Teils unserer Wandelanleihen und durch gestiegene aktivierte Zinsen im Zusammenhang mit dem Bau von Fertigungsstätten kompensiert.

Geschäftsjahr zum 30. 9.	2002	2003	2004
Zinsergebnis in Mio. €	-25	-52	-41
Prozent des Umsatzes	-1 %	-1 %	-1 %

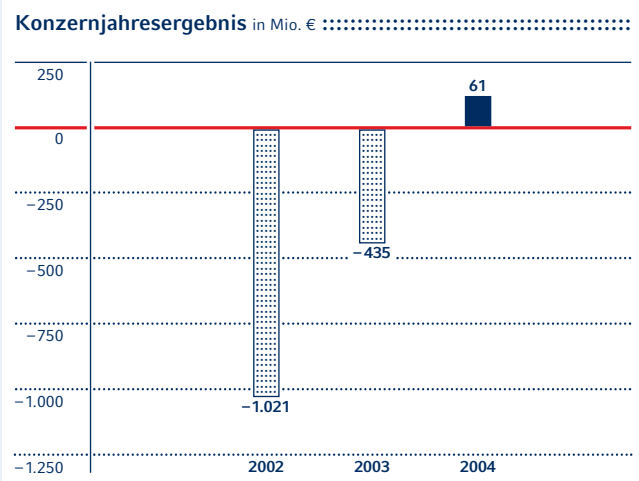
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002	2003	2004
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag in Mio. €	143	-84	-154
Prozent des Umsatzes	3 %	-1 %	-2 %
Steuerquote	12 %	-24 %	72 %

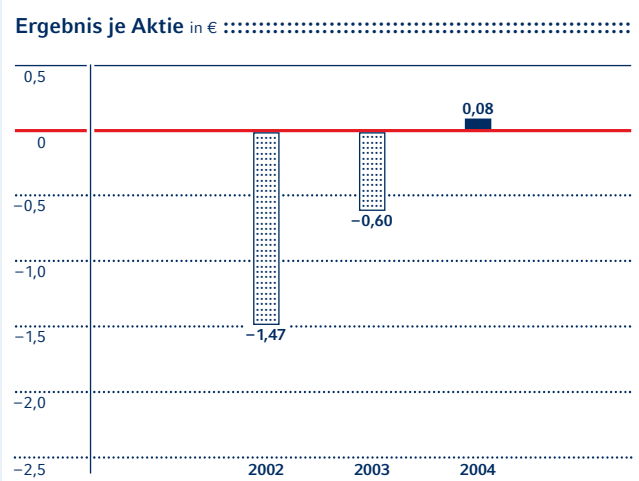
Gemäß US-GAAP müssen in Steuergebieten mit einem kumulierten Verlust über die letzten drei Jahre aktivierte latente Steuern wertberichtigt werden. Im Geschäftsjahr 2002 wiesen wir eine Erhöhung der Wertberichtigung in Höhe von 271 Millionen Euro aus, die den realisierbaren Steuerertrag begrenzte. Wir erhöhten die Wertberichtigung in Folge kumulativer Verluste in den letzten drei Jahren bis zum 30. September 2002 in bestimmten Steuergebieten. Wir haben für das Geschäftsjahr 2003 in den besagten Steuergebieten wiederholt keine Steuererträge ausgewiesen, und die Wertberichtigung wurde im Geschäftsjahr 2003 um 182 Millionen Euro erhöht. Trotzdem weisen wir im Geschäftsjahr 2003 Steueraufwendungen in profitablen Steuergebieten aus. Im Geschäftsjahr 2004 erhöhte sich unsere Steuerquote auf Grund von zusätzlichen Wertberichtigungen in Höhe von 54 Millionen Euro in Steuergebieten, die weiterhin kumulative Verluste in den letzten drei Jahren ausweisen und höhere nicht abzugsfähige Aufwendungen. Wir bewerten unsere latenten Steuern regelmäßig. Unsere Fähigkeiten zur Realisierung von Steuererträgen aus latenten Steuern hängen von der Möglichkeit ab, in der Zukunft steuerliche Einkünfte zu erzielen und steuerliche Verlustvorträge und Steuervergünstigungen vor Eintritt der Verjährung zu nutzen. Wir erwarten so lange keine Erträge für Steuern vom Einkommen und Ertrag in den besagten Steuergebieten auszuweisen, wie in diesen Steuergebieten über den Zeitraum der letzten drei Jahre ein kumulativer Verlust ausgewiesen wird.

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Konzernfehlbetrag im Geschäftsjahr 2003 verringerte sich deutlich, hauptsächlich in Folge des Umsatzwachstums, der gesteigerten Effizienz in der Fertigung und der Kostensenkungsprogramme. Auf Grund der Fortführung dieses Trends erreichten wir im Geschäftsjahr 2004 wieder Profitabilität. Diese Entwicklung wurde durch Wertberichtigungen, kartellrechtliche Verfahren und Steueraufwendungen belastet.



Durch erhöhte Nachfrage und gesteigerte Effizienz in der Fertigung konnte wieder Profitabilität erreicht werden.



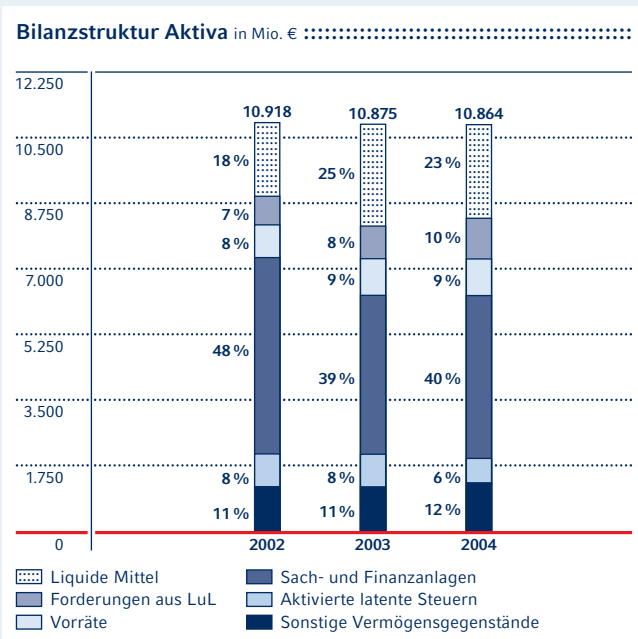
Darstellung der Vermögenslage

Geschäftsjahr zum 30.9. in Mio. €	2003	2004	Veränderung in %
Umlaufvermögen	5.376	5.292	-2
Anlagevermögen	5.499	5.572	1
Summe Aktiva	10.875	10.864	-0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.204	2.870	30
Langfristige Verbindlichkeiten	3.005	2.016	-33
Summe Verbindlichkeiten	5.209	4.886	-6
Summe Eigenkapital	5.666	5.978	6

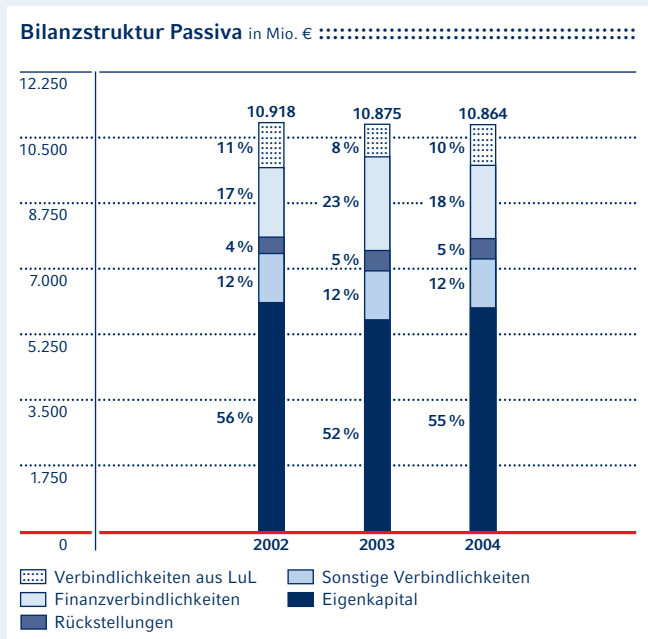
Das bilanzierte Gesamtvermögen befand sich zum Ende des Geschäftsjahrs 2004 auf dem gleichen Niveau wie zum Ende des Geschäftsjahrs 2003. Das Umlaufvermögen verringerte sich im Geschäftsjahr 2004. Dies beruht auf verschiedenen Geschäftstransaktionen, inklusive der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 549 Millionen Euro, kompensiert durch einen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Das Anlagevermögen stieg zum Ende des Geschäftsjahrs 2004 moderat an, weil Abschreibungen und Wertberichtigungen die Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen nahezu kompensierten.

Die gesamten Verbindlichkeiten sanken zum Ende des Geschäftsjahrs 2004 im Wesentlichen durch den Rückkauf unserer im Kalenderjahr 2007 fälligen Wandelanleihen im Nominalwert von 360 Millionen Euro. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen an, während sich die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten, da langfristige Finanzverbindlichkeiten des Vorjahrs zum 30. September 2004 auf Grund ihrer Restlaufzeit den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten zugeordnet wurden.

Unser Eigenkapital stieg im Wesentlichen durch die Ausgabe von 26.679.255 Stammaktien im Zusammenhang mit dem Erwerb des restlichen Anteils an der SC300 GmbH & Co.



Rückgang bei Liquide Mittel durch Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten.



Rückgang bei Finanzverbindlichkeiten durch Rückkauf eines Anteils eigener Wandelanleihen.

OHG (SC300) und dem Konzernjahresüberschuss im Geschäftsjahr 2004. Die Eigenkapitalquote beträgt 55 Prozent zum 30. September 2004 (Vorjahr: 52 Prozent).

Die Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite steigerten sich beide im Geschäftsjahr 2004 auf ein Prozent gegenüber minus sieben Prozent und minus vier Prozent im Geschäftsjahr 2003 auf Grund der Erreichung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2004. Die Anlagendeckung verbesserte sich im Geschäftsjahr 2004 auf 167 Prozent, basierend auf den die Investitionen in Sachanlagen übersteigenden Abschreibungen während des Geschäftsjahrs 2004. Die Verringerung des Verschuldungsgrads auf 33 Prozent im Geschäftsjahr 2004 (Vorjahr: 44 Prozent) war bedingt durch den Rückgang der Finanzverbindlichkeiten auf Grund der Ablösung eines Teils unserer Wandelanleihen.

Darstellung der Finanzlage

Cash-Flow

Der Cash-Flow zeigt Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit sind jeweils zahlungsbezogen ermittelt. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Konzernjahresergebnis indirekt abgeleitet. Die im Rahmen der indirekten Ermittlung berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft sind um Effekte

aus Währungsschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen bereinigt. Sie können deshalb nicht mit den entsprechenden Veränderungen der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

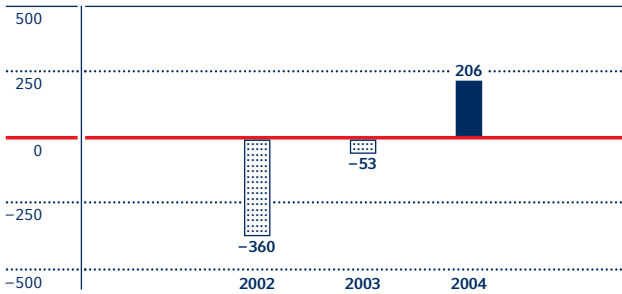
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2004 ergibt sich im Wesentlichen aus dem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 61 Millionen Euro, Abschreibungen in Höhe von 1.320 Millionen Euro, vorgenommenen Wertberichtigungen in Höhe von 136 Millionen Euro und latenten Steuern in Höhe von 96 Millionen Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit berücksichtigt unter den Veränderungen des Nettovermögens die Zuführung zu Rückstellungen/sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 148 Millionen Euro im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Verfahren und verbundenen Zivilforderungen. Diese Effekte wurden teilweise kompensiert durch den Aufbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 219 Millionen Euro und den Aufbau von Vorräten in Höhe von 40 Millionen Euro auf Grund des deutlich gestiegenen Geschäftsvolumens.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2004 resultiert überwiegend aus Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.163 Millionen Euro, im Wesentlichen zum Ausbau unserer Fertigungsstätten in Dresden und Richmond, Investitionen in Höhe von 386 Millionen Euro in assoziierte Unternehmen wie Inotera und dem Netto-Erwerb von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 158 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2004 bestand der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen aus dem Rückkauf von im Jahr 2007 fälligen eigenen Wandelanleihen in Höhe von 360 Millionen Euro.

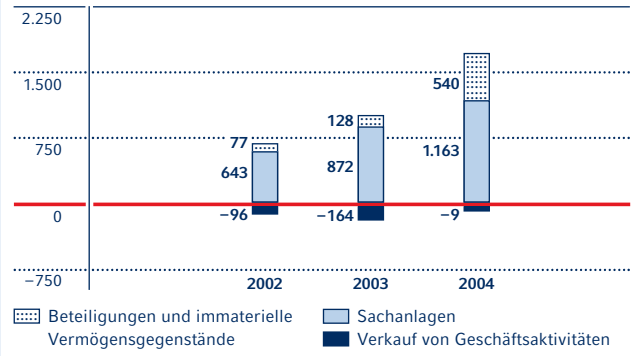
Geschäftsjahr zum 30.9. in Mio. €	2002	2003	2004
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von fortgeführten Geschäften	226	731	1.857
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.244	-1.522	-1.809
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.448	566	-402
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von aufgegebenem Geschäft	11	-1	-
Zahlungsmittel zum Ende des Geschäftsjahrs	1.199	969	608

Free-Cash-Flow in Mio. €



Höhere Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit stellen einen positiven Free-Cash-Flow sicher.

Investitionen/Desinvestitionen¹ in Mio. €



Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen dienen der Verbesserung der Produktionsprozesse und dem Ausbau der Fertigungskapazitäten.
1 Ohne Wertpapiere.

Free-Cash-Flow

Wir definieren den Free-Cash-Flow als Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, bereinigt um den Kauf und Verkauf von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren. Da wir einen Großteil unserer liquiden Mittel in Form von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren halten und in einer kapitalintensiven Industrie tätig sind, berichten wir den Free-Cash-Flow, um Investoren eine

Kennzahl zur Verfügung zu stellen, die die Veränderung der Liquidität unter Berücksichtigung von Investitionen zeigt. Es bedeutet nicht, dass der restliche verfügbare Cash-Flow für sonstige Ausgaben verwendet werden kann, da Schuldendienstverpflichtungen oder andere feste Ausgaben noch nicht abgezogen sind. Der Free-Cash-Flow wird wie folgt aus der Kapitalflussrechnung hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30.9. in Mio. €	2002	2003	2004
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aller Geschäfte	237	730	1.857
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.244	-1.522	-1.809
Kauf von Wertpapieren, Saldo	647	739	158
Free-Cash-Flow	-360	-53	206

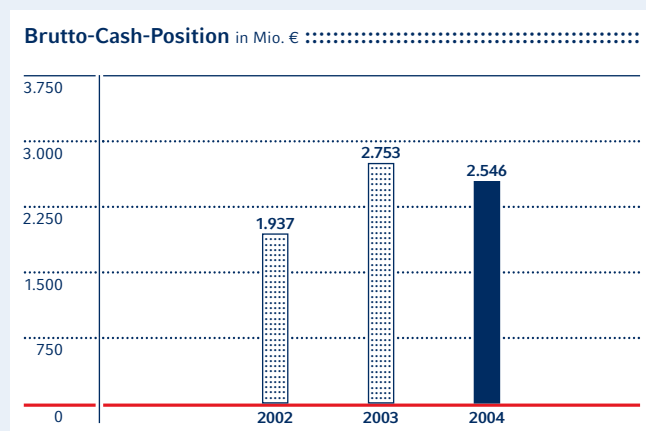
Netto-Zahlungsmittelbestand

Die folgende Tabelle stellt unseren Brutto- und Netto-Zahlungsmittelbestand sowie die Finanzverbindlichkeiten nach

ihren Fälligkeiten dar. Die Darstellung ist kein Ausblick auf die verfügbaren Zahlungsmittel der zukünftigen Perioden.

Zum 30.9.2004 in Mio. €, Zahlung fällig in:	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1-2 Jahren	2-3 Jahren	3-4 Jahren	4-5 Jahren	5 Jahren und länger
Zahlungsmittel	608	608	-	-	-	-	-
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.938	1.938	-	-	-	-	-
Brutto-Zahlungsmittelbestand	2.546	2.546	-	-	-	-	-
Abzüglich:							
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.427	-	49	655	5	2	716
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	571	571	-	-	-	-	-
Gesamte Finanzverbindlichkeiten	1.998	571	49	655	5	2	716
Netto-Zahlungsmittelbestand	548	1.975	-49	-655	-5	-2	-716

Unsere Brutto-Cash-Position – definiert als Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens – verringerte sich zum 30. September 2004 auf 2.546 Millionen Euro (Vorjahr: 2.753 Millionen Euro), überwiegend durch die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (vorwiegend unserer Wandelanleihe) in Höhe von 549 Millionen Euro, die den Free-Cash-Flow von 206 Millionen Euro mehr als kompensiert haben.



Brutto-Cash-Position verringert sich durch Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten.

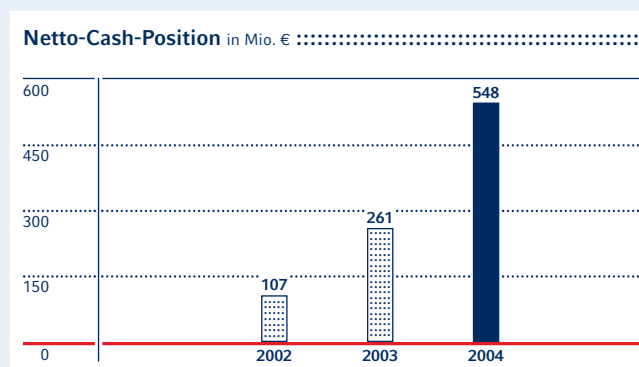
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Wandelanleihen, die zur Stärkung unserer Liquidität ausgegeben wurden und uns eine gesteigerte finanzielle Flexibilität in der Führung unseres operativen Geschäfts erlauben. Der gesamte ausstehende Betrag der Wandelanleihen belief sich am 30. September 2004 auf 1.340 Millionen Euro.

Am 5. Juni 2003 gaben wir nachrangige Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen Euro, mit Fälligkeit im Jahr 2010, im Rahmen eines an europäische institutionelle Investoren gerichteten verbindlichen Übernahmeangebots aus. Die Anleihen sind durch ihre Halter über die Laufzeit als Option wandelbar zu einer maximalen Anzahl von 68,4 Millionen Stammaktien und zu einem Wandelpreis von 10,23 Euro pro Aktie.

Am 6. Februar 2002 gaben wir nachrangige Wandelanleihen im Wert von 1.000 Millionen Euro, mit Fälligkeit im Jahr 2007, im Rahmen eines an europäische institutionelle Investoren gerichteten verbindlichen Übernahmeangebots aus. Die Anleihen sind durch ihre Halter über die Laufzeit als Option wandelbar zu einer maximalen Anzahl von 28,2 Millionen Stammaktien und zu einem Wandelpreis von

35,43 Euro pro Aktie. Während des Geschäftsjahrs 2004 kauften wir im Kalenderjahr 2007 fällige Wandelanleihen im Wert von 360 Millionen Euro zurück.

Die Netto-Cash-Position – Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens abzüglich Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristig) – erhöhte sich um 287 Millionen Euro auf 548 Millionen Euro zum 30. September 2004 (Vorjahr: 261 Millionen Euro), hauptsächlich wegen des Free-Cash-Flow in Höhe von 206 Millionen Euro.



Durch das verbesserte Ergebnis kann die positive Netto-Cash-Position ausgebaut werden.

Zur Sicherung unserer Cash-Position und zur Gewährleistung flexibler Liquidität haben wir eine Richtlinie implementiert, die das Anlagevolumen bezüglich Geschäftspartner, Rating, Branche, Laufzeit und Instrument begrenzt.

Kapitalbedarf

Im Geschäftsjahr 2005 benötigen wir Kapital zur:

- ::: Finanzierung der operativen Geschäftstätigkeit,
- ::: Rückzahlung fälliger Darlehen,
- ::: Zahlung unserer finanziellen Verbindlichkeiten zum Fälligkeitszeitpunkt und
- ::: planmäßigen Durchführung von Investitionen.

Wir erfüllen diese Anforderungen durch:

- ::: Cash-Flow aus dem operativen Geschäft,
- ::: verfügbare Zahlungsmittel und veräußerbare Wertpapiere und
- ::: verfügbare Kreditlinien.

Zum 30. September 2004 benötigen wir für das Geschäftsjahr 2005 Geldmittel in Höhe von 2.135 Millionen Euro, bestehend aus 571 Millionen Euro für kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und 1.564 Millionen Euro für vertragliche Verpflichtungen. Zusätzlich könnten 68 Millionen Euro derzeit bekannte Eventualverpflichtungen auftreten. Wir planen, maximal weitere 567 Millionen Euro für zusätzliche Investitionen in Sach- und Finanzanlagen und Beteiligungen aufzuwenden, für die wir noch keine Verpflichtungen eingegangen sind. In der Summe beläuft sich der Kapitalbedarf für finanzielle Verpflichtungen, Eventualverpflichtungen und geplante Investitionsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2005

am 30. September 2004 auf 2.770 Millionen Euro. Unser Brutto-Zahlungsmittelbestand beläuft sich am 30. September 2004 auf 2.546 Millionen Euro, und wir können 1.086 Millionen Euro aus den verfügbaren Kreditlinien finanzieren.

Zum 30. September 2004 weisen wir Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 571 Millionen Euro aus, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Die Hauptkomponente stellt unser Konsortialdarlehen mit einem Wert von 450 Millionen Euro dar, das im Zusammenhang mit der Ausweitung der Fertigungsstätte in Dresden bis zum 30. September 2004 voll in Anspruch genommen wurde und am 30. September 2005 fällig wird.

Vertragliche Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen

Zum 30.9.2004 ^{1,2} , in Mio. €, Zahlung fällig in	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1-2 Jahren	2-3 Jahren	3-4 Jahren	4-5 Jahren	5 Jahren und länger
Vertragliche Verpflichtungen:							
Zahlungen aus Leasingverträgen	918	83	101	77	74	55	528
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.711	1.356	187	69	37	17	45
Andere langfristige Verpflichtungen	321	125	50	45	101	-	-
Summe vertragliche Verpflichtungen	2.950	1.564	338	191	212	72	573
Eventualverpflichtungen							
Garantien	419	10	-	304	-	-	105
Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand ³	433	58	52	161	126	33	3
Summe Eventualverpflichtungen	852	68	52	465	126	33	108

Die oben stehende Tabelle sollte im Zusammenhang mit Anhang Nr. 31 zu unserem Konzernabschluss des Geschäftsjahrs 2004 gelesen werden.

1 Oben stehende Tabelle enthält gewisse Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen. Die wahrscheinliche Fälligkeit wurde von der Gesellschaft abgeschätzt. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

2 Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2004 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen 683 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004.

3 Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und nicht anderweitig garantiert sind, und müssen gegebenenfalls zurückerstattet werden, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

Investitionen

Investitionen in Mio. €	2002	2003	2004
Geschäftsjahr zum 30.9.			
Speicherprodukte	464	576	716
Nicht-Speicherprodukte	179	296	447
Gesamt	643	872	1.163

Zur Fertigstellung unserer 300-Milimeter-Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, und zur Verbesserung von Produktivität und Technologie an den übrigen Standorten beabsichtigen wir, im Geschäftsjahr 2005 zwischen 1.000 und 1.300 Millionen Euro in Sachanlagen zu investieren. Zum 30. September 2004 waren davon 833 Millionen Euro fest vereinbart und sind in den unbedingten Abnahmeverpflichtungen enthalten. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 60 Prozent der erwarteten Investitionen sollen auf die Front-End- und die Back-End-Fertigungen des Geschäftsbereichs Speicherprodukte entfallen. Zudem wollen wir bis zu 200 Millionen Euro Finanz- und Beteiligungsinvestitionen im Geschäftsjahr 2005 tätigen, von denen zum 30. September 2004 etwa 100 Millionen Euro bereits festgelegt und in andere langfristige Verpflichtungen ausgewiesen sind.

Kreditlinien

Wir haben verschiedene voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart. Diese Kreditlinien haben eine Höhe von 1.760 Millionen Euro, von denen 1.086 Millionen Euro zum 30. September 2004 verfügbar waren. Die Kreditlinien bestehen aus vier Gruppen (siehe unten stehende Tabelle).

Im September 2004 haben wir einen 400 Millionen US-Dollar/400 Millionen Euro-Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart. Dieser Kredit besteht aus zwei Tranchen: Tranche A umfasst 400 Millionen US-Dollar und ist zur Finanzierung

der Erweiterung der Produktionsanlagen am Standort Richmond/Virginia vorgesehen. Tranche B ist eine 400 Millionen Euro Mehrwährungskreditlinie, die revolving für generelle betriebliche Zwecke genutzt werden kann und die vorherige 375 Millionen Euro in 2005 auslaufende Mehrwährungskreditlinie ersetzt. Der maximal ausstehende Betrag der Tranche A reduziert sich durch ab 30. September 2006 einsetzende gleichmäßige Rückzahlungen. Die neue Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Zum 30. September 2004 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Der Zinssatz schwankt in Abhängigkeit von einer Profitabilitäts-Kennzahl. Gegenüber den Darlehensgebern der dargestellten 400 Millionen US-Dollar/400 Millionen Euro Kreditlinien wurde eine Negativklärung bezüglich der Bestellung von nicht zugelassenen Sachversicherungen abgegeben.

Zum 30. September 2004 halten wir die geforderten Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden Kreditlinien ein.

Nach unserer Planung soll die Finanzierung des Nettoumlaufvermögens und des übrigen Finanzmittelbedarfs aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Darlehen, Fördermitteln der öffentlichen Hand und, falls notwendig, durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Wir können nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, die zusätzlich benötigten Finanzmittel für Forschung und Entwicklung, zur Finanzie-

Kreditlinien in Mio. €

Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2004		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
Kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien, Cash-Management	163	73	90
Kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital	272	–	272
Langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	724	–	724
Langfristig¹	feste Zusage	Projektfinanzierung	601	601	–
Gesamt			1.760	674	1.086

¹ Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

zung des Nettoumlaufvermögens oder für andere Investitionen überhaupt beziehungsweise zu günstigen Konditionen beschaffen zu können.

Unter Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen Ressourcen einschließlich der intern generierten Zahlungsmittel und der derzeit verfügbaren Kreditlinien erwarten wir in der Lage zu sein, unsere derzeit geplanten operativen Verbindlichkeiten und Investitionsverpflichtungen aus liquiden Mitteln bedienen zu können.

Mitarbeiter und Campeon

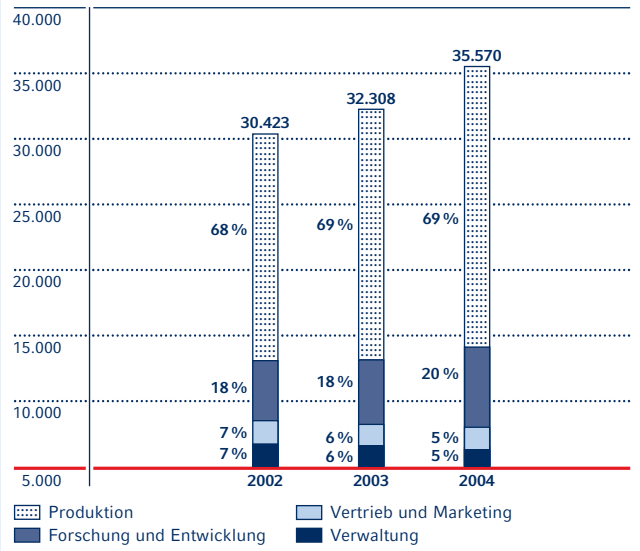
Campeon

Wir haben einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG (MoTo) abgeschlossen. Dieser beinhaltet eine Leasingvereinbarung über einen Bürokomplex im Süden Münchens, welcher von MoTo errichtet wird. Dieser Bürokomplex ermöglicht uns, die Mitarbeiter, die derzeit über verschiedene Standorte in München verteilt sind, in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammenzuführen. MoTo ist für den Bau, der in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2005 fertig gestellt sein soll, verantwortlich. Wir haben keine Finanzierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen.

Mitarbeiter

Diese Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Belegschaft nach Regionen und Funktionen jeweils zum 30. September.

Mitarbeiter in den Bereichen¹



Reduzierung des Mitarbeiterereinsatzes bei Vertrieb und Marketing sowie bei Verwaltung zu Gunsten von Forschung und Entwicklung.
1 Rundungsdifferenzen sind möglich.

Die Erhöhung der Mitarbeiteranzahl im Geschäftsjahr 2003 war bedingt durch den Hochlauf unserer 300-Millimeter-Fertigung und die Akquisition von SensoNor. Im Geschäftsjahr 2004 war vorwiegend die Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Malaysia und China für die Einstellung weiterer Mitarbeiter ausschlaggebend.

Zum 30.9.	2002	2003	2004
Funktionen:			
Produktion	20.822	22.405	24.540
Forschung und Entwicklung	5.374	5.935	7.160
Vertrieb und Marketing	2.010	2.048	1.948
Verwaltung	2.217	1.920	1.922
Gesamt	30.423	32.308	35.570
Regionen:			
Deutschland	15.716	16.166	16.387
Übriges Europa	4.590	5.034	5.631
Nordamerika	2.889	2.757	2.982
Asien-Pazifik	7.093	8.116	10.340
Japan	107	118	133
Andere	28	117	97
Gesamt	30.423	32.308	35.570

Risiken und Chancen

Vorbemerkung

Im Halbleitergeschäft wechseln sich regelmäßig Perioden des Marktwachstums mit Perioden der Marktrückgänge ab. Marktrückgänge sind insbesondere geprägt durch Überkapazitäten, steigende Auftragsstornierungen, überdurchschnittlich sinkende Preise und rückläufige Umsatzerlöse. Ergänzt wird diese Risikolage durch den sehr hohen Investitionsbedarf zur Absicherung der Marktführerschaft sowie den außerordentlich schnellen technologischen Wandel. Diesen hohen Risiken stehen im Halbleitergeschäft allerdings auch außergewöhnliche Chancen gegenüber.

Das Risikomanagementsystem bei Infineon Technologies

Bei der hohen Volatilität des Halbleitergeschäfts ist eine frühzeitige Reaktion auf die sich verändernden Marktbedingungen dringend erforderlich. Wir haben deshalb ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagementsystem installiert, das uns in die Lage versetzt, die sich aus dem Markt heraus ergebenden Chancen und Risiken zu identifizieren bzw. zu antizipieren. Der alle Bereiche umfassende Ansatz und die zugehörige Berichterstattung als zentrales Element des Risiko- und Chancenmanagementsystems geben der Unternehmensleitung die Möglichkeit, schnell und effektiv zu handeln. In jedem Bereich des Unternehmens sind Risikobeauftragte und Risikoberichterstatter benannt, die für die Umsetzung des Reporting-Prozesses Verantwortung tragen. Der Reporting-Prozess sieht vor, dass Risiken und Chancen in Risiko- bzw. Chancenkategorien eingeteilt und zusammen mit einer Einschätzung des wahrscheinlichen Eintritts und ihrer Auswirkungen, gemessen in Ebit, berichtet werden.

Das Risiko- und Chancenmanagementsystem ist umfassend in unserem Intranet dokumentiert und damit für unsere Mitarbeiter weltweit zugänglich.

Das System basiert auf individuellen Beobachtungen, unterstützt durch entsprechende Managementprozesse, und ist in unsere Kernaktivitäten integriert. Es beginnt bei der strategischen Planung und setzt sich über die Fertigung und den Vertrieb einschließlich des Forderungsmanagements fort. Als eine Erweiterung des Planungsprozesses in den Geschäftsbereichen, der Vertriebsorganisation, den Fertigungs-

Clustern und den Zentralbereichen dient das Risiko- und Chancenmanagementsystem zur Identifikation und Bewertung möglicher Abweichungen von erwarteten Entwicklungen. Neben der Identifikation und Bewertung von wesentlichen Entwicklungen, die unser Geschäft beeinflussen können, wird das System auch herangezogen, um Aktivitäten zu priorisieren und zu implementieren, um Chancen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren.

Die Geschäftseinheiten erstellen regelmäßig Risiko- und Chancenberichte, die den Kern des Risiko- und Chancenmanagementsystems darstellen. Die Berichte werden vom Vorstand und von den Geschäftsbereichsverantwortlichen bewertet und sind Teil des Berichtsprozesses.

Neben diesem zentralen System gibt es weitere Frühwarnsysteme, die zur Beherrschung und Steuerung von Risiken und Chancen beitragen. Hierzu gehört auch der Einsatz der Balanced Scorecard. Ferner wird die Methodik der quantitativen Risikoanalyse verwendet. Die durch Simulationen unterstützte Analyse von quantifizierbaren Risiken ist bereits integrativer Bestandteil des Managements von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Des Weiteren wird die Methodik der quantitativen Risikoanalyse bei Finanzentscheidungen wie Investments oder bei Umsatzprognosen eingesetzt. Ziel ist, neben der Risikobewertung eine Analyse und Bewertung von risikomindernden Maßnahmen unter Ausnutzung quantifizierbarer Unsicherheiten sicherzustellen.

Die systematische Weiterentwicklung bestehender und neuer Systeme mit Frühwarncharakter trägt maßgeblich zur weiteren Festigung und zum gezielten Ausbau unserer unternehmensweiten Risiko- und Chancenkultur bei. Diese wird auch unterstützt durch regelmäßig stattfindende Risiko/Chancen-Foren, die vorrangig als Diskussionsbasis und Informationsplattform dienen und so das Bewusstsein für diese wichtige Thematik weiter stärken.

Im Rahmen einer jährlich durchzuführenden Risikomanagementsystemanalyse (RMSA) werden über einen Fragenkatalog in den Geschäfts- und Zentralbereichen die Elemente des Risikomanagementsystems systematisch hinterfragt und so zwangsläufig Schwachstellen identifiziert. Die RMSA dient damit zum einen der Selbstbeurteilung mit anschließenden gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Subsysteme und zum anderen der Unterstützung der Prüfung des Risikomanagementsystems durch die interne Revision und den externen Wirtschaftsprüfer.

Das Risikofrüherkennungssystem ist vom Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft worden.

Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen, insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems, in geeigneter Weise getroffen hat und das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Gesamtwirtschaftliche Risiken

Durch Veränderungen in einigen geographischen Teilen der Welt, in denen wir aktiv sind, könnten Risiken entstehen.

Unsere weltweite Strategie sieht vor, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen Entwicklungs- und Fertigungsstandorte über den ganzen Globus verteilt unterhalten. Dies können Marktzugangs- oder auch Technologie- sowie Kostengründe sein. Über die Hälfte unserer Umsatzerlöse wird außerhalb Europas generiert. Mit den weiterhin zu erwartenden hohen Wachstumsraten in asiatischen Ländern wird unsere Investitionstätigkeit in dieser Region weiter zunehmen. Es können daher Risiken entstehen, die sich daraus ergeben, dass

- ::: wirtschaftliche und geopolitische Krisen Auswirkungen auf regionale Märkte haben,
- ::: länderspezifische Gesetze und Regelungen den Investitionsrahmen und die Möglichkeiten, freien Handel zu betreiben, beeinflussen und
- ::: unterschiedliche Praktiken bei der Auslegung von steuerlichen, juristischen oder administrativen Regeln die Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten eingrenzen.

Substanzielle Veränderungen in dem jeweiligen Umfeld können negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Es ist daher nicht auszuschließen, dass regionale Krisen wie in der Vergangenheit zum Beispiel SARS auch in Zukunft negative Auswirkungen auf unsere Ertragsfähigkeit haben können. Die breite Diversifikation innerhalb unseres Produktportfolios und eine Streuung der Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten sind jedoch ein wirksames Mittel gegen die Auswirkungen solcher regionalen Krisen, weil die Abhängigkeiten generell geringer sind.

Branchen- und unternehmensspezifische Risiken

Im Geschäftsbereich Speicherprodukte ist die Volatilität der DRAM-Speicherpreise weiterhin das bedeutendste Risiko, aber auch Chance sowohl für den Bereich als auch für Infineon.

Durch den Einstieg in das Geschäft mit Flash-Produkten weiten wir unser Produktportfolio gezielt aus, was neben den damit verbundenen Chancen allerdings auch erhebliche Risiken mit sich bringen kann. Bei der Produktion sehen wir im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr geringere Risiken, da die Umstellung auf die neueste 110-Nanometer-Technologie bereits im Wesentlichen erfolgt ist. Insgesamt rechnen wir mit einer annähernd ausgeglichenen Chancen/Risiken-Position.

Bei den Logikbereichen rechnen wir trotz insgesamt positiver Perspektiven insbesondere bei Sicheren Mobilien Lösungen und Drahtgebundener Kommunikation mit deutlichen Absatzrisiken. Der hohe Preisdruck mit entsprechenden Risiken bleibt im gesamten Bereich bestehen.

Ein insgesamt für die Halbleitertechnologie wesentliches geschäftstypisches Risiko ist der Hochlauf neuer Technologien mit dem Risiko von Verzögerungen bzw. deutlichen Ausbeuteschwankungen. Diesem Risiko versuchen wir mit kontinuierlich verbessertem Projektmanagement und entsprechend engem Monitoring der betroffenen Geschäftsprozesse zu begegnen.

Gegen Produktrisiken haben wir ein Netz von Qualitätskontrollen eingerichtet, in das auch die wichtigsten Lieferanten einbezogen sind. Alle Standorte sind nach der Norm TS 16949:2002 zertifiziert.

Wir schützen uns mit Versicherungen bestmöglich gegen Auswirkungen von Haftungsrisiken oder Schadensfällen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Im Patentbereich profitiert Infineon vom Schutz mehrerer Verträge mit wichtigen Wettbewerbern. Die Gesellschaft bemüht sich deshalb intensiv, diesen Schutz durch Verhandlungen mit führenden Wettbewerbern, mit denen noch keine patentrechtlichen Vertragsbeziehungen bestehen, weiter auszudehnen und somit Risiken zu minimieren.

Steuerliche, wettbewerbs- und börsenrechtliche Regelungen können ebenso Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.

Marktrisiken

Fremdwährungsmanagement

Die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit bringt eine Vielzahl von Zahlungsströmen in unterschied-

lichen Währungen – vor allem in US-Dollar – mit sich. Da wir aus diesen Geschäften einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, kommt der Absicherung des Währungsrisikos eine hohe Bedeutung zu.

Ein bedeutender Anteil unserer Umsatzerlöse, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten entsteht originär nicht in Euro, sondern vorwiegend in US-Dollar. Wechselkursschwankungen gegenüber dem Euro können einen negativen Effekt auf Umsatzerlöse, Kosten und Ergebnis haben.

Unsere Geschäftspolitik zur Begrenzung von kurzfristigen Fremdwährungsrisiken ist es, mindestens 75 Prozent des erwarteten Nettorisikos über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten im Voraus, je nach Art des Grundgeschäfts für einen bedeutenden Anteil auch darüber hinaus, zu sichern. Ein Teil des Fremdwährungsrisikos bleibt auf Grund des Unterschieds zwischen tatsächlichen und erwarteten Beträgen bestehen. Wir berechnen dieses Nettorisiko auf Basis des Kapitalflusses unter Berücksichtigung von Bilanzpositionen, eingegangenen oder vergebenen Aufträgen und allen anderen geplanten Einnahmen und Ausgaben. Das verbleibende Risiko wird im Rahmen definierter Value-at-Risk-Parameter gesteuert.

Management des Zinsrisikos

Unsere Zinsrisikopositionen resultieren hauptsächlich aus Geldanlageinstrumenten, Wertpapieremissionen und Kreditaufnahmen. In den Geschäftsjahren 2002 und 2003 haben wir jeweils eine Wandelschuldverschreibung begeben. Vor dem Hintergrund der hohen Geschäftszyklizität und der operativen Flexibilität halten wir einen vergleichsweise hohen Kassenbestand, den wir in Instrumente mit kurzer Zinsbindungsdauer anlegen. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos nutzen wir Zinsderivate, um die aktive und passive Zinsbindung einander anzunähern.

Materialpreissrisiken

Wir sind auf Grund unserer Abhängigkeit von verschiedenen Materialien Preisrisiken ausgesetzt. Wir versuchen, diese Risiken durch unsere Einkaufsstrategien und durch Einsatz geeigneter Instrumente zu minimieren. Wir setzen keine derivativen Finanzinstrumente zur Vermeidung von Restrisiken aus Preisschwankungen ein.

Finanzierungsrisiken

Alle Halbleiterunternehmen, die eigene Fertigungsstätten betreiben, müssen erhebliche Kapitalbeträge für den Bau, die Erweiterung, die Modernisierung und die Instandhaltung dieser Anlagen einsetzen. Darüber hinaus müssen erhebliche finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden. Der Finanzmittelbedarf soll aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Fördermitteln der öffentlichen Hand und – abhängig von Marktbedingungen – durch die Aufnahme von Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente gedeckt werden. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen von Forschung und Entwicklung und der Fertigung werden weiterhin aktiv genutzt, um den Finanzierungsbedarf zu reduzieren.

Rechtliches Risiko

Wie bei vielen Unternehmen in der Halbleiterbranche wird auch Infineon gegenüber behauptet, das Unternehmen habe gewerbliche Schutzrechte verletzt, fehlerhafte Produkte geliefert oder die Umweltschutzaufgaben nicht eingehalten oder gesetzliche Pflichten verletzt. Ungeachtet der Erfolgsaussichten derartiger Ansprüche, können dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Abwehr derartiger Ansprüche hohe Kosten entstehen. Infineon wehrt sich in solchen Angelegenheiten energisch mit Unterstützung interner und externer Experten.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar.

Ergänzende Beschreibungen der Risiken können Sie aus dem anliegenden Anhang zum Konzernabschluss und dem „Annual Report on Form 20-F“ entnehmen.

Infineon Technologies AG

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Infineon-Konzerns und führt die entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen aus. Die Infineon Technologies AG übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben, wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, das Personalwesen, strategische und produktionsorientierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Infineon Technologies AG verfügt über eigene Fertigungen in München und Regensburg.

Die Infineon Technologies AG stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) auf. Der vollständige Abschluss wird separat veröffentlicht.

Gewinn- und Verlust-Rechnungen¹ (Kurzfassung) in Mio. €

Geschäftsjahr zum 30.9.	2002	2003	2004
Umsatz	6.765	8.122	8.852
Umsatzkosten	-6.669	-7.201	-7.325
Bruttoergebnis	96	921	1.527
Aufwendungen für übrige Funktionsbereiche	-1.358	-1.460	-1.533
Übrige Aufwendungen und Erträge	580	252	136
Ergebnis vor Ertragssteuer	-682	-287	130
Ertragssteuer	65	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-617	-287	130
Verlustvortrag aus Vorjahr	-435	-1.052	-1.339
Bilanzverlust	-1.052	-1.339	-1.209

¹ Erstellt nach HGB.

Die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis der Infineon Technologies AG konnten im Berichtsjahr wegen einer gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten und einer günstigen Preisentwicklung, insbesondere bei Speicherprodukten, erhöht werden. Auf Grund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der Infineon Technologies AG als Verrechnungsdrehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze aus als der Konzern.

Bilanzen zum 30.9.¹ (Kurzfassung) in Mio. €

Geschäftsjahr zum 30.9.	2003	2004
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	794	768
Finanzanlagen	5.390	5.733
Anlagevermögen	6.184	6.501
Vorräte	461	470
Forderungen und Sonstiges	1.980	1.992
Wertpapiere, Zahlungsmittel	2.641	2.395
Umlaufvermögen	5.082	4.857
Summe Aktiva	11.266	11.358
Eigenkapital	6.774	7.182
Rückstellungen	612	798
Verbindlichkeiten und Sonstiges	3.880	3.378
Summe Passiva	11.266	11.358

¹ Erstellt nach HGB.

Die Vermögens- und Finanzlage der Infineon Technologies AG ist bei den Aktiva geprägt durch den Anstieg der Finanzanlagen und den Rückgang bei Wertpapieren und flüssigen Mitteln, im Wesentlichen auf Grund der Erhöhung unserer Beteiligungen an Inotera, SC300 und Eupec, teilweise kompensiert durch eine Kapitalherabsetzung bei der Infineon Technologies Holding B.V., Niederlande. In den Passiva stehen dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen eine Erhöhung der Rückstellungen, im Wesentlichen im Zusammenhang mit den kartellrechtlichen Ermittlungen, und eine Erhöhung des Eigenkapitals, resultierend aus der Ausgabe von Aktien für den Erwerb der restlichen Anteile an der SC300 und dem Jahresüberschuss, gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 63 Prozent (Vorjahr: 60 Prozent).

Dividende

Da der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG für 2002/2003 keinen Bilanzgewinn auswies, wurde für das Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet. Ebenso kann für das Geschäftsjahr 2003/2004 keine Dividende ausgeschüttet werden, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust ausweist.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 10. November 2004 haben die Gesellschaft und ProMOS eine Vereinbarung über die Lizenzvergabe von früher an ProMOS transferierten Technologien abgeschlossen. ProMOS darf Produkte auf Basis dieser Technologien herstellen und vertreiben und darauf basierende eigene Prozesse und Produkte entwickeln. ProMOS hat zugestimmt, einen Gesamtpreis von 156 Millionen US-Dollar in vier Raten bis April 2006 zu bezahlen. Bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von 36 Millionen US-Dollar für den Bezug von Produkten von ProMOS werden angerechnet. Die Parteien haben vereinbart, alle damit verbundenen Klagen zurückzuziehen, inklusive das Schiedsgerichtsverfahren. Die entsprechenden Lizenzentnahmen werden im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 gezeigt.

Ausblick

Führende Marktforschungsinstitute prognostizieren einen Rückgang der Wachstumsrate im weltweiten Halbleitermarkt von nahezu 30 Prozent (gemessen in US-Dollar) im Kalenderjahr 2004 auf ein einstelliges Wachstum im Kalenderjahr 2005. Diese Prognose impliziert eine Stagnation in der Branche im Hinblick auf die Wachstumsaussichten für die folgenden Quartale unseres Geschäftsjahrs 2005. Analog diesen Prognosen sehen wir für das erste Quartal unseres Geschäftsjahrs 2005 Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums in mehreren unserer Marktsegmente. In diesen Märkten sind für diese Jahreszeit relativ höhere Lagerbestände in den Versorgungsketten vorhanden.

Ausblick für unsere Segmente für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2005:

::: Im Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation erwarten wir angesichts des anhaltenden Preisdrucks und der Bereinigung von Lagerbeständen in diesem Markt, insbesondere in der asiatischen Region, im ersten Quartal unseres Geschäftsjahrs 2005 kein Wachstum in diesem Marktsegment. Wir erwarten, dass sich das negative Ebit des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation

im Geschäftsjahr 2005 beträchtlich reduzieren wird, sobald der Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts an Finisar abgeschlossen ist.

::: Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums und höhere Lagerbestände haben im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen dazu geführt, dass die Kunden, insbesondere im asiatischen Markt für Mobiltelefone, bei neuen Aufträgen erhebliche Zurückhaltung üben. Wir erwarten daher einen deutlichen Rückgang der Umsätze im ersten Quartal unseres Geschäftsjahrs 2005, der zu einer geringeren Kapazitätsauslastung führt und die Margen unter Druck setzt. Da die Marktforschungsinstitute im Mobiltelefonmarkt für das Kalenderjahr 2005 eine Verlangsamung des Wachstums voraussagen, sind wir sehr vorsichtig bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung des Umsatzvolumens. Das Unternehmen erwartet daher einen geringeren Auslastungsgrad der Produktion im gesamten Geschäftsjahr 2005.

::: Im Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik erwarten wir bei der Automobilelektronik einen anhaltenden Preisdruck und keine gravierenden Veränderungen der Nachfrage nach Halbleitern. Im Bereich Industrieelektronik gehen wir von einem leicht schwächeren Markt aus. Angesichts dieser Entwicklungen in Kombination mit saisonalen Effekten erwarten wir einen leichten Rückgang der Umsätze und Gewinne im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005.

::: Für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2005 erwarten wir im Geschäftsbereich Speicherprodukte eine Geschäftsentwicklung entsprechend der normalen, saisonal bedingten Nachfrage. Angesichts der zusätzlichen Kapazitäten bei unserem Gemeinschaftsunternehmen Inotera und bei Foundry-Partnern gehen wir von einem Anstieg der Bit-Produktion aus.

Im Geschäftsjahr 2005 rechnen wir nicht damit, uns vom Branchentrend abkoppeln zu können. Wir wollen profitabel wachsen, indem wir konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, unsere kooperative Unternehmenskultur erhalten und kontinuierlich unsere operative Leistungsfähigkeit durch moderne Fertigungsstätten und Spitzentechnologien verbessern.

München, im November 2004
Der Vorstand

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Aufsichtsrat und die Aktionäre der Infineon Technologies AG

Wir haben die beigefügten Konzernbilanzen der Infineon Technologies AG, einschließlich ihrer Tochterunternehmen, zum 30. September 2003 und 2004 sowie die zugehörigen Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, die Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen sowie die Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September 2002, 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre (Konzernrechnungslegung) geprüft. Die Konzernrechnungslegung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Konzernrechnungslegung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach den Standards des Public Company Accounting Oversight Board (United States) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernrechnungslegung frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben in der Konzernrechnungslegung auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Konzernrechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt die oben genannte Konzernrechnungslegung die Vermögens- und Finanzlage des Infineon-Konzerns zum 30. September 2003 und 2004 sowie die Ertragslage und die Zahlungsströme für die am 30. September 2002, 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles) in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

München, den 10. November 2004

**KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Hoyos
Wirtschaftsprüfer

Feege
Wirtschaftsprüfer

Konzernabschluss

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	Anhang Nr.	2002	2003	2004
Umsatzerlöse				
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	5	4.035	5.153	6.169
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen	27	855	999	1.026
Umsatzerlöse gesamt		4.890	6.152	7.195
Umsatzkosten	7	4.289	4.614	4.670
Bruttoergebnis vom Umsatz		601	1.538	2.525
Forschungs- und Entwicklungskosten		1.060	1.089	1.219
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten		643	679	718
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	8	16	29	17
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge, Saldo	7	-46	85	257
Betriebsergebnis		-1.072	-344	314
Zinsergebnis		-25	-52	-41
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	16	-47	18	-14
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	16	18	-2	2
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo		-41	21	-64
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		7	8	18
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.160	-351	215
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	143	-84	-154
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag von fortgeführten Geschäften		-1.017	-435	61
Ergebnis von aufgegebenem Geschäft	4	-4	-	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		-1.021	-435	61
Unverwässerter und verwässerter Konzernüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie in Euro	10			
von fortgeführten Geschäften		-1,46	-0,60	0,08
von aufgegebenem Geschäft		-0,01	0,00	0,00
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		-1,47	-0,60	0,08

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Konzern-Bilanzen zum 30. September in Mio. €

	Anhang Nr.	2003	2004
Aktiva			
Umlaufvermögen:			
Zahlungsmittel		969	608
Wertpapiere des Umlaufvermögens	11	1.784	1.938
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	876	1.056
Vorräte	13	959	960
Aktive kurzfristige latente Steuern	9	113	140
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	14	675	590
Summe Umlaufvermögen		5.376	5.292
Sachanlagen	15	3.817	3.587
Finanzanlagen	16	425	708
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel		67	109
Aktive latente Steuern	9	705	541
Sonstige Vermögensgegenstände	17	485	627
Summe Aktiva		10.875	10.864
Passiva			
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	21	149	571
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	877	1.098
Rückstellungen	19	577	555
Passive kurzfristige latente Steuern	9	39	16
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20	562	630
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		2.204	2.870
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	21	2.343	1.427
Passive latente Steuern	9	32	21
Sonstige Verbindlichkeiten	22	630	568
Summe Verbindlichkeiten		5.209	4.886
Eigenkapital:			
Grundkapital	23	1.442	1.495
Zusätzlich eingezahltes Kapital (Kapitalrücklage)		5.573	5.800
Verlustvortrag		-1.261	-1.200
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-88	-117
Summe Eigenkapital		5.666	5.978
Summe Passiva		10.875	10.864

Siehe auch die beigelegten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen für die am 30. September 2002, 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre

	Anhang Nr.	Ausgegebene Stückaktien Anzahl	Ausgegebene Stückaktien Betrag Mio. €
Konzernbilanz zum 1. Oktober 2001		692.382.575	1.385
Konzernjahresfehlbetrag		-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-	-
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Mitarbeiteraktien	24	355.460	1
Kauf von Catamaran	3	546.183	1
Kauf von MIC	3	27.500.000	55
Von Gemeinschaftsunternehmen gehaltene auf den Namen lautende Stückaktien		-	-
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo Einlagen der Siemens AG		-	-
Konzernbilanz zum 30. September 2002		720.784.218	1.442
Konzernjahresfehlbetrag		-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-	-
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Kauf von Catamaran	3	96.386	-
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo Andere Einlagen		-	-
Konzernbilanz zum 30. September 2003		720.880.604	1.442
Konzernjahresüberschuss		-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-	-
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Rückzahlung rückgewährbarer Einlagen	22	26.679.255	53
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo		-	-
Konzernbilanz zum 30. September 2004		747.559.859	1.495

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Zusätzlich ein- gezahltes Kapital/ Kapitalrücklage Mio. €	Verlustvortrag Mio. €	Kumulierte Fremdwährungs- rechnungsdifferenzen Mio. €	Zusätzliche Pensionsver- bindlichkeiten Mio. €	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Mio. €	Nicht realisierte Gewinne aus Sicherungsgeschäften Mio. €	Gesamt Mio. €
5.247	195	87	-12	-2	-	6.900
-	-1.021	-	-	-	-	-1.021
-	-	-92	-8	-	-	-100
						-1.121
7	-	-	-	-	-	8
8	-	-	-	-	-	9
270	-	-	-	-	-	325
4	-	-	-	-	-	4
23	-	-	-	-	-	23
10	-	-	-	-	-	10
5.569	-826	-5	-20	-2	-	6.158
-	-435	-	-	-	-	-435
-	-	-76	2	13	-	-61
						-496
1	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	7
-4	-	-	-	-	-	-4
5.573	-1.261	-81	-18	11	-	5.666
-	61	-	-	-	-	61
-	-	-41	18	-7	1	-29
						32
225	-	-	-	-	-	278
2	-	-	-	-	-	2
5.800	-1.200	-122	-	4	1	5.978

Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	Anhang Nr.	2002	2003	2004
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		-1.021	-435	61
Abzüglich: Ergebnis von aufgegebenem Geschäft		-4	-	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag von fortgeführten Geschäften		-1.017	-435	61
Anpassungen zur Überleitung des Konzernüberschusses/-fehlbetrags von fortgeführten Geschäften auf Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:				
Planmäßige Abschreibungen	15/17	1.370	1.437	1.320
Erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	3	37	6	9
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen		23	7	2
Wertberichtigungen auf Forderungen	12	-5	-16	15
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	11	1	-56	-9
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten	4	-39	10	2
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen		2	3	-5
Anteiliger Überschuss von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	16	47	-18	14
Aufwendungen/Erträge aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	16	-18	2	-2
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		-7	-8	-18
Außerplanmäßige Abschreibungen	16/17	51	98	136
Latente Steuern	9	-282	16	96
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	-131	-227	-219
Vorräte	13	-28	-112	-40
Sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	14	39	156	154
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	40	-217	228
Rückstellungen	19	86	164	92
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20	-37	-17	-22
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	17/22	94	-62	43
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		226	731	1.857

Fortsetzung Konzern-Kapitalflussrechnungen in Mio. €

	Anhang Nr.	2002	2003	2004
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:				
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens		-709	-2.752	-2.678
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens		62	2.013	2.520
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftsanteilen		96	164	9
Einzahlungen/Auszahlungen für Beteiligungen, abzüglich erworbene Zahlungsmittel		156	6	-29
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	16	-178	-76	-386
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17	-55	-58	-125
Auszahlungen für Sachanlagen	15	-643	-872	-1.163
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	15	27	53	43
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-1.244	-1.522	-1.809
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:				
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21	4	-36	62
Veränderung der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen	27	-40	-76	75
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	21	1.482	700	-
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	21	-21	-25	-549
Veränderung der als Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel		15	3	-43
Einzahlungen aus Ausgabe von Aktien an Minderheitsgesellschafter		-	-	53
Einzahlungen aus Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien		8	-	-
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		1.448	566	-402
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel		1	-4	-7
Veränderung der Zahlungsmittel von fortgeführten Geschäften		431	-229	-361
Veränderung der Zahlungsmittel von aufgegebenem Geschäft		11	-1	-
Zahlungsmittel am Periodenanfang		757	1.199	969
Zahlungsmittel am Periodenende		1.199	969	608

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Anhang zum Konzernabschluss

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Infineon Technologies Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften („die Gesellschaft“) entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten, eingesetzt. Das Produktspektrum der Gesellschaft umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden der Gesellschaft befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 30. September.

Gründung

Die Gesellschaft wurde als eigenständiges Rechtssubjekt mit Wirkung zum 1. April 1999 gegründet („Gründung“). Im Zuge der Gründung erfolgte die Übertragung des nahezu vollständigen mit dem Halbleitergeschäft verbundenen Vermögens der Siemens AG („Siemens“) mit allen Beteiligungen, Betrieben und Geschäftsaktivitäten. Der Börsengang der Gesellschaft erfolgte am 13. März 2000. Die Gesellschaft wird an der New York Stock Exchange gehandelt und ist eines der 30 Dax-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Grundlagen der Darstellung

Der Konzernabschluss wurde nach den in den USA geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung („US-GAAP“) erstellt. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs („HGB“) muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie zum Beispiel US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsmöglichkeit des § 292a HGB in Anspruch.

Alle in diesem Jahresabschluss gezeigten Beträge sind in Millionen Euro („€“), außer wenn anders angegeben.

Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vorjahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu gewährleisten. Das Konzernergebnis wird von diesen Umgliederungen nicht beeinflusst.

2. Bilanzierung und Bewertung

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Konsolidierungsgrundsätze

Der vorliegende Konzernabschluss umfasst, jeweils auf konsolidierter Basis, die Gesellschaft und deren wesentliche Tochtergesellschaften. Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mit 20% oder mehr beteiligt ist, die jedoch nicht unter der einheitlichen Leitung der Gesellschaft stehen („Assoziierte Unternehmen“), werden prinzipiell unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert (siehe Anhang Nr. 16). Das anteilige Jahresergebnis der nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften mit anderem Geschäftsjahresende wird im Allgemeinen um drei Monate zeitversetzt erfasst. Sonstige Beteiligungen, an denen die Gesellschaft einen Eigentumsanteil von weniger als 20% hält, werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. Die Auswirkungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen den konsolidierten Gesellschaften sind im Konzernabschluss eliminiert.

Der Infineon-Konzern besteht neben der Gesellschaft aus der folgenden Anzahl von Unternehmen:

	Konsolidierte Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gesamt
30. September 2003	52	11	63
Zugänge	8	4	12
Zusammenschlüsse	-4	-	-4
30. September 2004	56	15	71

Zusätzlich umfasst der Konzernabschluss 30 (2003: 30) Tochtergesellschaften und 9 (2003: 8) assoziierte Unternehmen, die im Geschäftsjahr 2004 nach der Equity-Methode und früher nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanziert wurden, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Auswirkung der Nicht-Konsolidierung dieser Unternehmen auf die Konzernbilanzsumme, die Konzernumsätze und das Konzernergebnis war in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 geringer als 1%.

Berichtswährung und Währungsumrechnung

Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden grundsätzlich unter Anwendung der Stichtagskursmethode umgerechnet. Posten der Gewinn- und Verlust-Rechnungen werden dagegen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Geschäftsjahrs umgerechnet. Unterschiede aus der Umrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden, die aus zu Vor-

jahren abweichenden Wechselkursen resultieren, werden innerhalb des Postens „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ (Other Comprehensive Income/Loss) separat im Eigenkapital ausgewiesen.

Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten Wechselkurse für die wichtigsten Währungen aufgeführt:

Währung in €	Wechselkurs zum 30. September		Jahresdurchschnittskurs	
	2003	2004	2003	2004
US-Dollar 1 USD	0,8762	0,8115	0,9234	0,8209
Japanischer Yen 100 JPY	0,7852	0,7320	0,7760	0,7545
Britisches Pfund 1 GBP	1,4428	1,4667	1,4797	1,4704
Singapur-Dollar 1 SGD	0,5060	0,4793	0,5276	0,4808

Umsatzrealisierung

::: Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Produktverkäufen werden gemäß SEC Staff Accounting Bulletin („SAB“) Nr. 104 Umsatzrealisierung in der Rechnungslegung realisiert, wenn Vereinbarungen bestehen, die Kaufpreise fest oder eindeutig bestimmbar sind, der Versand erfolgt ist und die Zahlung seitens des Kunden hinreichend wahrscheinlich ist. Für mögliche Rückgaben von Produkten, Rabatte sowie Nachlässe aus Preissicherungsklauseln erfasst die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Umsatzlegung Abschlüsse auf die Umsatzerlöse. Diese Abschlüsse basieren auf historischen Erfahrungen. Im Allgemeinen werden Warenrückgaben nur innerhalb der normalen 12-monatigen Gewährleistungsgarantie und auf Grund von Qualitätsmängeln erlaubt. Die Distributoren können unter bestimmten Umständen Bestände gegen gleiche oder andere Produkte umtauschen (Warenrotation), Verwurfsgutschriften oder Preisabsicherung verlangen. Gutschriften werden basierend auf der erwarteten Warenrotation, gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, abgegrenzt. Verwurfsgutschriften werden basierend auf den vertraglichen Vereinbarungen abgegrenzt und werden bei Berechtigung des Anspruchs bis zu einem bestimmten Maximalbetrag des durchschnittlichen Warenbestands werts erstattet. Preisabsicherungen ermöglichen den Distributoren eine Gutschrift für noch nicht verkaufte Vorräte zu beantragen, wenn die Gesellschaft die Standardlistenpreise für solche Waren reduziert hat. In einigen Fällen werden Rabatte mit bestimmten Kunden vereinbart, wobei Rabatte nur dann gewährt werden, wenn bestimmte Umsatzerlöse erreicht werden. Fallweise erhalten die Distributoren auch für gemeinsam festgelegte Werbung eine Erstattung.

::: Lizenzträge

Lizenzträge werden vereinnahmt, wenn die Leistung erbracht ist (siehe Anhang Nr. 5). Pauschalgebühren sind in der Regel nicht zurückzahlbar, werden entsprechend abgegrenzt und über den Zeitraum der Leistungserbringung vereinnahmt. Gemäß der Emerging Issues Task Force EITF Issue 00-21, Aufteilung der Umsätze bei Vertragsverhältnissen, die aus der Lieferung

mehrerer Einzelprodukte und/oder Dienstleistungen bestehen, werden Umsatzerlöse aus Verträgen mit mehreren Bestandteilen, die nach dem 1. Juli 2003 abgeschlossen wurden, mit dem relativen Marktwert eines jeden Bestandteils dann realisiert, wenn es keine nicht gelieferten Elemente gibt, die für das Funktionieren der gelieferten Bestandteile von Bedeutung sind, und die Bezahlung nicht von der Lieferung der noch ausstehenden Bestandteile abhängt. Stücklizenzgebühren werden zum Zahlungszeitpunkt erfolgswirksam vereinnahmt.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Fördergelder für Investitionen beinhalten steuerfreie Investitionszulagen und zu versteuernde Investitionszuschüsse für Sachanlagen. Der Anspruch auf Fördermittel wird dann bilanziert, wenn ein rechtlicher Anspruch auf die Fördermittel besteht und die Kriterien für die Erlangung der Fördermittel erfüllt wurden. Steuerfreie Investitionszulagen werden über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten periodengerecht abgegrenzt (siehe Anhang Nr. 22) und erfolgswirksam über die verbleibende Nutzungsdauer der geförderten Sachanlagen vereinnahmt. Zu versteuernde Investitionszuschüsse reduzieren die Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Anhang Nr. 6) und reduzieren damit die Abschreibungen der zukünftigen Perioden. Sonstige zu versteuernde Zuschüsse werden aufwandsmindernd erfasst (siehe Anhang Nr. 6, 20 und 22).

Produktbezogene Aufwendungen

Transport- und Abwicklungskosten, die auf den Verkauf von Produkten entfallen, sind in den Umsatzkosten enthalten. Ausgaben für Produktmarketing und Werbung sowie für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden zum Zeitpunkt des Anfalls als Aufwand erfasst. Gewährleistungsrückstellungen werden grundsätzlich zum Zeitpunkt der Umsatzrealisierung gebildet, basierend auf angenommenen Ausfallquoten und historischen Erfahrungswerten. Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei Anfall in voller Höhe als Aufwand gebucht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden nach der Verbindlichkeits-Methode ermittelt. Aktive und passive latente Steuern werden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert, um die künftige steuerliche Wirkung aus zeitlichen Unterschieden zwischen dem bilanziellen Wertansatz von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten und dem steuerlich beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern wird von den erwarteten Steuersätzen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Realisierung ausgegangen. Wirkungen aus den Änderungen von Steuersätzen werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung berücksichtigt. Steuervergünstigungen für Investitionen werden bei Erwerb des Vermögensgegenstands bilanziert.

Aktionsoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert Vergütungen in Form von Aktienoptionen auf der Grundlage der Innere-Wert-Methode entsprechend der Accounting Principles Board („APB“) Opinion 25, Bilanzierung an Mitarbeiter ausgegebener Aktien, und erfasst diese Personalkosten über den Zeitraum der Leistung. Die Gesellschaft hat das Wahlrecht wahrgenommen, nur die Erläuterung dieser Aktienoptionspläne gemäß SFAS Nr. 123, Bilanzierung für Aktienoptionspläne, ergänzt durch SFAS Nr. 148, Bilanzierung für Aktienoptionspläne – Überleitung und Publizität, anzugeben (siehe Anhang Nr. 24).

Kapitalerhöhungen von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen

Gewinne oder Verluste aus der Durchführung von Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen werden entsprechend der Veränderung der Anteilshöhe gemäß der Regelungen des SAB Topic 5:H, Bilanzierung bei Anteilsverkäufen von Tochtergesellschaften, ergebniswirksam erfasst (siehe Anhang Nr. 16).

Zahlungsmittel

Bargeld sowie alle Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als Zahlungsmittel ausgewiesen. Die Finanzmittel beliefen sich zum 30. September 2003 und 2004 auf €868 und €541 und beinhalteten hauptsächlich Bankeinlagen und festverzinsliche Anleihen mit Fälligkeit innerhalb von 3 Monaten.

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel beinhalten Geldanlagen, die im Rahmen der Finanzierung als Sicherheit für Abgrenzung von Personalaufwendungen, Unternehmensakquisition, Anlagen im Bau, Leasing oder Finanzierung hinterlegt sind (siehe Anhang Nr. 3 und Nr. 31).

Wertpapiere

Die Gesellschaft hält frei veräußerbare Wertpapiere („Available for Sale“-Papiere), die zu dem zuletzt gehandelten Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet sind. Kumulierte unrealisierte Gewinne und Verluste, nach Abzug von latenten Steuern, sind im Eigenkapital als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste und voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens werden, sofern angefallen, in der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ erfasst. Im Veräußerungsfall wird für die Ermittlung realisierter Gewinne oder Verluste von den individuellen Anschaffungskosten der Wertpapiere ausgegangen.

Vorräte

Die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet, wobei die Herstellungskosten vorwiegend zu Durchschnittswerten ermittelt werden. Die Herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren Material- und Lohnkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Kosten für Ersatzteile, laufende Instandhaltung und Reparaturen werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder degressiven Methode ermittelt. Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte und Anlagen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben. Die Herstellungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegenstände enthalten aktivierte Finanzierungskosten, die über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben werden. Während des Geschäftsjahrs 2004 wurden Zinsen in Höhe von €9 aktiviert. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern betragen bei:

	Jahre
Gebäuden	10–25
Technischen Anlagen und Maschinen	3–10
Sonstigen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1–10

Leasing

Die Gesellschaft ist Leasingnehmer von Sachanlagen. Alle Leasinggeschäfte, bei denen die Gesellschaft in der Position des Leasingnehmers als wirtschaftlicher Eigentümer zu sehen ist, werden gemäß dem vom Financial Accounting Standards Board („FASB“) veröffentlichten Statement of Financial Accounting Standards

(„SFAS“) Nr. 13, Rechnungslegung für Leasing und zugehörige Interpretationen, als Finanzierungsleasing behandelt und bei der Gesellschaft als Sachanlagen bilanziert. Alle anderen Leasinggeschäfte werden als Operating Leases behandelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß SFAS Nr. 141, Geschäftszusammenschlüsse, wendet die Gesellschaft die Erwerbsmethode an. Die Erwerbsmethode fordert, dass bei einem Unternehmenserwerb neben dem Geschäfts- und Firmenwert (Goodwill) die immateriellen Vermögensgegenstände getrennt erfasst und ausgewiesen werden.

Seit dem 1. Oktober 2001 wendet die Gesellschaft SFAS Nr. 142, Geschäfts- und Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, an. Bei der Einführung des SFAS Nr. 142, SFAS Nr. 141 folgend, überprüfte die Gesellschaft ihre vorhandenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Firmenwerte, die bei früheren Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden, und gliederte Beträge von €1, die zuvor dem Mitarbeiterstamm zugerechnet wurden, um, damit den neuen Kriterien des SFAS Nr. 141 entsprochen wird. Bei Einführung des SFAS Nr. 142 überprüfte die Gesellschaft die Nutzungsdauern und Restwerte aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände neu, was zu keinen wesentlichen Änderungen der Abschreibungsdauern führte. Die Gesellschaft stellte keine immateriellen Vermögensgegenstände mit unbegrenzter Nutzungsdauer fest. Im Zusammenhang mit der Einführung von SFAS Nr. 142 und der Umstellungsbewertung der Geschäfts- und Firmenwerte gab es kein Anzeichen dafür, dass die Geschäfts- und Firmenwerte der Berichtseinheiten zum Zeitpunkt der Umstellung wertberichtigt werden müssen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen hauptsächlich aus erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, wie z. B. Lizenzen und erworbenen Technologien, die zum Kaufpreis bilanziert wurden, sowie aus Geschäfts- und Firmenwerten, die im Zusammenhang mit Unternehmensakquisitionen als der Teil des Kaufpreises, der den Marktwert des erworbenen Nettovermögens überstieg, entstanden. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über den erwarteten Nutzungszeitraum, der von drei bis zehn Jahren reicht, abgeschrieben. Gemäß SFAS Nr. 142 werden Geschäfts- und Firmenwerte nicht abgeschrieben, sondern nach den Vorgaben des SFAS Nr. 142 mindestens einmal jährlich auf eventuelle Wertminderungen geprüft. Gewöhnlich nimmt die Gesellschaft die jährlichen Überprüfungen im letzten Quartal des Geschäftsjahrs vor. Falls der Buchwert der Geschäftseinheit inklusive Geschäfts- und Firmenwert den Marktwert übersteigt, ergibt sich die Wertminderung aus der Differenz zwischen dem Buchwert des Geschäfts- und Firmenwerts und dem Marktwert des Geschäfts- und Firmenwerts. Die Ermittlung der Marktwerte für die einzelnen Geschäftseinheiten und der zugehörigen Geschäfts- und Firmenwerte erfordert wesentliche Annahmen seitens des Managements.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Gesellschaft überprüft Anlagegüter einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen, sobald Ereignisse oder Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen könnten. Dabei wird der Restbuchwert mit den erwarteten künftigen Einnahmeüberschüssen, die von diesem Vermögensgegenstand generiert werden, verglichen. Eine außerplanmäßige Abschreibung wird insoweit vorgenommen, als nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Buchwert über dem Marktwert oder dem Barwert künftiger Einnahmeüberschüsse liegt. Die Beurteilung durch das Management erfordert wesentliche Annahmen, um diskontierte zukünftige Cash-Flows abschätzen zu können.

Finanzanlagen

Die Gesellschaft überprüft Wertminderungen bei nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanzierten Finanzanlagen, um festzustellen, ob es sich um eine nicht als vorübergehend zu bezeichnende Wertminderung handelt und somit dauerhaft ist. Diese Bewertung wird auf Basis verfügbarer Daten inklusive allgemeiner Marktdaten, spezifischer Industrie- und individueller Gesellschaftsdaten durchgeführt. Die Dauer und Höhe, die der Marktpreis die Anschaffungskosten unterschreitet, die Finanzlage und die kurzfristigen Aussichten dieser Gesellschaft sowie die Absicht und Fähigkeit der Gesellschaft, diese Finanzanlage zu halten, werden ebenso berücksichtigt.

Finanzinstrumente

Die Gesellschaft ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgesetzt. Zur Sicherung gegen Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente wie Devisentermin- und Optionsverträge als auch Zinsswapverträge eingesetzt. Die Gesellschaft wendet SFAS Nr. 133, Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften, erweitert durch SFAS Nr. 137, SFAS Nr. 138 und SFAS Nr. 149 an. Die Standards beinhalten Aussagen zur Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten einschließlich solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von Sicherungsgeschäften. Derivative Finanzinstrumente werden mit ihrem Marktwert unter den Sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen oder den Sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Üblicherweise betrachtet die Gesellschaft ihre derivativen Finanzinstrumente nicht als Sicherungsgeschäfte. Veränderungen der Marktwerte von nicht designierten Derivaten, die mit dem operativen Geschäft verbunden sind, werden als Teil der Umsatzkosten realisiert und die Veränderungen der Marktwerte der Derivate, die zu Finanzierungszwecken genutzt werden, als sonstige Aufwendungen. Veränderungen der Marktwerte von Derivaten, die für marktwertbezogene Sicherungsgeschäfte vorgesehen sind, werden ergebniswirksam erfasst. Ver-

änderungen der Marktwerte von Derivaten, die für zahlungsmittelbezogene Sicherungsgeschäfte bestimmt sind, werden bei effektiver Wirkung als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit den Aktionären resultieren, abgegrenzt und nachfolgend erfolgswirksam erfasst, wenn die zu Grunde liegende Transaktion in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erfasst wird. Bei ineffektiver Wirkung werden die Veränderungen der Marktwerte von Derivaten sofort ergebniswirksam realisiert. Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente und anderer Finanzinstrumente wird in Anhang Nr. 29 erläutert.

Pensionsverpflichtungen

Im Dezember 2003 veröffentlichte das FASB das SFAS Nr. 132 (überarbeitet im Jahr 2003), Ausweispflichten des Arbeitgebers für Pensionszusagen und pensionsähnliche Leistungszusagen, eine Ergänzung für die FASB-Erklärungen Nr. 87, 88 und 106, welches die Ausweispflicht des Arbeitgebers für Pensionszusagen und pensionsähnliche Leistungszusagen revidiert. Das 2003 revidierte SFAS Nr. 132 sieht zusätzliche Ausweispflichten vor (im Vergleich zu dem damit ersetzten ursprünglichen SFAS Nr. 132). Die Gesellschaft wendet für das am 30. September 2004 endende Geschäftsjahr das im Jahr 2003 revidierte SFAS 132 an. Die Angaben werden im Anhang Nr. 28 gezeigt.

Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert Schätzungen und Annahmen des Managements. Diese haben Einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. Die tatsächlichen Beträge können wesentlich von den Schätzungen des Managements abweichen.

Aktuelle Verlautbarungen zur Bilanzierung

Im Juni 2004 wurde EITF Nr. 03-01, Begriffsinhalt von anderen als vorübergehenden Wertminderungen und deren Anwendung auf bestimmte Anlagen veröffentlicht. EITF 03-01 beinhaltet neue Anleitungen für die Beurteilung und Erfassung anderer als vorübergehender Verluste auf Gläubiger- und Anteilspapiere, bilanziert unter SFAS 115, Bilanzierung bestimmter Anlagen in Gläubiger- und Anteilspapieren, sowie neue Offenlegungspflichten für bestimmte Anlagen, die als vorübergehend wertgemindert betrachtet werden. Während die Offenlegungsanforderungen für bestimmte Gläubiger- und Anteilspapiere und nach der Kostenmethode bilanzierte Anlagen für nach dem 15. Dezember 2003 endende Berichtsperioden anzuwenden sind, hat das FASB Board die FASB-Mitarbeiter angewiesen, die Einführung der in der Issue Nr. 03-1 enthaltenen Bewertungs- und Erfassungsvorschrift aufzuschieben. Diese Aufschubbefreiung nicht von den Verpflichtungen zur Erfassung von anderen als vorübergehenden Wertminderungen auf Grund bereits bestehender verbindlicher Vorschriften. Die Gesellschaft erwartet aus der Anwendung von EITF 03-01 keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3. Akquisitionen

Am 30. April 2004 vollendete die Gesellschaft die Übernahme von 100% der ADMtek Inc., Hsinchu, Taiwan („ADMtek“) für €75 in bar, wovon €6 zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen auf einem Treuhandkonto hinterlegt sind. Eine weitere Zahlung in Höhe von €28 ist auf einem Treuhandkonto hinterlegt und wird als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel bilanziert. Diese Zahlung ist vorgesehen für Mitarbeiterbindung und das Erreichen bestimmter Geschäfts- und Entwicklungsziele über die nächsten zwei Jahre und wird auf Basis erreichter Meilensteine fällig. Die Akquisition ermöglicht Infineon den Einstieg in den Markt für Home-Gateway-Systeme im Bereich der drahtgebundenen Kommunikation.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots hat die Gesellschaft am 18. Juni 2003 92,5% sowie bis zum 30. Juni 2003 die restlichen 7,5% der ausstehenden Aktien der SensoNor AS für insgesamt €34 in bar erworben. Zusätzlich brachte die Gesellschaft im Zuge des Erwerbsvorgangs €13 Eigenkapital ein. SensoNor entwickelt, produziert und vermarktet Reifendrucküberwachungssysteme und Sensoren für die Beschleunigungsmessung. Mit dem Erwerb wollte die Gesellschaft ihre Position auf dem Automobilmarkt im Bereich der Halbleitersensoren stärken. Auf Grund der Reorganisation des SensoNor-Geschäfts im Geschäftsjahr 2004 nahm die Gesellschaft eine im Rahmen des Erwerbs gebildete Wertberichtigung auf latente Steuern in Höhe von €8 zurück und reduzierte im gleichen Rahmen den Geschäfts- und Firmenwert.

Am 1. April 2003 hat die Gesellschaft den Netto-Vermögenserwerb von MorphICs Technology Inc. („MorphICs“) für €6 in bar abgeschlossen. MorphICs entwickelt digitale Basisbandschaltungen der dritten Generation für drahtlose Kommunikation. Die Erwerbsvereinbarung beinhaltet ebenfalls eine zusätzliche Vergütung von €9, die bei Erreichen bestimmter Meilensteine bezahlt werden. Die Erreichung der Meilensteine wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2005 bestimmt.

Im April 2001 hat die Gesellschaft ein Joint Venture (Infineon Technologies Flash; früher Ingentix), an dem die Gesellschaft 51% der Anteile hält, gegründet. Infineon Technologies Flash entwickelt Flash-Speicherprodukte. Das Geschäft von Infineon Technologies Flash wurde von Beginn an voll konsolidiert. Im Februar 2003 hat die Gesellschaft ihre Geschäftsanteile an der Infineon Technologies Flash auf 70 Prozent erhöht und dabei Barmittel und in Eigenkapital umgewandelte Darlehen eingebracht. Als Folge daraus entstanden ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von €4 und ein reduzierter fremden Gesellschaftern zustehender Anteil.

Am 9. September 2002 erwarb die Gesellschaft alle Aktien der in Schweden ansässigen Ericsson Microelectronics AB („MIC“). MIC ist ein Hersteller von Hochfrequenz-Mikroelektronikbauteilen für Mobilfunkapplikationen, High-End-Leistungsverstärkern, Bluetooth-Bauteilen und Breitband-Kommunikationsprodukten. MIC ist ein strategischer Zulieferer von Ericsson, einem Marktführer bei Basisstationen, für Bluetooth-Lösungen und Hochfrequenz-Bauteile für Mobiltelefone und drahtlose Infrastruktur. Ferner traf die Gesellschaft eine strategische Liefervereinbarung mit Ericsson über

eine Laufzeit von zwei Jahren mit bestimmten Einkaufsschwellenvereinbarungen, wofür eine Verbindlichkeit in Höhe von €50 zum 30. September 2002 gebildet worden ist.

Im Juni 2003 haben die Gesellschaft und Ericsson eine Ergänzungsvereinbarung zur MIC-Erwerbsvereinbarung unterschrieben. Die Gesellschaften beabsichtigen, ihre strategische Kooperation auf verschiedenen Gebieten der Mobilfunktechnologie und Mobilfunkinfrastruktur inklusive Bluetooth-Lösungen, RF ICs, RF Power und anderer Anwendungen zu verstärken. Darüber hinaus haben die Gesellschaften den Verzicht auf die restliche an Ericsson zahlbare Kaufpreisverpflichtung sowie die Aufhebung der noch nicht

erfüllten Abnahmeverpflichtungen und zugehörigen Vertragsstrafe vereinbart. Zusätzlich erhielt die Gesellschaft €50 von Ericsson. Diese Beträge wurden angepasst, im Wesentlichen beim Geschäfts- und Firmenwert, aber auch bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den latenten Steuern. Zudem wurden während des am 30. September 2003 abgelaufenen Geschäftsjahrs auf Grund des restrukturierten MIC-Geschäfts die Eröffnungsbuchungen angepasst und die ursprüngliche Wertberichtigung auf aktivierte latente Steuern von €16 zurückgenommen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Akquisitionen der Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 zusammen:

Erwerbszeitpunkt Segment	2002	2003		2004
	MIC	SensoNor	Sonstige	ADMtek
	September 2002 Sichere Mobile Lösungen	Juni 2003 Automobil- & Industrieelektronik	2003 Verschiedene	April 2004 Drahtgebundene Kommunikation
Zahlungsmittel	50	3	–	18
Sonstiges Umlaufvermögen	120	6	1	10
Sachanlagen	60	25	1	2
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Aktuelle Produkttechnologie	15	21	5	14
Basistechnologie	42	–	–	5
Patente (Kundenbeziehungen)	24	–	2	2
Erworbene R&D	37	4	2	9
Geschäfts- und Firmenwert	–	14	6	23
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	45	8	–	1
Gesamte erworbene Vermögensgegenstände	393	81	17	84
Kurzfristige Verbindlichkeiten	–38	–11	–9	–8
Langfristige Verbindlichkeiten	–28	–36	–	–1
Gesamte übernommene Verbindlichkeiten	–66	–47	–9	–9
Erworbenes Nettovermögen	327	34	8	75
Barzahlung	–	34	8	75
Ausgegebene Aktien	27.500.000	–	–	–

Die oben aufgeführten Akquisitionen wurden nach der Erwerbsmethode bilanziert. Somit enthält das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit die Ergebnisse der erworbenen Gesellschaften ab dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt. Der Wert der zur Kaufpreisbegleichung ausgegebenen Aktien wurde auf Grund der durchschnittlichen Marktpreise der Aktien der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwei Tagen vor und nach dem Tag, an dem die Anzahl der ausgegebenen Aktien festgelegt wurde, ermittelt.

Ausgegebene Aktien, die für Mitarbeiter als Anreiz für die Fortsetzung der Beschäftigung und die Erreichung bestimmter Meilensteine treuhänderisch hinterlegt wurden, werden als abgegrenzte Vergütung mit ihrem inneren Wert bilanziert. Die abgegrenzte Vergütung wird als Minderung der Kapitalrücklage in der Eigenkapitalveränderungsrechnung bilanziert und linear über die entsprechenden Beschäftigungs- oder Meilensteinzeiträume abgeschrieben, die zwischen zwei und vier Jahren betragen.

Ausgegebene Aktien, die für die Aktionäre der erworbenen Gesellschaften als Anreiz zur Erreichung bestimmter Meilensteine treuhänderisch hinterlegt wurden, stellen eine anteilige Kaufpreis-

zahlung dar und betreffen vornehmlich den Erwerb von Catamaran Communications Inc. („Catamaran“) im August 2001. Diese Aktien werden solange nicht in der Eigenkapitalveränderungsrechnung als ausgegeben und ausstehend dargestellt, bis bestimmte Meilensteine erreicht sind. Wenn das der Fall ist, wird der Kaufpreis um den jeweiligen Marktwert der ausgegebenen Aktien zum Stichtag angepasst. Während der Geschäftsjahre 2002 und 2003 wurden 546.183 bzw. 96.386 Aktien aus der treuhänderischen Hinterlegung freigegeben, da die Meilensteine erreicht wurden, was zu einer Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts von Catamaran von €9 bzw. €1 führte.

Bei jeder wesentlichen Akquisition wurde ein unabhängiger Dritter zur Bewertung des erworbenen Nettovermögens hinzugezogen. Als Folge dieser Bewertungen wurden in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 Beträge von €37, €6 und €9 als erworbene, noch nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen („erworbene R&D“) den R&D-Aufwendungen zugerechnet, da keine technologische Anwendung der Entwicklungen erkennbar war und keine zukünftige Alternativnutzung exis-

tierte. Die Beträge, die den erworbenen R&D zugerechnet wurden, sind durch anerkannte Bewertungspraktiken für den Hochtechnologie-sektor und zugehörige Richtlinien der SEC ermittelt.

Die Basistechnologien und Patente, die bei diesen Akquisitionen erworben werden, werden über ihre erwartete Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben, aktuelle Produkttechnologie wird über ihre erwartete Nutzungsdauer von zwei bis acht Jahren abgeschrieben.

Auf die Aufstellung von Pro-forma-Finanzdaten wurde verzichtet, da die Akquisitionen einzeln und gesamt gesehen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4. Aufgegebene Geschäfte und Geschäftsanteilsveräußerungen

Aufgegebene Geschäfte

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und OSRAM GmbH („Osram“) hat die Gesellschaft ihre gesamten optoelektronischen Aktivitäten zum 31. März 2003 an Osram übertragen. Die Vereinbarung beinhaltet die Übergabe aller Kundenbeziehungen und zugehörigen Auftragsbestände, die Kündigung aller optoelektronischen Vertriebsvereinbarungen durch die Gesellschaft und gibt der Gesellschaft bestimmte Rechte zur Rückgabe von zum 31. März 2003 nicht verkauften Beständen. Der Gesellschaft ist aus der Aufgabe der optoelektronischen Aktivitäten kein Verlust entstanden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Vergleichswerte für das aufgegebene Geschäft, das früher unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten war, für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004:

	2002	2003	2004
Optoelektronik:			
Umsatzerlöse:			
Dritte	241	113	–
Verbundene Unternehmen	76	32	–
Gesamte Umsatzerlöse	317	145	–
Ergebnis vor Steuern aus aufgegebenem Geschäft	–	–	–
Steueraufwendungen	–4	–	–
Ergebnis aus aufgegebenem Geschäft	–4	–	–

Für die aufgegebenen Geschäfte gibt es zum 30. September 2003 und 2004 keine ausstehenden Bilanzpositionen.

Veräußerung von Geschäftsanteilen

Die Gesellschaft hat am 29. April 2004 eine Vereinbarung mit Finisar Corporation („Finisar“) über den Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts geschlossen (siehe Anhang Nr. 14).

Im August 2003 hat die Gesellschaft ihren Anteil an UMCi verkauft und einen Vor-Steuer-Verlust von €9 realisiert. Dieser Betrag

ist in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen enthalten.

Am 1. Juli 2002 vollendete die Gesellschaft den Verkauf ihres Gallium-Arsenid-Geschäfts, das zum Bereich Sichere Mobile Lösungen gehörte, einschließlich bestimmter, nicht fertigungsrelevanter materieller und immaterieller Vermögensgegenstände sowie spezifizierter Kundenverträge und Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft hat in diesem Zusammenhang eine ursprüngliche Zahlung in Höhe von €50 erhalten. Mögliche Kaufpreisanpassungen werden durch die Menge verkaufter Gallium-Arsenid-Produkte, deren Preise wesentlich unter dem Marktpreis liegen und die bis zum 30. September 2004 durch den Erwerber abgesetzt werden, beeinflusst. Weitere Anpassungen können den Verkaufserlös beeinflussen. Dementsprechend wurden €44 als Verkaufserlös abgegrenzt und über den Zeitraum des Liefervertrages sowie entsprechend dem Erlöschen der Preiseventualverbindlichkeiten realisiert. Im Geschäftsjahr 2004 wurden Anpassungen vorgenommen, die zu einer Zahlungsverpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von €13 führten, die durch die Auflösung von abgegrenzten Erträgen kompensiert wurde. Die Gesellschaft hat zuvor abgegrenzte Erträge in Höhe von €29 und €2 in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 in Erfüllung der Liefervereinbarung realisiert.

Am 31. Dezember 2001 veräußerte die Gesellschaft ihren verbleibenden 81%-Anteil an der Infineon Technologies Krubong Sdn. Bhd., welcher das Geschäftsfeld Infrarotkomponenten darstellte und vorher unter den „Sonstigen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen wurde.

Des Weiteren trennte sich die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 von verschiedenen anderen gemeinschaftlich betriebenen Beteiligungen.

Nachfolgend werden die Finanzinformationen zu den veräußerten Geschäftseinheiten (bis zum Tag der Veräußerung) für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 jeweils zum 30. September zusammenfassend dargestellt:

	2002	2003	2004
Umsatzerlöse:			
Gallium-Arsenid	24	45	–
Infrarotkomponenten	11	–	–
Summe Umsatzerlöse	35	45	–
Ebit:			
Gallium-Arsenid	–18	5	–
Infrarotkomponenten	–7	–	–
UMCi	–1	–11	–
Summe Ebit	–26	–6	–
Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
Gallium-Arsenid	2	–	–
Infrarotkomponenten	39	–	–
UMCi	–	–9	–
Sonstige	–2	–1	–2
Summe Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39	–10	–2

5. Lizenzerträge

In den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 weist die Gesellschaft Umsätze aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von €147, €183 und €76 in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen aus. Darin enthalten sind früher abgegrenzte Lizenzerlöse in Höhe von €85, €135 und €48, die entsprechend SEC SAB 104 in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 als Umsatz realisiert wurden, da alle Verpflichtungen erfüllt wurden.

Im Februar 2003 haben die Gesellschaft, ProMOS und MVI vereinbart, eine bestehende Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten in Höhe von €60 zu tilgen, für die die Gesellschaft eine Garantie übernommen hatte. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Forderungen und Verbindlichkeiten der Parteien glattgestellt. Daher hat die Gesellschaft früher abgegrenzte Lizenzeinnahmen in Höhe von €60, die in Beziehung zu dieser Garantie standen, zum 30. September 2003 realisiert, da der Betrag vereinnahmt war.

Auf Grund der Beendigung der Vereinbarung über den Austausch von Technologien zwischen der Gesellschaft und ProMOS wurden zusätzliche €36 als Umsatz zum 30. September 2003 realisiert, da die Gesellschaft sämtliche Verpflichtungen erfüllt hat. Dieser Betrag wurde zuvor als abgegrenzte Lizenzeinnahme erfasst.

Im März 2000 hat die Gesellschaft mit ProMOS ein Technologietransfer-Abkommen geschlossen und bestehende Verträge mit MVI, dem größten Anteilseigner von ProMOS, neu geordnet. Noch nicht vereinnahmte Lizenzerlöse von MVI werden über die Laufzeit dieser abgeänderten Verträge als Umsätze realisiert.

Im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Technologieentwicklung, die mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) durchgeführt wird (siehe Anhang Nr. 16), hat Infineon dem Joint-Venture-Partner 2003 ein Lizenznutzungsrecht über die 110-Nanometer-Technologie in dessen bestehenden Betrieben eingeräumt. Die Lizenzeinkünfte werden gleichmäßig über den Technologielebenszyklus realisiert.

Im Zusammenhang mit einer Vereinbarung über die Erweiterung von Kapazitätsreservierungen mit Winbond Electronics Corp., Hsinchu, Taiwan („Winbond“) im August 2004, gewährte die Gesellschaft Winbond eine Lizenz über die Nutzung ihrer 110-Nanometer-Technologie in Winbond's Produktionsprozess für die für die Gesellschaft produzierten Produkte. Dementsprechend werden die Lizenzerträge abgegrenzt und über die Laufzeit der Vereinbarung realisiert.

6. Zuwendungen der öffentlichen Hand

Die Gesellschaft hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen staatlichen Stellen Fördermittel u. a. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung und Mitarbeiterschulung erhalten. Die in den vorliegenden Konzernabschlüssen enthaltenen Zuschüsse setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2002	2003	2004
In der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung sind enthalten:			
Forschungs- und Entwicklungszuschüsse	59	59	74
Umsatzkosten	34	54	86
	93	113	160
Investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der Sachanlagen abgesetzt wurden	83	17	49
Abgegrenzte staatliche Zulagen (siehe Anhang Nr. 20 und 22)	295	303	281

7. Zusätzliche Angaben zu betrieblichen Aufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2002	2003	2004
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.380	1.675	1.621
Aufwendungen für bezogene Leistungen	926	1.126	1.232
Summe Materialaufwendungen	2.306	2.801	2.853

Die Personalaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2002	2003	2004
Löhne und Gehälter	1.429	1.490	1.532
Sozialabgaben	255	268	280
Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 28)	29	27	28
Summe Personalaufwendungen	1.713	1.785	1.840

Die sonstigen betrieblichen Erträge/Aufwendungen (netto) setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2002	2003	2004
Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Geschäftseinheiten (siehe Anhang Nr. 4)	39	-10	-2
Wertberichtigung auf Geschäfts- und Firmenwert (siehe Anhang Nr. 17)	-12	-68	-71
Kartellrechtlich bezogene Aufwendungen (siehe Anhang Nr. 31)	-	-20	-194
Abgrenzung der Ausgabekosten der Wandelanleihe	-2	-4	-8
Andere	21	17	18
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	46	-85	-257

8. Umstrukturierungsmaßnahmen

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2004 hat die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Kostensenkung angekündigt. Dies beinhaltet den Abbau von Mitarbeitern, Dezentralisierung und Outsourcing bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen gab die Gesellschaft die Entlassung von 325 Mitarbeitern bekannt. Die Entlassungen im Geschäftsjahr 2004 sind hauptsächlich das Ergebnis der Verlegung von Aktivitäten von Regensburg und München nach Dresden und

	2003	2004			
		Umgliederungen	Restrukturierungsaufwendungen	Zahlungen	Verbindlichkeiten
Abfindungen	18	-3	16	-21	10
Andere Ausstiegskosten	9	-	1	-4	6
Gesamt	27	-3	17	-25	16

Während des Geschäftsjahrs 2003 hatte die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Kostensenkung angekündigt. Dies beinhaltete die Entlassung von Mitarbeitern, Dezentralisierung und Outsourcing bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen plante die Gesellschaft, 550 Mitarbeiter vorwiegend in Konzernfunktionen und der Logik-Produktion, aber auch in Folge von Auslagerungen an externe Anbieter, zu entlassen. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen wurden Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von €29 im Geschäftsjahr 2003 ausgewiesen. Zudem wurden €11, die früher

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach Regionen für die Geschäftsjahre zum 30. September ist in folgender Übersicht dargestellt:

	2002	2003	2004
Deutschland	15.773	16.043	16.340
Übriges Europa	4.376	4.753	5.507
Nordamerika	2.818	2.779	2.822
Asien-Pazifik	7.085	7.725	9.220
Japan	104	108	126
Andere	24	115	112
Summe Mitarbeiter	30.180	31.523	34.127

Die gesamten Aufwendungen für Operating-Lease-Verträge betragen in den Geschäftsjahren 2002 €133, 2003 €138 und 2004 €126.

der Schließung von Design Centern in Großbritannien, Irland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Der Abschluss der Entlassungen wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2005 vollzogen sein. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen wurden Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von €17 im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesen. Die Gesellschaft erwartet, dass jährliche Einsparungen in Höhe von €32 mit dem Abschluss des Restrukturierungsprogramms 2004 erreicht werden.

Die Entwicklung der Restrukturierungsaufwendungen setzte sich zum 30. September 2004 wie folgt zusammen:

für Umstrukturierung zurückgestellt wurden, im Rahmen einer Vereinbarung eines Dienstleistungsvertrags erlassen. Dieser Betrag wurde entsprechend in den Rückstellungen abgegrenzt und wird über die Laufzeit des Servicevertrags erfolgswirksam aufgelöst.

In den Geschäftsjahren 2003 und 2004 wurden in Folge der Umstrukturierungsmaßnahmen der Gesellschaft etwa 170 und 630 Mitarbeiter entlassen.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 fielen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen Aufwendungen in Höhe von €16 durch unkündbare Leasing-Verpflichtungen an.

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Gewinn/Verlust vor Steuern und vor Abzug der auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile verteilt sich in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 wie folgt auf die Regionen:

	2002	2003	2004
Deutschland	-1.403	-506	153
Ausland	236	147	44
Gesamt	-1.167	-359	197

Die Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ermitteln sich für die zum 30. September 2002, 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre wie folgt:

	2002	2003	2004
Laufender Steueraufwand:			
Deutschland	15	18	53
Ausland	124	50	5
	139	68	58
Latente Steuern:			
Deutschland	-236	40	144
Ausland	-46	-24	-48
	-282	16	96
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von fortgeführten Geschäften	-143	84	154
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von aufgegebenem Geschäft	4	-	-
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-139	84	154

Der Körperschaftsteuersatz der Gesellschaft beträgt 25% für das am 30. September 2002 endende Geschäftsjahr. Zusätzlich werden ein Solidaritätszuschlag von 5,5% und Gewerbesteuer in Höhe von 13% erhoben, was einer Gesamtsteuerbelastung von 39% entspricht.

Die folgende Überleitung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zum 30. September 2002, 2003 und 2004 erfolgte unter Zugrundelegung einer Gesamtsteuerbelastung der deutschen Körperschaftsteuerquote zuzüglich Gewerbesteuer für 2002 in Höhe von 39%, 2003 in Höhe von 41% (inklusive einer einjährigen Abgabe zur Flutopferhilfe von 2%) und 2004 in Höhe von 39%:

	2002	2003	2004
Erwarteter Aufwand/Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-455	-147	77
Veränderung verfügbarer Steuerfreibeträge	30	-35	-9
Steuerfreie Gewinne/Verluste aus Beteiligungen	-39	14	6
Differenz aus abweichenden Steuersätzen im Ausland	-46	1	-68
Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen und sonstige Rückstellungen	99	58	69
Änderung der deutschen Steuerrate – Auswirkung auf die Eröffnungsbilanz	-	2	-
Änderung der deutschen Steuerrate – Auswirkung im laufenden Geschäftsjahr	-2	7	-
Veränderung der Wertberichtigung	271	182	54
Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	10	1	3
Sonstige	-11	1	22
Tatsächlicher Aufwand/Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-143	84	154

Die aktiven und passiven latenten Steuern setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Vermögensgegenstände:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	115	100
Sachanlagen	105	155
Passive Rechnungsabgrenzung	117	109
Verlustvortrag und Steuervergünstigungen	1.029	919
Sonstiges	195	227
Bruttobetrag der aktiven latenten Steuern	1.561	1.510
Wertberichtigungen	-521	-567
Aktive latente Steuern	1.040	943
Verbindlichkeiten:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	58	49
Sachanlagen	148	125
Rückstellungen	31	75
Sonstiges	56	50
Passive latente Steuern	293	299
Summe latente Steuern, Saldo	747	644

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden in den Konzernbilanzen zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt ausgewiesen:

	2003	2004
Aktive latente Steuern:		
Kurzfristig	113	140
Langfristig	705	541
Passive latente Steuern:		
Kurzfristig	-39	-16
Langfristig	-32	-21
Summe latente Steuern, Saldo	747	644

Zum 30. September 2004 hatte die Gesellschaft steuerliche Verlustvorträge in Höhe von €1.779 (für Gewerbe- und Körperschaftsteuer und einen zusätzlichen Verlustvortrag nur auf Gewerbesteuer anwendbar in Höhe von €1.299) sowie Vorträge von Steuervergünstigungen in Höhe von €109. Diese steuerlichen Verlustvorträge und Steuervergünstigungen resultieren hauptsächlich aus der Geschäftstätigkeit in Deutschland und sind grundsätzlich nur durch die Gesellschaft nutzbar, bei der die steuerlichen Verluste oder die Steuerforderungen entstanden und nach geltendem Recht nicht verfallen sind. Erträge aus Steuergutschriften werden bei Erwerb des Vermögensgegenstands bilanziert.

Entsprechend dem SFAS Nr. 109 hat die Gesellschaft die aktivierten latenten Steuern auf die Notwendigkeit einer Wertberichtigung überprüft. Dazu ist eine Beurteilung erforderlich, ob es wahrscheinlich ist, dass Teile oder der Gesamtbetrag der aktiven latenten Steuern nicht realisierbar sein könnten. Die Überprüfung

verlangt vom Management unter anderem eine Beurteilung von Erträgen aus verfügbaren Steuerstrategien und künftigem zu versteuerndem Einkommen sowie anderen positiven oder negativen Faktoren. Die tatsächliche Realisierung von aktivierten latenten Steuern hängt von der Möglichkeit der Gesellschaft ab, entsprechendes zukünftiges zu versteuerndes Einkommen zu generieren, um Verlustvorträge oder Steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu können. Da die Gesellschaft in bestimmten Steuergebieten zum 30. September 2004 über einen Dreijahreszeitraum einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, wird der Einfluss von geplantem zu versteuerndem Einkommen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des SFAS Nr. 109 für diese Bewertung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt für diese Steuergebiete dementsprechend nur auf Grund der Erträge, die durch verfügbare Steuerstrategien und die Umkehr von zeitlichen Unterschieden in zukünftigen Perioden erlöst werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Überprüfung, hat die Gesellschaft zum 30. September 2004 die Wertberichtigung auf die aktivierten latenten Steuern um €54 erhöht und damit auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in Zukunft realisiert werden kann. Während der Geschäftsjahre 2002 und 2003 wurden Wertberichtigungen auf Verlustvorträge für fortgeführte Geschäfte in Höhe von €271 und €182 gebildet, da die vollständige Ausnutzung dieser Verlustvorträge nicht wahrscheinlich erschien.

Zum 27. Dezember 2003 wurden von der deutschen Regierung neue Steuergesetze erlassen, welche die Verrechnung des Verlustvortrags für deutsche Unternehmenssteuern auf 60% des jährlichen steuerpflichtigen Gewinns begrenzen. Die neuen Gesetze beschränken nicht die Nutzungsdauer der Verlustvorträge, welche weiterhin unbegrenzt bleibt. Für die Gesellschaft sind die neuen Steuergesetze ab 1. Oktober 2003 gültig. Die neuen Gesetze führten zu einer Erhöhung des laufenden Steueraufwands um €13 zum 30. September 2004.

Die Veränderungen der Wertberichtigungen für steuerliche Verlustvorträge zum 30. September 2003 und 2004 sind wie folgt:

	2003	2004
Stand zu Beginn des Geschäftsjahrs	310	521
Anwendung auf fortgeführte Geschäfte	182	54
Erworbene aktive latente Steuern	45	-
Anpassung aus Erwerbsvorgängen	-16	-8
Stand zum Ende des Geschäftsjahrs	521	567

Zum 30. September 2003 enthalten die Wertberichtigungen €45 in Verbindung mit Geschäftszusammenschlüssen, die in zukünftigen Perioden bei ihrer eventuellen Auflösung dem Buchwert des immateriellen Vermögensgegenstands zugerechnet werden. Während der Geschäftsjahre 2003 und 2004 hat die Gesellschaft, auf Grund der Nutzung operativer Verluste, €16 und €8 von diesen Wertberichtigungen zurückgenommen und den Geschäfts- und Firmenwert entsprechend gekürzt.

Die Gesellschaft hat zum 30. September 2004 auf kumulierte einbehaltene Gewinne ausländischer Gesellschaften keine zusätzlichen Ertrag- oder Quellensteuern berechnet, da diese Gewinne in den Auslandsgesellschaften unbegrenzt reinvestiert bleiben sollen. Eine betragsmäßige Schätzung der nicht berücksichtigten passiven latenten Steuern auf diese einbehaltenen Gewinne ist nicht zweckmäßig.

Die Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 wurden im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und in den Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, erfasst. Die direkt im Eigenkapital erfassten Beträge für unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren und Pensionsverpflichtungen beliefen sich in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 auf €-6, €4 und €10.

Die Gesellschaft hat in dem am 30. September 2004 endenden Geschäftsjahr einige Geschäftsaktivitäten in verschiedenen Steuer-

gebieten neu organisiert und dabei einen Steueraufwand von €54 abgegrenzt, wovon €39 unter den langfristigen Vermögensgegenständen ausgewiesen werden (siehe Anhang Nr. 17).

10. Ergebnis je Aktie

Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag, geteilt durch den gewogenen Mittelwert der während des Jahres ausstehenden Aktien. Bei dem verwässerten Ergebnis je Aktie wird der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die Anzahl der zusätzlichen Stückaktien erhöht, die ausstünden, wenn potenziell verwässernde Instrumente oder Stückaktien ausgegeben worden wären.

Ermittlung des Ergebnisses je Aktie sowie des verwässerten Ergebnisses je Aktie für die Jahre 2002, 2003 und 2004 (Aktienstückzahl in Millionen):

Geschäftsjahr zum 30. September	2002	2003	2004
Zähler:			
Ergebnis von fortgeführten Geschäften	-1.017	-435	61
Ergebnis von aufgegebenem Geschäft	-4	-	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag – unverwässert und verwässert	-1.021	-435	61
Nenner:			
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – unverwässert	694,7	720,9	734,7
Verwässerungseffekt durch Aktienoptionen	-	-	1,9
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – verwässert	694,7	720,9	736,6
Gewinn/Verlust je Aktie – verwässert und unverwässert in €			
Von fortgeführten Geschäften	-1,46	-0,60	0,08
Von aufgegebenem Geschäft	-0,01	-	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-1,47	-0,60	0,08

Das Ergebnis verwässernde Instrumente beinhalten 1,9 Mio. Aktienoptionen, die an Mitarbeiter ausgegeben werden. Die Wirkung von nicht verwässernden Aktienoptionen und nachrangigen Wandelanleihen wurde von der Berechnung ausgenommen. Da in den

abgelaufenen Geschäftsjahren 2002 und 2003 die angenommene Ausübung dieser Instrumente keinen Verwässerungseffekt im Ergebnis je Aktie ergab, wurde auf die Berechnung des verwässerten Verlusts je Aktie verzichtet.

11. Wertpapiere

Die Wertpapiere setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003				2004			
	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste
Ausländische Staatsanleihen	10	11	1	–	9	10	1	–
Variabel verzinsliche Anleihen	343	345	10	–8	548	551	7	–4
Sonstige Gläubigerpapiere	145	145	–	–	271	272	1	–
Summe Gläubigerpapiere	498	501	11	–8	828	833	9	–4
Anteils-papiere	27	36	10	–1	13	12	1	–2
Festgeldanlagen	1.261	1.260	–	–1	1.112	1.112	–	–
Summe Wertpapiere	1.786	1.797	21	–10	1.953	1.957	10	–6
Ausgewiesen als:								
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.774	1.784	20	–10	1.935	1.938	9	–6
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anhang Nr. 17)	12	13	1	–	18	19	1	–
Summe Wertpapiere	1.786	1.797	21	–10	1.953	1.957	10	–6

Mit Wirkung vom 1. April 2003 wurden die Anteile an ProMOS als Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert (siehe Anhang Nr. 16). Zum 30. September 2003 enthielt der Posten „Anteils-papiere“ Anteile an ProMOS in Höhe von €17, die kurzfristigen Veräußerungsbeschränkungen unterlagen. Die Gesellschaft veräußerte die restlichen Anteile an ProMOS im Januar 2004. Die Gesellschaft erzielte Gewinne in Höhe von €60 und €2 während der Geschäftsjahre 2003 und 2004 durch den Verkauf von ProMOS-Anteilen.

Unrealisierte Verluste bei Wertpapieren, die in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 weniger als zwölf Monate gehalten wurden, beliefen sich auf €0 und €4.

Die realisierten Gewinne/Verluste aus Wertpapieren (netto) sind unter den sonstigen Erträgen/Aufwendungen in den jeweiligen Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen ausgewiesen und betragen für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004:

	2002	2003	2004
Realisierte Gewinne	–	60	10
Realisierte Verluste	–1	–4	–1
Realisierte Gewinne/Verluste, Saldo	–1	56	9

Am 30. September 2004 hatten alle Festgeldanlagen Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten.

Die Gläubigerpapiere zum 30. September 2004 werden vertragsgemäß wie folgt fällig:

	Anschaffungskosten	Marktwert
Innerhalb eines Jahres	365	365
Zwischen einem und fünf Jahren	84	87
Nach fünf Jahren	379	381
Summe Gläubigerpapiere	828	833

Die tatsächlichen Fälligkeiten können auf Grund von Veräußerungs- oder Rückzahlungsrechten abweichen.

12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte	700	879
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	194	206
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	8	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto	902	1.097
Wertberichtigungen	–26	–41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	876	1.056

Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:

	2003	2004
Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahrs	43	26
Zuführung zu Wertberichtigungen (Wiederaufholung), Saldo	-16	15
Fremdwährungseffekte	-1	-
Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahrs	26	41

13. Vorräte

Die Vorräte setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85	84
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	489	560
Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	385	316
Summe Vorräte	959	960

14. Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände

Die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Derivative Finanzinstrumente (siehe Anhang Nr. 29)	154	106
Zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände	-	88
Fördermittel	98	84
Umsatzsteuer und sonstige Steuerforderungen	98	147
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	125	49
Sonstige Vermögensgegenstände	94	40
Finanzforderungen und sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	18	18
Forderungen gegen Arbeitnehmer	7	9
Immaterielle Vermögensgegenstände, Pensionen (siehe Anhang Nr. 28)	4	-
Sonstige	77	49
Summe sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	675	590

Zum 30. September 2004 beinhalten die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände, die zum Glasfaserkomponentengeschäft (Teil des Segments Drahtgebundene Kommunikation) gehören. Weder ein Gewinn noch ein Verlust wurde in dieser Position erfasst. Diese Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung der Produktionsstätten in Deutschland und der Tschechischen Republik. Zugehörige Verbindlichkeiten werden in den sonstigen, kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt (siehe Anhang Nr. 20). Gemäß SFAS Nr. 144, Bilanzierung von Wertberichtigungen oder von Veräußerung von Anlagegegenständen, werden Aufwendungen für Abschreibungen seit dem 31. März 2004 nicht mehr erfasst. Die Gesellschaft führte einen Werthaltigkeitstest durch und stellte fest, dass keine außerplanmäßige Abschreibung notwendig war. Die Aufwendungen für Abschreibungen für das Geschäftsjahr zum 30. September 2004 betragen €7.

Die zusammengefassten Bilanzdaten des Glasfaserkomponentengeschäfts sind nachfolgend dargestellt:

	2004
Kurzfristige Vermögensgegenstände	47
Langfristige Vermögensgegenstände	41
Summe zum Verkauf stehender Vermögensgegenstände	88
Kurzfristige Verbindlichkeiten	23
Langfristige Verbindlichkeiten	8
Summe zum Verkauf stehender Verbindlichkeiten (siehe Anhang Nr. 20)	31

Die Gesellschaft hat am 29. April 2004 eine Vereinbarung mit Finisar über den Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts geschlossen. Am 11. Oktober 2004 wurde einer Änderung der Vereinbarung zugestimmt, nach der Infineon 110 Mio. Finisar-Aktien mit einem an diesem Stichtag gültigen Wert von €115 als Gegenleistung für die Veräußerung des Geschäftsanteils und finanzielle Unterstützung zukünftiger Restrukturierungsmaßnahmen beim Glasfaserkomponenten-Geschäft erhält. Die Zahl der letztendlich zu erhaltenden Aktien ist abhängig von der Veränderung im Netto-Umlaufvermögen des Glasfaserkomponentengeschäfts. Zusätzlich enthält die Vereinbarung eine Anti-Wettbewerb-Klausel über drei Jahre und limitiert die Schadenersatzhaftung auf 20% des durch Finisar gezahlten Gegenwertes. Die Liefervereinbarung wird im gegenseitigen Einvernehmen beendet für den Fall, dass die Transaktion nicht bis zum 31. März 2005 beendet sein wird. Die Vereinbarung unterliegt den üblichen Abschlusskonditionen sowie der Zustimmung der Finisar-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion erwartet die Gesellschaft rund 33% der Finisar-Anteile zu halten und diese nach der Equity-Methode zu bilanzieren.

15. Sachanlagen

Eine Zusammenfassung der Sachanlagen zum 30. September 2004 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
Anschaffungskosten 30. September 2003	1.065	6.650	2.079	298	10.092
Zugänge	51	491	196	425	1.163
Abgänge	-7	-192	-103	-5	-307
Konsolidierungen	-	-42	-33	-	-75
Umbuchungen	11	168	45	-224	-
Fremdwährungseffekte	-19	-73	-8	-10	-110
30. September 2004	1.101	7.002	2.176	484	10.763
Kumulierte Abschreibungen 30. September 2003	-488	-4.101	-1.686	-	-6.275
Zugänge	-69	-870	-292	-	-1.231
Abgänge	4	164	101	-	269
Umbuchungen	-	4	-4	-	-
Fremdwährungseffekte	5	51	5	-	61
30. September 2004	-548	-4.752	-1.876	-	-7.176
Buchwert 30. September 2003	577	2.549	393	298	3.817
Buchwert 30. September 2004	553	2.250	300	484	3.587

Die Gesellschaft war Leasinggeber von technischen Anlagen und Maschinen (siehe Anhang Nr. 27). Deren Anschaffungskosten betragen zum 30. September 2003 und 2004 jeweils €191 und €166 bei korrespondierenden kumulierten Abschreibungen in Höhe von €179 und €166.

Die Gesellschaft gab am 23. April 2004 ihre Pläne zur Erweiterung der Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, bekannt. Diese beinhalten die Fertigstellung der Gebäude und die Installation von Produktionsanlagen für eine 300-Millimeter-Fertigungsstätte. Zum 30. September 2004 enthalten die Anlagen im Bau €166, in Zusammenhang mit dieser Erweiterung der Fertigungsstätte. Die Kosten für die Erweiterungen werden auf \$1 Mrd. geschätzt. Der Produktionsstart modernster DRAM-Chips auf 300-Millimeter-Wafern ist für die zweite Hälfte des Kalenderjahrs 2005 geplant.

16. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen haben sich in dem am 30. September 2004 endenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Assoziierte Unternehmen	Beteili- gungen	Gesamt
Stand 30. September 2003	320	105	425
Zugänge	364	22	386
Abgänge	-	-12	-12
Zum Verkauf stehende Aktivierungspflichtige Zinsen	-	-14	-14
Außerplanmäßige Abschreibungen	7	-	7
Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	-16	-49	-65
Umgliederung	-14	-	-14
Wertsteigerung durch Kapitalerhöhungen	7	-7	-
Fremdwährungseffekte	2	-	2
	-6	-1	-7
Stand 30. September 2004	664	44	708

Investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit dem Ziel, das Zukunftspotenzial der Gesellschaft auf dem Gebiet der geistigen Eigentumsrechte zu stärken.

Die folgenden wesentlichen assoziierten Unternehmen wurden zum 30. September 2004 nach der Equity-Methode bilanziert:

Namen der assoziierten Unternehmen	Direkte und indirekte Anteile in %
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG, Dresden („AMTC“)	33,3
ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich („ALTIS“)	50,1
Hwa-Ken Investment Inc., Taipeh, Taiwan („Hwa-Ken“)	50,0
Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan („Inotera“)	45,8
Newlogic Technologies AG, Lustenau, Österreich („Newlogic“)	24,9
ParoLink Technologies Co., Ltd., Hsinchu, Taiwan („ParoLink“)	56,0
Ramtron International Corp., Colorado Springs/Colorado, USA („Ramtron“)	20,0
StarCore LLC, Austin/Texas, USA („StarCore“)	38,7

Die Gesellschaft hat diese Beteiligungen nach der Equity-Methode bilanziert, da keine einheitliche Leitung von der Gesellschaft ausgeübt worden ist (siehe Anhang Nr. 2). Die oben aufgeführten Gesellschaften sind vorwiegend mit Forschung und Entwicklung, Entwurf und Fertigung von Halbleiterprodukten und damit in Zusammenhang stehenden Produkten befasst.

Am 16. Mai 2002 ging die Gesellschaft mit den Partnern Advanced Micro Devices Inc. („AMD“), USA, und DuPont Photomasks Inc. („DuPont“), USA, das AMTC-Joint-Venture mit dem Ziel ein, gemeinsam fortschrittliche Fotomaschinen zu entwickeln und herzustellen. Zudem vereinbarte die Gesellschaft den Verkauf von speziellen Fotomaschinen-Anlagen an DuPont und ging eine langfristige Bezugsvereinbarung bis 2011 ein. Dementsprechend wurden zum 30. September 2004 €20 abgegrenzt. Dieser Betrag wird über die Laufzeit der Bezugsvereinbarung vereinnahmt.

ALTIS ist ein Joint Venture von Infineon und IBM, in welchem beide Partner ein gleiches Stimmrecht haben. Im Geschäftsjahr 2003 änderten die Gesellschaft und IBM die Gesellschaftervereinbarung. Entsprechend wird die Gesellschaft ihren Anteil an den Produktionskapazitäten von ALTIS in den Kalenderjahren 2004 bis 2007 von derzeit 50% auf 100% erhöhen. IBM und die Gesellschaft haben vereinbart, über das zukünftige Geschäftsmodell von ALTIS nicht später als zum 1. Januar 2007 eine Entscheidung zu treffen. Zusätzlich gewährt die geänderte Vereinbarung Infineon eine Option auf den Erwerb des IBM-Anteils an ALTIS bis einschließlich 1. Juli 2007.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2001 erwarb die Gesellschaft einen Gesamtanteil von 24,9% an Newlogic für ein Gesamtentgelt in Höhe von €21.

Im März 2001 erwarb die Gesellschaft für einen Betrag von €31, der sich aus 443.488 Aktien und Barmitteln in Höhe von €11 zusammensetzt, einen Anteil von 20,1% (danach verwässert zu einem Anteil von 20,0%) an Ramtron. Ramtron ist ein führender

Entwickler von speziellen Halbleitern für Speicherprodukte mit Sitz in Colorado Springs/Colorado, USA, und ist unter dem Symbol RMTR an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notiert. Der Marktpreis pro Aktie betrug am Bilanzstichtag 30. September 2004 \$2,90 sowie am 20. Oktober 2004 \$3,96.

Am 13. November 2002 schlossen die Gesellschaft und Nanya Technology Corporation („Nanya“) Abkommen über eine strategische Kooperation zur Entwicklung von DRAM-Speicherprodukten und ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen (Inotera, direkt und indirekt über die Beteiligung Hwa-Ken Investment Inc.) zur Errichtung und zum Betrieb einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Taiwan. Gemäß den Vereinbarungen werden Nanya und die Gesellschaft modernste 90-Nanometer- und 70-Nanometer-Technologie entwickeln. Die Kosten hierfür werden zu zwei Dritteln von der Gesellschaft und zu einem Drittel von Nanya getragen. Die neue 300-Millimeter-Fertigungsstätte wird durch das Gemeinschaftsunternehmen Inotera finanziert und wendet zur DRAM-Fertigung die im Zusammenhang mit der zuvor genannten Vereinbarung entwickelte Technologie an. Die volle Kapazität der Fertigungsstätte wird in zwei Stufen errichtet. Im Geschäftsjahr 2004 wurde die erste Ausbaustufe abgeschlossen und die Volumenfertigung wurde begonnen. Die Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe wird für das Geschäftsjahr 2006 erwartet. Beide Partner an diesem Joint Venture haben sich verpflichtet, jeweils die Hälfte der Produktion dieser Fertigungsstätte zu Preisen, die teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen.

Im Geschäftsjahr 2004 hat die Gesellschaft €342 in Inotera investiert. Die Investition schließt aktivierte Zinsen in Höhe von €7 im Geschäftsjahr 2004 mit ein. Während des Geschäftsjahrs 2004 hat Inotera Aktien an Mitarbeiter ausgegeben, was die Besitzanteile der Gesellschaft verwässert und zur gleichen Zeit den Anteil der Gesellschaft am Eigenkapital von Inotera um €2 erhöht hat. Zum 30. September 2004 werden Aktien ausgewiesen, die für die Ausgabe an die Mitarbeiter bestimmt sind. Diese Aktien könnten die Beteiligung der Gesellschaft auf 44,1% verringern. Inoteras Antrag zur Zulassung als Aktiengesellschaft wurde am 7. Oktober 2004 von dem Securities and Futures Bureau akzeptiert.

Am 1. Oktober 2002 gründeten die Gesellschaft, Agere Systems Inc. und Motorola Inc. die StarCore LLC, ansässig in Austin/Texas. Am 30. September 2004 hält die Gesellschaft 38,7% der Geschäftsanteile mit einem Gesamtwert von €24. StarCore konzentriert sich auf die Entwicklung, Standardisierung und Verbreitung von Basistechnologien für Digitalsignal-Prozessoren (DSP).

Am 4. Oktober 2002 gab die Gesellschaft bekannt, dass sie den Gesellschaftervertrag mit Mosel Vitelic Inc. („MVI“) über ihr Gemeinschaftsunternehmen ProMOS auf Grund schwer wiegender Verletzungen des Aktionärsvertrags durch MVI zum 1. Januar 2003 gekündigt hat. Die Kapazitäts- und Liefervereinbarung, die sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Abnahme von Produkten von ProMOS für beide Anteilseigner enthielt, erlosch ebenfalls zum 1. Januar 2003. Am 27. Januar 2003 hat die Gesellschaft die Technologie-Lizenzvereinbarung mit ProMOS gekündigt. Daraufhin hat ProMOS ebenfalls dieselbe Vereinbarung gekündigt. Für den Streitfall sieht diese Vereinbarung ein Schiedsverfahren vor. Im

Mai 2003 hat ProMOS ein Schiedsverfahren im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung eröffnet und die Gesellschaft hat ihrerseits eine Gegenklage eingereicht (siehe Anhang Nr. 31).

Während des Geschäftsjahrs 2002 hat ProMOS durch Bonusprogramme Aktien an seine Mitarbeiter ausgegeben, welche einerseits den auf die Gesellschaft entfallenden Ergebnisanteil vervässerten und andererseits den Anteil der Gesellschaft am Eigenkapital von ProMOS um €18 erhöhten. Während des Geschäftsjahrs 2003 hat ProMOS eigene Aktien am Markt zurückgekauft. Dieses Vorgehen hat den Anteil der Gesellschaft an ProMOS erhöht und gleichzeitig den Anteil am Eigenkapital um €2 verringert.

Im Januar 2003 hat die Gesellschaft bekannt gegeben, dass sie ihre Geschäftsanteile an ProMOS, abhängig von Marktbedingungen und im Einklang mit taiwanischen Börsenverordnungen, veräußern will. Da die Gesellschaft keinen wesentlichen Einfluss mehr auf ProMOS ausüben kann, wird die Beteiligung mit Wirkung zum 1. April 2003 nicht mehr nach der Equity-Methode, sondern unter Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziell ausgewiesen (siehe Anhang Nr. 11). Infineon hat bis Januar 2004 alle Anteile an ProMOS veräußert.

Im November 2003 hat Infineon mit United Epitaxy Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, das Gemeinschaftsunternehmen ParoLink gegründet. Infineon hat €6 Eigenkapital eingebracht und hält 56% der Anteile an ParoLink. Die Gesellschaft bilanziert die Beteiligung an ParoLink als „At equity“-Beteiligung, da der Minderheitsgesellschafter wesentliche Rechte hat und eine beherrschende Kontrolle durch Infineon nicht gegeben ist. Auf Grund des geplanten Ausstiegs aus dem Glasfasergeschäft (siehe Anhang Nr. 14) sind die Gesellschaft und UEC in Gesprächen das Joint Venture zu beenden, und in Folge dessen hat die Gesellschaft zum 30. September 2004 diese Beteiligung komplett wertberichtigt.

Die Gesellschaft hat während der Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 bei Finanzanlagen Wertminderungen in Höhe von €39, €30 und €65 erfasst, da der Buchwert nicht nur kurzfristig über dem Marktwert lag. Auf Grund der Entscheidung, die Venture-Aktivitäten der Gesellschaft nicht weiterzuführen, haben wir für das Geschäftsjahr 2004 eine Wertberichtigung in Höhe von €28 vorgenommen, um den Buchwert des Venture-Portfolios an den zu erwartenden Verkaufserlös anzupassen.

In den Finanzanlagen sind zum 30. September 2004 Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von €32 enthalten.

Die zusammengefassten Finanzdaten der zum 30. September 2004 assoziierten Unternehmen für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 stellen sich wie folgt dar:

	2002	2003	2004
Umsatzerlöse	541	600	541
Bruttoergebnis vom Umsatz	62	67	26
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6	-6	-36

	2002	2003	2004
Umlaufvermögen	269	243	454
Anlagevermögen	650	682	1.690
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-442	-324	-383
Langfristige Verbindlichkeiten	-13	-15	-581
Eigenkapital	464	586	1.180

17. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Immaterielle Vermögensgegenstände	411	398
Forderungen für Investitionszuschüsse	12	92
Abgegrenzter Steueraufwand (siehe Anhang Nr. 9)	-	39
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen (siehe Anhang Nr. 28)	1	27
Langfristige Forderungen	23	24
Wertpapiere des Anlagevermögens (siehe Anhang Nr. 11)	13	19
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	11	10
Wechselforderungen	5	3
Forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang Nr. 27)	2	2
Sonstige	7	13
Summe sonstige langfristige Vermögensgegenstände	485	627

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2004 wie folgt zusammen:

	Firmenwerte	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt
Anschaffungskosten			
30. September 2003	243	339	582
Zugänge	-	125	125
Außerplanmäßige Abschreibungen (siehe Anhang Nr. 7)	-71	-	-71
Abgänge	-	-75	-75
Zukäufe (siehe Anhang Nr. 3)	23	30	53
Anpassungen	-8	-	-8
Fremdwährungseffekte	-15	-5	-20
30. September 2004	172	414	586
Kumulierte Abschreibungen			
30. September 2003	-25	-146	-171
Zugänge	-	-89	-89
Erworbene R&D	-	-9	-9
Abgänge	-	75	75
Fremdwährungseffekte	4	2	6
30. September 2004	-21	-167	-188
Buchwert			
30. September 2003	218	193	411
Buchwert			
30. September 2004	151	247	398

Die geschätzten Abschreibungen der sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände weisen für die nächsten fünf Geschäftsjahre die folgenden Werte auf: 2005 €82, 2006 €60, 2007 €47, 2008 €21 und 2009 €7.

Im Juni 2003 hat die Gesellschaft eine Technologieentwicklungs- und Lizenzvereinbarung mit IBM und Chartered Semiconductor für modernste Logik-Produktionsprozess-Technologien geschlossen. Lizenzen in Höhe von €43 werden über die erwartete Nutzungsdauer der entsprechenden Technologie von fünf Jahren abgeschlossen.

In den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 hat die Gesellschaft Wertminderungen in Höhe von €12, €68 und €71 vorgenommen. Auf Grund reduzierter erwarteter Erträge und geringerer Markterwartungen und unter Berücksichtigung bis dato erreichter technischer Meilensteine hat die Gesellschaft die erwarteten Erträge ihres Optischen-Netzwerk-Geschäfts des Segments Drahtgebundene Kommunikation reduziert. Dementsprechend hat die Gesellschaft die Geschäfts- oder Firmenwerte dieser Berichterstattungseinheit gemäß SFAS Nr. 142, Geschäfts- oder Firmenwerte und andere immaterielle Vermögensgegenstände, auf notwendige Wertminderungen auf Basis zukünftiger diskontierter geschätzter Cash-Flows hin überprüft und eine Wertminderung in Höhe von €68 im Geschäftsjahr 2003 vorgenommen. Als Teil der jährlichen Überprüfung der Werthaltigkeit der Geschäfts- und Firmenwerte hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 eine Wertminderung in Höhe von €71 vorgenommen, um den Geschäfts- und Firmenwert der Berichtseinheit an den Marktwert anzupassen. Dies ist hauptsächlich das Ergebnis reduzierter Umsatzerlöse im Berichtsjahr und reduzierter Markterwartungen.

18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	750	969
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	73	61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	54	68
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877	1.098

19. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	257	279
Gewährleistungen und Lizenzen	169	78
Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang Nr. 31)	28	67
Zinsen	42	33
Sonstige	81	98
Summe Rückstellungen	577	555

Am 15. September 2004 traf die Gesellschaft eine Einigung mit dem US-amerikanischen Justizministerium (DOJ) in Verbindung mit den kartellrechtlichen Ermittlungen (siehe Anhang Nr. 31) und erklärte sich bereit, eine Strafe von \$160 Mio. über die nächsten fünf Jahre zu zahlen. Der innerhalb des nächsten Geschäftsjahrs fällige Betrag ist in den Rückstellungen und der langfristige Anteil in den sonstigen Verbindlichkeiten (siehe Anhang Nr. 22) enthalten.

20. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Umsatzsteuer- und sonstige Steuerverbindlichkeiten	237	272
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	121	124
Abgegrenzte Zuwendungen der öffentlichen Hand (siehe Anhang Nr. 6)	80	90
Abgegrenzte Erträge	72	58
Restrukturierung (siehe Anhang Nr. 8)	27	16
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten (siehe Anhang Nr. 29)	11	17
Finanzverbindlichkeiten und sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	5	2
Verbindlichkeiten aus zum Verkauf stehenden Vermögensgegenständen (siehe Anhang Nr. 14)	-	31
Sonstige	9	20
Summe sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	562	630

Die abgegrenzten Erträge enthalten Erträge aus Lizenz- und Technologieübertragungen (siehe Anhang Nr. 5) und Zuwendungen der öffentlichen Hand (siehe Anhang Nr. 6). Der langfristige Anteil ist in sonstigen Verbindlichkeiten enthalten (siehe Anhang Nr. 22).

21. Finanzverbindlichkeiten

Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:		
Durchschnittszinssatz 2,3 %	8	53
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Durchschnittszinssatz 4,5 %	–	18
Kurzfristige Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	138	498
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3	2
Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	149	571
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:		
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 4,25 %, fällig 2007	987	636
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 5,0 %, fällig 2010	688	688
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:		
Unbesicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittszinssatz 2,54 %, fällig 2005 – 2007	566	69
Besicherte Darlehen mit Ratenzahlung		
Durchschnittszinssatz 1,75 %, fällig 2005 – 2010	28	7
Verbindlichkeiten, Durchschnittszinssatz 4,0 %, fällig 2005	6	–
Darlehen der öffentlichen Hand, Zinssatz 1,23 %, fällig 2027	60	27
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	8	–
Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.343	1.427

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen hauptsächlich aus Kreditaufnahmen im Rahmen von kurzfristigen Darlehensvereinbarungen. Die Verbindlichkeiten stellen Liquiditätszuflüsse der Minderheitsbeteiligten an den Infineon-Flash-Gesellschaften dar und sind sowohl unbesichert als auch anderen Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften untergeordnet.

Am 5. Juni 2003 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine im Jahr 2010 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €700 im Rahmen eines verbindlichen Übernahmeangebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese über die Laufzeit auf Anforderung in maximal 68,4 Mio. Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der Wandelpreis 10,23 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil

oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 5,0% pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und kann in den ersten drei Jahren nicht gewandelt werden. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger bei einem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft das Recht auf Rückzahlung. Eine Reorganisation der Gesellschaft mit Substitution der Bürgin wird nicht als Kontrollwechsel angesehen. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 125% des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Zum 30. September 2004 betragen die abgegrenzten Ausgabekosten dieser Anleihe €12.

Am 6. Februar 2002 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine im Jahr 2007 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €1.000 im Rahmen eines verbindlichen Übernahmeangebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese über die Laufzeit auf Anforderung in maximal 28,2 Mio. Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der Wandelpreis 35,43 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25% pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger das Recht auf Rückzahlung bei dem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 115% des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Während des Geschäftsjahrs 2004 tilgte die Gesellschaft einen Nominalbetrag in Höhe von €360 der in 2007 nachrangigen Wandelschuldverschreibung mit einem Gewinn in Höhe von €6 vor Steuern. Am 30. September 2004 betrug der ausstehende Nominalwert €640 wovon €500 im Rahmen eines Marktwerthedges gesichert ist (siehe Anlage 29). Die abgegrenzten Ausgabekosten betragen €5.

In kurzfristig fällige Bestandteile von langfristigen Finanzverbindlichkeiten ist zum 30. September 2004 ein Konsortialkredit in Höhe von €450 für den Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden enthalten. Diese war zum 30. September 2003 und 2004 voll in Anspruch genommen. Die Kreditlinie ist teilweise von der Bundesre-

publik Deutschland und einer anderen öffentlichen Körperschaft gesichert. Die Kreditlinie enthält bestimmte Restriktionen bezüglich der Bilanzrelationen, sieht jährliche Zinszahlungen vor und ist am 30. September 2005 rückzahlbar. Die Gesellschaft erwartet, dieser Verpflichtung im Geschäftsjahr 2005 aus verfügbaren Mitteln nachzukommen.

Im September 2004 hat die Gesellschaft einen \$400 Mio./€400-Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart. Dieser Kredit besteht aus zwei Tranchen: Tranche A umfasst \$400 Mio. und ist zur Finanzierung der Erweiterung der Produktionsanlagen am Standort Richmond/Virginia vorgesehen. Tranche B ist eine €400 Mehrwährungskreditlinie, die revolvingierend für generelle betriebliche Zwecke genutzt werden kann und die vorherige €375 in 2005 auslaufende Mehrwährungskreditlinie ersetzt. Der maximal ausstehende Betrag der Tranche A reduziert sich durch ab

30. September 2006 einsetzende gleichmäßige Rückzahlungen. Die neue Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Zum 30. September 2004 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Der Zinssatz schwankt in Abhängigkeit von einer Profitabilitätskennzahl. Gegenüber den Darlehensgebern der dargestellten \$400 Mio./€400 Kreditlinien wurde eine Negativerklärung bezüglich der Bestellung von nicht zugelassenen Sachsicherheiten abgegeben.

Die Darlehen der öffentlichen Hand enthalten eine unbesicherte Industrielanleihe im Zusammenhang mit der Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA. Die Gesellschaft nahm ihr Recht auf vorzeitige Rückzahlung wahr und tilgte €33 der Industrielanleihe.

Die Gesellschaft hat verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart.

Laufzeit	Zusage durch	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2004		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
Kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien, Cash-Management	163	73	90
Kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital	272	–	272
Langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	724	–	724
Langfristig¹	feste Zusage	Projektfinanzierung	601	601	–
Gesamt			1.760	674	1.086

¹ Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Zum 30. September 2004 hatte die Gesellschaft die geforderten Bilanzrelationen zu den entsprechenden Kreditlinien erfüllt.

Die Zinsaufwendungen beliefen sich auf €83, €115 und €126 in den Geschäftsjahren 2002, 2003 bzw. 2004.

Von den langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fällig:

Geschäftsjahr	Betrag
2006	49
2007	655
2008	5
2009	2
Folgende Jahre	716
Summe	1.427

22. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Rückgewährbare Einlagen	242	–
Abgegrenzte Zuwendungen der öffentlichen Hand (siehe Anhang Nr. 6)	223	191
Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang Nr. 31)	–	109
Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 28)	87	98
Langfristige Vorauszahlungen	–	45
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Kapitalanteile	5	39
Sonstige abgegrenzte Einnahmen (siehe Anhang Nr. 5)	50	18
Pensionsähnliche Leistungszusagen (siehe Anhang Nr. 28)	5	5
Sonstige	18	63
Summe sonstige langfristige Verbindlichkeiten	630	568

Nach den Verträgen zur Gründung der SC300 hatte die Gesellschaft das Recht die Anteile der anderen Investoren an dem Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen. Im März 2004 nahm die Gesellschaft ihr Recht in Anspruch und übernahm die restlichen Anteile an der SC300 in Höhe von €278, was den eingezahlten Einlagen Dritter zuzüglich angefallener Zinsen entspricht. Die angefallenen Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung der rückgewährbaren Einlagen in Höhe von €21, sind als Netto-Zinsaufwendungen des Geschäftsjahrs 2004 enthalten. Die Zahlung der Anteile erfolgte über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 26.679.255 neuen Aktien (siehe Anhang Nr. 23).

23. Grundkapital

Am 30. September 2004 hatte die Gesellschaft 747.559.859 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,00 Euro pro Aktie ausgegeben. Während des Geschäftsjahrs 2004 wurde das Grundkapital mit €53 durch Ausgabe von 26.679.255 neuen Aktien gegen Sacheinlage in Zusammenhang mit der Akquisition der restlichen Anteile an SC300 erhöht (siehe Anhang Nr. 22). Während des Geschäftsjahrs 2003 wurden 96.386 Aktien freigegeben, die als bedingte Kaufpreiskomponenten im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran (siehe Anhang Nr. 3) vor Beginn des Geschäftsjahrs ausgegeben waren und von einem Treuhänder verwahrt wurden, da vereinbarte Meilensteine erreicht wurden. Diese Freigabe ist in der Eigenkapitalveränderungsrechnung ausgewiesen.

Genehmigtes und Bedingtes Kapital

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand, zusätzlich zu den ausgegebenen Anteilen das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Anteile zu erhöhen. Zum Stichtag 30. September 2004 kann der Vorstand folgende Genehmigte Kapitalien zur Ausgabe neuer Aktien ausüben:

∴ Das Genehmigte Kapital I/2002 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 21. Januar 2007 um bis zu €297 durch die Ausgabe von jungen Aktien gegen Bareinlagen, wobei das Bezugsrecht teilweise ausgeschlossen werden kann, oder im Zusammenhang mit Geschäftszusammenschlüssen (Sacheinlagen), wobei das Bezugsrecht für alle Aktien ausgeschlossen werden kann.

∴ Das Genehmigte Kapital II/2004 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 19. Januar 2009 um bis zu €30, um Aktien an Mitarbeiter auszugeben (wobei die Bezugsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen sind).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €96 („Bedingtes Kapital I“) bzw. um bis zu €29 („Bedingtes Kapital III“) bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital kann durch Ausgabe von bis zu 62,5 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien im Rahmen der Aktienoptionspläne der Gesellschaft verwendet werden (siehe Anhang Nr. 24). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €50 durch Ausgabe von bis zu 25 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die im Februar 2002 begeben wurden und bis zum 23. Januar 2007 umgewandelt werden können (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €136,8 durch Ausgabe von bis zu 68,4 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibung, die im Juni 2003 begeben wurde. Diese Wandelschuldverschreibung kann bis zum 22. Mai 2010 in Aktien umgetauscht werden (siehe Anhang 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Weiterhin ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu €213,2 durch Ausgabe von bis zu 106,6 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 21. Januar 2007 begeben werden können (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Dividenden

Nach dem deutschen Aktiengesetz bestimmt sich der Betrag, der zur Dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfügung steht, nach dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft, der nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs ermittelt wird. Alle Dividendenzahlungen müssen von der Hauptversammlung beschlossen werden.

Da der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG für 2002/2003 keinen Bilanzgewinn auswies, wurde für das Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet. Ebenso kann für das Geschäftsjahr 2003/2004 keine Dividende ausgeschüttet werden, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust ausweist.

24. Aktienoptionspläne

Aktienoptionsplan mit fester Ausübungshürde

Am 6. April 2001 stimmten die Aktionäre einem internationalen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 2001) zu, der den Aktienoptionsplan 1999 ablöst. Optionen, die auf Grundlage des Aktienoptionsplan 1999 ausgegeben wurden, behalten ihre Wirksamkeit zu den damaligen Ausgabekonditionen, es werden jedoch keine weiteren Optionen aus diesem Plan mehr ausgegeben. Entsprechend den Bedingungen des neuen Plans können insgesamt

bis zu 51,5 Mio. Optionen innerhalb einer Fünfjahresfrist gewährt werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 105% des durchschnittlichen Aktienkurses während der fünf Handelstage vor Gewährung der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren ausgeübt werden, sofern seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwischen zwei und vier Jahre vergangen sind und der Aktienkurs der Gesellschaft den Ausübungspreis an mindestens einem Handelstag erreicht hat.

Im Jahr 1999 verabschiedete die Hauptversammlung einen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 1999), wonach nicht übertragbare Rechte zum künftigen Erwerb von Aktien gewährt werden. Entsprechend diesem Plan können über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 48 Mio. Aktienoptionen ausgegeben werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 120% des durchschnittlichen Aktienpreises während der fünf Handelstage

vor dem Ausgabebetrag der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs an mindestens einem Handelstag während der jeweiligen Laufzeit den Ausübungspreis erreicht hat.

Nach den Regelungen des Aktienoptionsplans von 2001 entscheidet der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses über die Zahl der dem Vorstand zu gewährenden Optionen. Der Vorstand wird im gleichen Zeitraum über die Zahl der an bezugsberechtigte Mitarbeiter zu gewährende Optionen entscheiden.

Die Aktienoptionspläne von 1999 und 2001 sowie ihre Änderungen innerhalb der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar (Optionsvolumen in Mio. Stück, Ausübungspreis in Euro):

	2002		2003		2004	
	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis
Ausstehende Optionen zu Beginn des Geschäftsjahrs	11,3	€48,56	19,9	€35,96	29,9	€25,56
Gewährte Optionen	9,4	€21,74	11,7	€8,97	8,1	€12,32
Ausgeübte Optionen	–	–	–	–	–	–
Verfallene Optionen	–0,8	€45,90	–1,7	€32,80	–2,0	€25,17
Ausstehende Optionen zum Ende des Geschäftsjahrs	19,9	€35,96	29,9	€25,56	36,0	€22,59
Ausübbar zum Ende des Geschäftsjahrs	5,1	€42,00	9,6	€48,56	13,2	€39,89

Die folgende Tabelle fasst Informationen über die ausstehenden Aktienoptionen zum 30. September 2004 zusammen (Optionsvolumen in Mio., Ausübungspreis in Euro):

Spanne der Ausübungspreise	Ausstehend			Ausübbar	
	Anzahl der Optionen	Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis
€5 – €10	10,6	5,16	€8,92	–	–
€10 – €15	9,2	5,98	€12,41	0,7	€12,57
€15 – €20	0,2	4,84	€15,75	0,1	€15,75
€20 – €25	7,0	4,18	€23,70	3,4	€23,70
€25 – €30	0,1	4,01	€27,40	0,1	€27,45
€40 – €45	4,4	2,46	€42,03	4,4	€42,03
€50 – €55	0,1	3,50	€53,26	0,1	€53,26
€55 – €60	4,4	3,16	€55,18	4,4	€55,18
Gesamt	36,0	4,60	€22,59	13,2	€39,89

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Die Gesellschaft bietet ein weltweites Programm zum Aktienwerb durch Mitarbeiter, das den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Aktien der Gesellschaft mit einem Abschlag von 15% zu erwerben, solange eine bestimmte Obergrenze pro Mitarbeiter nicht überschritten und eine Mindesthaltedauer von einem Jahr eingehalten wird. Im Rahmen und unter den Bedingungen dieses Plans erwerben Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2002 355.460 Aktien. In den Geschäftsjahren 2003 und 2004 gab es kein entsprechendes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.

Marktwert-Angaben

Wie in Anhang Nr. 2 erläutert, bilanziert die Gesellschaft Aktienoptionspläne gemäß APB Opinion 25, Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter, und den entsprechenden Regelungen zur Bilanzierung von Aktienoptionsplänen. SFAS Nr. 123 gibt eine alternative Möglichkeit zur Bewertung des Aufwands für Mitarbeitervergütung vor, indem der Marktwert der Optionen zum Gewährungszeitpunkt durch Optionspreismodelle bestimmt wird. Optionspreismodelle wurden entwickelt, um den Marktwert von frei handelbaren, fungiblen Optionen ohne Mindesthaltedauer zu bestimmen, die sich jedoch deutlich von den Optionen mit Ausübungsrestriktionen unterscheiden, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitern gewährt. Diese Modelle benötigen weiterhin subjektive Annahmen wie die zukünftige Volatilität des Aktienkurses und den erwarteten Zeitraum bis zur Ausübung, die den festgestellten Optionspreis erheblich beeinflussen. Die Gesellschaft bewertete den Marktwert einer gewährten Option zum Ausgabezeitpunkt mittels eines Black-Scholes-Optionspreismodells, das von einer Einzelbewertung der Optionen ausgeht und den Verfall zum jeweiligen Eintrittszeitpunkt annimmt.

In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Annahmen zur Optionspreisbewertung in den einzelnen Geschäftsjahren zum 30.09. dargestellt:

	2002	2003	2004
Durchschnittliche Annahmen:			
Risikofreier Zinssatz in %	4,19	3,85	3,68
Erwartete Volatilität in %	52	59	59
Dividendenertrag in %	0	0	0
Erwartete Laufzeit in Jahren	4,50	4,50	4,50
Durchschnittlicher Marktwert pro Option zum Gewährungszeitpunkt in €	9,09	4,41	5,88

Wären Personalaufwendungen auf der Grundlage des Marktwerts nach SFAS Nr. 123 bilanziert worden, wodurch sich ein Aufwand für Mitarbeitervergütung auf Grundlage oben dargestellter Marktwerte ergeben hätte, so hätten sich der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag und das Ergebnis je Aktie gemäß der Anwendung von SFAS Nr. 148, Bilanzierung von Aktienoptionen – Übergang und Offenlegung, wie in den folgenden Pro-forma-Angaben jeweils zu dem am 30.09. endenden Geschäftsjahr verringert:

	2002	2003	2004
Konzernjahresüberschuss/ Fehlbetrag			
Ist	-1.021	-435	61
Abzüglich:			
Im Konzernergebnis enthaltene Aufwendungen für aktienbezogene Mitarbeitervergütung, abzüglich zugehöriger Steuer	23	7	2
Zuzüglich:			
Aufwendungen für alle aktienbezogenen Mitarbeitervergütungen, über Marktwertmethode ermittelt, abzüglich Steuer	-92	-43	-37
Pro forma	-1.090	-471	26
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie			
Ist	€-1,47	€-0,60	€0,08
Pro forma	€-1,57	€-0,65	€0,03

25. Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, haben sich für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 wie folgt entwickelt:

	2002			2003			2004		
	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren:									
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus gehaltenen Wertpapieren	-4	2	-2	11	-	11	4	-	4
Umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen Gewinnen/Verlusten	3	-1	2	4	-2	2	-11	-	-11
Unrealisierte Gewinne/Verluste, netto	-1	1	-	15	-2	13	-7	-	-7
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Zusätzliche Mindestpensionsverbindlichkeit	-13	5	-8	4	-2	2	28	-10	18
Unterschiede aus Fremdwährungsumrechnung	-92	-	-92	-76	-	-76	-41	-	-41
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-106	6	-100	-57	-4	-61	-19	-10	-29
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, zu Beginn des Geschäftsjahrs	65	8	73	-41	14	-27	-98	10	-88
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, am Ende des Geschäftsjahrs	-41	14	-27	-98	10	-88	-117	-	-117

26. Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung

	2002	2003	2004
Auszahlungen für:			
Zinsen	53	104	144
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46	53	59
Erhaltene Zahlungen für steuerfreie Investitionszulagen	86	34	65
Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungsaktivitäten:			
Einlagen von/an Siemens	10	-6	-
Über Kapitalleasing erworbene Vermögensgegenstände	2	5	-

Die Gesellschaft gab Aktien aus, um den rückgewährbaren Anteil am SC300 Venture in Höhe von €278 während des am 30. September 2004 endenden Geschäftsjahrs abzulösen (siehe Anhang Nr. 22).

Nach der Ausgründung von Siemens gründete die Gesellschaft einen Pensionsplan für ihre amerikanischen Mitarbeiter gesondert von dem Siemens-US-Pensionsplan. Zum Zeitpunkt der Ausgründung wurde der eingezahlte Bestand des der Gesellschaft zuzurechnenden Teils des Siemens-US-Pensionsplans im Verhältnis zu den übertragenen Mitarbeitern als Pensionsrückstellung erfasst. Nachträglich transferierte Siemens, basierend auf einer versicherungsmathematischen Ermittlung, Vermögensgegenstände, um diese Rückstellung finanziell zu unterlegen. Die Differenz zwischen der versicherungsmathematischen Bewertung am Tag der Unterlegung und der ursprünglich verrechneten Rückstellung in Höhe von €10 und €-6 wurde als Eigenkapitaltransaktion in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 ausgewiesen.

Die Gesellschaft gab Aktien aus, um die Akquisition von MIC für €325 während des am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahrs durchzuführen (siehe Anhang Nr. 3).

27. Verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft unterhält übliche Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen des Siemens-Konzerns und zu den sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (im Folgenden als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet). Infineon bezieht bestimmte Vorprodukte, insbesondere Chipsätze, von verbundenen Unternehmen. Zugleich

verkauft die Gesellschaft auch einen beträchtlichen Teil der Produktion an verbundene Unternehmen. Diese Käufe von und Verkäufe an verbundene Unternehmen orientieren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an Herstellungskosten zuzüglich einer Gewinnmarge.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Kurzfristig:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	194	206
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	8	12
Finanzforderungen und sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	18	18
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	125	49
Forderungen gegen Arbeitnehmer	7	9
	352	294
Langfristig:		
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	11	10
Forderungen gegen Arbeitnehmer	2	2
	13	12
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	365	306

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zum 30. September 2003 und 2004 wie folgt zusammen:

	2003	2004
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	73	61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	54	68
Finanzverbindlichkeiten und sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	5	2
Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	132	131

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber bzw. Forderungen gegen verbundene Unternehmen wird wie folgt unterschieden: (1) Positionen, bei denen entweder von oder an Siemens-Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft Geschäftsanteile hält, schuldet oder geschuldet wird, und (2) nach dem zu Grunde liegenden Geschäftsvorfall. Die als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren aus dem Kauf bzw. Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Finanzforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten die geschuldeten Beträge aus Darlehen sowie die zu Interbankensätzen aufgelaufenen Zinsen.

Die Gesellschaft und IBM haben jeweils einen befristeten revolvingkredit an ALTIS verlängert. Zum 30. September 2003 und 2004 war der Kredit in Höhe von €61 und €42 in der Position „Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ausgewiesen.

Am 30. September 2003 enthielten die „Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ein unbesichertes Darlehen in Höhe von €58 an Inotera, welches marktüblich verzinst und im Oktober 2003 zurückgezahlt wurde.

Darstellung des Geschäftsverkehrs mit verbundenen Unternehmen für die zum 30. September 2002, 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre:

	2002	2003	2004
Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen:			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	685	836	957
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	170	163	69
Gesamte Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen	855	999	1.026
Bezüge von verbundenen Unternehmen:			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	681	413	264
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	686	470	357
Gesamtbefüge von verbundenen Unternehmen	1.367	883	621
Zinserträge/-aufwendungen von verbundenen Unternehmen			
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5	4	2
Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-2	-1	—
Gesamt	3	3	2

Die Umsätze mit Unternehmen des Siemens-Konzerns beinhalten Verkäufe an Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte, die sich in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 auf jeweils €77, €86 und €23 beliefen. Grundsätzlich wird der Verkauf an Dritte über die eigenen Vertriebsorganisationen der Gesellschaften abgewickelt. In bestimmten Ländern, in denen die Gesellschaft keine eigene Vertriebsorganisation unterhält, unterstützen die Vertriebsgesellschaften des Siemens-Konzerns den Verkauf an Dritte und erhalten hierfür eine Kommission.

Die Käufe von Gesellschaften des Siemens-Konzerns bestehen hauptsächlich aus Vorräten, IT-Dienstleistungen und Verwaltungsdienstleistungen.

Im Februar 2004 hat die Gesellschaft den Erwerb von Vermögensgegenständen, inklusive der Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten, der Protocol-Software-Aktivitäten der Siemens AG für €13 und die Übernahme von rund 145 Software-Ingenieuren auf dem Gebiet der mobilen Kommunikation abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat technische Anlagen und Maschinen an das Gemeinschaftsunternehmen ALTIS geleast (siehe Anhang Nr. 15). Der Leasingvertrag endete zum 30. September 2004.

Siemens hat am 10. August 2000 eine garantierte Wandelanleihe (Exchangeable Note) mit einem Nominalvolumen von €2.500 ausgegeben. Die mit 1% p.a. verzinsten Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum 10. August 2005. Jeder Inhaber einer Teilschuldverschreibung hat bei Eintritt bestimmter Bedingungen das Recht, diese Teilschuldverschreibung bis zum 27. Juli 2005 in 1.000 Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Während des Geschäftsjahrs 2004 hat Siemens Teilschuldverschreibungen in Höhe von €1.905 zurückgekauft. Zum 30. September 2004 war das noch ausstehende Nominalvolumen der Wandelanleihe in 5.955.000 Aktien der Gesellschaft umwandelbar.

Am 5. Dezember 2001 übertrug Siemens in einem Treuhandabkommen 200 Mio. Aktien der Gesellschaft bzw. rund 28,9% des zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft an eine nicht stimmberechtigte Treuhandgesellschaft, die nicht mit dem Siemens-Konzern in Beziehung steht. Der Treuhänder hat einen Rechtsanspruch auf die im Treuhandvermögen gebundenen Aktien, Siemens hat unwiderruflich alle Stimmrechte daraus aufgegeben. Der Treuhänder ist jedoch nicht berechtigt, das Stimmrecht der mit diesem Treuhandvertrag übertragenen Aktien auszuüben. Siemens ist weiterhin berechtigt, den wirtschaftlichen Nutzen aus den in Treuhandverwahrung befindlichen Aktien zu ziehen, einschließlich des Rechts auf Dividendenzahlung oder Erlöse aus einem erlaubten Verkauf der Aktien der Gesellschaft aus der Treuhandverwahrung. Gemäß dem Treuhandvertrag hält der Treuhänder die Aktien zum Nutzen der Begünstigten, die sowohl Siemens als Treuhandgeber als auch fremde Dritte – Aktionäre der Gesellschaft – umfassen. Das Treuhandverhältnis erlischt, wenn der Siemens-Konzern direkt oder indirekt weniger als 50% des stimmberechtigten Grundkapitals der Gesellschaft, inklusive der im Treuhandverhältnis vom Treuhänder gehaltenen Anteile, über einen Zeitraum von zwei Jahren hält oder gehalten hat. Gewisse Bestimmungen des Treuhandvertrags, einschließlich derjenigen, die sich auf die Stimmrechte und die Übertragung der treuhändisch gehaltenen Aktien beziehen, dürfen nicht ohne Zustimmung von Aktionären der Gesellschaft geändert werden.

Die Übertragung der Aktien der Gesellschaft an einen nicht stimmberechtigten Treuhänder durch Siemens am 5. Dezember 2001 verringerte die durch Siemens gehaltenen stimmberechtigten Anteile an der Gesellschaft um den der Anzahl der übertragenen Aktien entsprechenden Stimmrechtsanteil.

Mit einem am 12. Dezember 2002 datierten Schreiben hat der Siemens Pension Trust e.V. mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil am 2. Dezember 2002 unter 10% gefallen sei. Die Gesellschaft geht davon aus, dass damit der Anteil von Siemens insgesamt unter 50% gefallen sei und somit die Vereinbarung der Nicht-Stimmberechtigung im Dezember 2004 endet.

Am 12. Januar 2004 hat die Siemens AG bekannt gegeben, dass sie 150 Mio. Aktien der Infineon Technologies AG verkauft hat. Auf Grund dieser Transaktion ist der Anteil der Siemens Nederland N.V. unter 10% gefallen. Zum 30. September 2004 wurde der noch übrige Siemens-Anteil in Höhe von 18,2% von der nicht stimmberechtigten Treuhandgesellschaft gehalten.

28. Pensionsverpflichtungen

Die Gesellschaft hat einem bedeutenden Anteil ihrer Mitarbeiter Pensionszusagen gewährt. Die Pensionszusagen richten sich im Wesentlichen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ein Teil der Altersversorgungspläne bezieht sich auf das Einkommen im letzten oder in den letzten fünf Jahren der Betriebszugehörigkeit,

andere feste Versorgungspläne sind vom durchschnittlichen Einkommen und der Position abhängig. Der Bewertungsstichtag für die Pensionspläne der Gesellschaft ist der 30. Juni.

Die Daten zu den Pensionsplänen der Gesellschaft sind für die deutschen Versorgungspläne („Inland“) und die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 30. September 2002, 2003 und 2004 in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2002		2003		2004	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Kumulierte Anwartschaftsbarwerte (ABO) zum Ende des Geschäftsjahrs	-182	-23	-205	-52	-226	-56
Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO):						
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Beginn des Geschäftsjahrs	-197	-47	-218	-58	-243	-70
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-13	-5	-13	-5	-14	-7
Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-12	-3	-13	-4	-13	-4
Versicherungstechnische Gewinne/Verluste	-	2	3	-5	-	3
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-7	-	-7	-1	-1
Desinvestitionen	1	-	-	-	1	-
Neu geschaffener Plan	-1	-2	-	-	-	-2
Planänderung	-	-	-4	-	-3	-
Gezahlte Versorgungsleistungen	2	2	2	1	2	1
Kürzungen	2	-	-	3	-	-
Fremdwährungseffekte	-	2	-	5	-	2
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Ende des Geschäftsjahrs	-218	-58	-243	-70	-271	-78
Entwicklung des Marktwerts des Planvermögens:						
Marktwert zu Beginn des Geschäftsjahrs	133	24	120	26	143	27
Einlagen und Übertragungen	2	3	22	2	19	2
Tatsächliche Rendite auf das Planvermögen	-13	1	3	-	14	3
Gezahlte Versorgungsleistungen	-2	-2	-2	-1	-2	-1
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-	-	4	-	-
Neu geschaffener Plan	-	2	-	-	-	-
Fremdwährungseffekte	-	-2	-	-4	-	-1
Zeitwert am Ende des Geschäftsjahrs	120	26	143	27	174	30
Finanzierungsstatus des Planvermögens	-98	-32	-100	-43	-97	-48
Noch nicht in den Gewinn-und-Verlust-Rechnungen erfasster versicherungsmathematischer Verlust	68	3	66	6	59	2
Noch nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasste Versorgungsansprüche aus vorhergehenden Geschäftsjahren	-	-	4	-2	7	-2
Zuführungen nach der Gutachtenberechnung	10	-	16	-	1	1
Pensionsverpflichtungen, Saldo	-20	-29	-14	-39	-30	-47

Die in der Bilanz zum 30. September ausgewiesenen Verpflichtungen setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	2002		2003		2004	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen (siehe Anhang Nr. 17)	-	-	-	1	27	-
Immaterielle Vermögensgegenstände (siehe Anhang Nr. 14)	-	-	4	-	-	-
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	33	-	29	-	-	-
Pensionsverbindlichkeiten (siehe Anhang Nr. 22)	-53	-29	-47	-40	-51	-47
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-6	-
Pensionsverpflichtungen, Saldo	-20	-29	-14	-39	-30	-47

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 30. September 2004 beziehen sich in Höhe von €6 auf die Pensionsverbindlichkeiten aus dem Fiber-Optics-Geschäft, welches zum Verkauf steht (siehe Anlage Nr. 20).

Die Daten zu den Pensionsplänen mit Anwartschaftsbarwerten und kumulierten Anwartschaftsbarwerten im Vergleich werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2002		2003		2004	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Anwartschaftsbarwerte	218	58	243	70	271	78
Marktwert des Planvermögens	120	26	143	27	174	30
Kumulierte Anwartschaftsbarwerte	182	37	205	48	53	51
Marktwert des Planvermögens	120	22	143	22	-	23

Die bereits entstandenen Versorgungsansprüche, resultierend aus den Pensionsplänen, werden zu gleich hohen Beträgen auf die Jahre, in denen jeder momentan Beschäftigte voraussichtlich Bezüge aus dem Pensionsvermögen erhalten wird, abgeschrieben.

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in die Netto-Pensions-Kosten für diejenigen Jahre mit eingeschlossen, in denen zu Beginn des Geschäftsjahrs die nicht realisierten Gewinne oder Verluste den Anwartschaftsbarwert oder, falls größer, den Markt-

wert des Planvermögens um 10% übersteigen. Die Abschreibungsrate berechnet sich aus dem Überschuss dividiert durch die durchschnittlich verbleibende Versorgungsperiode, in der aktive Mitarbeiter voraussichtlich Bezüge aus dem Planvermögen erhalten werden.

Der Ermittlung der durchschnittlich gewichteten versicherungsmathematischen Werte der wesentlichen Versorgungspläne lagen folgende Annahmen zu Grunde:

	2002		2003		2004	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Abzinsungsfaktor in %	6,0	6,4	5,8	5,9	5,8	5,6
Personalkostenteuerungsrate in %	3,0	3,8	3,0	3,9	3,0	3,7
Erwartete Rendite auf das Planvermögen in %	5,4	8,0	4,9	6,8	6,8	7,0

Die Abzinsungsfaktoren werden auf der Basis erstklassiger Rentenpapiere gebildet, die, falls die Pensionsanwartschaften zum Stichtag glattgestellt würden, bis zum Fälligkeitszeitpunkt die benötigten zukünftigen Einzahlungen bereitstellen würden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass kurzfristige Schwankungen der Zinssätze keinen Einfluss auf ihre langfristigen Verpflichtungen haben werden.

Investitionsstrategie

Die Investitionsstrategie für den Pensionsplan der Gesellschaft beinhaltet ein gewisses Maß an Flexibilität, um sich ergebende Anlagechancen frühestmöglich ergreifen zu können. Gleichzeitig stellen angemessene Kennzahlen sicher, dass die Vorsichts- und Sorgfaltspflichten bei der Ausführung des Investitionsprogramms erfüllt werden. Das Vermögen des Pensionsfonds wird von mehreren Anlageberatern angelegt. Die Pläne sehen eine Kombination aus aktiven und passiven Investitionsprogrammen vor. Unter Berücksichtigung der Laufzeit der zu Grunde liegenden Verpflichtungen wird ein Portfolio der Investitionen des Planvermögens bestehend aus Anteils-, Gläubiger- und anderen Wertpapieren angestrebt, um die langfristige Gesamtkapitalrendite bei einem bestimmten Risiko zu maximieren. Das Investitionsrisiko wird durch laufende periodenweise Prüfungen des Portfolios, durch Meetings

mit Anlageberatern und durch jährliche Verbindlichkeitsberechnungen kontrolliert. Die Investitionsmethoden und -strategien werden periodisch überprüft, um sicherzustellen, dass die Ziele der Versorgungspläne, unter Berücksichtigung jeder Änderung im Aufbau des Versorgungsplans, der Marktbedingungen oder anderer wesentlicher Punkte, nicht verfehlt werden.

Erwartete langfristige Rendite des Planvermögens

Um die erwartete Gesamtkapitalrendite des Planvermögens festlegen zu können, bedarf es Annahmen. Die Methode der Gesellschaft, die Rendite des Planvermögens zu bestimmen, basiert auf dauerhaften historischen Finanzmarktbeziehungen, den verschiedenen Arten der Investitionsklassen, in denen das Pensionsvermögen angelegt wurde, langfristigen Investitionsstrategien sowie auch der kumulierten Rendite, welche die Gesellschaft mit ihrem Portfolio normalerweise in einem bestimmten Zeitraum erwarten kann.

Die Gesellschaft überprüft die erwartete langfristige Gesamtkapitalrendite jährlich und nimmt, wenn nötig, Anpassungen vor. Zusätzlich gibt die Gesellschaft detaillierte Vermögens-/Verbindlichkeits-Studien in Auftrag, die regelmäßig von unabhängigen Anlageberatern und Versicherungsfachleuten durchgeführt werden.

Verteilung des Planvermögens

Am 30. September 2003 bzw. 2004 betrug der Prozentsatz des investierten Planvermögens in den wesentlichen Vermögensposten:

	2002		2004		Zielverteilung	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Anteilspapiere in %	42	51	45	60	45	60
Gläubigerpapiere in %	50	40	46	38	52	40
Sonstiges in %	8	9	9	2	3	0
Gesamt in %	100	100	100	100	100	100

Die Verteilung des Planvermögens der Gesellschaft auf das Anlagevermögen des Pensionsplans basiert auf der Einschätzung der Geschäfts- und Finanzlage, demographischen und versicherungsmathematischen Daten, Finanzierungsmöglichkeiten, geschäftsbezogenen Risikofaktoren, Marktsensitivitätsanalysen und anderen relevanten Faktoren. Insgesamt soll die Verteilung der Sicherung des Planvermögens dienen und gleichzeitig für ausreichend stabile, also beispielsweise inflationsbereinigte Einkünfte sorgen, um

sowohl derzeitige wie auch zukünftige Pensionszusagen zu erfüllen. Auf Grund des aktiven Portfoliomanagements kann die tatsächliche Verteilung des Anlagevermögens, innerhalb bestimmter Grenzen der verschiedenen Risikoklassen, von der geplanten Verteilung abweichen. Gemäß den Richtlinien der Gesellschaft investieren die Pensionspläne der Gesellschaft nicht in eigene Aktien.

Die Pensionsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 beinhalten:

	2002		2003		2004	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-13	-5	-13	-5	-14	-7
Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-12	-3	-13	-4	-13	-4
Erwarteter Ertrag aus Planvermögen	5	1	6	2	11	2
Amortisation von noch nicht realisierten Verlusten	-2	-	-3	-	-3	-
Amortisation noch nicht realisierter Verpflichtungen, netto	-2	-	-	-	-	-
Realisierter Gewinn aus Kürzungen	2	-	-	3	-	-
Aufwendungen für Pensionen und Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 7)	-22	-7	-23	-4	-19	-9

Am 25. September 2000 gründete die Gesellschaft den Infineon Technologies Pension Trust e.V. („Pension Trust“) zum Zwecke der Finanzierung zukünftiger Pensionszahlungen für Mitarbeiter in Deutschland. Die Gesellschaft leistete eine Einlage in Höhe von €155 in Form von Zahlungsmitteln und Wertpapieren, die Gläubiger- bzw. Eigentümerrechte verbriefen. Die Einlage fällt als Planvermögen des Pension Trust zur Finanzierung dieser Pensionsverpflichtungen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87 und reduziert insoweit die Pensionsrückstellungen der Gesellschaft.

Die Auswirkungen der Mitarbeiterentlassungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 8) auf die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft werden auf Grund der Anwendung von SFAS Nr. 88, Bilanzierung für Abgeltung und Kürzungen von Pensionsverpflichtungen und Abfindungen, als Kürzung in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 dargestellt.

Die Gesellschaft schätzt, dass die aggregierten Zuschüsse zu den Pensionsplänen während des Geschäftsjahrs 2005 die Zuschüsse im Geschäftsjahr 2004, basierend auf dem momentanen Finanzstatus und Annahmen zum erwarteten Kapitalertrag, nicht wesentlich übersteigen werden.

Die zukünftigen Pensionszahlungen, die eine zukünftige Leistung darstellen, belaufen sich entsprechend der Auszahlungserwartung der Pensionspläne der Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren und danach auf:

Für die Geschäftsjahre zum 30. September	Inland	Ausland
2005	5	1
2006	6	1
2007	7	2
2008	8	2
2009	9	2
2010–2014	67	20

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 etablierte die Gesellschaft ein Programm zur betrieblichen Altersvorsorge für deutsche Mitarbeiter, wobei die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen Teil des Gehalts in eine Rentenzahlung inklusive aufgelaufener Zinsen zum Renteneintritt umzuwandeln. Die Verbindlichkeit für zukünftige Zahlungen in Höhe von €5 und €9 für die Geschäftsjahre 2003 und 2004 ist versicherungsmathematisch bestimmt und auf der

gleichen Basis wie andere Pensionspläne der Gesellschaft berechnet worden.

Die Gesellschaft gewährt bestimmten Mitarbeitern in den USA nach ihrem Ausscheiden Krankenversicherungsleistungen. Der Gesellschaft entstanden hierfür Kosten in Höhe von weniger als €1 für die Geschäftsjahre 2002, 2003, 2004. Die Nettoverbindlichkeit betrug in den Bilanzen der Geschäftsjahre 2003 €5 und 2004 €5.

Am 8. Dezember 2003 wurde in den Vereinigten Staaten das Gesetz zur Verbesserung und Modernisierung der Gesundheitsvorsorge und rezeptpflichtiger Arzneimittel („U.S. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act“) rechtskräftig. Dieses Gesetz sieht vor, dass Zuwendungen der US-amerikanischen öffentlichen Hand, die zur Förderung der Versorgungspläne zur Gesundheitsfürsorge von Rentnern beitragen, der Höhe nach, zumindest versicherungsmathematisch, gleichwertig der gesetzlich festgelegten Leistung sein müssen.

29. Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft schließt Geschäfte über Derivate einschließlich Zins-Swap-Vereinbarungen, Fremdwährungstermin- und -optionsgeschäften ab. Ziel dieser Transaktionen ist die Verringerung der Marktrisiken aus Veränderungen von Zinssätzen und Währungsrelationen für die in Fremdwährung lautenden Zahlungsströme. Derivative Finanzinstrumente werden bei der Gesellschaft nicht zu Handels- oder spekulativen Zwecken eingesetzt.

Die Nominal- und Marktwerte der von der Gesellschaft zum 30. September 2003 und 2004 gehaltenen Derivate sind im Folgenden dargestellt:

	2003		2004	
	Nominalwert	Marktwert	Nominalwert	Marktwert
Forward-Verträge				
Verkauf:				
US-Dollar	306	5	371	8
Japanischer Yen	8	–	4	–
Britisches Pfund	2	–	–	–
Forward-Verträge				
Kauf:				
US-Dollar	54	–1	56	–1
Japanischer Yen	29	1	55	–
Singapur-Dollar	20	–	29	–
Britisches Pfund	4	–	4	–
Sonstige Währungen	15	1	5	–
Währungsoptionen				
Verkauf:				
US-Dollar	175	–10	520	–16
Währungsoptionen				
Kauf:				
US-Dollar	186	7	514	9
Währungsübergreifender Zins-Swap:				
US-Dollar	547	113	406	60
Zins-Swap-Vereinbarungen	1.200	27	1.442	29
Marktwert, Saldo		143		89

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben)

Im Geschäftsjahr 2004 hat die Gesellschaft zwei Zins-Swap-Vereinbarungen mit einem Nominalwert von €500 als zahlungsmittelbezogene Sicherungsgeschäfte zur Marktwertsicherung des korrespondierenden Grundbetrags der 2007 fälligen Wandelanleihe bestimmt. Die Veränderung des Marktwerts des Sicherungsgeschäfts betrug €1 im Geschäftsjahr 2004 und ist in den Zinsaufwendungen enthalten.

Die Gesellschaft hat mit unabhängigen Finanzinstituten Zins-Swap-Vereinbarungen abgeschlossen. Diese Zins-Swaps dienen zur Absicherung des Cash-Flow gegenüber Veränderungen des Zinssatzes für die in den nächsten zehn Jahren zu erwartende Leasingzahlung für den Campeon-Leasingvertrag (siehe Anhang Nr. 31). Der ineffektive Teil des Cash-Flow-Sicherungsgeschäfts in Höhe von €0 ist im Geschäftsjahr 2004 als sonstiger Ertrag erfasst. Der effektive Teil in Höhe von €1 wird als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit den Aktionären resultieren, abgegrenzt und wird voraussichtlich anteilmäßig, mit Beginn des Leasings im Geschäftsjahr 2006 über die gesamte Leasingzeit, in sonstige Erträge/Aufwendungen als Teil der Leasingaufwendungen umgliedert.

Gewinne und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten sind in den Konzern-Gewinn- und -Verlust-Rechnungen enthalten. Gewinne oder Verluste, die dem operativen Geschäft zuordenbar sind, werden überwiegend in den Umsatzkosten und solche, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen entstanden, in den sonstigen Erträgen oder Aufwendungen gezeigt.

Die Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften stellten sich in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 wie folgt dar:

	2002	2003	2004
Gewinn/Verlust aus Fremdwährungen:			
Umsatzkosten	7	8	44
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen	–20	106	3
	–13	114	47
Gewinn/Verlust aus Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften:			
Umsatzkosten	–21	–40	–50
Sonstige Erträge/Aufwendungen	18	–106	–12
	–3	–146	–62
Netto-Gewinn/Verlust aus Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften	–16	–32	–15

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder als Discounted-Cash-Flow ermittelt. Der Marktwert der unbesicherten Darlehen und der verzinslichen Bankverbindlichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die Verzinsung den derzeit marktüblichen Zinsen

entspricht. Zum 30. September 2004 wurden die Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2007 bzw. 2010 an der Börse in Luxemburg mit Aufschlägen von 0,4% bzw. 14,4% gegenüber ihrem Nominalwert gehandelt. Die Marktwerte der Zahlungsmittel, Forderungen gegen Dritte, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie der übrigen derivativen Finanzinstrumente entsprechen auf Grund ihrer kurzfristigen Fälligkeiten annähernd deren Buchwerten. Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Marktwerten bilanziert (siehe Anhang Nr. 11).

30. Risiken

Die Finanzrisiken der Gesellschaft resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Zahlungsmitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Fremdwährungs-Derivaten. Das Kreditrisiko bei Forderungen ist auf Grund der großen Anzahl sowie wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. Die Gesellschaft steuert Kreditrisiken durch Kreditgenehmigungen, Kreditlimits und Überwachungsprozesse sowie umfassende Kreditprüfungen aller Kunden. Ein beträchtlicher Teil der Forderungen und Umsätze aus Lieferungen und Leistungen wird mit verbundenen Unternehmen realisiert. Das Kreditrisiko in Bezug auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Fremdwährungs-Derivate durch Transaktionen mit einer begrenzten Anzahl von Banken ist auf vorgegebene Obergrenzen beschränkt. Die Gesellschaft glaubt, dass das Risiko einer Nichterfüllung eines Geschäftspartners gering ist, da die Gesellschaft deren Kreditrisiko prüft und die Höhe der Außenstände und die Anzahl der Vereinbarungen mit allen Finanzinstituten limitiert.

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit hat die Gesellschaft anhaltend hohe Aufwendungen für Prozesstechnologien sowie für Forschung und Entwicklung. Falls die Ergebnisse aus diesen Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich verschlechtern, könnten Teile der erwarteten Rückflüsse aus diesen Investitionen ausbleiben.

Bedingt durch den High-Tech-Charakter des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft ist geistiges Eigentum von großer Bedeutung. Die Gesellschaft besitzt geistiges Eigentum, welches selbst entwickelt, zugekauft oder von Dritten lizenziert wurde. Die Gesellschaft ist der Verletzung ihrer Rechte durch Dritte an diesem geistigen Eigentum ausgesetzt. Umgekehrt können Dritte behaupten, dass die Gesellschaft deren Rechte an geistigem Eigentum verletzt hat.

Auf Grund der Nutzung von Fremdfertigern und Joint-Venture-Abkommen hat die Gesellschaft eine bedeutende Anzahl an Produktionskapazitäten, welche außerhalb ihrer direkten Kontrolle liegen. Die Gesellschaft ist von diesen anderen Gesellschaften in Bezug auf die rechtzeitige oder unterbrochene Belieferung mit Produkten abhängig sowie möglichen Schwankungen der Einkaufspreise zu einem gewissen Maße ausgesetzt.

Die Gesellschaft hat Regeln und Vorgehensweisen für ihre Mitarbeiter eingeführt, welche bei Nichteinhaltung, die Gesell-

schaft Risiken aufgrund falscher Handlungen ihrer Mitarbeiter aussetzt.

Etwa 10.000 unserer Mitarbeiter sind an Tarifvereinbarungen gebunden. Für 3.290 dieser Mitarbeiter laufen die Tarifvereinbarungen während des Geschäftsjahrs 2005 aus. Die Bedingungen der bestehenden Vereinbarungen bleiben darüber hinaus bestehen, bis eine Nachfolgevereinbarung abgeschlossen ist. Vereinbarungen für den Zeitraum nach Ablauf der Vertragsdauer müssen mit den entsprechenden Gewerkschaften in gemeinsamen Tarifverhandlungen geschlossen werden.

31. Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Rechtsangelegenheiten

Im August 2000 hat Rambus Inc., USA, („Rambus“) Klagen gegen die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und in Deutschland erhoben. Rambus behauptet, die Gesellschaft habe Rambus' Patente in Bezug auf SDRAM- und DDR DRAM-Produkte verletzt.

Im Mai 2001 hat ein Bezirksgericht in Virginia, USA, alle 57 Patentverletzungsansprüche von Rambus gegen die Gesellschaft abgewiesen. Zusätzlich befand das Gericht Rambus der arglistigen Täuschung durch ihr Verhalten gegenüber der JEDEC-Standardisierungs-Organisation für schuldig und erkannte der Gesellschaft dafür Schadenersatz zu. Im Januar 2003 verwarf das US-Berufungsgericht des betreffenden Bundesbezirks die Entscheidung des Bezirksgerichts bezüglich vier Ansprüchen und verwies die Klage an das Bezirksgericht für ein Geschworenengericht zurück. Das Berufungsgericht hat auch die Bezirksgerichtsentscheidung bezüglich der arglistigen Täuschung seitens Rambus im Verhalten gegenüber JEDEC aufgehoben. Die Gesellschaft hat gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts beim obersten US-Gericht erfolglos Einspruch eingelegt. Am 8. Januar 2004 hat das Bezirksgericht entschieden, dass die Patentverletzungsklage von Rambus auf vier Ansprüche begrenzt bleibt und hat Rambus nicht gestattet, eine Reihe von weiteren, ähnlichen Ansprüchen geltend zu machen. Zwischen 18. Februar und 26. August 2004 haben die Parteien eine Reihe von Anträgen und Eingaben beim Bezirksgericht eingereicht. Das Bezirksgericht hat den Beginn der Verhandlung für den 10. Februar 2005 festgesetzt. Die Gesellschaft glaubt, eine gute Verteidigungsposition gegen die Verletzungsvorwürfe und berechnete Gegenansprüche gegen Rambus zu haben, die die Durchsetzung der Patente verhindern würden.

Das deutsche Gerichtsverfahren begann im Dezember 2000 und ist noch anhängig. Ein gerichtlich bestellter Gutachter legte ein Gutachten vor, das Gericht kam jedoch noch zu keiner Entscheidung auf Basis dieses Gutachtens. Das Europäische Patentamt hat im September 2002 entschieden, dass das Rambus-Patent unzulässig erweitert wurde. Rambus hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Im Februar 2004 hat das Europäische Patentamt das Rambus-Patent widerrufen. Im Juni 2004 hat Rambus

seine ursprüngliche Klage zurückgenommen, aber zwei neue Patente in den Rechtsstreit eingeführt. Die Patente werden jedoch in einem abgetrennten Verfahren behandelt. Die Gesellschaft glaubt, eine gute Verteidigungsposition gegen die neue Klage zu haben.

SDRAM- und DDR DRAM-Produkte, die die Technologie, die derzeit im Rambus-Verfahren behandelt wird, nutzen, stellen nahezu alle Produkte des Geschäftsbereichs Speicherprodukte dar. Dieses Segment erzielte im Geschäftsjahr 2004 Umsatzerlöse in Höhe von €2.926 und ein Ebit in Höhe von €169. Ein Fertigungsverbot von SDRAM- und DDR DRAM-Produkten würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erheblich negativ beeinflussen, da die Produktlinien SDRAM und DDR DRAM aufgegeben werden oder Lizenzabkommen mit Rambus geschlossen werden müssten, die erhebliche Lizenzzahlungen auslösen würden.

Die Gesellschaft lizenziert RDRAM-Technologie von Rambus, die nicht Gegenstand des zuvor beschriebenen Rechtsstreits ist.

Des Weiteren hat Rambus am 5. Mai 2004 bei einem Gericht des Staates Kalifornien eine Klage gegen die Gesellschaft, ihre US-Tochtergesellschaft sowie Siemens, Micron Technology, Inc. („Micron“) und Hynix Semiconductor, Inc. („Hynix“) erhoben. In der Klage behauptet Rambus, dass die beklagten DRAM-Hersteller kartellrechtswidrige Absprachen über die Beschränkung der Produktionsmengen und über die Preise von Rambus DRAM („RDRAM“) getroffen hätten, mit dem Ziel, eine weitreichende Adaption von RDRAM als „Hauptspeicher“ für PCs zu verhindern und den weltweiten DRAM-Markt zu monopolisieren. Rambus macht entgangene Lizenzzahlungen von mindestens einer Milliarde Dollar geltend und verlangt dreifachen Schadenersatz sowie Strafschadenersatz („punitive damages“). Basierend auf der Klage vor dem kalifornischen Gericht, hat Rambus am 18. Juni 2004 auch eine Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die Gesellschaft, sowie Siemens, Micron und Hynix eingereicht. Die Gesellschaft hat die EU Kommission in ihrer Erwiderung zur Rambus-Beschwerde vom 28. September 2004 gebeten, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich energisch gegen die von Rambus geltend gemachten Ansprüche zu verteidigen.

Am 15. September 2004 hat die Gesellschaft mit der Kartellabteilung des US-Bundesjustizministeriums („DOJ“) in Verbindung mit der andauernden Untersuchung des DOJ's von möglichen Verletzungen US-amerikanischen Kartellgesetzen in der DRAM-Industrie ein so genanntes Plea Agreement abgeschlossen. In diesem Vertrag hat die Gesellschaft sich bereit erklärt, sich in einem einzigen und begrenzten Anklagepunkt schuldig zu bekennen, der die Preisbildung für DRAM-Produkte zwischen dem 1. Juli 1999 und dem 15. Juni 2002 betrifft. Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat sich die Gesellschaft verpflichtet, eine Strafzahlung in Höhe von \$160 Mio. zu leisten. Die Zahlung inklusive angefallener Zinsen erfolgt in gleichen jährlichen Raten bis 2009. Am 25. Oktober 2004 hat das US-Bundesgericht für Nordkalifornien das Plea Agreement zwischen der Gesellschaft und dem DOJ bestätigt. Damit ist die Angelegenheit zwischen der Gesellschaft und dem DOJ im Hinblick auf die andauernde industrieweite Untersuchung des DOJ geklärt. Allerdings ist die Gesellschaft weiterhin verpflichtet, mit dem DOJ bei dessen Untersuchung gegen andere DRAM-

Hersteller zu kooperieren. Das vom DOJ vorgeworfene Fehlverhalten war auf sechs OEM-Kunden, die Computer und Server herstellen, begrenzt. Die Gesellschaft hat mit allen, bis auf einen dieser Kunden Vergleichsverträge abgeschlossen und befindet sich mit letzterem in Vergleichsverhandlungen.

Seit dem Beginn des DOJ-Verfahrens sind mehrere Sammelklagen gegen die Gesellschaft, ihre US-Tochtergesellschaft und weitere DRAM-Hersteller eingereicht worden. 16 Klagen wurden zwischen 21. Juni 2002 und 19. September 2002 bei Bundesgerichten eingereicht, davon eine in dem südlichen Distrikt von New York, fünf im Distrikt von Idaho und zehn im Distrikt Nördliches Kalifornien. Jede dieser Klagen ist in der Form der Sammelklage für Einzelpersonen und juristische Personen erhoben worden, die DRAM-Produkte direkt von DRAM-Anbietern in einem festgelegten Zeitraum beginnend mit oder nach dem 1. Oktober 2001 erworben haben. Die Kläger behaupten die Verletzung des „Sherman Act“ durch Preisabsprachen und machen Schadenersatz in unspezifizierter Höhe, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten geltend. Im September 2002 entschied das „Judicial Panel on Multi-District Litigation“ (Gerichtssenat für Zuständigkeitsentscheidungen bei Betroffenheit mehrerer Bezirke), diese Verfahren an das US-Bundesgericht für Nordkalifornien zu verweisen, um sie dort koordiniert und gemeinsam als Teil einer Multi-District Litigation („MDL“) weiter zu behandeln.

19 weitere Klagen wurden zwischen 2. August 2002 und 15. Oktober 2004 bei den folgenden US-Einzelstaatsgerichten eingereicht: Kalifornien (fünf in San Francisco County, eine in Santa Clara County, eine in Los Angeles County, eine in Humboldt County), Massachusetts (eine in Essex County und eine in Middlesex County), Florida (eine in Seventeenth and eine in Collier County), West Virginia (Brooke County), Kansas (Johnson County), Michigan (Wayne County), North Carolina (Mecklenburg County), South Dakota (Pennington County), Arkansas (Hot Spring County) and Tennessee (Davidson County). Jede dieser Klagen ist in der Form der Sammelklage im Namen von Einzelpersonen oder juristischen Personen erhoben worden, die indirekt DRAM-Produkte in einem bestimmten Zeitraum beginnend oder nach 1999 erworben haben. Die Kläger behaupten Verletzungen des kalifornischen „Cartwright Act“ und der Wettbewerbsrechte der jeweilig betroffenen US-Staaten sowie angeblich ungerechtfertigte Bereicherung und beantragen Schadenersatz in unspezifizierter Höhe, Wiedergutmachung, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten. Auf Antrag eines der Kläger entschied ein vom „Judicial Council of California“ benannter Richter, dass die zu jenem Zeitpunkt anhängigen kalifornischen Fälle an den „San Francisco County Superior Court“ übertragen werden sollten, um dort koordiniert und gemeinsam behandelt zu werden. Der Massachusetts Essex County und der Florida Collier County Fall wurden aufgrund gerichtlicher Verfügung an das US-Bundesgericht für Nordkalifornien übertragen, um sie dort als der Teil der oben beschriebenen MDL im Rahmen eines koordinierten und gemeinsamen Vorverfahrens („Pretrial Proceedings“) weiter zu behandeln.

Im April 2003 hat die Gesellschaft ein Auskunftsverlangen der Europäischen Kommission („Kommission“) erhalten, das einer Prüfung dienen soll, ob die EU-Wettbewerbsregeln im Rahmen bestimmter, der Kommission zur Kenntnis gelangter Praktiken am europäischen Markt für DRAM-Produkte verletzt wurden. Die Gesellschaft hat die Angelegenheit nach Abschluss des „Plea Agreements“ mit dem DoJ erneut bewertet und hat eine Rückstellung für die Folgen dieses Verfahrens gebildet, um eine mögliche Mindeststrafe abzudecken, die verhängt werden könnte. Sollte die EU-Kommission tatsächlich eine Strafe verhängen, könnte diese auch erheblich höher als die Rückstellung sein; allerdings kann die Gesellschaft derzeit die Höhe einer solchen Strafe nicht genauer abschätzen. Im Rahmen dieser Untersuchung kooperiert die Gesellschaft umfassend mit der Kommission.

Im Mai 2004 hat die kanadische Wettbewerbsbehörde („Competition Bureau“) die US-Tochtergesellschaft von Infineon davon in Kenntnis gesetzt, dass sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen Ziel einer formellen Untersuchung über mutmaßliche Verletzungen des kanadischen Wettbewerbsgesetzes in der DRAM-Industrie sind. Ein Zwangsverfahren (z. B. im Rahmen von hoheitlichen Anordnungen) wurde nicht eingeleitet. Die Untersuchungen des Competition Bureau's befindet sich in einem relativ frühen Stadium. Die Gesellschaft unterstützt die Untersuchungen des Competition Bureau's kooperativ.

Am 1. Oktober 2004 hat die Gesellschaft aus Presseberichten erfahren, dass eine Anwaltskanzlei aus San Francisco behauptet, eine Sammelklage beim US-District Court für Nordkalifornien eingereicht zu haben. Die Klage behauptet Verletzungen von US-Kapitalmarktregeln und Anlegerschutzvorschriften und begehrt Schadensersatz im Namen einer angeblichen Gruppe von Käufern von an Kapitalmärkten gehandelten Aktien und American Depositary Shares der Gesellschaft für die Zeit von 13. März 2000 bis 19. Juli 2004. Nach anderen Presseberichten sollen weitere Sammelklagen bei US-Gerichten eingereicht sein, die mit ähnlichen angeblichen Verletzungen von US-Kapitalmarktregeln und Anlegerschutzvorschriften für ähnliche Zeiträume begründet sein sollen. Einige Sammelklagen erweitern diesen Zeitraum vermutlich bis zum 15. September 2004. Die Gesellschaft wird sich energisch gegen Anschuldigungen verteidigen, US-Kapitalmarktregeln und Anlegerschutzvorschriften verletzt zu haben.

Rückstellungen für Rechtsverfahren werden dann gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung entstanden ist, und der entsprechende Betrag annähernd abgeschätzt werden kann. Wo der abgeschätzte Betrag der Verbindlichkeiten innerhalb einer Bandbreite liegt und kein Betrag innerhalb der Bandbreite besser ist als ein anderer abgeschätzter Betrag oder die Bandbreite nicht abgeschätzt werden kann, wird der Mindestbetrag zurückgestellt. Die Gesellschaft hatte deshalb in den Jahren endend am 30. September 2003 und 2004 Aufwendungen in Höhe von jeweils €28 und €209 für die Kartellverfahren und die damit verbundenen zivilen Rechtsansprüche und -klagen bilanziert. Sowie weitere Informationen verfügbar werden, wird eine mögliche Verpflichtung erneut überprüft und, wenn notwendig, werden die Abschätzungen entsprechend angepasst. Bei zukünftigen neuen Entwicklungen in

jeder Angelegenheit oder veränderten Umständen wird die Rückstellung angepasst, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Ein negativer Ausgang der Rambus-Klagen, der Kartellverfahren oder der damit verbundenen oben beschriebenen Zivilklagen könnte erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Gesellschaft begründen und andere negative Auswirkungen haben, was wiederum einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann. Unabhängig von der Richtigkeit der Vorwürfe und dem Erfolg der genannten Klagen, können der Gesellschaft erhebliche Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen die Vorwürfe oder mit deren gütlichen Erledigung entstehen, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Einer der Kunden der Gesellschaft hat uns am 18. Mai 2000 mitgeteilt, dass er einen Brief von Rambus erhalten habe, in dem behauptet wurde, dass eine Komponente eines seiner Produkte Rambus' Patente verletze. Die Gesellschaft hat diesem Kunden die betreffende Komponente geliefert, und dieser Kunde hat von der Gesellschaft verlangt, dass sie ihn von allen Forderungen von Rambus freistelle. Die Benachrichtigung enthielt keinen Betrag für diese Forderung. Daher kann die Gesellschaft derzeit nicht vorhersehen, wie hoch das Risiko, wenn es überhaupt eines gibt, aus diesem Anspruch ist, wenn er begründet sein sollte.

Am 7. Mai 2003 erhob ProMOS gegen die Gesellschaft eine Schiedsklage in München nach den ICC-Schiedsregeln. Die Gesellschaft hatte ProMOS bestimmte DRAM-Technologien lizenziert, diesen Vertrag aber wegen erheblichen Vertragsbruchs durch ProMOS gekündigt. ProMOS beantragt ein Feststellungsurteil, dass ProMOS den Lizenzvertrag wegen eines Vertragsbruchs durch die Gesellschaft hätte kündigen können, aber weiter berechtigt sei, die lizenzierten Technologien zu nutzen. ProMOS klagt außerdem auf Zahlung von zirka \$36 Mio. für DRAM-Produkte, die der Gesellschaft verkauft wurden. Ursprünglich hatte ProMOS \$31 Mio. geltend gemacht. Am 19. Dezember 2003 erweiterte ProMOS diesen Anspruch auf \$36 Mio. und erhob einen neuen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von zirka \$354 Mio. wegen des behaupteten Bruchs des Lizenzvertrags durch die Gesellschaft. Am 18. Juni 2004 korrigierte ProMOS diesen Schadensersatzanspruch auf zirka \$175 Mio. nach unten, erhöhte ihn aber am 17. September 2004 wieder auf zirka \$338 Mio. Die Gesellschaft bestreitet den behaupteten Vertragsbruch und hat vollständige Klageabweisung beantragt. Mit einer Widerklage beantragt die Gesellschaft Feststellung, dass sie zur Kündigung des Lizenzvertrags wegen eines erheblichen Vertragsbruchs durch ProMOS berechtigt war, dass ProMOS verpflichtet werde, die Nutzung der DRAM-Technologien der Gesellschaft zu unterlassen, und der Gesellschaft Schadenersatz für die missbräuchliche Nutzung ihrer DRAM-Technologien zustehe. Zwischen dem 31. März 2004 und dem 17. September 2004 hat die Gesellschaft ihren Schadensersatzanspruch näher begründet und angepaßt. Mit ihrer letzten Eingabe macht die Gesellschaft Schadensersatz von bis zu \$568 Mio. geltend (nach Verrechnung mit zirka \$36 Mio. für DRAM-Produkte, die der Gesellschaft

von ProMOS geliefert wurden). Der exakte Schadenersatz, wenn zugesprochen, ist vom Schiedsgericht festzusetzen. Die Gesellschaft geht nicht davon aus, dass dieses Verfahren erhebliche negative Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wird (siehe Anhang Nr. 33).

Gegen Jahresende 2002 behauptete MOSAID Technologies Inc., USA („MOSAID“), dass die Gesellschaft elf DRAM-bezogene US-Patente von MOSAID verletze. Im Dezember 2002 reichte die Gesellschaft beim US-Bezirksgericht für Nordkalifornien eine Klage ein mit dem Antrag festzustellen, dass die Gesellschaft diese US-Patente nicht verletze. Am 7. Februar 2003 erhob MOSAID Widerklage mit dem Antrag, neben der Klageabweisung auch auf Schadenersatz für Patentverletzung zu erkennen. Am 3. November 2003 gab MOSAID bekannt, dass sie eine erweiterte Widerklage eingereicht und damit zwei neue Patente der früheren Klage hinzugefügt hat. Das Verfahren wurde nach den Regelungen für „federal multidistrict litigation“ mit einem Verfahren von MOSAID gegen Samsung vor dem US-Bezirksgericht für New Jersey zusammengelegt. Ende Januar 2004 fand ein „Markman Hearing“ statt und die Entscheidung über die Claim Construction erging am 23. März 2004. Der Beginn der Gerichtsverhandlung vor dem US-Bezirksgericht für Nordkalifornien wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2005 sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich energisch gegen die von MOSAID geltend gemachten Ansprüche zu verteidigen. Eine endgültige Entscheidung könnte zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen und weitere negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere einen erheblichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Gegen die Gesellschaft laufen verschiedene andere Rechtsstreite und Verfahren im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit. Diese betreffen Produkte, Leistungen, Patente und andere

Sachverhalte. Die Gesellschaft hat Rückstellungen für erwartete Gerichtskosten verschiedener anhängiger und potenzieller Verfahren zum Bilanzstichtag gebildet. Das Management der Gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass aus dem Ausgang der übrigen anhängigen Verfahren kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögenslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Zukunft liegenden Verfahrensabschlüsse die Finanz- und Ertragslage wesentlich negativ beeinflussen können.

Im Rahmen der Gründung der Gesellschaft verblieben bei Siemens bestimmte Betriebsstätten in den USA sowie die damit zusammenhängenden Umweltaltlasten. Die von Siemens bei der Gründung der Gesellschaft eingebrachten Geschäfte haben in der Vergangenheit einige dieser Betriebsstätten genutzt. Auf Grund der US-amerikanischen Rechtsprechung könnte die Gesellschaft für die Beseitigung von Umweltaltlasten in Anspruch genommen werden, obwohl diese Betriebsstätten bei Siemens verblieben sind. Siemens hat gegenüber bestimmten Dritten sowie Behörden Garantien abgegeben. Alle beteiligten Parteien sehen die Verantwortung für die betreffenden Standorte bei Siemens. Bislang wurden keine Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht. Die Höhe eventueller Ansprüche aus der Beseitigung von Altlasten, sofern solche bestehen, wurde nicht ermittelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihr Risiko zur Entsorgung der Altlasten der bei Siemens verbliebenen Betriebsstätten in den USA gering ist.

Vertragliche Verpflichtungen

Die Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2004 sind wie folgt^{1, 2}:

Zahlungen fällig in	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	5 Jahren und länger
Vertragliche Verpflichtungen:							
Zahlungen aus Leasingverträgen	918	83	101	77	74	55	528
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.711	1.356	187	69	37	17	45
Andere langfristige Verpflichtungen	321	125	50	45	101	–	–
Summe vertraglicher Verpflichtungen	2.950	1.564	338	191	212	72	573

1 Oben stehende Tabelle enthält gewisse Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen, und solche, deren wahrscheinliche Fälligkeiten im jeweiligen Fall vom Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.
 2 Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2004 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen €683 im Geschäftsjahr 2004.

In vorheriger Tabelle ist enthalten:

- ∴ Zahlungen aus Leasingverträgen beinhalten geplante Leasingzahlungen unter der Annahme, dass der Leasinggeber seine vertragliche Verpflichtung erfüllt und die Baumaßnahmen vollendet werden und der Umzug vollzogen wird.
- ∴ Unbedingte Abnahmeverpflichtungen beinhalten Bestellungen für Produktionsanlagen für die Fertigungsstätten der Gesellschaft, inklusive der Erweiterungen in Richmond/Virginia, USA, und Suzhou, China, die hauptsächlich im Geschäftsjahr 2005 fällig werden.

Im Dezember 2002 haben die Gesellschaft und Semiconductor Manufacturing Industrial Corporation („SMIC“) eine Technologieübertragungs- und Kapazitätsreservierungsvereinbarung getroffen. Im Austausch für die Technologieübertragung wird SMIC für einen Zeitraum von fünf Jahren spezifische Produktionskapazitäten bereitstellen. Die Preise basieren auf einer Marktpreisformel. In 2004 ergänzten die Parteien die Vereinbarung um eine neue Technologiegeneration einzubringen.

Am 28. Juli 2003 vereinbarten die Gesellschaft und China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Company („CSVC“) die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau einer Back-End-Fertigungsstätte in China. Das vom CSVC investierte Kapital wird verzinst und hat im Falle einer Gesellschaftsauflösung einen bestimmten Rangvortritt. Alle aufgelaufenen Ergebnisse und Dividenden stehen der Gesellschaft zu. Diese Gesellschaft wird deshalb von Beginn an voll konsolidiert.

Die Gesellschaft ist mit verschiedenen verbundenen Unternehmen und externen Auftragsfertigern Vereinbarungen eingegangen, die der Gesellschaft Kapazitäten zur Produktion und zum Testen von Halbleiterprodukten garantieren. Diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Gesellschaft hat darin vereinbart, einen Teil von deren Produktion auf Marktpreisen basierend zu kaufen.

Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entsprechend dem üblichen Geschäftsverlauf als Aufwendungen erfasst. Um der Nachfrage seitens ihrer Kunden nach ihren Produkten entsprechen zu können, überprüft die Gesellschaft regelmäßig den voraussichtlichen Einkaufsbedarf. Die Einkaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtlichen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die Marktpreise unter die Vertragspreise fallen.

Eventualverpflichtungen

Die folgende Tabelle zeigt die Eventualverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2004, ohne mögliche Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten¹:

Ende der Verpflichtungsdauer in	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	5 Jahren und länger
Maximale potenzielle künftige Zahlungen:							
Garantien	419	10	–	304	–	–	105
Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand ²	433	58	52	161	126	33	3
Summe Eventualverpflichtungen	852	68	52	465	126	33	108

¹ Oben stehende Tabelle enthält gewisse Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen. Die wahrscheinliche Fälligkeit wurde von der Gesellschaft abgeschätzt. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

² Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und gegebenenfalls zurückerstattet werden müssen, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

Am 23. Dezember 2003 hat die Gesellschaft einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG („MoTo“) abgeschlossen. Dieser beinhaltet eine Leasingvereinbarung über einen Bürokomplex im Süden Münchens, welcher von MoTo errichtet wird. Dieser Bürokomplex ermöglicht der Gesellschaft, die momentan in München über mehrere Standorte verteilten Mitarbeiter in eine zentrale Arbeitsumgebung zusammenzuführen. MoTo ist für den Bau, der in der zweiten Jahreshälfte 2005 fertig gestellt sein soll, verantwortlich. Wir haben keine Finanzierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen. Nach der Fertigstellung wird der Bürokomplex für 20 Jahre von der Gesellschaft gemietet. Nach 15 Jahren hat die Gesellschaft das Recht, den Bürokomplex (non-bargain purchase option) zu kaufen oder für die restlichen fünf Jahre weiterhin zu mieten. Gemäß der Leasingvereinbarung leistete die Gesellschaft eine Mietkaution in Höhe von €75 auf ein Treuhandkonto, welche zum 30. September 2004 unter als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel enthalten ist und vom Leasinggeber nicht vor Einzug verwendet werden kann. Die Leasingzahlungen unterliegen limitierten Anpassungen basierend auf festgelegten Finanzkennzahlen der Gesellschaft. Die Leasingvereinbarung wird als operatives Leasing gemäß SFAS Nr. 13, Rechnungslegung für Leasing, mit einer linearen monatlichen Leasingrate über den Leasingzeitraum ausgewiesen. Die Vereinbarung enthält aufschiebende Bedingungen.

Die Gesellschaft hat Zuwendungen der öffentlichen Hand für den Bau und die Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten erhalten. Diese Beträge werden bei Erreichen definierter Kriterien erfolgswirksam vereinnahmt. Die Gesellschaft hat bestimmte Zuwendungen erhalten unter der Voraussetzung, dass bestimmte projektbezogene Kriterien innerhalb einer bestimmten Periode nach Erhalt der Zuwendung erfüllt werden. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollten jedoch diese Bedingungen nicht erfüllt werden, können zum Stichtag 30. September 2004 höchstens €433 der Zuwendungen zurückgefordert werden.

Im Zusammenhang mit ihrer regelmäßigen Geschäftstätigkeit kann die Gesellschaft bei bestimmten Umsätzen und anderen Verträgen verpflichtet sein, ihre Vertragspartner unter bestimmten Konditionen vom Schadenersatz bei Gewährleistungsfällen, Patentverletzungen und anderen Vorfällen freizustellen. Der Höchstbetrag von eventuellen zukünftigen Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden, da die eventuelle Verpflichtung von Vorkommission, deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bestimmbar ist, und von bestimmten vertragspezifischen Fakten und Umständen abhängig ist. Historisch gesehen, hatten Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen keinen materiellen Effekt auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung der Gewährleistungsrückstellungen im Geschäftsjahr 2004:

	2004
Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 1. Oktober 2003	139
Zurückgestellt während des Jahres, netto	24
Beigelegt während des Jahres	-95
Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 30. September 2004	68

Aufgrund der Beurteilung von Gewährleistungen zum 30. September 2004, hat die Gesellschaft eine Rückstellung und die zugehörige Versicherungsforderung aufgelöst.

Die Gesellschaft hat zum 30. September 2004 Dritten gegenüber Garantien in Höhe von €419 ausstehend. Weiterhin hat die Gesellschaft als Mutterunternehmen wie allgemein üblich in bestimmten Fällen Garantien für bestimmte Verpflichtungen ihrer konsolidierten Tochterunternehmen gegenüber Dritten übernommen. Diese Verpflichtungen sind in den konsolidierten Finanzdaten durch die Konsolidierung bereits enthalten. Zum 30. September 2004 betragen solche Intercompany-Garantien von konsolidierten Tochterunternehmen gegenüber Dritten in Verbindung mit Finanzverbindlichkeiten €1.911, wovon €1.340 die Wandelschuldverschreibungen betreffen.

32. Segmentberichterstattung

Die Gesellschaft berichtet über ihre Geschäftsbereiche und nach Regionen gemäß den Regelungen des SFAS Nr. 131, Angaben zu den Segmenten eines Unternehmens und damit in Zusammenhang stehende Informationen.

Die Gesellschaft ist schwerpunktmäßig in vier Geschäftsbereichen tätig. Drei von ihnen sind anwendungsorientiert: Drahtgebundene Kommunikation, Sichere Mobile Lösungen und Automobil- und Industrieelektronik. Der Geschäftsbereich Speicherprodukte ist produktorientiert. Ferner entsprechen einige der verbleibenden Aktivitäten aus verkauften Geschäften, für die keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen nach dem Verkaufstermin bestehen, und neue Geschäftsaktivitäten der Definition gemäß SFAS Nr. 131 für ein Segment, erreichen aber nicht die Berichterstattungskriterien gemäß SFAS Nr. 131. Deshalb wurden für Berichterstattungs-zwecke diese Bereiche unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ zusammengefasst.

Im Geschäftsjahr 2004 gliederte die Gesellschaft bestimmte Aktivitäten ihres Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen zum Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik um. Dementsprechend wurden die Vorjahreszahlen dieser Umgliederung angepasst, um die Analyse gegenwärtiger und zukünftiger Finanzdaten zu unterstützen.

Jedes dieser Segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, der direkt dem Chief Operating Officer und dem Finanzvorstand

berichtet. Diese als Chief Operating Decision Makers („CODM“) Bezeichneten tragen gemeinsam die Entscheidungsverantwortung für das laufende Geschäft. Sie entscheiden gemeinsam über die Ressourcenzuteilung auf die Geschäftsbereiche und beurteilen deren Erfolg anhand der Kennzahlen Umsatzerlöse und Ebit. Die Aktiva der Gesellschaft werden den Geschäftsbereichen nicht in einer regelmäßigen Berichterstattung zugerechnet, mit Ausnahme von bestimmten Vorratsinformationen, die den CODM regelmäßig auf Segmentbasis berichtet werden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für die Geschäftsbereiche entsprechen grundsätzlich den bereits erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 2). Das Anlagevermögen wird für Management-Berichterstattungs-zwecke nicht regelmäßig in den einzelnen Geschäftsbereichen zugeordnet und demzufolge nicht zugerechnet. Die Gesellschaft ordnet den einzelnen Geschäftsbereichen die Abschreibungen nach Maßgabe des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf Basis von Standardkosten zu.

Informationen zu den Geschäftsbereichen:

::: Drahtgebundene Kommunikation

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Glasfaserbauteile für Kommunikationsanwendungen, WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und Carrier-Access (Breitband und traditionelle Zugänge) des drahtgebundenen Kommunikationsmarkts. Die Gesellschaft hat eine Vereinbarung zum Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts aus diesem Segment an die Finisar Corporation abgeschlossen.

::: Sichere Mobile Lösungen

Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt ein breites Spektrum von Bausteinen für drahtlose Anwendungen, Sicherheitskontrollbausteine, Sicherheitsspeicherbausteine und andere Halbleiterprodukte sowie komplette Systemlösungen für drahtlose und Sicherheitsanwendungen.

::: Automobil- und Industrieelektronik

Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.

::: Speicherprodukte

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Konfigurationen und Gehäusen bzw. Architekturen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in Standard-, speziellen und eingebetteten Speicheranwendungen.

::: Sonstige Geschäftsbereiche

Bestimmte verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften und andere sonstige Geschäftsaktivitäten sind in „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten.

Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Segmentdaten für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004:

	2002	2003	2004
Umsatzerlöse:			
Drahtgebundene Kommunikation	386	459	434
Sichere Mobile Lösungen	1.015	1.403	1.790
Automobil- und Industrieelektronik	1.464	1.634	1.820
Speicherprodukte	1.861	2.485	2.926
Sonstige Geschäftsbereiche	117	139	196
Konzernfunktionen	47	32	29
Summe Umsatzerlöse	4.890	6.152	7.195

	2002	2003	2004
Ebit:			
Drahtgebundene Kommunikation	-245	-188	-179
Sichere Mobile Lösungen	-143	-65	124
Automobil- und Industrieelektronik	138	187	244
Speicherprodukte	-630	31	169
Sonstige Geschäftsbereiche	9	-49	-58
Konzernfunktionen	-264	-215	-44
Summe Ebit	-1.135	-299	256

	2002	2003	2004
Abschreibungen:			
Drahtgebundene Kommunikation	97	61	49
Sichere Mobile Lösungen	247	280	278
Automobil- und Industrieelektronik	282	293	274
Speicherprodukte	709	768	683
Sonstige Geschäftsbereiche	35	35	36
Konzernfunktionen	-	-	-
Summe Abschreibungen	1.370	1.437	1.320

	2002	2003	2004
Vorräte:			
Drahtgebundene Kommunikation	62	59	34
Sichere Mobile Lösungen	159	142	197
Automobil- und Industrieelektronik	270	277	311
Speicherprodukte	360	452	368
Sonstige Geschäftsbereiche	21	21	13
Konzernfunktionen	19	8	37
Summe Vorräte	891	959	960

	2002	2003	2004
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften:			
Drahtgebundene Kommunikation	-	-2	-2
Sichere Mobile Lösungen	-	-2	-4
Automobil- und Industrieelektronik	-	-	-
Speicherprodukte	-56	22	-16
Sonstige Geschäftsbereiche	-1	-1	-4
Konzernfunktionen	10	1	12
Summe anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	-47	18	-14

Zum 30. September 2004 verteilte sich der Geschäfts- und Firmenwert wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

	2003	2004
Geschäfts- und Firmenwert:		
Drahtgebundene Kommunikation	98	47
Sichere Mobile Lösungen	2	4
Automobil- und Industrieelektronik	22	13
Speicherprodukte	90	81
Sonstige Geschäftsbereiche	6	6
Konzernfunktionen	-	-
Summe Geschäfts- und Firmenwert	218	151

Zwischen den Geschäftsbereichen werden auf Grund ihrer organisatorischen Struktur keine Umsätze getätigt. Dementsprechend resultieren die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche aus Umsätzen mit Dritten.

Die Vorprodukte und unfertigen Erzeugnisse bestimmter gemeinsamer Logik-Front-End-Fabriken sowie die unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Back-End-Fabriken stehen nicht unter der direkten Kontrolle und Verantwortung der zuständigen Bereichsleiter, sondern unter der des Standortmanagements, welches für die Umsetzung des Produktionsplans nach Mengen und Einheiten verantwortlich ist. Deshalb werden diese Vorräte in der Zeile „Konzernfunktionen“ ausgewiesen und nicht unter den einzelnen Geschäftsbereichen. Lediglich die Vorprodukte der Back-End-Fabriken (Chipbestände) und die Fertigprodukte sind den Geschäftsbereichen zugeordnet und in den Segmentinformationen, welche an die verantwortlichen CODM berichtet werden, enthalten.

Bestimmte Posten sind in den Konzernfunktionen enthalten und werden nicht auf die Segmente umgelegt. Dies gilt für bestimmte Kosten der Konzernzentrale, bestimmte Inkubatorkosten und Aufwendungen für Grundlagenforschung, für Einmalgewinne und spezielle strategische Technologieinitiativen. Rechtskosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Produktangelegenheiten werden bei den Segmenten zum Zeitpunkt der Ausgabe-

wirksamkeit gezeigt. Dies kann sich unterscheiden vom Zeitpunkt des Aufwands, da er in den Konzernfunktionen gezeigt wird. Die Gesellschaft ordnet Leerkosten auf Basis eines Auftragsfertigermodells zu, wobei die Vorlaufzeit der Auftragsstornierung oder -änderung bei der Leerkostenzuordnung berücksichtigt wird. Alle nicht verrechneten Leerkosten werden in den Konzernfunktionen gezeigt. Wesentliche Positionen im Ebit in den Konzernfunktionen für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004 sind:

	2002	2003	2004
Konzernfunktionen:			
Nicht verrechnete Leerkosten	-211	-101	-34
Restrukturierungsaufwendungen	-16	-29	-17
Zentrale IT-Entwicklungskosten	-36	-13	-
Andere	-1	-72	7
Summe Konzernfunktionen	-264	-215	-44

Es folgt eine Übersicht zu der Geschäftstätigkeit nach Regionen für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004:

	2002	2003	2004
Umsatzerlöse:			
Deutschland	1.266	1.535	1.675
Übriges Europa	943	1.112	1.263
Nordamerika	1.158	1.393	1.524
Asien-Pazifik	1.287	1.821	2.263
Japan	159	256	364
Andere	77	35	106
Summe Umsatzerlöse	4.890	6.152	7.195

	2002	2003	2004
Sachanlagen:			
Deutschland	2.467	2.152	1.962
Übriges Europa	688	652	514
Nordamerika	969	641	619
Asien-Pazifik	366	369	490
Japan	1	1	1
Andere	-	2	1
Summe Sachanlagen	4.491	3.817	3.587

Der Ausweis des Umsatzes mit Dritten richtet sich nach dem Sitz des Rechnungsempfängers. Die Anzahl der Beschäftigten wird im Anhang Nr. 7 regional dargestellt.

Mit Ausnahme von Verkäufen an Siemens, die in Anhang Nr. 27 erläutert sind, entfielen in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 auf keinen Einzelkunden mehr als 10% der Gesamtumsatzerlöse. Die Umsatzerlöse mit Siemens resultieren insbesondere aus den Nicht-Speicher-Geschäftsbereichen.

Ebit ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management der Gesellschaft nutzt das Ebit als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Die Gesellschaft berichtet Ebit-Daten, um Investoren nützliche Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft und im Speziellen über die einzelnen Segmente zur Verfügung zu stellen.

Das Ebit wird ohne Anpassung der US-GAAP-Werte wie folgt aus der Gewinn-und-Verlust-Rechnung hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. September	2002	2003	2004
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag) von fortgeführten Geschäften	-1.017	-435	61
Bereinigt um: Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-143	84	154
Zinsaufwand	25	52	41
Ebit	-1.135	-299	256

33. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 10. November 2004 haben die Gesellschaft und ProMOS eine Vereinbarung über die Lizenzvergabe von früher an ProMOS transferierte Technologien abgeschlossen. ProMOS darf Produkte auf Basis dieser Technologien herstellen und vertreiben und darauf basierende eigene Prozesse und Produkte entwickeln. ProMOS hat zugestimmt einen Gesamtpreis von \$156 Mio. in vier Raten bis April 2006 zu bezahlen. Bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von \$36 Mio. für den Bezug von Produkten von ProMOS werden angerechnet. Die Parteien haben vereinbart alle damit verbundenen Klagen zurückzuziehen, inklusive das Schiedsgerichtsverfahren. Die entsprechenden Lizenzeinnahmen werden im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 gezeigt.

Ergänzende Erläuterungen

Ergänzende Erläuterungen für den nach US-GAAP aufgestellten Anhang zum Konzernabschluss entsprechend den Anforderungen nach § 292a HGB

Die Gesellschaft hat für das zum 30. September 2004 beendete Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsgesetzbuch aufgestellt. Sie hat sich dabei gemäß den handelsrechtlichen Regelungen dafür entschieden, über den Konzernabschluss auf der Grundlage der international anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze („US-GAAP“) zu berichten. Die Berichterstattung nach dem deutschen Handelsrecht umfasst neben dem Konzernabschluss nach US-GAAP zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht.

Hinweis für den Geschäftsbericht

Der Konzernabschluss nach deutschem Handelsrecht und der Konzernlagebericht unterliegen deutschen Prüfungsvorschriften. Die KPMG Deutsche-Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 126492 hinterlegt oder kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.

Wesentliche Unterschiede zwischen deutscher und US-Rechnungslegung

Vorbemerkung

Die Gesellschaft muss als deutsches Mutterunternehmen grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufstellen. § 292a HGB befreit jedoch von dieser Pflicht, wenn der Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und offen gelegt wird (wie z. B. US-GAAP). Die Gesellschaft stellt den Konzernabschluss nach US-GAAP auf. Im Folgenden werden wesentliche von den deutschen Rechnungslegungsvorschriften abweichende Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden erläutert. Weiterhin sind Gesellschaften mit einer Börsennotierung in den USA verpflichtet, den Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) zu entsprechen.

Grundsätzliche Unterschiede

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach dem deutschen HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für die Investoren legt, ist die HGB-Rechnungslegung von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips geprägt.

Gliederungsvorschriften

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Bilanzgliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke ist für Kapitalgesellschaften grundsätzlich in § 266 HGB definiert. Die Gliederung orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt laut HGB und US-GAAP grundsätzlich nach gleichen Grundsätzen, sofern die Leistung erbracht und die Einzahlung erfolgt ist. Unterschiede können bezüglich des Zeitpunkts der Vereinnahmung auftreten, wenn die leistende Gesellschaft weitere finanzielle, operative oder leistungsbezogene Verpflichtungen gegenüber der leistungsempfangenden Gesellschaft übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht hinreichend objektivierbar sind.

Marktgängige Wertpapiere

Marktgängige Wertpapiere, die Anteils- oder Gläubigerrechte verbrieft, sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind nach US-GAAP als Available-for-Sale-Securities zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Wertsteigerungen oder Wertminderungen dieser Wertpapiere werden, nach Berücksichtigung latenter Steuern, ergebnisneutral im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst.

Vorräte

Die Vorräte sind nach HGB ebenso wie nach US-GAAP mit den Herstellungskosten zu bewerten.

Die Herstellungskosten nach US-GAAP werden als produktionsbezogene Vollkosten definiert, bei denen neben den Material- und Lohn Einzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung

die Material- und Fertigungsgemeinkosten einzubeziehen sind. Zudem sind Verwaltungskosten zu berücksichtigen, sofern sie in eindeutigem Zusammenhang mit der Erzeugung der zu bewertenden Produkte stehen. Nach HGB brauchen von den oben genannten Kosten Teile der indirekten Kosten wie z. B. Verwaltungskosten nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen zu werden.

Geschäfts- und Firmenwert

Unter US-GAAP ist gemäß SFAS Nr. 141, Kapitalkonsolidierung, in Verbindung mit SFAS Nr. 142, Geschäfts- und Firmenwerte und andere immaterielle Vermögensgegenstände, der Geschäfts- und Firmenwert bei Kapitalkonsolidierungen unter Anwendung der Erwerbsmethode nach dem 30. Juni 2001 nicht mehr länger abzuschreiben, sondern jährlich auf Werthaltigkeit zu überprüfen. Unter HGB ist der Geschäfts- und Firmenwert in jedem folgenden Geschäftsjahr mindestens zu einem Viertel abzuschreiben oder kann über den Zeitraum der zu erwartenden Lebensdauer abgeschrieben werden.

Nicht abgeschlossene Entwicklungen geistiger Eigentumsrechte bei Beteiligungserwerben

Aufwendungen, die bei erworbenen Unternehmen für nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Geschäfts- und Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Nach HGB werden derivative Finanzinstrumente grundsätzlich nicht bilanziert. Dies bedeutet, dass Wertsteigerungen nicht zu berücksichtigen sind. Für Wertminderungen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen Rückstellungen zu bilden. Nach US-GAAP sind derivative Finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert anzusetzen. Die Marktwertänderungen werden in der Gewinn- und Verlust-Rechnung oder unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst. Dies ist einerseits abhängig davon, ob die derivativen Finanzinstrumente Bestandteil eines Sicherungsgeschäfts sind, und andererseits von der Art des Sicherungsgeschäfts.

Latente Steuern

Der wesentliche Unterschied in der Bilanzierung latenter Steuern zwischen HGB und US-GAAP ist, dass bislang nach den Vorschriften des HGB keine latenten Steuern auf Verluste aktiviert werden. Nach US-GAAP sind latente Steuern auf Verluste (inklusive Ver-

lustvorträgen) zu berücksichtigen. Auf aktive latente Steuern, deren Realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind Wertberichtigungen vorzunehmen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Nach US-GAAP sind Pensionsrückstellungen unter Berücksichtigung der für die Zukunft zu erwartenden Entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwert-Verfahren zu bewerten. Diese Methode ist auch nach dem HGB zulässig.

Weiterhin kommen ggf. unterschiedliche Zinssätze für die Barwertberechnung der Rückstellung zum Ansatz.

Auf Grund der Übertragung der treuhänderischen Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pension-Trust-Verein wurden nach US-GAAP die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei der Gesellschaft bilanziert. Nach HGB sind die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Übertragung auf den Pension-Trust-Verein weiterhin bei der Gesellschaft zu bilanzieren.

Aktienoptionsprogramm

Für die gewährten Aktienoptionen werden nach HGB Rückstellungen gebildet, sofern der Marktwert zum Bilanzstichtag über dem Ausübungspreis für die Optionsrechte liegt.

Nach US-GAAP bilanziert die Gesellschaft die gewährten Aktienoptionen nach der Innere-Wert-Methode entsprechend APB Opinion 25, Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter, die nicht zu einer Aufwandserfassung führt, wenn der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Ausgabe der Option nicht deren Ausübungspreis übersteigt.

Kosten für Kapitalerhöhungen

Nach HGB wurden Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit dem Börsengang als Aufwendungen erfasst. Nach US-GAAP wurden diese Aufwendungen mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Rückstellungen

Nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen Aufwandsrückstellungen in bestimmten Fällen auch ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gebildet werden. Nach US-GAAP sind Rückstellungen nur bei gegenüber Dritten bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für eng eingegrenzte Tatbestände zu bilden.

Fremdwährungsumrechnung

Nach HGB werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt der Erfassung des

Geschäftsvorfalles bzw. jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wobei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst werden. Nach US-GAAP erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsfordernungen und -verbindlichkeiten zum Fremdwährungskurs des Bilanzstichtags, wobei die daraus ermittelten nicht realisierten Gewinne und Verluste in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst werden. Die Gesellschaft hat zum 30. September 2004 die Fremdwährungsumrechnung für kurzfristige Positionen auch nach HGB auf die Stichtagsbewertung umgestellt.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Nach HGB dürfen Investitionszulagen und Zinszuschüsse im Geschäftsjahr des Zuflusses erfolgswirksam vereinnahmt werden. Nach US-GAAP wurden diese Zuwendungen abgegrenzt und über den Zeitraum der Verrechnung der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen erfolgswirksam vereinnahmt.

Anteiliges Jahresergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Nach HGB dürfen die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Unternehmen, basierend auf den nach den jeweiligen landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ergebnissen, vereinnahmt werden. Unter US-GAAP werden die nach US-GAAP ermittelten Ergebnisse der assoziierten Unternehmen anteilig vereinnahmt.

Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen

Nach HGB dürfen Wertsteigerungen des anteiligen Eigenkapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen erfolgswirksam erfasst werden. Nach US-GAAP- und SEC-Rechnungslegungsvorschriften hängt eine solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der Erfüllung weiterer Kriterien neben der Durchführung der Kapitalerhöhung ab. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die Werterhöhung des anteiligen Eigenkapitals erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen.

Ergebnisanteile konzernfremder Gesellschafter

Die Berücksichtigung der Anteile konzernfremder Gesellschafter bei der Erstkonsolidierung als auch bei Verteilung der ihnen zugerechneten Ergebnisanteile einer Gesellschaft richtet sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, in der Regel nach den zivilrechtlichen Anteilsverhältnissen. US-GAAP folgt bei der Konsolidierung des Minderheitenanteils den wirtschaftlichen Verhältnissen des Joint Ventures und es kann daher zu Abweichungen hinsichtlich des Ausweises der Minderheitenanteile oder Ergebnisanteile kommen.

Anwendung von Befreiungsvorschriften

Nach § 264a HGB haben offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen keiner der Gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene Handelsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter ist, einen Jahresabschluss nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gesellschaft hat die in § 264b HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

- ::: COMNEON GmbH & Co. OHG, Nürnberg,
- ::: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden,
- ::: Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG, Dresden (ehemals Ingentix GmbH & Co. KG),
- ::: Infineon Technologies Immobilien Regensburg GmbH & Co. KG, Regensburg,
- ::: Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG, Dresden,

in Anspruch genommen, da diese Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen sind.

Die Gesellschaft hat die in § 264 Abs. 3 HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

- ::: Infineon Technologies Ventures GmbH, München,
- ::: EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke,

in Anspruch genommen, da zwischen den zwei zuvor genannten Unternehmen und der Gesellschaft ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Die Capital Group International Inc., Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 mitgeteilt, dass sie am 25. September 2003 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage 5,068% (entspreche 36.534.489 Stammaktien). Diese Stimmrechte würden ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 WpHG zugerechnet.

Am selben Tag hat uns The Capital Group Companies, Inc., Los Angeles, USA, mitgeteilt, dass sie am 25. September 2003 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage 5,068% (entspricht 36.534.489 Stammaktien). Alle diese Stimmrechte würden ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 WpHG zugerechnet.

Am 14. Januar 2004 hat die Siemens AG der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie am 14. Januar 2004 die Schwellen von 10% und 5% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe des Stimmrechtsanteils betrage nunmehr 0,00%. Dies entspreche Stück 0 Aktien, die eine gleiche Anzahl an Stimmrechten vermittelten.

Außerdem hat die Siemens AG als Muttergesellschaft der Siemens Nederland N.V., Den Haag, Niederlande, für diese mitgeteilt, dass diese am 14. Januar 2004 die Schwellen von 10% und 5% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe ihres Stimmrechtsanteils betrage nunmehr 0%. Dies entspreche Stück 0 Aktien, die eine gleiche Anzahl von Stimmrechten vermittelten.

Die Wachovia Trust Company National Association, Wilmington, Delaware, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 14. Januar 2004, eingegangen am 14. Januar 2004, mitgeteilt, dass sie am 14. Januar 2004 die Schwelle von 25% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe ihres Stimmrechtsanteils betrage nunmehr 18,91%. Dies entspreche Stück 136.292.363 Aktien, die eine gleiche Anzahl an Stimmrechten vermittelten.

Angabe gemäß § 161 AktG

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechungserklärung wurde am 19. November 2003 abgegeben und den Aktionären im Internet dauerhaft zugänglich gemacht.

Angaben nach Ziffer 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex

1. Am 10. Mai 2004 hat Herr Max Dietrich Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats und (damals) Vorsitzender des Vorstands, 7.100 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €10,70 je Aktie erworben.

2. Am 9. August 2004 hat Herr Max Dietrich Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats und (damals) Vorsitzender des Vorstands, 3.632 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €7,99 je Aktie erworben.

Aufwendungen für Abschlussprüfung

Im Geschäftsjahr 2004 sind für weltweite Prüfungsleistungen des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, KPMG, Aufwendungen in Höhe von €4,3 angefallen.

Vorstand und Aufsichtsrat

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2004 €0,5 Mio. Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 1.500 Wertsteigerungsrechte. Der Vorstand erhält für das Geschäftsjahr feste Gehaltsbestandteile in Höhe von €4,1 Mio. Zudem hat er 500.000 Aktienoptionen sowie eine einmalige Ausgleichszahlung im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Dienstverträge über €1,9 Mio. erhalten. Die Aktienoptionen des Vorstands sowie die Wertsteigerungsrechte des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2004 nach den Regelungen des Long-Term-Incentive-Plan 2001 ausgegeben.

Für variable Bezüge des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2004 €1,3 Mio. Rückstellungen gebildet, die von der Veränderung des Ergebnisses der Gesellschaft abgeleitet und in der Zielerreichungsspanne begrenzt sind. Der Wert pro Option bzw. Wertsteigerungsrecht, wenn nach den gleichen Grundsätzen wie Aktienoptionen bewertet, betrug zum Ausgabezeitpunkt €5,92. Frühere Vorstandsmitglieder erhielten Gesamtbezüge in Höhe von €3,6 Mio. Für Pensionsverpflichtungen früherer Mitglieder des Vorstands bestehen zum Bilanzstichtag Pensionsrückstellungen in Höhe von €2,9 Mio. Als Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren bestellt:

Der Vorstand

Name	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Dr. Wolfgang Ziebart	54	Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer seit dem 01.09.2004 Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Mitglied des Board of Directors ::: Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China
Peter Bauer	44	Mitglied des Vorstands und Chief Sales & Marketing Officer Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Siemens VDO Automotive AG, München Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors ::: Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan Mitglied des Board of Directors ::: Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur ::: Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China ::: Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA ::: Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel
Peter Fischl	58	Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich Mitglied des Board of Directors ::: Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur ::: Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China ::: Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA

Der Vorstand

Name	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Dr. Andreas von Zitzewitz	44	<p>Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Steag Hamatech AG, Sternefeld</p> <p>Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats ::: Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich</p> <p>Mitglied des Board of Directors ::: Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur ::: Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China ::: Infineon Technologies Richmond Limited Partnership, Wilmington, Delaware, USA</p> <p>Vorsitzender der Gesellschafterdelegationen ::: EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke ::: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co OHG, Dresden</p>
Ausgeschiedene Vorstände:		
Max Dietrich Kley		<p>Vorstandsvorsitzender vom 25.03.2004 bis 31.08.2004 Vergütung Netto € 246.334,60 Brutto € 500.000,00</p>
Dr. Ulrich Schumacher		Vorstandsvorsitzender bis zum 25.03.2004

Der Aufsichtsrat

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Max Dietrich Kley	64	2005	€ 33.834,00	<p>Vorsitzender (Amt ruhend vom 25.03.2004 bis 31.08.2004) Mitglied des Aufsichtsrats BASF AG</p> <p>Externe Mandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: SGL Carbon AG, Wiesbaden</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats ::: Schott AG, Mainz ::: HeidelbergCement AG, Heidelberg</p> <p>Vergleichbare Mandate: Mitglied des Verwaltungsrats ::: Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz (bis 11.10.2004)</p>
Klaus Luschtinetz ¹	61	2009	€ 38.666,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender ab 20.01.2004</p> <p>Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Strasse</p> <p>Externe Mandate: Vergleichbare Mandate: Mitglied des Verwaltungsrats Siemens Betriebskrankenkasse, München</p>
Dr. h.c. Martin Kohlhausen	68	2005	€ 43.500,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG</p> <p>Externe Mandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: HOCHTIEF AG, Essen</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats ::: Bayer AG, Leverkusen ::: Heraeus Holding GmbH, Hanau ::: Schering AG, Berlin ::: ThyssenKrupp AG, Düsseldorf ::: Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart</p>
Alfred Eibl ¹	55	2009	€ 41.087,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender bis 20.01.2004</p> <p>Mitglied des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Strasse</p>

Der Aufsichtsrat

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Dr. Joachim Faber	54	2005	€ 29.000,00	<p>Mitglied des Vorstands der Allianz AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Bayerische Börse AG, München ::: Societa Metallurgica Italiana S.p.A., Florenz, Italien</p> <p>Konzernmandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: DBI Dresdner Bank Investment Management Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt ::: DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH, Frankfurt ::: Deutscher Investment Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH, Frankfurt</p> <p>Vergleichbare Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: AGF Asset Management S.A., Paris, Frankreich</p>
Günther Fritsch	69	2005	€ 16.916,00	<p>ab 01.03.2004 Industriekaufmann</p>
Jakob Hauser ¹	52	2009	€ 26.584,00	<p>Vorsitzender des Betriebsrats München/Perlach Mitglied des Gesamtbetriebsrats</p>
Dr. Stefan Jentzsch	43	2005	€ 29.000,00	<p>Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Deutsche Börse AG, Frankfurt</p> <p>Konzernmandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: HVB Alternative Financial Products AG, Wien, Österreich ::: HVB Alternative Investment AG, Wien, Österreich ::: DAB Bank AG, München</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ::: Vereins- und Westbank AG, Hamburg ::: HVB Info AG, München</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats ::: HVB Systems AG, München ::: Bank Austria Creditanstalt AG, Wien, Österreich</p> <p>Vergleichbare Mandate: Mitglied des Verwaltungsrats ::: HVB Wealth Management Holding GmbH, München</p>

Der Aufsichtsrat

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge	69	2005	€ 36.250,00	Professor an der Technischen Universität München
Michael Ruth ¹	44	2009	€ 29.000,00	Leiter Strategie, Planung und Controlling Corporate Logic Vertreter der leitenden Angestellten Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Mitglied des Verwaltungsrats ::: ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich
Dieter Scheitor ¹	51	2009	€ 19.334,00	Leiter der Betreuung IT-Industrie, IG Metall Frankfurt
Gerd Schmidt ¹	50	2009	€ 29.000,00	Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West
Kerstin Schulzendorf ¹	42	2009	€ 19.334,00	Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats Infineon Dresden
Alexander Trüby ¹	34	2009	€ 26.584,00	Mitglied des Betriebsrats Infineon Dresden
Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn	57	2005	€ 36.250,00	Vorsitzender des Vorstands der Audi AG Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Salzgitter AG, Salzgitter ::: FC Bayern München AG, München ::: TÜV Süddeutschland Holding AG, München Konzernmandate: Vergleichbare Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: SEAT S.A., Barcelona, Spanien ::: Lamborghini Holding S. p. A., Sant'Agata, Italien

Der Aufsichtsrat

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2004)
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer	60	2005	€ 37.459,00	Mitglied des Vorstands der Siemens AG Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: Deutsche Messe AG, Hannover Konzernmandate: Mitglied des Aufsichtsrats ::: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München Vergleichbare Mandate: Vorsitzender des Verwaltungsrats ::: Siemens Ltd., Peking, China ::: Siemens E&A, Atlanta, Georgia, USA ::: Siemens K.K., Tokio, Japan ::: Siemens S.A., Lissabon, Portugal Mitglied des Verwaltungsrats ::: EviopTempo AG, Athen, Griechenland ::: Siemens Ltd., Mumbai, Indien

1 Arbeitnehmersvertreter.

Ausschüsse des Aufsichtsrats**1. Vermittlungsausschuss**

Max Dietrich Kley (Amt ruhend vom 25.03.2004 bis 31.08.2004)
 Dr. Martin Kohlhaussen (vom 01.04.2004 bis 31.08.2004)
 Alfred Eibl (bis 20.01.2004)
 Klaus Luschtinetz (ab 20.01.2004)
 Karl Heinz Midunsky (bis 29.02.2004)
 Gerd Schmidt (bis 20.01.2004)
 Alexander Trüby (ab 20.01.2004)
 Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (ab 01.03.2004)

2. Präsidialausschuss

Max Dietrich Kley (Amt ruhend vom 25.03.2004 bis 31.08.2004)
 Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (vom 01.04.2004 bis 31.08.2004)
 Alfred Eibl (bis 20.01.2004)
 Dr. Martin Kohlhaussen
 Klaus Luschtinetz (ab 20.01.2004)

3. Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss

Max Dietrich Kley (Amt ruhend vom 25.03.2004 bis 31.08.2004)
 Dr. Martin Kohlhaussen (vom 01.04.2004 bis 31.08.2004)
 Alfred Eibl (bis 20.01.2004)
 Klaus Luschtinetz (ab 20.01.2004)
 Karl Heinz Midunsky (bis 29.02.2004)
 Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (ab 01.03.2004)

4. Strategie- und Technologieausschuss seit dem 01.04.2004

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer
 Alfred Eibl
 Jakob Hauser
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge
 Alexander Trüby
 Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn

Ausgeschiedene Aufsichtsräte

Ausgeschieden zum 20.01.2004:
 Ender Beyhan, Vergütung € 9.666,00
 Johann Dechant, Vergütung € 9.666,00
 Heinz Hawreliuk, Vergütung € 9.666,00
 Wolfgang Müller, Vergütung € 9.666,00

Ausgeschieden zum 29.02.2004:
 Karl Heinz Midunsky, Vergütung € 18.125,00

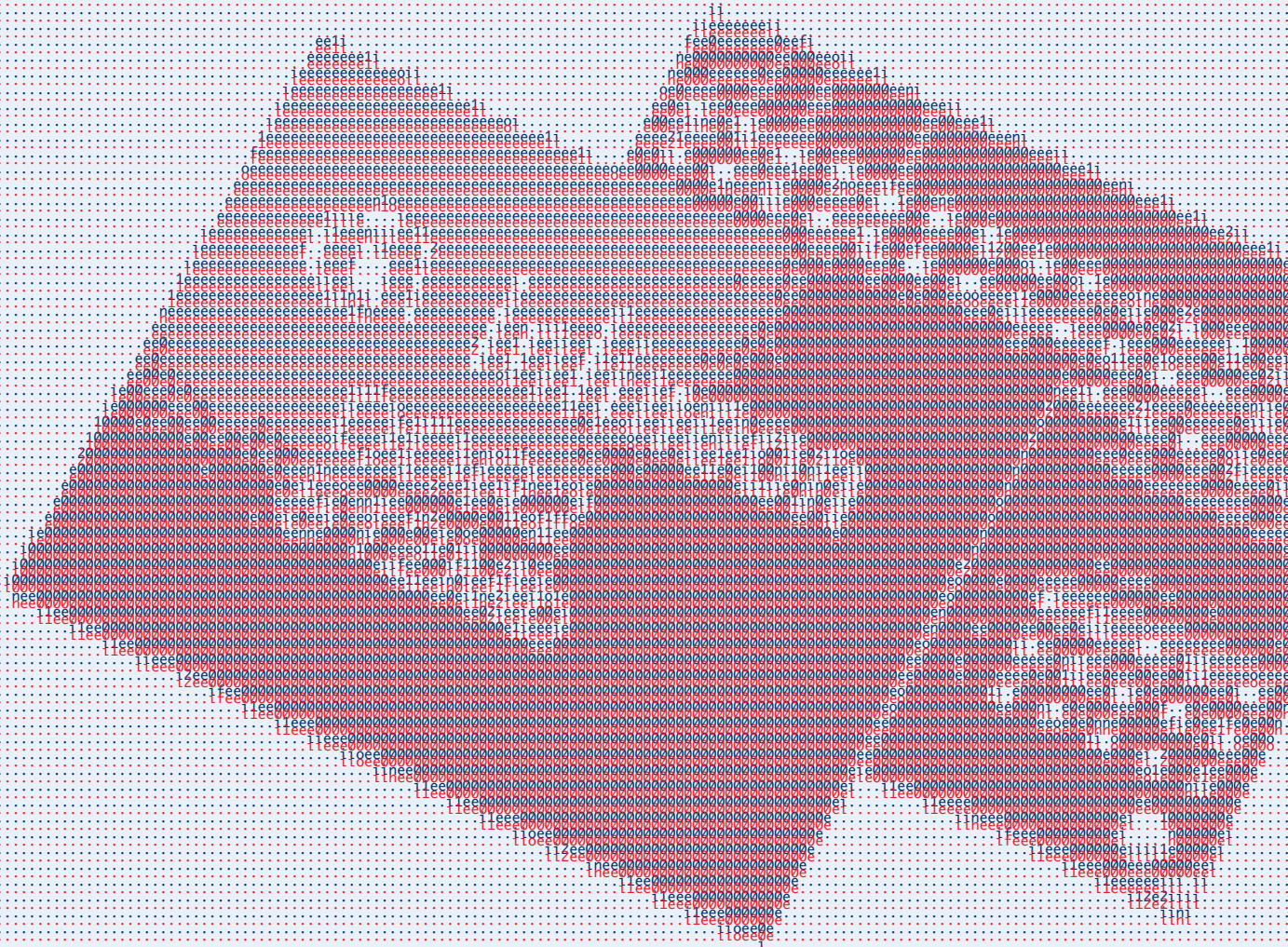
Wesentliche Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil
EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke	100 %
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	100 %
Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG, Dresden	100 %
Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich	100 %
Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores, Portugal S.A., Vila do Conde, Portugal	100 %
Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis, Frankreich	100 %
Infineon Technologies Holding B.V., Rotterdam, Niederlande	100 %
SensoNor AS, Horten, Norwegen	100 %
Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA	100 %
Infineon Technologies Richmond LP, Wilmington, Delaware, USA	100 %
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur	100 %
Infineon Technologies (Advanced Logic) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies (Integrated Circuit) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan	100 %
Infineon Technologies Suzhou Co., Ltd., Suzhou, China	73 %
ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich	50 %
Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan	44 %

Wussten Sie, dass ...

- ... Infineons Mobile-RAMs in jedem dritten Personal Digital Assistant (PDA) weltweit eingebaut sind?
- ... Infineons Mobile-RAMs in jedem fünften Smart Phone weltweit eingebaut sind?
- ... jedes fünfte neue Notebook und jeder fünfte Server weltweit Speichermodule von Infineon enthalten?
- ... Mitte 2004 schon jeder zehnte digitale Fernsehempfänger weltweit Speicher von Infineon enthielt?

Weitere Informationen



Mehrmjahresübersicht 2000–2004

Ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG in Mio. €¹

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	2000	2001	2002	2003	2004
Daten der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen					
Umsatzerlöse	6.989	5.347	4.890	6.152	7.195
nach Regionen:					
Deutschland	1.520	1.636	1.266	1.535	1.675
Übriges Europa	1.570	1.172	943	1.112	1.263
Nordamerika	1.747	1.208	1.158	1.393	1.524
Asien-Pazifik	1.815	1.056	1.287	1.821	2.263
Japan	232	191	159	256	364
Andere	105	84	77	35	106
nach Geschäftsbereichen²:					
Drahtgebundene Kommunikation	661	766	386	459	434
Sichere Mobile Lösungen	1.540	1.225	1.015	1.403	1.790
Automobil- und Industrieelektronik	942	1.450	1.464	1.634	1.820
Speicherprodukte	3.479	1.614	1.861	2.485	2.926
Sonstige Geschäftsbereiche	276	236	117	139	196
Konzernfunktionen	91	56	47	32	29
Umsatzkosten	3.815	4.580	4.289	4.614	4.670
Bruttoergebnis vom Umsatz	3.174	767	601	1.538	2.525
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.025	1.189	1.060	1.089	1.219
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	668	782	643	679	718
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	–	117	16	29	17
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	–2	–200	–46	85	257
Betriebsergebnis	1.483	–1.121	–1.072	–344	314
Zinsergebnis	75	–1	–25	–52	–41
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten und assoziierten Unternehmen	92	21	–47	18	–14
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	53	11	18	–2	2
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	36	65	–41	21	–64
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	–6	6	7	8	18
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.733	–1.019	–1.160	–351	215
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–614	427	143	–84	–154
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag von fortgeführten Geschäften	1.119	–592	–1.017	–435	61
Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	7	1	–4	–	–
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	1.126	–591	–1.021	–435	61
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert in €	1,83	–0,92	–1,47	–0,60	0,08
Ebit	1.658	–1.018	–1.135	–299	256
nach Geschäftsbereichen²:					
Drahtgebundene Kommunikation	48	–93	–245	–188	–179
Sichere Mobile Lösungen	303	–206	–143	–65	124
Automobil- und Industrieelektronik	74	207	138	187	244
Speicherprodukte	1.330	–938	–630	31	169
Sonstige Geschäftsbereiche	23	192	9	–49	–58
Konzernfunktionen	–121	–180	–264	–215	–44

Fortsetzung ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG in Mio. €¹

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	2000	2001	2002	2003	2004
Daten der Konzern-Bilanzen					
Zahlungsmittel	511	757	1.199	969	608
Wertpapiere des Umlaufvermögens	498	93	738	1.784	1.938
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.316	626	758	876	1.056
Vorräte	841	882	891	959	960
Aktive kurzfristige latente Steuern	100	39	82	113	140
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	569	479	523	675	590
Summe Umlaufvermögen	3.835	2.876	4.191	5.376	5.292
Sachanlagen	4.034	5.233	4.491	3.817	3.587
Finanzanlagen	432	655	708	425	708
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	132	86	70	67	109
Bilanzsumme	8.853	9.743	10.918	10.875	10.864
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristiger Teil langfristiger Finanzverbindlichkeiten	138	119	120	149	571
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	128	249	1.710	2.343	1.427
Summe Eigenkapital	5.806	6.900	6.158	5.666	5.978
Daten der Konzern-Kapitalflussrechnungen					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.077	221	226	731	1.857
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.327	-1.813	-1.244	-1.522	-1.809
Planmäßige Abschreibungen	834	1.121	1.370	1.437	1.320
Investitionen in Sachanlagen	-1.571	-2.282	-643	-872	-1.163
Börsenkennzahlen zum 30.9. (Börsengang am 13.03.2000)					
Dividendenertrag pro Aktie in €	0,65	0	0	0	0
Aktienkurs Xetra-Handelssystem in €	54,88	13,50	5,61	11,22	8,22
Aktienkurs New York Stock Exchange (NYSE) in US-\$	47,50	12,39	5,70	12,89	10,22
Anzahl der Aktien in Mio. Stück	625,5	692,4	720,8	720,9	747,6
Marktkapitalisierung in Mrd. €	34.327	9.347	4.044	8.088	6.145
Marktkapitalisierung in Mrd. US-\$	29.711	8.579	4.109	9.292	7.640
Kennzahlen					
Eigenkapitalquote	66 %	71 %	56 %	52 %	55 %
Verschuldungsgrad	5 %	5 %	30 %	44 %	33 %
Netto-Cash-Position am 30.9. ³	743	482	107	261	548
Mitarbeiter zum 30.9. (absolute Zahlen)	29.166	33.813	30.423	32.308	35.570
nach Regionen:					
Deutschland	14.247	16.814	15.716	16.166	16.387
Übriges Europa	3.409	5.007	4.590	5.034	5.631
Nordamerika	2.838	3.023	2.889	2.757	2.982
Asien-Pazifik	8.553	8.822	7.093	8.116	10.340
Japan	119	127	107	118	133
Andere	0	20	28	117	97
nach Funktionen:					
Produktion	20.371	23.416	20.822	22.405	24.540
Forschung und Entwicklung	4.733	5.510	5.374	5.935	7.160
Vertrieb und Marketing	2.043	2.259	2.010	2.048	1.948
Verwaltung	2.019	2.628	2.217	1.920	1.922

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Im Geschäftsjahr 2004 haben wir einige unserer Geschäftsbereiche reorganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der vorausgegangenen Jahre wurden entsprechend umgestellt, so dass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahrs entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

3 Entspricht der Kalkulation: Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

Finanz- und Technologieglossar

Finanzglossar

ADS: American Depositary Shares – ADS sind in den USA gehandelte Aktienzertifikate über nicht-amerikanische Aktien. Sie erleichtern nicht-amerikanischen Unternehmen den Zugang zu US-amerikanischen Kapitalmärkten und bieten so US-amerikanischen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in nicht-amerikanische Gesellschaften. Infineons ADS werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt (Verhältnis ADS:Aktie = 1:1).

Brutto-Cash-Position: Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Bruttoergebnis vom Umsatz: Umsatz abzüglich Herstellungskosten des Umsatzes.

Cash-Flow: Zahlungswirksamer Saldo aus Mittelzuflüssen und -abflüssen innerhalb eines Geschäftsjahrs. Der Cash-Flow ist Teil des Konzernabschlusses und zeigt für einen bestimmten Zeitraum, aus welchen Quellen sich eine Gesellschaft finanziert und wofür die Zahlungsmittel verwendet wurden, gegliedert nach laufender Geschäftstätigkeit (Mittel, die durch Kauf/Verkauf von Produkten und Dienstleistungen generiert wurden), Investitionstätigkeit (Mittelabfluss einer Gesellschaft für Investitionen oder Mittelzufluss aus Desinvestitionen) und Finanzierungstätigkeit (Mittelzufluss durch die Ausgabe von Aktien, Anleihen und Darlehen beziehungsweise Mittelabfluss durch die Rücknahme von Aktien und Anleihen bzw. Rückzahlung von Darlehen).

Dax: Deutscher Aktienindex. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 30 hinsichtlich Orderumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Ebit: Earnings Before Interests and Taxes. Bei Infineon ist Ebit definiert als Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Dies ist die Kennzahl, mit der Infineon die operative Ertragskraft seiner Geschäftsbereiche bewertet.

Ebit-Marge: Kennzahl zur Bestimmung der operativen Ertragskraft, die das Ebit im Verhältnis zum Umsatz darstellt.

Eigenkapitalquote: Zeigt den Anteil des Eigenkapitals in der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft, berechnet aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Eigenkapitalrendite: Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Ergebnisanteile, auf konzernfremde Gesellschafter entfallende: Anteile am Jahresergebnis, die nicht dem Konzern, sondern Konzernfremden, die Anteile an verbundenen Unternehmen des Konzerns halten, zugerechnet werden.

Ergebnis je Aktie bzw. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie: Das unverwässerte Konzernergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum (Quartal oder Geschäftsjahr) ausstanden, dividiert wird. Das verwässerte Konzernergebnis je Aktie wird errechnet, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum ausstanden, zuzüglich der Zahl der Aktien, die emittiert würden, falls ausstehende Aktienoptionen, zugeteilte Aktienrechte und Wandelschuldverschreibungen ausgeübt bzw. gewandelt würden, dividiert wird.

Free-Cash-Flow: Saldo des Mittelzuflusses bzw. -abflusses aus Infineons laufender Geschäftstätigkeit und des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit, bereinigt um kurzfristig verfügbare Wertpapiere.

Gesamtkapitalrentabilität: Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Gesamtkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Goodwill (Geschäfts- und Firmenwert): Immaterieller Vermögensgegenstand, der im Rahmen einer Unternehmensakquisition entstehen kann. Er stellt den Betrag dar, mit dem der Kaufpreis (die Kosten) für eine erworbene Gesellschaft den angenommenen Marktwert der erworbenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übersteigt. Nach US-GAAP wird der Geschäfts- und Firmenwert nicht über eine Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern bei einer eventuellen Wertminderung durch eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Die Überprüfung des Wertes erfolgt mindestens einmal jährlich.

Latente Steuern: Da die steuerliche Gesetzgebung des Öfteren von den handelsrechtlichen Vorgaben abweicht, können Unterschiede zwischen (a) dem zu versteuernden Einkommen und dem handelsrechtlichen Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und (b) der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten und ihren jeweiligen Buchwerten entstehen. Eine latente Steuerverbindlichkeit und der zugehörige Aufwand entstehen aus dem Einkommen, das bereits handelsrechtlich, jedoch nicht steuerrechtlich erfasst ist. Umgekehrt entsteht eine latente Steuerforderung, wenn der Aufwand erst in Zukunft steuerlich abzugsfähig ist, jedoch handelsrechtlich bereits erfasst wurde.

Namensaktien: Aktien, die auf den Namen einer bestimmten Person lauten. Diese Person wird entsprechend den aktienrechtlichen Vorgaben mit einigen persönlichen Angaben sowie der Aktienanzahl in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Nur wer im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, gilt gegenüber der Gesellschaft als Aktionär und kann beispielsweise seine Rechte in der Hauptversammlung ausüben.

Netto-Cash-Position: Brutto-Cash-Position minus kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten.

Risikomanagement: Systematische Vorgehensweisen, um potenzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Risikohandhabung und -verringeringung auszuwählen und im Unternehmen umzusetzen.

US-GAAP: Accounting Principles Generally Accepted in the United States of America; US-amerikanische Norm der Rechnungslegung. Infineon stellt den Konzernabschluss gemäß den Vorgaben von US-GAAP auf.

Verschuldungsgrad: Kennzahl der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft. Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

Technologieglossar

2G – Zweite Generation: digitale Mobiltelefonie. Nach den analogen Netzen (erste Generation) bekommt der Teilnehmer hier mit digitalen Signalisierungen einheitlich gute Sprachqualität und zahlreiche Datendienste. Mobilfunkstandard der zweiten Generation in Europa: GSM.

2,5G: Gegenwärtige Infrastruktur des Mobilfunks. Mobilfunkstandard der 2,5-Generation in Europa: GPRS.

3G: Dritte Generation des Mobilfunks. Sprache und Daten werden gemeinsam breitbandig – also mit wesentlich höherer Transportkapazität als bei der zweiten Generation – übertragen. Mobilfunkstandard der dritten Generation in Europa: UMTS.

300-Millimeter-Technologie: Oberbegriff für die Herstellung und Prozessierung von Wafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Bei Infineon als Synonym für die Herstellung von Speicherchips auf 300-Millimeter-Wafern verwendet.

ASIC: Application Specific Integrated Circuit. Logikschaltung, die auf speziellen Kundenwunsch für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde.

ASSP: Application Specific Standard Product. Standardprodukt, das für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde und von vielen Kunden genutzt werden kann.

Back-End-Fertigung: Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der ausgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat (vgl. Front-End-Fertigung). Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, etwaige notwendige Reparaturen der Chips, Sägen der Wafer und Verpackung der einzelnen Chips. Immer mehr Halbleiterhersteller lagern den Montagevorgang an unabhängige Montageunternehmen aus, einige sogar das Testen. Ein Großteil der Montageunternehmen befindet sich in Ländern des pazifischen Raumes.

Basisband-IC: Im Basisband-IC werden die empfangenen und zu sendenden digitalen Signale verarbeitet. Dieser komplexe Baustein enthält üblicherweise einen digitalen Signalprozessor, einen Mikrocontroller, Speicher und analoge Schaltungen. Er bildet gewissermaßen das Herz eines drahtlosen Kommunikationssystems.

Bit: Informations- bzw. Recheneinheit, die einen von zwei Werten annimmt, zum Beispiel „richtig“/„falsch“ oder „0“/„1“.

Bluetooth: Technologie zur Funkübermittlung von Sprache und Daten über kurze Strecken.

Breitbandanwendungen: Hierzu zählen Netzwerktechnologien, die für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite genutzt werden. Diese Technologie umfasst Bandbreiten von mehreren hundert Kilo-bit pro Sekunde oder mehr.

Byte: Maß für Informationseinheit bei Datenverarbeitungsanlagen; ein Byte entspricht acht Bit.

Carbon-Nanoröhrchen: CNT (Carbon Nano Tubes) sind mikroskopisch kleine röhrenförmige Gebilde aus Kohlenstoff, wobei ihre Wände eine wabenartige Struktur aus Sechsecken einnehmen. Der Durchmesser der Röhren liegt meist im Bereich von einem bis 50 Nanometer; die Länge kann bis zu 20 Zentimetern erreichen.

CDMA: Code Division Multiple Access. Verfahren, das in Mobilfunksystemen eingesetzt wird und mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Übertragungskanal ermöglicht. Vorteil: bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite.

Chipkarte: Kunststoffkarte mit eingebautem Speicherchip oder Mikroprozessor, kann mit Geheimzahl kombiniert werden.

CMOS: Complementary Metal Oxide Substrate. Halbleiter-Standardfertigungstechnologie, um Mikrochips mit geringem Energieverbrauch und hohem Integrationsgrad zu produzieren.

DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Einheitlicher europäischer Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme.

DRAM: Dynamic Random Access Memory. Auf Grund der hohen Integrationsdichte und des daraus resultierenden niedrigen Preises weit verbreitete Speicherchip-Technologie. Beispiele für DRAM-Chips sind SDRAM, DDR DRAM, RDRAM, SGRAM (vgl. RAM).

Ethernet: Netzwerk-Standard für Hochgeschwindigkeits-Kommunikation für den lokal begrenzten Einsatz (Ausdehnung bis zehn Kilometer).

Flash-Memory: Eine Variante nicht-flüchtiger Speicher. Sein Inhalt bleibt erhalten, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Flüchtiger Speicher: Speicher, der die in ihm gespeicherten Informationen verliert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Front-End-Fertigung: Verarbeitung von Wafern, die im Reinraum durchgeführt wird, im Gegensatz zu dem Verarbeitungsprozess, der nach der eigentlichen Fertigstellung der Wafer stattfindet. Nachdem die Verarbeitung der Wafer im Reinraum beendet ist, werden sie an die Back-End-Fertigung weitergeleitet; dort werden sie getestet und verpackt (vgl. Back-End-Fertigung).

Giga: ²³⁰ im informationstechnischen Sinn; z. B. Gigabit (Gbit), Gigabyte (Gbyte).

GPRS: General Packet Radio Service heißt eine neue Mobilfunkgeneration der 2,5-Gruppe für höhere Datenübertragungsraten (bis zu 115 Kilobit/Sekunde) in GSM-Netzen.

GPS: Global Positioning System. Satellitengestütztes Funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung auf Grund von Laufzeitunterschieden der empfangenen Signale.

GSM: Das Global System for Mobile Communication ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale Mobilfunksystem.

Halbleiter: Kristalliner Werkstoff, der bei Erwärmung eine mit der Temperatur ansteigende elektrische Leitfähigkeit zeigt. Halbleiter sind z. B. Silizium und Germanium. Der Begriff wird auch für ICs aus diesem Werkstoff verwendet. Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern kann durch Einbringung von Dotierstoffen (in der Regel Bor oder Phosphor) gezielt verändert werden.

Hochfrequenz-Transceiver: Transceiver ist ein Kunstwort aus Transmitter (= Sender) und Receiver (= Empfänger). Es beschreibt für die drahtgebundene und drahtlose Kommunikation eine Kombination aus Sende- und Empfangsschaltung in einer Einheit. Hochfrequenz- oder Radio-Frequency(RF)-Transceiver werden in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt, z. B. in Mobil- und Schnurlos-Telefonen.

Home-Gateway: Über das Home-Gateway können Daten mit hoher Geschwindigkeit vom und zum Privathaushalt übertragen werden. Home-Gateways liefern digitale Informationen rund um den Privat-

haushalt. Sie gelten als der nächste evolutionäre Schritt nach dem Fernsehempfänger (Decoder).

IC: Integrated Circuit (integrierte Schaltung). Bauelement auf Basis eines Halbleitermaterials wie beispielsweise Silizium, auf dem zahlreiche Komponenten wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden integriert und miteinander verbunden sind.

ISDN: Integrated Services Digital Network. Online-Verbindungstyp, der Telekommunikationsdienste wie Telefon, Telefax oder Datenkommunikation in einem Netz integriert.

Kilo: ²¹⁰ im informationstechnischen Sinn; z. B. Kilobit (Kbit), Kilo-byte (Kbyte).

LAN: Local Area Network (lokales Netzwerk). Datenkommunikationsnetz in einem räumlich eng begrenzten Gebiet, z. B. innerhalb eines Gebäudes.

Leistungshalbleiter: In den letzten 30 Jahren haben Leistungshalbleiter in der Antriebstechnik ebenso wie in der Energieübertragung und -verteilung weitgehend die elektromechanischen Lösungen verdrängt, weil mit ihnen hohe Energieflüsse fast nach Belieben gefordert werden können. Der Vorteil der Bauelemente besteht darin, dass sie extrem schnell – typischerweise innerhalb weniger Millionstelsekunden – zwischen den Zuständen „offen“ und „geschlossen“ wechseln können. Durch die schnelle Folge von Ein/Aus-Pulsen kann fast jede beliebige Form des Energieflusses nachgebildet werden, z. B. auch eine Sinuswelle.

Logikbereich: Zusammenfassung der drei Infineon-Geschäftsbereiche Automobil- und Industrieelektronik, Drahtgebundene Kommunikation sowie Sichere Mobile Lösungen.

MAN: Metropolitan Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk in einem relativ kleinen räumlichen Gebiet, z. B. einer Stadt.

Mega: ²²⁰ im informationstechnischen Sinn; z. B. Megabit (Mbit): zirka eine Million Bit, Megabyte (Mbyte): ca. eine Million Byte.

Mikrokontroller: Mikroprozessor, der auf einem einzelnen IC, mit Speicher und Schnittstellen kombiniert, integriert ist und als eingebettetes System funktioniert. In einem Mikrokontroller lassen sich komplexe logische Schaltungen realisieren und per Software kontrollieren.

Mikrometer (engl. micron): Metrisches Längenmaß. Entspricht dem millionsten Teil eines Meters (10^{-6} m), das Symbol ist μm . Der Durchmesser eines Menschenhaars ist z. B. 0,1 Millimeter oder 100 Mikrometer.

Mobile-RAM: DRAM mit geringem Leistungsverbrauch für mobile Applikationen, wie PDAs und Smart Phones.

MRAM: Magneto-resistives Random Access Memory ist eine nicht-flüchtige Speichertechnologie, die seit den 90er-Jahren entwickelt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Speichertechnologien wie DRAM und SRAM werden die Informationen nicht mit elektrischen, sondern mit magnetischen Ladungselementen gespeichert – d. h., es wird die Eigenschaft bestimmter Materialien ausgenutzt, die ihren elektrischen Widerstand unter dem Einfluss magnetischer Felder ändern. Prinzipiell können verschiedene Wirkmechanismen angewandt werden: Anisotropic Magneto Resistance, Giant Magneto Resistance und Tunneling Magneto Resistance. Letztere ist derzeit die favorisierte Technologie für die Entwicklung Magneto-resistiver RAMs.

Nicht-flüchtiger Speicher: Speicher, der die gespeicherten Informationen behält, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

PDA: Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch; wird im Allgemeinen mit dem PC synchronisiert.

Radio Frequency Identification: Unter Radio Frequency Identification (RFID) versteht man den drahtlosen Datenaustausch mit einer Sende- und Empfangseinheit. Das Auslesen und Beschreiben erfolgt in Bruchteilen von Sekunden. Solche Identifikationssysteme werden z. B. in Form von Etiketten an Waren und Gütern angebracht.

RAM: Random Access Memory (Halbleiterspeicher mit wahlfreier Adressierung). Die Namensgebung leitet sich von der sequenziellen Adressierung eines Bandspeichers ab. Auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichneter Datenspeicher, enthält Programme und Daten. Beispiele sind SRAM und SDRAM (vgl. DRAM).

ROM: Read Only Memory (Nur-Lese-Speicher). Digitaler, nicht-flüchtiger Datenspeicher, in dem Daten auch ohne Spannungsversorgung dauerhaft gespeichert sind. Die jüngste Entwicklung stellen die Flash-Speicher (NAND und NOR) dar.

Silizium: Werkstoff mit halbleitenden Eigenschaften. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in großem Umfang als Grundstoff verwendet.

Smartcard: Eine Smartcard ist eine Plastikkarte mit eingebautem Mikrokontroller. Im Gegensatz zu einer speicherbasierten Karte ermöglicht der Mikroprozessor die Verarbeitung großer Datenmengen mit einem hohen Grad an Sicherheit. Die Smartcard hat gewöhnlich die Maße einer Kreditkarte.

Teilnehmeranschlussleitung: Die Teilnehmeranschlussleitung, auch Amtsleitung oder letzte Meile genannt, stellt innerhalb eines Telefonnetzes die Verbindung zwischen der Ortsvermittlungsstelle des Diensteanbieters (Provider) und dem Telefonanschluss des Dienstnutzers/Nutzers (User, Subscriber) innerhalb des Hauses dar.

Telematik: Aus Telekommunikation und Informatik zusammengesetztes Kunstwort.

Tire Pressure Monitoring System (TPMS): Reifendrucksensoren überwachen den Luftdruck im Autoreifen und weisen den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

UMTS: Das Universal Mobile Telecommunications System soll ein künftiger digitaler Weltstandard für Mobilfunk werden. UMTS ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu zwei Megabit pro Sekunde.

Voice-over-IP: Die IP-Telefonie, auch als Voice over IP (kurz VoIP) bekannt, ist das Telefonieren über ein Computernetzwerk auf der Grundlage des Internet-Protokolls. Wird die IP-Telefonie genutzt, um Gespräche über das Internet zu führen, spricht man von Internet-Telefonie. Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Telefonie besteht darin, dass die Sprachinformation nicht über eine geschaltete Verbindung in einem Telefonnetz übertragen wird, sondern aufgeteilt in IP-Pakete, die auf nicht festgelegten Wegen in einem Netzwerk zum Ziel gelangen. Die IP-Telefonie kann sich die Infrastruktur, also das Netzwerk, mit anderen Kommunikationsdiensten teilen.

Wafer: Scheibe aus einem Halbleiterwerkstoff, z. B. Silizium, mit einem Durchmesser von bis zu 300 Millimetern.

WAN: Wide Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk, das eine große geographische Fläche, wie zum Beispiel ein Land, abdeckt.

WDCT: Worldwide Digital Cordless Technology. Einheitlicher Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme in Nordamerika; wurde vom DECT-Standard abgeleitet.

xDSL: xDigital Subscriber Line. Oberbegriff für verschiedene technische Konzepte zur breitbandigen digitalen Datenübertragung über herkömmliche verdrehte Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das x für Asymmetric (A), High Rate (H), Single Line (S), Symmetric High Bit-Rate (SH) oder Very High Bit-Rate (V).

Stichwortverzeichnis

Abschlussprüfer (Bericht der unabhängigen)	85, 96ff.
Akquisitionen	9, 58, 61, 67ff., 112, 115, 118
Aktioptionspläne	53, 94, 112f., 131, 134
Anhang zum Konzernabschluss	92ff.
Assoziierte Unternehmen	74, 116, 141
Aufsichtsrat (Bericht)	48ff.
Aufsichtsrat (Besetzung)	134ff.
Ausblick	84
Automobil- und Industrieelektronik	Umschlag, 4f., 9f., 20f., 31, 35, 46, 56, 61f., 64f., 84, 127f., 144
Bericht der Abschlussprüfer	85
Bericht des Aufsichtsrats	48ff.
Bericht des Vorstands (Lagebericht)	54ff.
Bestätigungsvermerk	85
Bilanz	83
Bilanzierung	54, 85, 92, 96, 127, 130
Brief an die Aktionäre	4ff.
Campeon	40, 79, 121, 126
Cash-Flow (Kapitalflussrechnung)	Umschlag, 74ff., 121
Chancen (und Risiken)	80f.
Chronik 2004	8f.
Corporate Governance	52f., 113, 133
Desinvestitionen	58, 75, 118
Dividende	Umschlag, 12, 83, 112, 145
Drahtgebundene Kommunikation	Umschlag, 9, 46, 55f., 59ff., 84, 97, 105, 109, 127ff., 144
Eigenkapitalveränderungs-Rechnung	88f.
Einkauf (Rationalisierung)	82
Ereignisse nach dem 30.09.2004/Bilanzstichtag	129
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60
Ergebnis je Aktie	72, 103, 114
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)	Umschlag, 46, 70f., 84, 128f.
Fertigungskapazitäten	23, 34, 55, 57, 60, 66, 75, 79
Finanzanlagen	54, 69, 71, 73, 77, 83, 95, 106, 145
Finanzdaten (ausgewählte Konzern-)	Umschlag, 144f.
Finanzlage	74, 83, 95, 120
Finanzverbindlichkeiten	74, 85, 110
Forschung und Entwicklung (Aufwendungen)	Umschlag, 24, 55, 57, 67, 79, 86, 145
Fremdwährungsmanagement	61, 81f.
Geschäftsanteilsveräußerungen	98
Geschäftsbereiche	Umschlag, 16ff., 46, 62ff., 70f.
Geschäftstätigkeit, Gründung	54, 92
Gewinn-und-Verlust-Rechnung	60, 83, 86
Grundkapital	12f., 112, 117
Impressum	152
Infineon-Aktie	11ff.
Infineon Technologies AG	83
Innovationen	5, 17f., 21f., 24ff., 30f., 35
Investitionen	19, 35, 50, 56ff., 67, 73ff., 77f., 118f., 145f.
Jahresabschluss	83, 92ff.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Umschlag, 72, 74, 83, 86, 103, 114, 144

Kapitalbedarf	76f.
Kapitalerhöhung	12, 94, 112, 131f., 144
Kapitalflussrechnung (Cash-Flow)	Umschlag, 74f., 121
Konsolidierungsgrundsätze	92
Konzern-Finanzdaten (ausgewählte)	144f.
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, -Bilanzen, -Kapitalflussrechnungen	144ff.
Konzernlagebericht	54ff.
Konzernrechnungslegung	85, 92, 147
Kooperationen	9, 26, 35, 55, 60, 63
KPMG (Wirtschaftsprüfer)	85, 133
Kunden	2, 5f., 24f., 27ff., 31, 34f., 39f., 43, 64
Lagebericht	54ff.
Mehrjahresübersicht	144
Mitarbeiter	5f., 24f., 27, 29, 38ff., 43, 79, 100
Pensionsverpflichtungen	118, 134
Risiken	80ff., 122
Sachanlagen	34f., 73ff., 78, 83, 90ff., 106,
Segmentdaten, -berichterstattung	62ff., 84, 127ff.
Sichere Mobile Lösungen	Umschlag, 18f., 25, 56, 62, 64, 66ff., 70f., 127f., 145
Speicherprodukte	Umschlag, 9, 22f., 34, 56ff., 83, 127f., 144
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60, 70, 72, 101, 144
Tochtergesellschaften	83, 94, 141
Umsatzerlöse	Umschlag, 60ff., 67f., 80ff., 93, 144
Umsatzkosten	65f., 83, 86, 99, 121, 144
Umstrukturierung (inkl. Restrukturierung)	100
Umweltschutz	42f.
Vermögenslage	73ff.
Vertriebskosten & allgemeine Verwaltungskosten	60, 68, 86, 144
Vorstand	4ff., 134
Weltwirtschaft	54, 59
Zinsergebnis	60, 71, 144

Finanzkalender

Wichtige Finanztermine 2005

- ::: **Montag, 24. Januar:**
Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2005
 - ::: **Dienstag, 25. Januar, 10.00 Uhr:**
Hauptversammlung 2005 in München, Olympiahalle
 - ::: **Dienstag, 26. April:**
Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2005
 - ::: **Dienstag, 26. Juli:**
Veröffentlichung des Berichts über das 3. Quartal 2005
 - ::: **Donnerstag, 10. November*:**
Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das 4. Quartal
und das Geschäftsjahr 2005
- *Vorläufig.

Impressum Geschäftsbericht 2004

- Herausgeber:** Infineon Technologies AG, München
Redaktion: Investor Relations, Corporate Communications, Accounting & Financial Reporting
Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September
Abschlussprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main
Gestaltung: häfelinger+ wagner design, München
Fotonachweis: Robert Brembeck
Druck: Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Gedruckt in Deutschland.

Die folgenden Bezeichnungen sind **eingetragene Namen, Markennamen und/oder Markenzeichen** der Infineon Technologies AG: Infineon und das Infineon Technologies-Logo, BlueMoon, CellularRAM, ConVerGate-C, Constellation, CoolMOS, CoolSET F3, Core to Door, E-GOLDlite, GOLDMOS, LightMOS, MetroMapper, Mobile-RAM, MultiMediaCard, OptiMOS, PROFET, Secure Digital Card, S-GOLD, SMARTi SD, SPT6, StarCore, TC 1130, TriCore-AUDO-NG, TriCore-2, VINETIC und XPAK.

Das **Bluetooth**-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet.

Alle anderen in diesem Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Wenn Sie **zusätzliche Exemplare dieses Geschäftsberichts** in deutscher oder englischer Sprache bestellen oder wenn Sie diese Berichte und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns im Internet unter www.infineon.com/boerse. Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

Für interne Bestellungen

- SPLS Fürth-Bislohe**
Per Intranet: <http://www.click4business-supplies.com>
Per Fax: +49 (0)911 6544271
Bestellnummer: (deutsch) B192-H8086-G2
(englisch) B192-H8086-G2-X-7600

Hauptsitz: St.-Martin-Straße 53, D-81669 München, Tel. +49 (0)89 234-0
Kontakt für Anleger und Analysten: Investor.Relations@infineon.com, Tel. +49 (0)89 234-26655, Fax +49 (0)89 234-26155
Kontakt für Journalisten: Media.Relations@infineon.com, Tel. +49 (0)89 234-28480, Fax +49 (0)89 234-28482
Besuchen Sie uns im Internet: www.infineon.com



Never stop thinking.